



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 3.6.2026
COM(2026) 504 final

2026/0139 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende een kader voor maatregelen ter versterking van het halfgeleiderecosysteem van de Unie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/1781 (chipsverordening 2.0)

{SEC(2026) 504 final} - {SWD(2026) 504 final} - {SWD(2026) 505 final}

(Voor de EER relevante tekst)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• Motivering en doel van het voorstel

Halfgeleiders ondersteunen alle digitale technologieën, van slimme wearables en auto's tot medische, defensie- en missiekritieke apparatuur, en de datacentra die de revolutie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) aandrijven. Sinds 2020 hebben een aantal leveringstekorten en pogingen om de EU economisch onder druk te zetten, de kwetsbaarheid van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders en de kwetsbaarheid van de sector van eindgebruikers aan het licht gebracht. Deze verstoringen waren het gevolg van mondiale crises zoals de COVID-19-pandemie, individuele schokken zoals de zaak Nexperia en de aanhoudende structurele discrepantie tussen vraag en aanbod op de wereldmarkt. Samen hebben deze factoren onder de aandacht gebracht dat buitensporige externe afhankelijkheden tot kwetsbaarheid van volledige markten kan leiden.

Tegelijkertijd hebben de toenemende geopolitieke rivaliteit, waaronder de spanningen tussen China en de VS, en de snelle opkomst van AI het strategische belang van halfgeleiders verder onderstreept. Geavanceerde maar ook reguliere chips zijn steeds vaker een belangrijke geopolitieke troef geworden, en in de mondiale waardeketen voor halfgeleiders zijn verschillende knelpunten ontstaan. Dit heeft de wedloop om delen van deze knelpunten te controleren, versneld.

De toenemende omvang van deze sector weerspiegelt het geopolitieke belang ervan. Halfgeleiders zijn de op twee na meest verhandelde producten ter wereld — na olie en voertuigen — met wereldwijde inkomsten van 700,9 miljard USD in 2025¹. Naar verwachting zal de markt **tegen 2026** goed zijn voor meer dan **1 biljoen USD² en tegen 2030 groeien tot 1,6 biljoen USD³**. Als kritieke leverancier en katalysator voor bijna alle moderne industrieën en voor de infrastructuur die deze industrieën ondersteunt, is de halfgeleidersector uitgegroeid tot een **strategische hulpbron**. In een meer transactionele en assertieve mondiale omgeving zorgt deze positie er ook voor dat de sector een potentiële bron van **geopolitieke invloed** is. Regio's die niet over aanzienlijke capaciteiten beschikken om halfgeleiders te ontwerpen of te fabriceren, lopen derhalve het risico afhankelijk te worden van onderdelen die door anderen kunnen worden beperkt of aan voorwaarden worden onderworpen.

De in februari 2022 voorgestelde Europese chipsverordening vormde **het eerste strategische antwoord van de EU op kritieke kwetsbaarheden** in de mondiale waardeketen voor halfgeleiders, die werden blootgelegd door de COVID-19-pandemie en de toenemende wereldwijde, door subsidies aangejaagde concurrentie van derde landen. De EU besloot dat **doortastende, gecoördineerde tussenkomst essentieel was** om structurele afhankelijkheden in haar ecosysteem voor halfgeleiders aan te pakken en de industrie te ondersteunen. Zonder aanzienlijke investeringen in onderzoeks- en fabricagecapaciteit en zonder passende crisisresponsmechanismen zou Europa structureel kwetsbaar blijven. De chipsverordening kwam tot stand in een periode waarin **veel aandacht aan de groene en de digitale transitie werd besteed** en steeds meer Europese consensus bestond over de noodzaak om **het economische concurrentievermogen van de regio te versterken en het afnemen van de**

¹ WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025, <https://www.wsts.org/76/103/WSTS-Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025>.

² Global Semiconductor Sales Increase Substantially in February, <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-substantially-in-february/>.

³ The next era of semiconductor value creation, McKinsey, <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-next-era-of-semiconductor-value-creation>.

industriële capaciteit om te buigen. In het rapport-Draghi van september 2024 zouden deze bezorgdheden later worden uiteengezet en zou worden gepleit voor dringende industriële vernieuwing⁴.

Uit de evaluatie van de Europese chipsverordening blijkt dat deze **belangrijke resultaten heeft opgeleverd**. Bijvoorbeeld:

- er zijn infrastructuren opgezet, waaronder kenniscentra, een platform voor beginnende ontwerpen en vijf geavanceerde proeflijnen die een aantal van de meest innovatieve technologie-infrastructuren ter wereld vertegenwoordigen;
- er is meer dan 52 miljard EUR vastgelegd voor publieke en particuliere investeringen in faciliteiten voor lopende productie in het kader van pijler II, en
- er is een coördinatie- en crisisresponsmechanisme opgezet in het kader van pijler III via de Europese Raad voor halfgeleiders (ESB), waarbij alle lidstaten en de Commissie betrokken zijn.

Hoewel aanzienlijke vooruitgang is geboekt en de Unie sterke punten vertoont in belangrijke segmenten van de waardeketen voor halfgeleiders, zoals de mainstreamproductie van halfgeleiders (vermogenselektronica, microcontrollers, fotonica, sensoren), productieapparatuur en -materialen, **blijven er duidelijke capaciteitstekorten bestaan** die nog moeten worden aangepakt.

De EU produceert minder dan 10 %⁵ van de halfgeleiders ter wereld en is bijna volledig afhankelijk van de Verenigde Staten en Azië voor de meest geavanceerde en allernieuwste chips van minder dan 5 nanometer — waaronder AI-chips. Deze structurele afhankelijkheden vergroten het risico op verstoringen van de toelevering, uitoefening van druk en systeemshokken die gevolgen hebben voor belangrijke industrieën in de EU, van de automobiel- en energiesector tot lucht- en ruimtevaart en defensie. In het algemeen tonen halfgeleiders aan dat de **uitdaging op het gebied van technologische soevereiniteit** waar Europa voor staat, een urgent karakter heeft.

Technologische soevereiniteit is een strategische noodzaak geworden voor de EU. Het doel is ervoor te zorgen dat Europa in staat blijft zijn eigen koers te kiezen, buitensporige afhankelijkheden te verminderen en ervoor te zorgen dat kritieke digitale infrastructuren en technologieën veilig en veerkrachtig blijven en op de Europese waarden afgestemd blijven.

De chipsverordening 2.0 zal dan ook deel uitmaken van het **pakket voor technologische soevereiniteit**, samen met andere initiatieven zoals de verordening cloud- en AI-ontwikkeling (CADA).

De Europese benadering van technologische soevereiniteit is gebaseerd op openheid, partnerschap en eerlijke concurrentie. Door de technologische basis van de EU te versterken, kan de EU open blijven en blijven samenwerken, en tegelijkertijd haar capaciteit in stand houden om onafhankelijk op te treden en haar belangen, veiligheid en democratische beginselen te beschermen.

In dit verband zijn de **twee belangrijkste problemen** die de herziening van de chipsverordening beoogt aan te pakken:

⁴ “The future of European competitiveness”, deel B, hoofdstuk 3 — Mario Draghi, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

⁵ IDC, “Semiconductors market data by feature size, sector and region”, CNECT/2022/MVP/0084 — tweede tussentijds verslag. De waardeketen omvat IE, EDA, kapitaalgoederen, substraten, materialen, fabriekloze bedrijven, fabrikanten van componenten voor geïntegreerde schakelingen (IDM's), gieterijen en OSAT-aanbieders. Alleen ontvangsten van ondernemingen met een hoofdzetel in de EU worden in aanmerking genomen.

- a) te grote afhankelijkheid van derde landen voor het ontwerp en de fabricage van halfgeleiders;
- b) onvoldoende capaciteit op het gebied van crisisparaatheid.

Voortbouwend op de doelstellingen van de eerste chipsverordening en gebaseerd op een analyse van deze uitdagingen en de onderliggende oorzaken daarvan, zijn **twee overkoepelende doelstellingen voor de chipsverordening 2.0** vastgesteld:

- 1) Het concurrentievermogen van de Europese waardeketen voor halfgeleiders vergroten om de technologische soevereiniteit en veerkracht ervan te verbeteren. Dit betekent dat de voorwaarden moeten worden gecreëerd die noodzakelijk zijn voor het concurrentievermogen, de technologische soevereiniteit en de veerkracht van de EU op het gebied van halfgeleidertechnologieën door: i) de industriële uitrol van onderzoek en innovatie te versnellen; ii) de leveringszekerheid te waarborgen; en iii) strategische afhankelijkheden op het gebied van ultramoderne en volwassen halfgeleidertechnologieën te verminderen.
- 2) De crisisparaatheid verbeteren om de leveringszekerheid van de EU te waarborgen. Dit betekent dat de werking van de interne markt moet worden verbeterd door de crisisparaatheid te vergroten en een uniform rechtskader tot stand te brengen om de economische veiligheid van de Unie te beschermen en haar onontbeerlijke karakter, veerkracht en welvaart op het gebied van halfgeleidertechnologieën te vergroten.

Het concurrentievermogen van de Europese waardeketen voor halfgeleiders vergroten om de technologische soevereiniteit en veerkracht ervan te verbeteren

Naarmate de EU steeds afhankelijker wordt van leveringen van halfgeleiders van buiten de EU, wordt zij kwetsbaarder voor externe dwang, waaronder de mogelijke instrumentalisering van afhankelijkheden in de toeleveringsketen. Zonder een robuuste industriële basis op het gebied van ontwerp en fabricage van halfgeleiders bestaat het gevaar dat de EU haar sterk onderzoeks- en innovatie-ecosysteem niet kan omzetten in productiviteitswinsten en de grootschalige industrialisering van nieuwe technologieën.

Tegelijkertijd worden de Europese verwerkende industrieën geconfronteerd met aanzienlijke onzekerheden in de toeleveringsketen, wat leidt tot hogere voorraadniveaus en minder investeringen. Dit ondermijnt dan weer het algemene concurrentievermogen van de fabricagesector in de EU. Bovendien vergroten afhankelijkheden in de toeleveringsketens voor halfgeleiders de geopolitieke en veiligheidsrisico's, met name in tijden van crisis, wanneer de toegang tot kritieke technologieën kan worden beperkt of deze technologieën mogelijk naar andere regio's worden verlegd.

Tegen deze achtergrond was **de oorspronkelijke chipsverordening voornamelijk op het aanbod gericht, terwijl in de chipsverordening 2.0 meer nadruk wordt gelegd op maatregelen aan de vraagzijde**. De twee dimensies versterken elkaar: het stimuleren van een robuuste lokale vraag helpt om het lokale aanbod van halfgeleiders te versterken. Op die manier draagt de uitbreiding van zowel vraag als aanbod bij tot een grotere industriële veerkracht, kortere en veiligere toeleveringsketens, meer strategische autonomie en een betere afstemming van de Europese productiecapaciteit op de behoeften van belangrijke industrieën.

Deze benadering hangt nauw samen met bredere EU-initiatieven, met name de verordening cloud- en AI-ontwikkeling, waarin maatregelen zijn opgenomen om **de vraag naar ultramoderne AI-chips te stimuleren** door in de hele Unie nieuwe datacentra te ontwikkelen. Deze maatregelen zullen naar verwachting een grotere vraag naar halfgeleiders met zich meebrengen, wat de doelstellingen van de herziene chipsverordening kan

ondersteunen. In de **mededeling getiteld “Actieplan voor het AI-continent”**⁶ wordt uiteengezet hoe de Unie, in het kader van de bredere inspanningen om **AI-gigafabrieken** te ontwikkelen, ernaar streeft strategische autonomie te bereiken bij het ontwerp en de productie van AI-halfgeleiders, de afhankelijkheid van kritieke technologieën te verminderen en de soevereiniteit op het gebied van geavanceerde halfgeleiders te versterken.

Het versterken van de Europese waardeketen voor halfgeleiders — onder meer op voor AI kritieke gebieden — is essentieel om de strategische doelstellingen van de Unie te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft het absoluut noodzakelijk om de productiecapaciteit voor **mainstreamhalfgeleiders** in Europa te stimuleren. Volwassen en gespecialiseerde nodes zijn van vitaal belang voor Europese industriële ecosystemen zoals **de automobielsector, de luchtvaart, defensie, telecommunicatie en de cloud**, waar de vraag naar betrouwbare, toepassingsspecifieke chips blijft toenemen. Het versterken van de veerkracht in deze segmenten is dus essentieel om de industriële basis van Europa te beschermen en buitensporige afhankelijkheden te verminderen. Het is net zo belangrijk om de **capaciteiten van Europa op het gebied van chipontwerp** te verbeteren en nauwere samenwerking tussen ontwerpers, fabrikanten en eindgebruikerssectoren te bevorderen, onder meer door middel van benaderingen voor **gezamenlijk ontwerp** die ervoor zorgen dat halfgeleideroplossingen worden geoptimaliseerd voor industriële en strategische toepassingen.

Voortbouwend op de noodzaak om zowel het aanbod als de vraag in het Europese ecosysteem voor halfgeleiders te versterken, biedt de chipsverordening 2.0 tevens een kader voor de uitrol van **strategische projecten** om belangrijke segmenten van de waardeketen voor halfgeleiders van de Unie te versterken. Aan deze projecten wordt prioriteit toegekend en ze worden ondersteund door middel van een **gecoördineerde mix van publieke en particuliere investeringen**, die betrekking hebben op soevereine en geavanceerde fabricage, geavanceerd chipontwerp en veerkracht van de toeleveringsketen. Deze benadering vormt een aanvulling op de hierboven beschreven maatregelen, versterkt de landsgrensoverschrijdende integratie in de hele waardeketen en draagt bij aan de versterking van de strategische autonomie en de technologische soevereiniteit van Europa.

In dit verband en in het kader van het instrument voor de coördinatie van het concurrentievermogen (CCT) wordt aan een **strategisch project inzake geavanceerde fabricage** de hoogste prioriteit toegekend om de productie van AI-chips en andere halfgeleiders te ondersteunen. Het initiatief heeft tot doel de eerste halfgeleiderfaciliteit in de Unie op te zetten, waarbij de fabricage van ultramoderne nodes wordt gecombineerd met de integratie van chiplets en capaciteit op het gebied van geavanceerde 3D-behuizing. De proefproductie kan worden gepland voor de periode 2030-2033.

Om de veerkracht van het ecosysteem verder te vergroten, wordt het toepassingsgebied van de bepalingen inzake **pioniersinitiatieven** verduidelijkt. Deze bepalingen hebben betrekking op de gehele waardeketen voor halfgeleiders, waaronder **op fabricage gerichte chipontwerpprojecten, speciale materialen, fabricageapparatuur, printplaten, geavanceerde behuizing en assemblage**. Pioniersbeoordelingen zijn ook van toepassing op nationale medefinanciering voor strategische projecten indien de strategische projecten ook als pioniersprojecten worden aangemerkt, overeenkomstig de mededingingsregels.

In de chipsverordening 2.0 wordt de nadruk gelegd op **snellere industrialisering van proeflijnen**, waarbij succesvolle proeffaciliteiten voor fabricage worden omgevormd tot commercieel levensvatbare fabricagecapaciteit. Hierbij worden **fotonica en in fotonica geïntegreerde circuits** toegevoegd aan het versterkte “Chips voor Europa”-initiatief 2.0,

⁶ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan voor het AI-continent (COM(2025) 165 final van 9.4.2025).

aangezien dit belangrijke ontsluitende technologieën zijn voor een brede waaier aan strategische sectoren, waaronder telecommunicatie, datacentra, AI, gezondheidszorg, de automobielsector en kwantumtechnologie. Zoals het **initiatief “Chips voor Europa” heeft aangetoond**, speelt het een cruciale rol bij het versterken van het leiderschap van de Unie op het gebied van onderzoek, innovatie en industriële toepassing van halfgeleiders. Het is daarom essentieel dit initiatief voort te zetten. Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 ondersteunt beproefde instrumenten — zoals proeflijnen, het netwerk van kenniscentra, het ontwerpplatform en activiteiten op het gebied van kwantumchips — en heeft tot doel ervoor te zorgen dat Europa zijn concurrentievoordeel behoudt, de productie op commerciële schaal versnelt en de bijdrage van halfgeleidertechnologieën aan duurzaamheid en technologische soevereiniteit maximaliseert.

Aan de vraagzijde worden ook aanvullende maatregelen ingevoerd om Europese technologieën sneller ingang te doen vinden op de markt. **Innovatiegerichte overheidsopdrachten en grote uitdagingen** zullen helpen om de vraag in een vroeg stadium aan te zwengelen, referentie-uitrol mogelijk te maken en snellere markttoegang voor in de Unie ontwikkelde geavanceerde chips te bevorderen. Daarnaast kan in overheidsopdrachten voor infrastructuur, apparatuur of systemen waarin halfgeleiders worden toegepast, naast prijsoverwegingen een criterium met betrekking tot leveringszekerheid worden opgenomen wanneer dergelijke technologieën worden ingezet voor essentiële diensten of kritieke infrastructuur. Doordat deze maatregelen de vraag van het publiek op gecoördineerde wijze als hefboom gebruiken, vormen ze een aanvulling op instrumenten aan de aanbodzijde, bevorderen ze de toepassing van veilige technologieën in de hele Unie en versterken ze de veiligheid en de veerkracht van strategische downstreamsectoren. Overeenkomstig de klimaat-, milieu- en energiedoelstellingen van de Unie moet prioriteit worden gegeven aan de energie-efficiënte en duurzame productie en werking van chips. Vergunningsprocedures moeten ook worden gestroomlijnd om de industriële uitrol te versnellen en het internationale concurrentievermogen in stand te houden, met name op basis van het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het versnellen van milieubeoordelingen. Parallel met de uitvoering van de chipsverordening en vooruitlopend op de herziening van de cyberbeveiligingsverordening worden in een **cyberbeveiligingsrisicobeoordeling** zowel de technische kwetsbaarheden geëvalueerd als de niet-technische factoren die van invloed zijn op de cyberbeveiliging van halfgeleiders die bij overheidsopdrachten voor specifieke kritieke sectoren worden gebruikt.

Om regionaal leiderschap in de waardeketen voor halfgeleiders te stimuleren, wordt in dit voorstel een keurmerk **“Europese uitmuntende halfgeleiderregio”** ontwikkeld voor regio's met een robuust plan voor regionale investeringen in halfgeleiders dat is afgestemd op de strategische prioriteiten. Het gaat onder meer om het opvoeren van de fabricage van halfgeleiders, samenwerking op het gebied van O&O, de ontwikkeling van vaardigheden, en duurzame infrastructuur. Dit zou internationale investeerders duidelijk maken dat de regio beschikt over een ecosysteem met een groot potentieel voor bedrijfsactiviteiten in verband met halfgeleiders.

De crisisparaatheid verbeteren om de leveringszekerheid van de EU te waarborgen

Ondanks de instrumenten voor monitoring en crisisrespons die in het kader van pijler III van de eerste chipsverordening zijn ontwikkeld, blijven er aanzienlijke lacunes bestaan in het vermogen van de Unie om crises in de toelevering van halfgeleiders doeltreffend aan te pakken. De EU beschikt nog steeds niet over voldoende ontwikkelde mechanismen, instrumenten en institutionele capaciteit om tijdig en gecoördineerd op verstoringen in te spelen en deze te beoordelen.

Om de **paraatheid in de toeleveringsketen voor halfgeleiders te verbeteren**, zal de Commissie steun verlenen voor de oprichting van een **business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders (“het platform”)**, waar ondernemingen niet-commercieel gevoelige informatie in geaggregeerde vorm kunnen delen. Dit zal helpen om een digitaal model voor toeleveringsketens te ontwikkelen, waardoor structurele onderlinge afhankelijkheden beter zichtbaar worden, risico’s systematisch kunnen worden vastgesteld en de veerkracht ten aanzien van verstoringen wordt versterkt. Bij waarschuwingen kan de Commissie informatie opvragen bij individuele ondernemingen en bij het platform. Deze verzoeken om informatie moeten strikt beperkt blijven tot wat noodzakelijk is en moeten evenredig zijn. Ondernemingen die aan het platform deelnemen, worden vrijgesteld van de verplichting om op verzoeken om informatie te antwoorden. Parallel aan de chipsverordening 2.0 zal de Commissie tegen het tweede kwartaal van 2027 een **EU-blauwdruk voor halfgeleidercrisisbeheer** ontwikkelen. De blauwdruk bevat duidelijke procedures, rollen en verantwoordelijkheden in de fasen voorafgaand aan de crisis en tijdens de crisis en bouwt voort op de eerste simulatieoefening over verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders die in 2025 met de lidstaten is uitgevoerd. Deze inspanningen zijn in overeenstemming met de strategie voor een paraatheidsunie en het bijbehorende actieplan.

- **Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein**

Halfgeleiders zijn kritieke katalysatoren voor de schone en de digitale transitie. Het strategische belang ervan voor de EU wordt verder versterkt door geopolitieke spanningen, de huidige te grote afhankelijkheid van de Unie op het gebied van geavanceerde productie en geavanceerd ontwerp, en de toenemende instrumentalisering van deze afhankelijkheden door derde landen. In dit verband is de chipsverordening 2.0 onontbeerlijk voor de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de Commissie, met name “Een nieuw plan voor duurzame welvaart en concurrentievermogen in Europa” en “Een nieuw tijdperk voor Europese defensie en veiligheid”⁷.

Het voorstel voor de chipsverordening 2.0 kan worden beschouwd als een antwoord op de noodzaak om dringend actie te ondernemen op het gebied van halfgeleiders om de toekomst van de EU als economische grootmacht, aantrekkelijke plek om te investeren en centrum van productieactiviteiten veilig te stellen, zoals wordt erkend in de **Clean Industrial Deal**,⁸ het **EU-kompas voor concurrentievermogen**⁹ en de gezamenlijke mededeling over de **versterking van de economische veiligheid van de EU**¹⁰.

Het voorstel is in overeenstemming met de algemene digitale visie, de doelstellingen en de wegen naar een succesvolle digitale transformatie van de EU tegen 2030, zoals de Commissie die heeft voorgesteld in haar mededeling **“Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”** (mededeling digitaal kompas)¹¹ en in haar daaropvolgende besluit

⁷ [Prioriteiten 2024-2029 — Europese Commissie](#).

⁸ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Clean Industrial Deal: Een gezamenlijke routekaart voor concurrentievermogen en decarbonisatie”, COM(2025) 85 final van 26.2.2025.

⁹ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Het EU-kompas voor concurrentievermogen”, COM(2025) 30 final van 29.1.2025.

¹⁰ Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad, “Versterking van de economische veiligheid van de EU”, JOIN(2025) 977 van 3.12.2025.

¹¹ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Digitaal Kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”, COM(2021) 118 final van 9.3.2021.

over het **beleidsprogramma voor het digitale decennium**¹², met bijzondere aandacht voor halfgeleiders. Dit voorstel is bedoeld om de Unie het nodige vermogen te bezorgen om haar doelstelling voor 2030 te halen. De evaluatie van het beleidsprogramma voor het digitale decennium is gepland voor juni 2026¹³.

Dit voorstel draagt bij tot de uitvoering van de **verklaring van de Semicon Coalition**, die op 29 september 2025 door de respectieve ministers van de 27 lidstaten is ondertekend en waarin wordt opgeroepen tot een versterkte en toekomstgerichte chipsverordening 2.0 om de positie van Europa in de mondiale waardeketen voor halfgeleiders te versterken¹⁴.

In het voorstel worden ook een aantal van de doelstellingen van de **verordening industriële versnelling**¹⁵ gedeeld, waarin een kader van maatregelen wordt vastgesteld om het concurrentievermogen van de EU te versterken, de decarbonisatie van de industrie te versnellen en de strategische productiecapaciteit te stimuleren.

Het voorstel komt in grote lijnen overeen met EU-initiatieven die daarmee verband houdende doelstellingen nastreven, met name het **programma Digitaal Europa, Horizon Europa en de verordening kritieke grondstoffen**¹⁶, alsook het **Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), InvestEU en Erasmus+**.

Van de bovengenoemde initiatieven is het voorstel met name in overeenstemming met het programma Digitaal Europa en Horizon Europa, die samen de ruggengraat vormen voor de financiering van pijler I in het huidige meerjarig financieel kader. Het programma Digitaal Europa verleent steun voor digitale infrastructuren, terwijl Horizon Europa stroomopwaarts onderzoek, proefprojecten en demonstraties ondersteunt.

Bovendien vormt het voorstel ook een aanvulling op de verordening kritieke grondstoffen, aangezien beide gericht zijn op strategische autonomie door in te gaan op verschillende segmenten van de waardeketen: in de chipsverordening wordt aandacht besteed aan het ontwerp en de fabricage van halfgeleiders, terwijl de verordening kritieke grondstoffen gericht is op kritieke grondstoffen.

De chipverordening is in overeenstemming met de agenda's van de EU op het gebied van strategische autonomie, economische veiligheid en concurrentievermogen. Ze is afgestemd op de **strategie voor economische veiligheid van de EU**¹⁷, de **controles op de uitvoer van producten voor tweërlei gebruik**¹⁸, de **verordening buitenlandse subsidies**¹⁹ en het **platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)**²⁰. Samen verminderen deze

¹² Besluit (EU) 2022/2481 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot vaststelling van het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030, 19.12.2022.

¹³ Survey opens on the future of the Digital Decade Policy Programme, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/survey-opens-future-digital-decade-policy-programme>.

¹⁴ Semicon Coalition calls for reinforced Chips Act, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/semicon-coalition-calls-reinforced-chips-act>.

¹⁵ Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader van maatregelen voor de versnelling van de industriële capaciteit en de decarbonisatie in strategische sectoren en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1724, (EU) 2024/1735 en (EU) 2024/3110 ("verordening industriële versnelling"), COM(2026) 100 final van 4.3.2026.

¹⁶ Verordening (EU) 2024/1252 van het Europees Parlement en de Raad van 11 april 2024 tot vaststelling van een kader om een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 en (EU) 2019/1020 ("verordening kritieke grondstoffen").

¹⁷ Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad betreffende een "strategie voor economische veiligheid van de EU", JOIN(2023) 20 final.
[Exporting dual-use items - Trade and Economic Security](#).

¹⁸ Verordening (EU) 2022/2560 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.

²⁰ Strategic Technologies for Europe Platform, https://strategic-technologies.europa.eu/index_en.

instrumenten strategische afhankelijkheden, versterken ze de industriële capaciteit en pakken ze verstoringen aan die worden veroorzaakt door buitenlandse subsidies op de eengemaakte markt.

Het voorstel is in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake cyberbeveiliging. Bepaalde categorieën chips vallen binnen het toepassingsgebied van de **verordening cyberweerbaarheid**²¹, en investeringen in het kader van de chipsverordening zijn erop gericht de doelstellingen ervan te bevorderen door voort te bouwen op de sterke punten van de Europese industrie in het marktsegment van veilige chips. Het voorstel vormt ook een aanvulling op de voorgestelde herziening van de **cyberbeveiligingsverordening** door een dimensie over leveringszekerheid toe te voegen voor overheidsopdrachten met betrekking tot halfgeleiders door kritieke entiteiten.

In het **industriële actieplan voor de Europese autosector** werd het belang van de halfgeleiderindustrie voor een innovatieve en gedigitaliseerde autosector benadrukt²².

De chipsverordening 2.0 is ook ontworpen in aanvulling op andere initiatieven, zoals de belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's). In dit verband is de voorbereiding van de komende IPCEI-kandidaat voor geavanceerde halfgeleidertechnologieën²³ volledig in overeenstemming met de geest van de **chipsverordening**, doordat wordt ingegaan op de eerste industriële toepassingen van baanbrekende innovaties.

De chipsverordening 2.0 is zodanig ontworpen dat ze verenigbaar is met het huidige meerjarig financieel kader (MFK) (2021-2027) en het volgende MFK (2028-2034), met inbegrip van het Europees Fonds voor concurrentievermogen (EFC), kaderprogramma 10 (KP10) en de plannen voor nationaal en regionaal partnerschap (NRPP's). Door de architectuur ervan zijn onmiddellijk optreden en effect in het kader van het huidige MFK mogelijk, en worden tegelijkertijd de continuïteit en schaalbaarheid in het kader van het volgende MFK gewaarborgd. Het voorstel loopt niet vooruit op en komt niet in de plaats van het resultaat van het lopende wetgevingsproces inzake het MFK.

Voorts doet de chipsverordening 2.0 geen afbreuk aan de regels inzake staatssteun en mededingingsregels, met inbegrip van het O&O&I-kader en de IPCEI-mededeling, en handhaaft de afzonderlijke doelstellingen ervan. Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang en het O&O&I-kader spelen een centrale rol bij de ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en de eerste industriële toepassing, met name voor zeer innovatieve en landsgrensoverschrijdende projecten met sterke overloopeffecten.

²¹ Verordening (EU) 2024/2847 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2024 betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor producten met digitale elementen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 168/2013 en (EU) 2019/1020 en Richtlijn (EU) 2020/1828 ("verordening cyberweerbaarheid").

²² Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, "Industrieel actieplan voor de Europese autosector", COM(2025) 95 final van 5.3.2025.

²³ De IPCEI-kandidaat AST wordt momenteel ontworpen om voort te bouwen op bestaande EU initiatieven, met name proeflijnen en het Europees ontwerpplatform, en zo te zorgen voor continuïteit en versnelling in plaats van duplicatie. Aangedreven door megatrends zoals AI, automatisering, veiligheid en duurzaamheid kan IPCEI-kandidaat AST uiteindelijk een collectief Europees antwoord bieden op disruptieve technologische veranderingen. AST kan aandacht besteden aan belangrijke technologiegebieden, waaronder bijvoorbeeld AI-chips en versnellers, in fotonica geïntegreerde circuits, heterogene integratie en geavanceerde behuizing, sensoren, vermogenslektronica, energie-efficiënte oplossingen en veilige communicatie, en tegelijkertijd de volledige waardeketen voor halfgeleiders bestrijken, waaronder ontsluitende technologieën zoals EDA, apparatuur, tests, materialen en wafers.

Maatregelen in het kader van de chipsverordening 2.0 bouwen voort op deze architectuur doordat ze het toepassingsgebied van het pionierskader op grond van pijler II verder verduidelijken en verfijnen en ervoor zorgen dat de hele waardeketen wordt bestreken.

- **Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie**

Het voorstel is verenigbaar met de mededingings- en industriestrategie van de EU, zoals blijkt uit de industriële strategieën en het rapport-Draghi, en vormt een aanvulling op de kaders voor de digitale en de schone transitie.

Dit voorstel zal deel uitmaken van het **pakket voor technologische soevereiniteit**, samen met de **verordening cloud- en AI-ontwikkeling (CADA)** en een **strategische routekaart voor digitalisering en AI in de energiesector**. Het pakket heeft tot doel ervoor te zorgen dat de Unie de capaciteit behoudt om autonoom te beslissen, doeltreffend op te treden en mondiale technologische ontwikkelingen vorm te geven, en tegelijkertijd open en concurrerend blijft en zich blijft inzetten voor internationale samenwerking en regels.

Er is coördinatie nodig tussen de chipsverordening en het voorgestelde **Europees Fonds voor concurrentievermogen (EFC)**²⁴ en de komende **kwantumverordening**²⁵. Verenigbaarheid met de kwantumverordening biedt de gelegenheid om een alomvattend Europees kwantumbelidskader tot stand te brengen waarin optimaal wordt gebruikmaakt van synergieën tussen meerdere instrumenten.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

- **Rechtsgrondslag**

Net als bij de eerste chipsverordening zijn de rechtsgrondslagen voor de chipsverordening 2.0 artikel 173, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De Unie moet via haar beleidsmaatregelen en activiteiten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen in artikel 173, lid 1. In artikel 173, lid 1, VWEU is bepaald dat de doelstellingen erin bestaan dat ervoor wordt gezorgd dat de omstandigheden die nodig zijn voor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie, aanwezig zijn. Overeenkomstig een systeem van open en concurrerende markten heeft deze maatregel tot doel: i) de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te versnellen; ii) een gunstig klimaat voor het ontplooiën van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), te bevorderen; iii) een gunstig klimaat voor de samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen; en iv) een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren. Het doel van artikel 114 VWEU is de instelling en de werking van de interne markt door maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de nationale voorschriften vast te stellen.

De chipsverordening 2.0 bouwt voort op de doelstellingen van de huidige chipsverordening. De eerste specifieke doelstelling van de chipsverordening 2.0, die ten grondslag ligt aan pijler I, is het creëren van grote innovatiecapaciteit en een adequaat technologisch vermogen in de halfgeleiderindustrie om innovatie te versnellen en zich aan die innovatie aan te passen.

²⁴ Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor concurrentievermogen, met inbegrip van een specifiek programma voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op defensiegebied, tot intrekking van de Verordeningen (EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU) 2021/697 en (EU) 2021/783, tot intrekking van bepalingen van de Verordeningen (EU) 2021/696 en (EU) 2023/588, en tot wijziging van Verordening (EU) [EDIP], COM(2025) 555 final van 16.7.2025.

²⁵ Commission invites contributions to shape future EU Quantum Act, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act>.

Daarnaast beoogt de verordening de veerkracht en de leveringszekerheid van de Unie op het gebied van halfgeleider technologie te vergroten door investeringen in de fabricage van geavanceerde halfgeleiders te ondersteunen en te coördineren (pijler II) en gecoördineerde monitoring en crisisrespons mogelijk te maken (pijler III).

De passende rechtsgrondslag voor de eerste doelstelling is artikel 173, lid 3, VWEU. In het geval van artikel 173, lid 3, VWEU mogen de genomen maatregelen niet leiden tot de harmonisatie van nationale wet- en regelgeving, maar moeten ze het concurrentievermogen en de veerkracht van de industriële basis van halfgeleiders versterken. De chipsverordening 2.0 heeft tot doel de kracht en veerkracht van de Europese halfgeleider technologie en het Europese industriële landschap te versterken en het innovatiepotentieel van het ecosysteem voor halfgeleiders in de hele EU een impuls te geven. Dit omvat het verminderen van de afhankelijkheid van een aantal ondernemingen en regio's van buiten de EU, en het vergroten van het vermogen van de EU om geavanceerde halfgeleiders te ontwerpen en te fabriceren. Het "Chips voor Europa"-initiatief (pijler I), dat verder zal worden ondersteund via de nieuwe wetgevingsmaatregel, beoogt deze doelstellingen te helpen verwezenlijken door de kloof tussen de uitmuntendheid van de EU op onderzoeksgebied en de doeltreffende, duurzame industriële uitrol ervan te dichten.

- **Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)**

De doelstellingen van het voorstel kunnen niet door de lidstaten alleen worden verwezenlijkt, aangezien de problemen landsgrensoverschrijdend van aard zijn, en blijven niet beperkt tot afzonderlijke lidstaten of tot een aantal lidstaten. De voorgestelde acties zijn gericht op gebieden waar optreden op Unieniveau aantoonbare meerwaarde biedt door de omvang, de snelheid en de reikwijdte van de vereiste inspanningen.

Een alomvattende reactie op de halfgeleidercrisis vereist een snel en gecoördineerd gezamenlijk optreden van diverse belanghebbenden, in samenwerking met de lidstaten. Geen enkele lidstaat kan dit alleen bereiken. Gezien de complexiteit van het ecosysteem voor halfgeleiders zijn de gevolgen van de structurele afhankelijkheden, de vraag en de leveringstekorten in de Unie bovendien zo verreikend dat EU-optreden het meest is aangewezen om die problemen aan te pakken.

Het is duidelijk dat optreden op Unieniveau het meest geschikt is om de Europese actoren te bewegen tot een gemeenschappelijke visie en uitvoeringsstrategie. Dat is cruciaal om schaal- en toepassingsvoordelen te genereren en de kritieke massa tot stand te brengen die nodig is voor baanbrekende capaciteit. Het zal ook versnippering van de inspanningen, een subsidiewedloop en suboptimale nationale oplossingen tegengaan of zelfs vermijden.

Het optreden van de Unie is noodzakelijk op de gebieden waarop dit voorstel via de drie pijlers betrekking heeft.

- Wat de eerste pijler ("Chips voor Europa"-initiatief) betreft, zal het versterkte "Chips voor Europa"-initiatief 2.0 de activiteiten van het "Chips voor Europa"-initiatief, dat in het kader van de eerste chipsverordening is opgezet, blijven ondersteunen. Dit betekent grootschalige technologische capaciteitsopbouw en innovatie in de hele Unie om de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde halfgeleider- en kwantumtechnologie van de volgende generatie mogelijk te maken en om de chronische structurele zwaktes van Europa in ontwerp en productie aan te pakken. Na **twee succesvolle belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's)** op het gebied van micro-elektronica, die landsgrensoverschrijdende innovatieve projecten in de gehele waardeketen voor micro-elektronica ondersteunen, wordt een mogelijk **derde IPCEI** op dit gebied

ontwikkeld. Deze initiatieven zijn van strategisch belang voor de sector. In dit stadium is het echter onwaarschijnlijk dat ze op zichzelf voldoende gericht zijn op capaciteitsopbouw in de vorm van proeflijnen en ontwerpinfrastructuur. Deze moeten ruim beschikbaar zijn voor alle belanghebbende derden in heel Europa en stellen de Unie tevens in staat een sterkere rol te spelen in een wereldwijd en onderling afhankelijk ecosysteem. Door de omvang van de investeringen en de nodige knowhow kunnen dergelijke grootschalige faciliteiten alleen op het niveau van de Unie worden gerealiseerd.

- Wat de tweede pijler (leveringszekerheid en vraag) betreft, kunnen acties die gericht zijn op het versnellen van **investeringen in de fabricage van halfgeleiders**, alleen op passende wijze op het niveau van de Unie worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit is het geval wegens de omvang van de noodzakelijke investeringen en omdat deze fabricagefaciliteiten per definitie de hele interne markt bedienen, het hele ecosysteem versterken en de leveringszekerheid in crisissituaties waarborgen. Daarnaast zouden maatregelen inzake **strategische projecten** worden ontwikkeld door een mix van publieke en particuliere investeringen met een hoge particuliere hefboomwerking te bevorderen.
- Met betrekking tot de derde pijler (monitoring en crisisrespons) zal nauwere **samenwerking op het niveau van de Unie** zorgen voor de noodzakelijke verzameling van vergelijkbare gegevens. Samen zullen de lidstaten en de Commissie doeltreffender kunnen anticiperen op tekorten, de crisisfase activeren in het geval van ernstige tekorten en de nodige maatregelen treffen om een **dergelijke crisis op doeltreffendere wijze aan te pakken** dan via een lappendeken van nationale maatregelen.
- **Evenredigheid**

Het voorstel is bedoeld om het Europese ecosysteem voor halfgeleiders te versterken via: i) paraatheid en monitoring op korte termijn om de transparantie van toeleveringsketens voor halfgeleiders te vergroten; ii) acties voor leveringszekerheid op middellange termijn om de productiecapaciteit voor halfgeleiders in Europa te vergroten; en iii) acties voor technologie- en innovatieleiderschap op langere termijn om ontwerp- en fabricagefaciliteiten voor geavanceerde en opkomende halfgeleidertechnologieën op te zetten.

In dat verband is het voorstel gericht op de onderdelen van het ecosysteem voor halfgeleiders die het meeste bijdragen tot de veerkracht van de toeleveringsketen in de Unie. Door de klemtoon te leggen op het ecosysteem zelf en niet op het bredere domein van elektronische componenten en systemen of op gebieden waarin halfgeleiders en/of elektronische componenten en systemen worden toegepast, worden de acties beperkt tot een van de meest cruciale pijnpunten voor de Europese economie en samenleving in het algemeen.

Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 bevat de mechanismen die nodig zijn om het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de Europese industrie op langere termijn te waarborgen via: i) onderzoeks- en ontwerpcapaciteit, ii) proeflijnen voor tests en experimenten, iii) capaciteit voor kwantumchips en in fotonica geïntegreerde circuits, iv) kenniscentra, en v) een fonds voor start-ups, scale-ups en kmo's.

Bij nieuwe acties op het gebied van leveringszekerheid in het kader van pijler II om de productiecapaciteit voor halfgeleiders in de Unie te vergroten, kan een faciliteit worden erkend als een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie. Op basis van die erkenning moeten de lidstaten waarborgen dat die faciliteiten en gieterijen via versnelde procedures een vergunning krijgen.

De nieuwe paraatheidsacties van pijler III zijn gebaseerd op monitoring en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Unie om te anticiperen op verstoringen in de toeleveringsketen. In geval van (verwachte) verstoringen kunnen gecoördineerde maatregelen worden getroffen om tekorten aan halfgeleiders en andere verstoringen te beperken of te voorkomen.

- **Keuze van het instrument**

Een verordening wordt het meest passende instrument geacht, omdat daarin voorschriften kunnen worden opgenomen die rechtstreeks van toepassing zijn voor de nationale autoriteiten en de betrokken marktdeelnemers. Dit zal er mede voor zorgen dat de vereisten tijdig en op geharmoniseerde wijze worden uitgevoerd, wat tot meer rechtszekerheid zal leiden en de continuïteit met de eerste chipsverordening zal waarborgen.

Het voorstel heeft de vorm van een verordening van het Europees Parlement en de Raad. Dit is het meest geschikte rechtsinstrument voor pijler I van het voorstel tot oprichting van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0. De reden hiervoor is dat alleen een verordening, met haar rechtstreeks toepasselijke wettelijke bepalingen, de uniformiteit kan bieden die nodig is om een initiatief van de Unie voort te zetten en te beheren dat gericht is op de ondersteuning van een industriële sector in de hele interne markt. De keuze voor een verordening als rechtsinstrument voor pijler II wordt gerechtvaardigd door de behoefte aan een uniforme toepassing van de nieuwe regels, met name de definitie van Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie en strategische projecten, en een uniforme procedure voor het erkennen en ondersteunen daarvan. Daarnaast is een verordening het geschiktste instrument voor pijler III, omdat die een mechanisme moet bieden om te anticiperen op ernstige verstoringen van de levering van halfgeleiders in de Unie en die verstoringen aan te pakken. Bij dit mechanisme is ook geen sprake van verplichte omzetting door middel van nationale maatregelen en het is rechtstreeks toepasselijk.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

- **Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan**

Overeenkomstig artikel 40 van de chipsverordening heeft de Commissie een eerste verslag over de evaluatie en de toetsing van de verordening ingediend bij het Europees Parlement en de Raad, dat uiterlijk op 20 september 2026 moest worden ingediend. Het doel van de evaluatie was een kritische, onpartijdige en empirisch onderbouwde beoordeling te maken van de vooruitgang die werd geboekt bij de chipsverordening en de mate waarin ze in staat is om het ecosysteem voor halfgeleiders van de Unie te versterken²⁶.

De evaluatie had betrekking op de drie pijlers van de chipsverordening en op pijleroverschrijdende aspecten. Er werd gekeken naar het effect van de chipsverordening op de economie, governance en sociale factoren, en er werd een effectbeoordeling gemaakt van de chipsverordening 2.0. Daarin werden de kosten en baten van de chipsverordening binnen elke pijler vastgesteld en gekwantificeerd. Daarnaast werd uiteengezet welke lessen zijn getrokken bij de uitvoering ervan en werd gewezen op aanhoudende en opkomende problemen die van invloed zijn op de werking van de verordening. De evaluatie bestreek de periode vanaf de inwerkingtreding van de chipsverordening op 21 september 2023 tot eind november 2025.

²⁶ Link naar het werkdocument van de diensten van de Commissie, bijlage bij het evaluatieverslag.

In de evaluatie werd geconcludeerd dat **de chipsverordening van cruciaal belang is geweest voor de ontwikkeling van een Europees regelgevings- en beleidskader voor halfgeleiders**, dat voorheen niet bestond en in een kort tijdsbestek werd opgezet. Hierbij werden aanzienlijke publieke en particuliere investeringen aangetrokken, werd geavanceerde infrastructuur op EU-niveau ingevoerd en werden governancemechanismen voor coördinatie en crisisparaatheid opgezet. Het vertrouwen van belanghebbenden in de algemene strategische koers blijft hoog en de verordening wordt in brede kring beschouwd als een noodzakelijk antwoord op geopolitieke, technologische en economische druk.

Tegelijkertijd is **de omschakeling van het leveren van output naar systeembrede resultaten en effecten nog aan de gang**. De belangrijkste beperkingen zijn eerder van structurele en economische dan van operationele aard. Ze houden verband met de mate waarin de Unie in staat is om innovatie te industrialiseren, scale-ups te financieren, de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken en inlichtingen te genereren op systeemniveau.

De verordening is **van belang geweest om in een vroeg stadium technologie-infrastructuren en productiecapaciteit op te bouwen**. De oprichting van proeflijnen, kenniscentra en gedeelde infrastructuur op EU-niveau heeft ervoor gezorgd dat de inspanningen gecoördineerd verliepen. Deze initiatieven verbeteren reeds de toegang tot geavanceerde instrumenten en ondersteunen intensieve landsgrensoverschrijdende samenwerking. Het effect van andere onderdelen (namelijk proefprojecten voor kwantumchips en het ontwerpplatform) zal pas in een later stadium duidelijk worden. In elk geval erkent een brede waaier aan belanghebbenden de bijdrage die de verordening levert aan de versterking van de O&I-basis van Europa en betere coördinatie tussen de lidstaten.

De **vooruitgang bij de uitrol van de productie en de daaruit voortvloeiende toegenomen strategische autonomie bevinden zich daarentegen nog in een beginstadium**, deels als gevolg van de lange doorlooptijden tussen investeringsbeslissingen en de feitelijke productie in de fabriek. Europa blijft in kritieke segmenten, met name in geavanceerde technologienodes, structureel afhankelijk van leveranciers van buiten de EU. Het verlies van of de vertraging bij grote investeringsprojecten toont ook aan dat de soevereiniteit nog niet wezenlijk is verbeterd.

In alle evaluatiecriteria komt **de kloof tussen het laboratorium en de fabricage als een grote uitdaging naar voren**. De verordening heeft ertoe bijgedragen dat technologieën naar een hoger niveau van gereedheid zijn gebracht, en gelet op de recente inwerkingtreding van de verordening, zullen naar verwachting de komende jaren stabiele trajecten naar grootschalige fabricage tot ontwikkeling komen. Veel outputs zijn doeltreffend op technisch niveau en zullen de industriële capaciteit genereren die nodig is om de Europese toelevering in een later stadium veilig te stellen. De uitdaging waarmee de EU wordt geconfronteerd, is niet langer in de eerste plaats het genereren van innovatie, maar **industrialisering en schaalvergroting**.

Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat **beperkt particulier kapitaal een belemmering blijft vormen voor de opschaling van Europese halfgeleiderbedrijven**. Door de verordening zijn ongekende niveaus van publieke financiering aangetrokken, maar particuliere investeringen (met name investeringen in een gevorderd stadium en institutionele investeringen) blijven ontoereikend in vergelijking met concurrerende regio's. Steun voor scale-ups wordt beperkt door structurele kenmerken van het Europese financiële stelsel, waaronder het ontbreken van een daadwerkelijke kapitaalmarktenunie, bestaande regels voor pensioenfondsen en conservatieve beleggingspraktijken. Dit verzwakt de Europese waardecreatie en stimuleert scale-ups om hun onderneming te verplaatsen of te verkopen aan

bedrijven buiten de EU. De verordening heeft de innovatiecapaciteit in het beginstadium verbeterd, maar de begroting die is toegewezen aan het (onderdeel voor de EIC-accelerator van het) chipfonds, is in de eerste twee jaar opgebruikt en is ontoereikend gebleken. Er zijn thematische instrumenten met geduldkapitaal nodig om start-ups op het gebied van halfgeleiders te helpen opschalen, en er moeten bredere maatregelen worden ontwikkeld om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de opkomst van technologiebedrijven met een hoog potentieel.

Daarnaast bleek uit de evaluatie dat de huidige **instrumenten op EU-niveau om de leveringszekerheid en kwetsbaarheden op het gebied van economische veiligheid aan te pakken, nuttig zijn, maar verder moeten worden versterkt**. Enerzijds wordt de uitrol van de productie voornamelijk bepaald door investeringsbeslissingen van de industrie die worden ondersteund via nationale financieringskaders. Zwakke punten aan de vraagzijde ondermijnen de veerkracht verder. Anderzijds beperken versnipperde markten, lage volumes in belangrijke sectoren en beperkte coördinatie van aanbestedingen de commerciële levensvatbaarheid van de Europese productie. Zonder bundeling van de vraag en betrouwbare marktsignalen bestaat het risico dat nieuwe capaciteit onderbenut blijft.

Tot slot werd in de evaluatie geconcludeerd dat **het inzicht van de EU in Europese en mondiale toeleveringsketens voor halfgeleiders te beperkt is om een sterke crisisparaatheid te ondersteunen**. De ESB heeft voor aanzienlijke verbetering van de ESB gezorgd en er zijn mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing ingevoerd. Er moet echter worden nagedacht over een meer geïntegreerde benadering voor de monitoring van alle materialen, apparatuur, ontwerpinstrumenten en downstreamgebruikers. De gegevensverzameling blijft versnipperd en gevoelig, waardoor het vermogen om te anticiperen op verstoringen, beperkt blijft. Pijler III zorgt dus slechts voor gedeeltelijke zichtbaarheid op systeemniveau.

In het algemeen heeft de chipsverordening haar oorspronkelijke doel inzake opbouw van Europese capaciteit snel en op betrouwbare wijze bereikt. De doeltreffendheid op het gebied van autonomie en veerkracht hangt echter af van de vraag of Europa voortaan infrastructuur kan omzetten in industriële output, innovatie in schaalvergroting en coördinatie in bruikbare inlichtingen.

- **Raadpleging van belanghebbenden**

Overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving heeft de Commissie een uitgebreid raadplegingsproces van belanghebbenden uitgevoerd, met als doel betrouwbare informatie te verzamelen aan de hand van een reeks methoden, geraadpleegde partijen en instrumenten.

De Commissie heeft meerdere activiteiten georganiseerd: een **openbare raadpleging** tussen 5 september 2025 en 28 november 2025 (er zijn 105 reacties en 39 standpuntnota's ingediend); een **verzoek om input** voor de effectbeoordeling (er zijn 209 reacties en 85 standpuntnota's ingediend); een gerichte **enquête onder belanghebbenden** (64 reacties); **interviews** (met respondenten die een breed, strategisch geselecteerd spectrum van organisaties vertegenwoordigen die betrokken zijn bij of gevolgen ondervinden van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders); **16 thematische workshops** die tussen september en december 2025 zijn gehouden met deelname van verschillende belanghebbenden uit het Europese ecosysteem voor halfgeleiders; **zes workshops met de lidstaten** die tussen januari en maart 2026 zijn gehouden.

Belanghebbenden wezen op een te grote afhankelijkheid van niet-Europese leveranciers, met name voor hoogperformante chips. De belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van een EU-waardeketen voor AI-chips zijn onder meer onvoldoende productiecapaciteit, beperkte investeringsinstrumenten, tekorten aan geschoolde arbeidskrachten en een zwakke interne vraag van hyperscalers en AI-bedrijven. In de hele waardeketen werden ook structurele kostennadelen vastgesteld: in de EU gevestigde fabrieken worden geconfronteerd met hogere operationele en bouwkosten, langere termijnen voor vergunningverlening en voor opbouw en ingebruikneming, en zwakkere agglomeratie-effecten in vergelijking met concurrenten in Oost-Azië.

Door financiële beperkingen worden deze uitdagingen nog groter. Een gebrek aan durfkapitaal en risicofinanciering werd aangemerkt als een belangrijke belemmering voor ontwerpbedrijven, terwijl fabrikanten van geïntegreerde apparatuur en andere productiegerichte bedrijven langdurige vergunningsprocedures en hoge energiekosten aanhaalden als aanzienlijke belemmeringen. Daarnaast blijven er systemische belemmeringen bestaan in de vorm van tekorten aan financiering in een gevorderd stadium, versnipperd beheer en afhankelijkheid van gieterijen buiten de EU, die verhinderen dat bedrijven prototypen kunnen opschalen tot commerciële producten — een probleem dat tijdens de openbare raadpleging werd bevestigd.

Tekorten aan vaardigheden kwam als een transversale bezorgdheid naar voren bij belanghebbenden. Er werd benadrukt dat voor vaardighedenpijplijnen voor halfgeleiders een investeringshorizon van tien jaar vereist is, maar dat veel relevante programma's met kortere begrotingscycli werken, waardoor het effect ervan op langere termijn beperkt blijft. De belanghebbenden wezen er ook op dat er ruimte is voor verbetering met betrekking tot de coördinatie tussen de EU en de nationale overheden.

De resultaten van de openbare raadpleging zijn samengevat in het samenvattende feitenverslag dat, samen met de antwoorden op het verzoek om input, op het portaal “Uw mening telt!” is gepubliceerd.

- **Effectbeoordeling**

Overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving is dit regelgevingsvoorstel gebaseerd op een effectbeoordeling waarin het probleem en de deelproblemen in verband met de noodzaak om het concurrentievermogen van de halfgeleiderecosystemen van de EU te versterken, worden geanalyseerd. In de effectbeoordeling worden mogelijke beleidsopties aangedragen om de onderliggende oorzaken van de problemen aan te pakken, en worden de waarschijnlijke effecten van die opties beoordeeld. De effectbeoordeling was zodanig gestructureerd dat rekening werd gehouden met de raadpleging van de interdepartementale stuurgroep van de Commissie over de chipsverordening 2.0.

De effectbeoordeling heeft op 28 januari 2026 van de Raad voor regelgevingstoetsing een negatief advies gekregen. De raad gaf de volgende aanbevelingen:

- de analyse van het probleem verder uitwerken, waaronder een uitgebreidere beoordeling van de huidige en vereiste EU-capaciteiten en productiecapaciteit in kritieke onderdelen van de waardeketen voor halfgeleiders, voor zowel volwassen als geavanceerde chips;
- de doelstellingen verduidelijken en beter omschrijven, met name met betrekking tot het niveau en de reikwijdte van de technologische soevereiniteit die voor verschillende soorten chips wordt beoogd;

- de interventielogica versterken door duidelijk aan te tonen hoe verschillende maatregelen zich tot elkaar verhouden, waaronder instrumenten aan de aanbodzijde en aan de vraagzijde, en hoe deze gezamenlijk bijdragen aan de verwezenlijking van het gewenste niveau van soevereiniteit;
- de voorgestelde maatregelen uitvoeriger omschrijven, zodat het effect ervan naar behoren kan worden beoordeeld, waaronder duidelijkere informatie over de totale kosten van de interventie, de verdeling van die kosten en de risico's die gepaard gaan met mogelijke ondoelmatigheden bij de toewijzing van middelen; en
- de transparantie met betrekking tot de onzekerheden in verband met het volgende MFK verbeteren en een grondigere analyse verstrekken van de mate waarin de maatregelen samenhangen met bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven.

Alle bovengenoemde punten zijn zo volledig mogelijk behandeld. Voor de herziene effectbeoordeling die daarop is ingediend, heeft de raad op 30 maart 2026 een positief advies met voorbehoud uitgebracht. De punten van voorbehoud van de raad hadden betrekking op de volgende aspecten:

- de maatregel om prikkels te verstrekken voor betrouwbare chips, is niet voldoende gedetailleerd beschreven om het effect ervan naar behoren te kunnen beoordelen;
- in het verslag wordt de samenhang met bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven en -instrumenten onvoldoende geanalyseerd en wordt niet duidelijk toegelicht hoe de wisselwerking tussen maatregelen aan de aanbodzijde en maatregelen aan de vraagzijde voor synergieën zullen zorgen;
- de analyse van het risico van een ondoelmatige toewijzing van middelen is onvoldoende uitgewerkt.

De adviezen van de raad, de definitieve effectbeoordeling en de samenvatting ervan worden samen met dit voorstel gepubliceerd.

De effectbeoordeling is opgebouwd rond een reeks van drie specifieke doelstellingen om de vastgestelde oorzaken van het probleem aan te pakken. Ze bevat drie beleidsopties voor elke specifieke doelstelling, op basis van het niveau van de beleidsinterventie, het toepassingsgebied, de efficiëntie en de samenhang, alsook de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit.

Bij **beleidsoptie 0 (BO0)** wordt de huidige uitvoering van de chipsverordening ongewijzigd voortgezet. Het bestaande O&O&I-programma in het kader van pijler I blijft behouden en de benadering om investeringen via staatssteun te ondersteunen, wordt gehandhaafd (met gebruikmaking van het pionierskader op grond van de bestaande staatssteunregels). Er wordt geen bijkomende begroting van de Unie vrijgemaakt in het kader van pijler II. In het kader van pijler III wordt het huidige crisisresponsmechanisme behouden, dat werkt op basis van een vrijwillige regeling voor het verzamelen van gegevens uit de particuliere sector (behalve tijdens een crisis). Deze beleidsoptie omvat geen beleidsmaatregelen die verder gaan dan het toepassingsgebied van de bestaande chipsverordening.

Beleidsoptie 1 (BO1) — de horizontale (“marktbevorderende”) beleidsbenadering — is toegespitst op het verbeteren van de algemene randvoorwaarden. Dit omvat meer steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, investeringen in vaardigheden en het scheppen van een gunstig investeringsklimaat. **Er wordt geen aanvullende financiering op Unieniveau ingevoerd voor grootschalige fabricage en ontwerp, met name voor AI-chips.** Bij deze benadering vertrouwt de EU er op lange termijn op leveranciers van buiten de EU aan te

trekken die in staat zijn geavanceerde chips te vervaardigen, alsook mondiale ontwerpbedrijven.

Beleids optie 2 (BO2) — de verticale (“proactieve”) industriële beleidsbenadering — bouwt voort op de horizontale maatregelen, maar vult deze aan met gerichte financiële interventies, met name via **strategische projecten** die kunnen worden ondersteund in het kader van het voorgestelde **Europees Fonds voor concurrentievermogen**. Deze benadering is gebaseerd op Europese technologische activa die in het kader van de eerste chipsverordening zijn ontwikkeld, met name proeflijnen, en vertaalt deze naar industriële uitrol. Door een duidelijke EU-dimensie voor de financiering van industriële projecten in te voeren en landsgrensoverschrijdende investeringen in de hele waardeketen mogelijk te maken, beoogt deze benadering de versnippering te verminderen en tegelijkertijd het concurrentievermogen, de veerkracht en de technologische soevereiniteit van Europa te versterken. De meerwaarde ligt in de poging om “made in Europe”-technologie te ontwikkelen.

In het algemeen is **BO2 de voorkeursoptie**, aangezien deze het meest doeltreffende en evenredige antwoordt biedt op de vastgestelde problemen, waarbij het subsidiariteitsbeginsel in acht wordt genomen en de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt. Ze speelt in op de bevindingen van de evaluatie, waarin wordt gepleit voor sterkere integratie tussen activiteiten op het gebied van O&I en industriële uitrol, snellere industrialisatietrajecten en doeltreffendere mechanismen voor inlichtingen over de toeleveringsketen.

- **Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging**

De voorkeursoptie (BO2) zorgt voor vereenvoudiging doordat op EU-niveau een gecoördineerd kader voor strategische projecten wordt ingevoerd. Eén enkele projectenpijplijn voor grootschalige investeringen in halfgeleiders voorkomt dubbele administratieve stappen en overlappende documentatie. De toelichting over “pionier” zorgt voor verdere vereenvoudiging van pioniersprocedures, zowel voor lidstaten als voor ondernemingen. Daarnaast wordt het concept van een Europees consortium voor chipinfrastructuur (“ECIC”) met het oog op vereenvoudiging geschrappt in de chipsverordening 2.0, aangezien het in het kader van de huidige verordening nooit is gebruikt. Andere efficiëntiewinsten zijn het gevolg van snellere en meer voorspelbare vergunningsprocedures. De vergunnings- en ontwerpfasen voor geavanceerde halfgeleiderfaciliteiten in de EU nemen gemiddeld 7,5 maanden meer in beslag dan in belangrijke concurrerende rechtsgebieden. Ervan uitgaande dat met elk jaar vertraging de totale projectkosten ongeveer 5 % worden verhoogd, brengt dit bijkomende kosten van ongeveer 3,125 % van de totale investering met zich mee. Voor een fabriek voor geavanceerde fabricage van 20 miljard EUR zou dit bijvoorbeeld neerkomen op ongeveer 625 miljoen EUR. Door herhaalde uitwisselingen met autoriteiten te verminderen en trajecten voor vergunningverlening te verduidelijken, levert BO2 aanzienlijke impliciete kostenbesparingen op die opwegen tegen de kosten in verband met naleving. Een ander voordeel van vereenvoudiging bestaat erin dat crisisgestuurde ad-hocverzoeken om informatie worden vervangen door een gestructureerd **business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders**. Dit vermindert dubbel werk en zorgt voor betere coördinatie tussen de lidstaten.

Op grond van het “one in, one out”-beginsel leidt BO2 tot beperkte bijkomende administratieve lasten, die grotendeels worden gecompenseerd door structurele vereenvoudiging. Nieuwe informatieverplichtingen (“IN’s”) voor bedrijven bestaan

voornamelijk uit informatieverschaffing over kwetsbaarheden in de toeleveringsketen. Deze worden geraamd op maximaal tien mandagen per verzoek, wat overeenkomt met ongeveer 2 783 EUR per grote onderneming, waarbij de totale kosten maximaal 1,34 miljoen EUR bedragen per verzoek in een scenario met volledige dekking. Deze lasten worden gecompenseerd door lastenverminderingen (“OUT’s”) in de vorm van minder dringende en dubbele crisisgerelateerde gegevensoproepen, gestroomlijnde informatie-uitwisseling en minder inspanningen voor interne monitoring doordat activiteiten met betrekking tot marktonderzoek gedeeltelijk worden uitbesteed aan het platform. Bedrijven worden geconfronteerd met een administratieve nettolasten, namelijk het opstarten van deelname aan het platform en informatieverschaffing. Deze worden echter grotendeels gecompenseerd door de leveringszekerheid die het delen van gegevens met zich meebrengt. Bovendien worden beoordelingen in de eerste fase alleen op kwalitatieve basis gemaakt, tenzij er sprake is van een formele crisis.

- **Grondrechten**

In artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”) is de vrijheid van ondernemerschap vastgelegd. De maatregelen in het kader van de pijlers I en II van dit voorstel creëren capaciteit voor innovatie en bevorderen de leveringszekerheid van halfgeleiders, wat de vrijheid van ondernemerschap kan versterken overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgeving en praktijken. Niettemin kunnen sommige maatregelen van pijler III die nodig zijn om het feit aan te pakken dat ernstige verstoringen van de levering van halfgeleiders in de Unie de vrijheid van ondernemerschap en de contractvrijheid, die worden beschermd door artikel 16 van het Handvest, en het recht op eigendom, dat wordt beschermd door artikel 17 van het Handvest, tijdelijk zouden kunnen beperken. Elke beperking van die rechten in dit voorstel zal, overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het Handvest, bij wet worden gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen en in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, eerbiedigt de verplichting om specifieke informatie aan de Commissie mee te delen, de wezenlijke inhoud van de vrijheid van ondernemerschap, en zal die vrijheid niet onevenredig worden aangetast (artikel 16 van het Handvest). Elk verzoek om informatie dient de doelstelling van algemeen belang van de Unie, aangezien het mogelijk maakt dat eventuele mitigatiemaatregelen tijdens een crisis als gevolg van een tekort aan halfgeleiders worden vastgesteld. Die verzoeken zijn passend en doeltreffend om het doel te bereiken, aangezien ze informatie opleveren die nodig is om de crisis te beoordelen. De Commissie verzoekt in beginsel alleen om informatie van representatieve organisaties. Zij kan alleen bijkomende verzoeken richten tot individuele ondernemingen indien dit noodzakelijk is. In het licht van de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen van een tekort aan halfgeleiders en het belang van beperkende maatregelen, staan verzoeken om informatie in verhouding tot het beoogde doel. Bovendien wordt de beperking van de vrijheid van ondernemerschap en van het recht op eigendom gecompenseerd door passende waarborgen. Verzoeken om informatie zijn alleen mogelijk in een situatie waarin de Commissie de crisisfase heeft geactiveerd door middel van een uitvoeringshandeling.

De verplichting om als prioritair aangemerkte bestellingen te aanvaarden en daaraan voorrang te geven, eerbiedigt de wezenlijke inhoud van de vrijheid van ondernemerschap, de contractvrijheid (artikel 16 van het Handvest) en het recht op eigendom (artikel 17 van het Handvest), en tast die niet onevenredig aan. Die verplichting dient de doelstelling van algemeen belang van de Unie, aangezien ze waarborgt dat kritieke sectoren die worden getroffen door een verstoorde levering als gevolg van een tekort aan halfgeleiders, kunnen

blijven functioneren. De verplichting is passend en doeltreffend om dit doel te bereiken, aangezien ze waarborgt dat de beschikbare middelen bij voorkeur worden gebruikt voor producten die aan deze sectoren worden geleverd. Geen enkele andere maatregel is even doeltreffend. In een crisissituatie is het evenredig om bepaalde ondernemingen te verplichten bepaalde bestellingen te aanvaarden en prioriteren. Die ondernemingen omvatten faciliteiten voor de fabricage van halfgeleiders die een aanvraag hebben ingediend om te worden erkend als “Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie”, andere faciliteiten voor de fabricage van halfgeleiders die deze mogelijkheid hebben aanvaard in ruil voor overheidssteun, of ondernemingen in de toeleveringsketen voor halfgeleiders die een als prioritair aangemerkte bestelling van een derde land hebben moeten aanvaarden in de mate dat dit gevolgen heeft voor de leveringszekerheid van kritieke sectoren. Passende waarborgen garanderen dat eventuele negatieve gevolgen van de prioriteringsverplichting voor de vrijheid van ondernemerschap, de contractvrijheid of het recht op eigendom geen schending van die rechten vormen. De verplichting om bepaalde bestellingen voorrang te geven, mag alleen worden gebruikt in een situatie waarin de Commissie de crisisfase heeft geactiveerd door middel van een uitvoeringshandeling. De betrokken onderneming kan de Commissie verzoeken de als prioritair aangemerkte bestelling te herzien als deze niet bij machte is de bestelling uit te voeren of als de bestelling een onredelijke economische last en bijzondere problemen met zich meebrengt. Bovendien is het voorwerp van de verplichting vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade wegens schending van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het nakomen van de verplichting.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De gevolgen voor de begroting hebben betrekking op het personeel van de diensten van de Commissie en op steun voor het opzetten van een business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders. Voor het voorstel zijn personele middelen nodig voor de taken die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie vallen. Sommige taken kunnen worden uitgevoerd door bestaande personeelsleden te herschikken die momenteel vergelijkbare taken uitvoeren, bv. in verband met programmatoezicht, contacten met belanghebbenden, en verslaglegging voor activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en capaciteitsopbouw in het kader van pijler I. Aanvullend personeel is nodig voor het uitvoeren van andere taken, bv. het toezicht houden op strategische projecten, waaronder het monitoren van mijlpalen en resultaten; nalevingscontroles (staatssteun, aanbestedingen); landsgrensoverschrijdende coördinatie met de lidstaten; administratief (niet-fiscaal) toezicht; en verslaglegging aan de Raad/het Parlement. Daarnaast brengt het voorstel bijkomende taken met zich mee die verband houden met het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders, zoals het monitoren van toeleveringsketens voor halfgeleiders; functies voor analyse en crisisparaatheid; het behandelen van verzoeken om informatie en het controleren en samenvoegen van gegevens tijdens de fase voorafgaand aan de crisis; en sectoroverschrijdende coördinatie met belanghebbenden uit de sector.

Steun voor het opzetten en exploiteren van een business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders vereist operationele uitgaven ten belope van 70 miljoen EUR. De Commissie zou het platform ondersteunen.

Zie voor nadere gegevens over de gevolgen voor de begroting het financieel en digitaal memorandum in bijlage bij dit voorstel.

Naast de bovengenoemde gevolgen voor de begroting kunnen operationele en administratieve begrotingen voor de uitvoering van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 en strategische projecten in het MFK 2028-2034 pas in een later stadium worden opgevraagd.

5. ANDERE ASPECTEN

- **Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende monitoring, evaluatie en rapportage**

De Commissie draagt de verantwoordelijkheid om de uitvoering van het optreden op regelmatige basis te monitoren. Dit kan worden ondersteund door externe studies, gegevens van de lidstaten en marktgegevens. De Commissie zal een uitgebreide evaluatie uitvoeren van de doeltreffendheid, doelmatigheid, samenhang, evenredigheid en subsidiariteit van de chipsverordening 2.0. Binnen **vier tot vijf jaar** na de datum van toepassing van de wetgevingshandeling wordt een **evaluatieverslag** met de belangrijkste bevindingen ingediend bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. In voorkomend geval kan de Commissie dit verslag vergezeld doen gaan van voorstellen voor verbetering of aanpassing van de chipsverordening 2.0.

Dit evaluatiemechanisme volgt de benadering die in het kader van de eerste chipverordening is vastgesteld. Het waarborgt de continuïteit, de vergelijkbaarheid van de resultaten en biedt een langetermijnperspectief op de beleidsresultaten. De Commissie zal, in nauwe samenwerking met de lidstaten, de uitvoering en toepassing van de wettelijke bepalingen regelmatig monitoren, met bijzondere aandacht voor de doeltreffendheid van de vastgestelde maatregelen. Bij de monitoringactiviteiten wordt gebruikgemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, die gebaseerd zijn op gegevens van belanghebbenden in de gehele waardeketen voor halfgeleiders, de lidstaten en betrokken EU-organen. Het algemene succes van het initiatief wordt beoordeeld aan de hand van bewijsmateriaal over een versterkte **leveringszekerheid**. Dit omvat vooruitgang met betrekking tot relevante meetbare aspecten, zoals het aandeel van de EU in de wereldwijde productie van halfgeleiders en veranderingen in de marktconcentratie. Door de uitvoering van de chipsverordening 2.0 en de bijbehorende maatregelen kunnen de specifieke doelstellingen, de verwachte voordelen en de daarmee samenhangende effecten systematisch worden gevolgd.

Met het oog op de uitvoering van de evaluatie verstrekken de lidstaten en de nationale bevoegde autoriteiten de Commissie op haar verzoek de nodige en relevante informatie.

- **Artikelsgewijze toelichting**

1.1. Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

In **hoofdstuk I** wordt het onderwerp van de verordening vastgesteld. Ook de overige in het instrument gebruikte definities worden daarin gedefinieerd. In de verordening wordt het “Chips voor Europa”-initiatief (voortaan het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0) voortgezet en verder ontwikkeld. In het kader van pijler I worden de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn om de capaciteit van de Unie voor industriële innovatie te versterken, en worden maatregelen vastgesteld om de vraag te stimuleren. In het kader van pijler II worden de criteria vastgesteld voor het erkennen van Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie als pioniersinitiatieven en van strategische projecten die de leveringszekerheid en de veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie bevorderen. In het kader van pijler III worden maatregelen uiteengezet om het coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie, dat oorspronkelijk was opgezet op grond van Verordening (EU) 2023/1781 (chipsverordening), te verbeteren.

1.2. Hoofdstuk II — “Chips voor Europa”-initiatief 2.0

Hoofdstuk II is toegespitst op het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0, dat erop gericht is het concurrentievermogen, de veerkracht en de innovatiecapaciteit van de Unie te versterken. Door in het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 te investeren, moet de Unie haar onderzoek en technologie doeltreffender gaan omzetten in vraaggerichte, toepassingsgestuurde, veilige en energie-efficiënte halfgeleidertechnologie van de hoogste kwaliteit. Tegelijk moet de Unie haar toeleveringsindustrie de kans bieden om van die investeringen te profiteren.

Daartoe omvat dit hoofdstuk de algemene bepalingen en doelstellingen van het “Chips voor Europa”-initiatief, dat oorspronkelijk was opgezet op grond van Verordening (EU) 2023/1781. Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 is erop gericht grootschalige capaciteitsopbouw in de hele Unie te ondersteunen op het gebied van bestaande ultramoderne halfgeleidertechnologie van de volgende generatie. Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 omvat momenteel zes onderdelen: 1) ontwerpcapaciteiten voor geïntegreerde halfgeleidertechnologieën; 2) proeflijnen voor de voorbereiding van innovatieve productie-, test- en experimenteerfaciliteiten; 3) geavanceerde technologie- en technische capaciteit om de ontwikkeling van kwantumchips te versnellen; 4) een netwerk van kenniscentra en voor de ontwikkeling van vaardigheden; 5) activiteiten van het chipfonds voor toegang tot kapitaal voor start-ups, scale-ups en kmo's; en 6) geavanceerd ontwerp, ontwikkeling van prototypes en industriële toepassing van technologieën op basis van in fotonica geïntegreerde circuits opbouwen en versterken in de hele Unie. In het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 wordt sterk de nadruk gelegd op maatregelen voor industrialisering en stimulering van de vraag, zoals grote uitdagingen, het vraagforum en vraagaanjagers.

Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 moet worden ondersteund met financiering van Horizon Europa en het programma Digitaal Europa in het kader van het huidige MFK, met name de nieuwe specifieke doelstelling 6 van Digitaal Europa, en moet worden uitgevoerd overeenkomstig de verordeningen tot vaststelling van die programma's en, in voorkomend geval en zonder afbreuk te doen aan de MFK-onderhandelingen, de opvolgers daarvan.

De verordening biedt een procedureel kader ter facilitering van gecombineerde financiering door de lidstaten, zonder afbreuk te doen aan de staatssteunregels, de begroting van de Unie en particuliere investeringen.

Het hoofdstuk bevat ook bepalingen over de uitvoering. De uitvoering van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 wordt voorts in de eerste plaats toevertrouwd aan de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” en, in voorkomend geval, aan de gemeenschappelijke onderneming of een andere vergelijkbare entiteit die of een ander vergelijkbaar initiatief dat dit vervangt en uit hoofde van het recht van de Unie is opgericht in het kader van een volgend meerjarig financieel kader. De technische beschrijving van de acties is opgenomen in bijlage I. Bijlage III bevat meetbare indicatoren om de uitvoering te monitoren en verslag uit te brengen over de voortgang van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 bij het bereiken van de doelstellingen. De Commissie is bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van meetbare indicatoren. Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 bouwt voort op de sterke punten van Europa in de wereldwijde waardeketen voor halfgeleiders en vergroot de synergieën met acties die momenteel door de Unie en de lidstaten worden ondersteund. Om de positieve effecten te optimaliseren, moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 het derhalve mogelijk maken dat synergieën tot stand worden gebracht met de in bijlage IV beschreven programma's van de Unie.

1.3. Hoofdstuk III — Leveringszekerheid en vraag

Hoofdstuk III, afdeling 1, bevat het kader voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie en strategische projecten. De Commissie kan projecten binnen de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie of in een derde land als strategisch project erkennen indien de projecten aan de volgende criteria voldoen: ze bieden meerwaarde van de EU doordat ze substantieel bijdragen aan doelstellingen van gemeenschappelijk belang van de Unie; ze hebben een duidelijke landsgrensoverschrijdende dimensie; ze dragen bij tot het verbeteren van de onontbeerlijke aard, de veerkracht en de welvaart van de waardeketen voor halfgeleiders van de Unie; en ze dragen bij tot een aanzienlijke vergroting van de technologische soevereiniteit en het technologisch leiderschap van Europa.

De technologische gebieden die zijn aangemerkt als potentiële gebieden voor de erkenning van strategische projecten, zijn opgenomen in bijlage II.

Afdeling 2 van dit hoofdstuk bevat bepalingen voor versnelde procedures voor vergunningverlening voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie en strategische projecten. Hierin wordt ook het gebruik van Europese portemonnees voor ondernemingen beschreven als centrale toegangsportalen voor het indienen van één enkele vergunningsaanvraag voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie en strategische projecten.

In hoofdstuk III, **afdeling 3**, worden de doelstellingen van het keurmerk “Europese uitmuntende halfgeleiderregio” beschreven en worden de visie en het toepassingsgebied van het investeringsplan voor Europese halfgeleiderregio’s uiteengezet.

In **afdeling 4** van hoofdstuk III wordt ingegaan op maatregelen om de veerkracht van de toeleveringsketen te vergroten, met name voor overheidsopdrachten inzake kritieke infrastructuur en in bepaalde sectoren van de economie die als risicogevoelige sectoren zijn aangemerkt.

1.4. Hoofdstuk IV — Monitoring en crisisrespons

Hoofdstuk IV bevat een mechanisme voor gecoördineerde monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders en voor de respons op verstoringen van de levering van halfgeleiders die nadelig zijn voor de goede werking van de interne markt.

In **afdeling 1** wordt een uitgebreid strategisch inventarisatiesysteem voor de halfgeleidersector van de EU vastgesteld, dat bedoeld is om kwetsbaarheden, afhankelijkheden en toekomstige behoeften in kaart te brengen om de veerkracht van de toeleveringsketen te vergroten. De Commissie moet in samenwerking met de ESB een grondige analyse van kritieke aspecten uitvoeren. Het gaat onder meer om belangrijke industrieën en infrastructuren die afhankelijk zijn van halfgeleiders (bv. gezondheidszorg, defensie en digitale sectoren), segmenten van de toeleveringsketen (van ontwerp tot fabricage en materialen), technologische afhankelijkheden (met name van derde landen), tekorten aan vaardigheden en potentiële risico’s, waaronder risico’s die voortvloeien uit onderinvesteringen of geopolitieke verstoringen. Bij de inventarisatie worden de mogelijke effecten van crisisinterventies ook beoordeeld (bv. als prioritair aangemerkte bestellingen of uitvoercontroles op grond van de artikelen 41, 42 en 43). De resultaten worden regelmatig met de ESB gedeeld om beleidsbeslissingen te onderbouwen.

Om risico’s proactief te monitoren, moet de Commissie op basis van de bevindingen van de inventarisatie een lijst van indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing (bv. knelpunten in de toelevering, pieken in de vraag of geopolitieke spanningen) opstellen en regelmatig bijwerken. Het proces is voornamelijk gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens en niet-vertrouwelijke input van de industrie. De Commissie kan halfgeleiderbedrijven echter om

aanvullende vrijwillige informatie verzoeken indien er lacunes bestaan, via gestandaardiseerde, veilige kanalen om de vertrouwelijkheid te beschermen. Alle verzamelde gegevens worden overeenkomstig strikte vertrouwelijkheidsregels behandeld (artikel 50), en de Commissie verstrekt richtsnoeren om consistente en veilige informatie-uitwisseling te waarborgen. Het kader en de methodologie voor de inventarisatie worden ook op gezette tijden geëvalueerd om ze aan te passen aan veranderende sectorale uitdagingen. Uiteindelijk is dit systeem erop gericht te anticiperen op verstoringen, strategische investeringen te sturen en de autonomie van de EU op het gebied van halfgeleiders te versterken.

In **afdeling 1** worden ook de opzet en de doelstellingen van het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders beschreven. Het platform zal een digitale tweeling van de toeleveringsketen voor halfgeleiders zijn met als doel de transparantie en veerkracht ervan te vergroten. De wettelijke vertegenwoordiger van het platform zal de Commissie in kennis stellen van huidige of verwachte verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders.

Afdeling 2 bevat regels om de crisisfase voor halfgeleiders te activeren en beschrijft de noodmaatregelen waarmee op een crisis kan worden gereageerd.

Het eerste aspect is de verplichting voor de nationale bevoegde autoriteiten om de Commissie zo spoedig mogelijk te waarschuwen indien ze een risico op ernstige verstoring van de toelevering of andere geloofwaardige bedreigingen voor de beschikbaarheid van halfgeleiders vaststellen. Hierdoor treedt een preventieve fase in werking, waarin de Commissie snel moet optreden door een buitengewone vergadering van de ESB bijeen te roepen. De rol van de ESB omvat het beoordelen van de ernst van de verstoring, onder meer door preventieve verzoeken om informatie te doen en door te bespreken of een formele crisisprocedure moet worden opgestart. Daarnaast kan de Commissie overleg plegen met derde landen om op samenwerking gebaseerde oplossingen te zoeken, en de nationale autoriteiten verzoeken de paraatheid van belangrijke marktspelers te evalueren.

Indien gezamenlijke aanbesteding noodzakelijk wordt geacht, moet hierbij worden voldaan aan de EU-regels inzake overheidsopdrachten (Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU), waarbij transparantie en mededinging worden gewaarborgd. Het verzamelen van informatie is eveneens een cruciaal instrument. De Commissie kan preventieve verzoeken om informatie indienen bij het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders, met waarborgen voor gevoelige commerciële informatie. De Commissie kan ook preventieve verzoeken om informatie richten tot individuele ondernemingen die niet aan het platform deelnemen. De antwoorden worden gedeeld met de ESB en de betrokken lidstaten, waardoor het collectief bewustzijn wordt gewaarborgd.

Het kader escaleert alleen naar een crisisfase als aan twee voorwaarden is voldaan: 1) ernstige verstoringen van de toeleveringsketen die tot aanzienlijke tekorten leiden, en 2) ernstige gevolgen voor kritieke sectoren (bv. gezondheidszorg, defensie of digitale infrastructuur) die de stabiliteit op maatschappelijk, economisch of veiligheidsgebied in gevaar brengen. De Commissie kan, na raadpleging van de ESB, aan de Raad voorstellen om de crisisfase te activeren, die daarover met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een beslissing neemt. De crisisfase duurt maximaal twaalf maanden, met mogelijke verlengingen indien gerechtvaardigd, waarin regelmatig verslag moet worden uitgebracht bij de ESB en het Europees Parlement. Tijdens die fase moeten de lidstaten de nationale maatregelen via de ESB coördineren om versnipperde reacties te voorkomen. Zodra de crisis is afgelopen, moet de Commissie de monitoring van de toeleveringsketen binnen zes maanden actualiseren, waarbij de geleerde lessen worden opgenomen. De bepalingen inzake activering van de

crisisfase blijven ongewijzigd ten opzichte van de bepalingen in de chipsverordening, na het akkoord van de medewetgevers, en blijven geschikt voor het beoogde doel.

In **afdeling 3** is beschreven welke maatregelen moeten worden genomen om halfgeleidercrises in de Unie aan te pakken.

Op grond van artikel 41 kan de Commissie gegevens over de productie en verstoringen opvragen bij ondernemingen in de toeleveringsketen voor halfgeleiders om de crisis en mogelijke oplossingen te beoordelen. Verzoeken moeten strikt noodzakelijk zijn en mogen de nationale veiligheid niet in gevaar brengen.

Op grond van artikel 42 kan de Commissie fabrikanten van halfgeleiders verplichten om prioriteit te geven aan bestellingen voor in een crisis kritieke producten, die primeren boven bestaande overeenkomsten.

Bij artikel 43 worden gemeenschappelijke aankopen ingevoerd, waarbij de Commissie optreedt als centrale inkoper voor meerdere lidstaten die met ernstige tekorten worden geconfronteerd. Dit mechanisme versterkt de onderhandelingsmacht en voorkomt dat EU-landen met elkaar concurreren om beperkte leveringen.

De Commissie is bevoegd om de crisisfase te activeren door middel van een uitvoeringshandeling als er concrete, ernstige en betrouwbare aanwijzingen zijn voor een halfgeleidercrisis. Een halfgeleidercrisis doet zich voor bij ernstige verstoringen in de levering van halfgeleiders die tot aanzienlijke tekorten leiden. Deze tekorten houden ernstige negatieve gevolgen in voor een of meer belangrijke sectoren van de Unie of belemmeren de levering, de reparatie of het onderhoud van essentiële producten die door kritieke sectoren worden gebruikt. In de uitvoeringshandeling moet de duur van de crisisfase of de verlenging ervan worden gespecificeerd. Vóór het einde van de crisisfase moet de Commissie, rekening houdend met het advies van de ESB, beoordelen of die fase moet worden verlengd. Tijdens de crisisfase belegt de ESB buitengewone vergaderingen, zodat de lidstaten nauw met de Commissie kunnen samenwerken en nationale maatregelen met betrekking tot de toeleveringsketen voor halfgeleiders kunnen coördineren.

1.5. Hoofdstuk V — Governance

Hoofdstuk V bevat het kader voor de voortzetting van de ESB, die uit vertegenwoordigers van de lidstaten bestaat en wordt voorgezeten door de Commissie. De ESB zal advies verstrekken over het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 aan de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” (pijler I). De raad zal advies en bijstand verlenen aan de Commissie bij de beoordeling van aanvragen voor Europese initiatieven voor halfgeleiders en strategische projecten (pijler II). De raad zal van gedachten wisselen met de Commissie over de vooruitgang bij de uitvoering van het investeringsplan voor Europese halfgeleiderregio's, de identificatie van specifieke kritieke sectoren en technologieën bespreken en voorbereiden, en kwesties op het gebied van monitoring en crisisrespons aanpakken (pijler III). Tot slot zal de raad steun verlenen om de voorgestelde verordening consequent toe te passen en de samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken. De ESB zal de Commissie ondersteunen bij internationale samenwerking en strategische partnerschappen voor halfgeleiders. De raad zal ook samenwerken en informatie uitwisselen met relevante crisisstructuren die krachtens het Unierecht zijn ingesteld. De ESB zal in verschillende samenstellingen bijeenkomen en afzonderlijk vergaderen over zijn taken in het kader van pijler I en in het kader van de pijlers II en III. De Commissie kan permanente of tijdelijke subgroepen van de ESB oprichten en organisaties die de belangen van de halfgeleiderindustrie en andere belanghebbenden vertegenwoordigen, uitnodigen als waarnemers. De ESB moet ervoor zorgen dat de stuurgroep van de industriële alliantie voor

halfgeleiders, die de activiteiten van de industriële alliantie op het gebied van processoren en halfgeleidertechnologieën zal overnemen, wordt uitgenodigd om ten minste eenmaal per jaar actualiseringen te presenteren.

Op nationaal niveau wijzen de lidstaten een of meer nationale bevoegde autoriteiten aan, waaronder een centraal contactpunt voor de uitvoering van de verordening.

1.6. Hoofdstukken VI, VII en VIII — Slotbepalingen

In **hoofdstuk VI** wordt benadrukt dat alle partijen verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van gevoelige bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen te eerbiedigen. Die verplichting geldt voor de Commissie, de nationale bevoegde instanties en andere instanties van de lidstaten, alsmede voor alle vertegenwoordigers en deskundigen die de vergaderingen van de ESB en het Comité bijwonen. In het hoofdstuk worden ook regels vastgesteld voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties en boetes voor niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, die onderworpen zijn aan passende waarborgen. De Commissie kan dwangsommen opleggen indien de betrokken ondernemingen tijdens een halfgeleidercrisis bepaalde bestellingen niet aanvaarden en prioriteren. Voorts kan de Commissie geldboeten opleggen aan een onderneming die foute, onvolledige of misleidende informatie verstrekt of die informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt.

Hoofdstuk VII bevat regels en voorwaarden voor het uitoefenen van de bevoegdheidsdelegatie en van uitvoeringsbevoegdheden. Het voorstel machtigt de Commissie om indien nodig uitvoeringshandelingen vast te stellen, zodat procedures kunnen worden gespecificeerd en een eenvormige toepassing wordt gewaarborgd van de verordening en de gedelegeerde handelingen tot wijziging van bijlage I (de daarin opgenomen activiteiten, op een wijze die strookt met de doelstellingen van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0) en bijlage III (de meetbare indicatoren en de bepalingen inzake de vaststelling van een monitoring- en evaluatiekader ter aanvulling van deze verordening).

In **hoofdstuk VIII** is een verplichting opgenomen voor de Commissie om regelmatig verslagen aan het Europees Parlement en de Raad op te stellen voor de evaluatie en herziening van de verordening.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende een kader voor maatregelen ter versterking van het halfgeleiderecosysteem van de Unie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/1781 (chipsverordening 2.0)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 173, lid 3, en artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité²⁷,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's²⁸,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EU) 2023/1781 van het Europees Parlement en de Raad²⁹ tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese halfgeleiderecosysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/694 (chipsverordening) is een alomvattend kader op Unieniveau vastgesteld ter ondersteuning van het halfgeleiderecosysteem, teneinde de technologische capaciteit van de Unie te versterken, de veerkracht te vergroten en de leveringszekerheid te waarborgen.
- (2) Uit de evaluatie³⁰ van Verordening (EU) 2023/1781 blijkt dat de verordening het mogelijk heeft gemaakt aanzienlijke publieke en private investeringen aan te trekken, geavanceerde infrastructuur uit te rollen en coördinatie- en crisisparaatheidsmechanismen in te stellen, en zo heeft bijgedragen aan betere samenwerking tussen de lidstaten en aan de werking van de interne markt. Uit de evaluatie is gebleken dat Verordening (EU) 2023/1781 als katalysator heeft gediend voor een gecoördineerde benadering van de Unie met betrekking tot halfgeleiders, waarbij de onderzoeks- en innovatiecapaciteit is versterkt, toegang is geboden tot technologische infrastructuur, een kader voor productiecapaciteit is opgezet en een crisis- en responsmechanisme is ingesteld om op mogelijke verstoringen te

²⁷ PB C , , blz. .

²⁸ PB C , , blz. .

²⁹ Verordening (EU) 2023/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese halfgeleiderecosysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/694 (chipsverordening) (PB L 229 van 18.9.2023, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj>).

³⁰ [verwijzing naar het gepubliceerde evaluatieverslag toe te voegen].

anticiperen. Tegelijkertijd zijn in de evaluatie structurele tekortkomingen en aanhoudende uitdagingen aan het licht gekomen die de doeltreffendheid ervan bij het aanpakken van veranderende industriële en economische behoeften beperken.

- (3) Hoewel het bij Verordening (EU) 2023/1781 vastgestelde kader doeltreffend is gebleken voor de ondersteuning van innovatie en capaciteit in een vroeg stadium, bevindt de overgang van technologische ontwikkeling naar grootschalige industriële uitrol zich nog in een vroeg stadium. Lange investeringscycli, structurele afhankelijkheden in kritieke segmenten van de waardeketen en beperkingen bij het opschalen van de productie zijn nog steeds van invloed op het vermogen van de Unie om een veerkrachtig en concurrerend ecosysteem voor halfgeleiders tot stand te brengen.
- (4) Daarnaast is uit de evaluatie gebleken dat de beperkte beschikbaarheid van particulier kapitaal, met name voor financiering in een later stadium, en structurele kenmerken van de financiële markten de groei en schaalvergroting van ondernemingen voor halfgeleiders in de Unie belemmeren. Tegelijkertijd verminderen de versnippering van de vraag over industriële sectoren, de beperkte marktschaal en onvoldoende coördinatie tussen inkopers de commerciële levensvatbaarheid van investeringen in productie, en houden ze het risico in dat opkomende capaciteiten worden onderbenut.
- (5) Bovendien is de halfgeleidersector een hoeksteen geworden van de economische stabiliteit, de technologische soevereiniteit en de veiligheid van de Unie. De versnelde integratie van geavanceerde digitale technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), heeft de wereldwijde vraag naar halfgeleiders aanzienlijk doen toenemen en tegelijkertijd de concurrentie op de internationale markten versterkt. Die ontwikkelingen hebben structurele kwetsbaarheden in de toeleveringsketens voor halfgeleiders in de Unie blootgelegd, waaronder afhankelijkheid van een beperkt aantal externe leveranciers, ontoereikende binnenlandse productiecapaciteit en versnippering tussen de lidstaten.
- (6) Met name heeft het toenemende belang van AI-toepassingen geleid tot een stijging van de vraag naar zeer gespecialiseerde chips, zoals geavanceerde logische halfgeleiders en geheugenhalfgeleiders, die cruciaal zijn voor het trainen en uitrollen van complexe AI-modellen. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten, waardoor de bestaande onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod worden versterkt en de reeds kwetsbare mondiale toeleveringsketens extra onder druk komen te staan. Tegelijkertijd hebben geopolitieke spanningen, uitvoerbeperkingen en verstoringen die samenhangen met mondiale crises, nogmaals de aandacht gevestigd op de risico's die gepaard gaan met buitensporige afhankelijkheid van fabricage uit derde landen en beperkte diversificatie.
- (7) In het licht van die ontwikkelingen moet het bij Verordening (EU) 2023/1781 vastgestelde kader worden versterkt en aangevuld om de overgang van innovatie naar industriële schaal te ondersteunen, de veerkracht en de economische veiligheid te vergroten en de doeltreffende werking van de interne markt te waarborgen. Verordening (EU) 2023/1781 moet derhalve worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.
- (8) Aangezien deze verordening het bij Verordening (EU) 2023/1781 vastgestelde kader versterkt en aanvult zonder de fundamentele doelstellingen ervan te wijzigen, blijven de rechtsgrondslagen die aan dat kader ten grondslag liggen, ongewijzigd.

- (9) Deze verordening moet dus ook worden gebaseerd op artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zodat de Unie maatregelen kan nemen om de capaciteit verder in stand te houden en op te bouwen en haar ecosysteem voor halfgeleiders te versterken. Die maatregelen mogen geen betrekking hebben op de harmonisatie van nationale wet- en regelgeving. In dat verband moet de Unie het concurrentievermogen en de veerkracht van de technologische en industriële basis van halfgeleiders versterken en tegelijk de innovatiecapaciteit van haar halfgeleiderecosysteem Uniebreed versterken, de afhankelijkheid van een beperkt aantal ondernemingen en geografische gebieden uit derde landen verminderen en haar capaciteit versterken om geavanceerde halfgeleiders te ontwerpen, te produceren, te verpakken, te hergebruiken en te recyclen. Het “Chips voor Europa”-initiatief dat voor het eerst werd opgezet bij Verordening (EU) 2023/1781 moet die doelstellingen in het kader van deze verordening blijven ondersteunen door nog meer inspanningen te leveren die verder gaan dan het dichten van de kloof tussen de geavanceerde onderzoeks- en innovatiecapaciteiten van de Unie en de duurzame industriële exploitatie ervan, en door ervoor te zorgen dat dergelijke capaciteiten binnen de Unie doeltreffend worden omgezet in productie en marktintroductie op industriële schaal. Het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 moet capaciteitsopbouw blijven bevorderen om ontwerp-, productie- en systeemintegratie in halfgeleider technologieën van de volgende generatie mogelijk te maken, en moet de samenwerking tussen belangrijke spelers in de hele Unie blijven ondersteunen, waardoor de toeleverings- en waardeketens voor halfgeleiders van de Unie worden versterkt, belangrijke industriële sectoren worden bediend en nieuwe markten worden gecreëerd.
- (10) Daarnaast, en om de doeltreffende werking van de interne markt te waarborgen, moet deze verordening bijdragen aan de vaststelling van een samenhangend Uniekader, waarbij bepaalde voorwaarden en coördinatiemechanismen beter op elkaar worden afgestemd, overeenkomstig artikel 114 VWEU. Een dergelijk kader is noodzakelijk om belemmeringen voor de werking van de interne markt te voorkomen, versnippering te verminderen en te zorgen voor een consistente en doeltreffende reactie op risico's in de toeleveringsketen, met inachtneming van het Unierecht en internationale verplichtingen. Dit is met name essentieel gezien het feit dat halfgeleiders een basistechnologie zijn die ten grondslag ligt aan een brede waaier aan economische activiteiten en kritieke infrastructuren in de hele Unie. Tegen een achtergrond van toegenomen geopolitieke spanningen, strategische wereldwijde concurrentie en toenemende economische veiligheidsoverwegingen is het ecosysteem voor halfgeleiders een belangrijke factor geworden voor de stabiliteit en werking van de interne markt. De halfgeleidersector wordt gekenmerkt door complexe landsgrensoverschrijdende onderlinge afhankelijkheden in de hele waardeketen, met zeer gespecialiseerde activiteiten die geconcentreerd zijn in verschillende geografische gebieden, terwijl de verwerkende industrieën sterk verspreid zijn over de hele Unie. Die kenmerken houden in dat verstoringen, beperkingen of verstoringen die van invloed zijn op de toeleveringsketens voor halfgeleiders, waarschijnlijk aanzienlijke landsgrensoverschrijdende effecten zullen hebben en gevolgen zullen hebben voor de werking van de interne markt. Uiteenlopende nationale maatregelen om dergelijke risico's aan te pakken, kunnen tot versnippering leiden, de mededinging verstoren en het gelijke speelveld binnen de interne markt ondermijnen, met name gezien het geïntegreerde karakter van productie- en distributienetwerken. De doelstellingen om de veerkracht, veiligheid en goede werking van de toeleveringsketens voor halfgeleiders in de Unie te waarborgen, kunnen daarom niet voldoende door de

lidstaten alleen worden bereikt, maar kunnen wegens de omvang en landsgrensoverschrijdende gevolgen ervan beter op het niveau van de Unie worden verwezenlijkt.

- (11) De verwezenlijking van deze doelstellingen moet verder worden ondersteund door de Europese Raad voor halfgeleiders, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de Commissie, teneinde een vlotte, doeltreffende en geharmoniseerde uitvoering van deze verordening, alsook samenwerking en uitwisseling van informatie te faciliteren. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie adviseren en bijstaan met betrekking tot specifieke kwesties, waaronder de consistente uitvoering van deze verordening, de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van informatie over kwesties die verband houden met deze verordening. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie ook adviseren over internationale samenwerking op het gebied van halfgeleiders, waaronder strategische partnerschappen voor halfgeleiders, en over taken op het gebied van informatieverzameling. Aan de vergaderingen kunnen verschillende subgroepen deelnemen.
- (12) Gezien de mondiale aard van de toeleveringsketen voor halfgeleiders is internationale samenwerking met derde landen een belangrijk element om tot een veerkrachtig halfgeleiderecosysteem van de Unie te komen. De maatregelen die in het kader van deze verordening worden getroffen, moeten de Unie ook in staat stellen om als expertisecentrum een sterkere rol te spelen in een beter functionerend mondiaal, onderling afhankelijk halfgeleiderecosysteem. Indien relevant moeten de standpunten van de industriële alliantie op het gebied van halfgeleiders³¹, die de activiteiten van de industriële alliantie op het gebied van processoren en halfgeleidertechnologieën overneemt, en van andere belanghebbenden in aanmerking worden genomen. De Unie en de lidstaten kunnen, met inachtneming van internationale verplichtingen, contacten — ook diplomatieke — leggen met internationale strategische partners die een voordelige positie genieten in de halfgeleidersector, teneinde oplossingen te vinden om de leveringszekerheid te versterken en toekomstige verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders aan te pakken, bijvoorbeeld door uitvoerbeperkingen van derde landen, en om de beschikbaarheid van grondstoffen en tussenproducten in kaart te brengen. De Commissie en de lidstaten moeten hun internationale inspanningen coördineren, met name met steun van de Europese Raad voor halfgeleiders. Hierbij kan het in voorkomend geval nodig zijn te coördineren in relevante internationale fora, investerings- en handelsovereenkomsten te sluiten, of andere diplomatieke inspanningen te leveren of contacten te leggen met belanghebbenden.
- (13) Om de kritieke infrastructuur, de veiligheid, de industriële basis en het technologisch leiderschap van de Unie te versterken, is veilige en betrouwbare toegang vereist tot zowel geavanceerde als reguliere halfgeleidertechnologieën, met inbegrip van processors en geheugen-, analoge, vermogens-, sensor-, radiofrequentie- en connectiviteitschips, die essentieel zijn om strategische sectoren als energie, defensie, de automobiëlindustrie, de luchtvaart, telecommunicatie, de gezondheidszorg, cloud computing en industriële automatisering toekomstbestendig te maken. De Unie beschikt over solide capaciteiten op het gebied van een breed scala aan rijpe technologieën, met inbegrip van chips van automobielkwaliteit en energiezuinige en

³¹

Mandaat — <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/78326>.

beveiligde chips, en moet haar concurrentievermogen, veerkracht en strategische autonomie in de volledige waardeketen voor halfgeleiders blijven versterken.

- (14) De halfgeleiderindustrie vereist aanzienlijke investeringen, zowel voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten als voor de bouw van hypermoderne test- en validatie-installaties om fabricage op industriële schaal mogelijk te maken. Deze noodzaak om fors te investeren, is direct van invloed op het concurrentie- en innovatievermogen van de Unie en beïnvloedt eveneens de leveringszekerheid en de algehele veerkracht van haar halfgeleiderecosysteem. Tegelijkertijd zijn het concurrentievermogen en de veerkracht van de Unie afhankelijk van de voortdurende beschikbaarheid en ontwikkeling van reguliere en rijpe halfgeleidertechnologieën, waaronder analoge, vermogens-, sensor-, connectiviteits-, automobiel- en luchtvaartchips, die nog steeds onontbeerlijk zijn in strategische industriële waardeketens en kritieke infrastructuur. In de huidige context van toenemende mondiale concurrentie, geopolitieke spanningen en structurele kwetsbaarheden in toeleveringsketen zijn halfgeleiders een strategische troef geworden die bijdraagt aan de economische veiligheid, het technologisch leiderschap en de industriële veerkracht van de Unie. Met het oog op de lessen die zijn getrokken uit eerdere tekorten en verstoringen van toeleveringsketen in de Unie en wereldwijd, de uitvoerbeperkingen en regelgevende maatregelen van derde landen en de constante veranderingen op het gebied van technologische uitdagingen en innovatiecycli, die gevolgen hebben voor de waardeketen van halfgeleiders, moeten de huidige sterke punten van de Unie, waaronder haar leidende positie in diverse reguliere segmenten van de halfgeleiderindustrie, worden geconsolideerd door middel van een verdere versterking van het “Chips voor Europa”-initiatief, zodat de marktpenetratie, het concurrentievermogen, de veerkracht en de onderzoeks- en innovatiecapaciteit kunnen worden vergroot.
- (15) In het kader van het versterkte “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 moet rekening worden gehouden met de ervaring die reeds is opgedaan bij de uitvoering van het oorspronkelijke “Chips voor Europa”-initiatief, zodat hierop kan worden voortgebouwd en verbeteringen kunnen worden aangebracht met het oog op de aanpak van resterende structurele tekortkomingen en om in te spelen op nieuwe strategische behoeften. Met name zijn intensievere inspanningen nodig om te waarborgen dat de geavanceerde onderzoeks- en innovatiecapaciteiten van de Unie zich daadwerkelijk vertalen in industriële toepassingen, opschaling en fabricage op commerciële schaal binnen de Unie.
- (16) De verantwoordelijkheid voor een sterke industriële, competitieve, duurzame en innovatieve basis in de Unie ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. De aard en de omvang van de uitdagingen op het gebied van onderzoek en innovatie wat betreft halfgeleiders vereisen echter een gezamenlijk optreden op het niveau van de Unie. Om ervoor te zorgen dat de Unie beschikt over de onderzoeks- en innovatiecapaciteiten op het gebied van halfgeleidertechnologie die nodig zijn om voorop te blijven lopen wat onderzoeks- en industriële investeringen in geavanceerde technologie betreft, en voortbouwend op de opgedane ervaring en de lessen die zijn getrokken uit de uitvoering van het “Chips voor Europa”-initiatief, is het noodzakelijk deze capaciteiten verder te versterken en uit te breiden teneinde een effectieve industriële toepassing, opschaling en fabricage op commerciële schaal binnen de Unie waarborgen. Met dit doel voor ogen moeten de Unie en de lidstaten hun inspanningen onderling blijven afstemmen en gezamenlijk investeren.

- (17) Gezien de toegenomen mondiale concurrentie, de geopolitieke spanningen en het risico op verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders — met inbegrip van verstoringen die voortvloeien uit regelgevende maatregelen van derde landen en die gevolgen kunnen hebben voor de toegang tot cruciale halfgeleidertechnologieën en aanverwante grondstoffen — is het, zoals ook wordt onderstreept in het verslag van Mario Draghi over de toekomst van het Europese concurrentievermogen, voor het concurrentievermogen, de economische veiligheid en de technologische soevereiniteit van de Unie inmiddels een strategische prioriteit om het vermogen van de Unie te versterken om dergelijke technologieën op haar grondgebied te ontwikkelen, te produceren en toe te passen. Deze uitdagingen voor het halfgeleiderecosysteem van de Unie vereisen de ontwikkeling van grootschalige capaciteit en een gezamenlijke inspanning van de lidstaten, waarbij de Unie de ontwikkeling en inzet moet bevorderen van grootschalige capaciteit in de volledige innovatie- en industriële waardeketen, met inbegrip van proeflijnen, opschaling van de productie en commerciële toepassing, om op deze manier te garanderen dat uitmuntendheid op het gebied van onderzoek zich daadwerkelijk vertaalt in industrieel leiderschap en duurzame productiecapaciteit binnen de Unie.
- (18) Zoals wordt geconcludeerd in de evaluatie van Verordening (EU) 2023/1781, zijn de instrumenten die zijn ingesteld in het kader van het “Chips voor Europa”-initiatief waarin die verordening voorziet, namelijk het ontwerpplatform, proeflijnen, proefprojecten voor kwantumchips en de verspreiding van kennis, de EU-academie voor vaardigheden op het gebied van chips in het kader van de allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden en het Europees pact voor vaardigheden, evenals de kenniscentra voor het volledige halfgeleiderecosysteem, geschikt voor het beoogde doel en moet de ondersteuning hiervan in het kader van deze verordening worden voortgezet. Met deze inspanningen moet tevens een bijdrage worden geleverd aan de bredere doelstelling van de Unie om haar concurrentievermogen, innovatiecapaciteit en industriële basis op lange termijn te versterken, onder meer door middel van synergieën met toekomstige Unieprogramma’s voor de bevordering van onderzoek, innovatie en industriële toepassing, zoals het voorgestelde³² kaderprogramma dat Horizon Europa moet gaan opvolgen – het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad³³ (Horizon Europa) (FP10) – en het voorgestelde Europees Fonds voor concurrentievermogen³⁴, terwijl de voordelen van de toepassing van halfgeleidertechnologieën als krachtige katalysatoren in alle onderdelen en acties van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 zo veel mogelijk moeten worden geïntegreerd en gemaximaliseerd, bijvoorbeeld voor de transitie naar duurzaamheid die kan leiden tot nieuwe producten en een efficiënter, effectiever, schoner en duurzamer gebruik van hulpbronnen, met inbegrip van de

³² Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2028-2034, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding, en tot intrekking van Verordening (EU) 2021/695

³³ Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>.

³⁴ Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor concurrentievermogen (“EFC”), met inbegrip van het specifieke programma voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op defensiegebied, tot intrekking van de Verordeningen (EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU) 2021/697 en (EU) 2021/783 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/696, (EU) 2023/588 en (EU) [EDIP].

energie en materialen die nodig zijn voor de fabricage en het gebruik van halfgeleiders gedurende de volledige levenscyclus.

- (19) Om de algemene doelstelling te verwezenlijken en de uitdagingen aan zowel de aanbod- als aan de vraagzijde van het huidige halfgeleiderecosysteem het hoofd te bieden, en voortbouwend op de opgedane ervaring en de lessen die zijn getrokken uit de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1781 – waaruit is gebleken dat het nog steeds noodzakelijk is de capaciteit van de Unie te versterken, niet alleen op het gebied van onderzoek en innovatie, maar ook met betrekking tot industriële toepassing en opschaling van de productie – moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 de vijf krachtens Verordening (EU) 2023/1781 vastgestelde operationele doelstellingen blijven ondersteunen en verder versterken. In het kader van het initiatief moet tevens een nieuwe operationele doelstelling worden ingevoerd die is gericht op de versterking van de capaciteiten van de Unie op het gebied van fotonische technologieën, en moet het concept van “grote uitdagingen” worden ingevoerd als instrumenten ter bevordering van grootschalige, sectoroverschrijdende initiatieven waarmee belangrijke technologische en industriële uitdagingen kunnen worden aangepakt die van strategisch belang zijn voor de Unie. De uitvoering van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 moet primair de verantwoordelijkheid blijven van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” en, indien van toepassing, van de gemeenschappelijke onderneming of een andere soortgelijke entiteit die of initiatief dat deze onderneming opvolgt en krachtens het Unierecht wordt opgericht binnen een volgend meerjarig financieel kader.
- (20) In de eerste plaats moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 de ontwerpcapaciteit van de Unie versterken. Daartoe moet wederom steun worden verleend aan het virtuele ontwerpplatform dat is opgezet in het kader van het “Chips voor Europa”-initiatief om gemeenschappen van ontwerpbureaus, start-ups, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), leveranciers van intellectuele eigendom en instrumenten, en organisaties voor onderzoek en technologie met elkaar in contact te brengen, teneinde virtuele prototypeoplossingen te verschaffen op basis van een gezamenlijke ontwikkeling van technologie en de overgang van ontwerp naar industriële productie en commerciële toepassing binnen de Unie te faciliteren.
- (21) Ten tweede moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 blijven helpen om bestaande proeflijnen te versterken en nieuwe geavanceerde proeflijnen te ontwikkelen, zodat ultramoderne halfgeleider technologieën en halfgeleider technologieën van de volgende generatie kunnen worden ontwikkeld en toegepast, teneinde de basis te kunnen leggen voor het versterken van de leveringszekerheid en het halfgeleiderecosysteem van de Unie. De proeflijnen moeten de industrie in staat stellen om halfgeleider technologieën en concepten voor systeemontwerp te testen en valideren en ermee te experimenteren, waarbij de milieueffecten zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de transitie naar de fabricage van halfgeleiders op industriële schaal binnen de Unie kan worden versneld. Investerings in proeflijnen door de Unie, in samenwerking met de lidstaten en de particuliere sector, blijven noodzakelijk om hardnekkige structurele uitdagingen en marktfalen – waaronder de ontoereikende beschikbaarheid in de Unie van capaciteiten voor het testen en valideren van halfgeleiders en voor de fabricage van halfgeleiders op industriële schaal – aan te pakken die de innovatie, de industriële toepassing en het mondiale concurrentievermogen blijven belemmeren.
- (22) Ten derde moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 ondersteuning bieden voor ontwerpbibliotheken voor kwantumchips, voor proeflijnen voor de bouw van kwantumchips en voor faciliteiten om de door de proeflijnen geproduceerde

kwantumchips te testen en te valideren, ter versnelling van de voor de ontwikkeling van de halfgeleidersector bevorderlijke innovatieve ontwikkeling van kwantumchips en bijbehorende halfgeleidertechnologieën, waaronder op halfgeleidermateriaal gebaseerde of in fotonica geïntegreerde halfgeleidertechnologieën, en om de industriële toepassing ervan mogelijk te maken en het technologisch leiderschap van de Unie op het gebied van opkomende halfgeleidertechnologieën te versterken.

- (23) Ten vierde moet het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 de lidstaten de mogelijkheid blijven bieden om in elke lidstaat de oprichting te ondersteunen van ten minste één kenniscentrum voor halfgeleiders door bestaande centra te verbeteren en nieuwe faciliteiten in het leven te roepen, ter bevordering van het gebruik van halfgeleidertechnologie en teneinde toegang te bieden tot ontwerp- en proeflijnfaciliteiten en vaardigheidstekorten in de hele Unie aan te pakken.
- (24) Ten vijfde zijn fotonica en fotonische geïntegreerde schakelingen sleuteltechnologieën voor een breed scala aan strategische sectoren, waaronder telecommunicatie, datacentra, artificiële intelligentie, sensortechnologie, technologieën voor de gezondheidszorg, de automobiellindustrie en de luchtvaart, en kwantumtechnologieën. Deze technologieën maken een snelle gegevensoverdracht, een energie-efficiënte verwerking en geavanceerde detectiecapaciteiten mogelijk en zijn derhalve kritiek voor het technologisch leiderschap, het concurrentievermogen en de leveringszekerheid van de Unie. De Unie heeft solide onderzoeks- en innovatiecapaciteiten opgebouwd en heeft een leidende positie in diverse segmenten van de fotonicawaardeketen. Er zijn echter aanvullende inspanningen nodig om de capaciteit van de Unie te vergroten om fotonische geïntegreerde schakelingen en aanverwante fotonische halfgeleidertechnologieën te ontwikkelen, er prototypen voor te ontwikkelen, en deze technologieën te industrialiseren en op grote schaal te produceren. Om de ontwikkeling van technologie op het gebied van fotonica en fotonische geïntegreerde schakelingen te stimuleren, is het derhalve noodzakelijk om de ontwikkeling van ontwerpbibliotheken en ontwerpinstrumenten te bevorderen, productietechnologieën en materiaalplatforms te verbeteren, en te zorgen voor meer solide proeflijnen en fabricage-installaties die vrij toegankelijk zijn voor meerdere materiaalplatforms. Deze maatregelen moeten de ontwikkelingen van prototypes, testen en valideren, en de industriële toepassing vergemakkelijken, onder meer door middel van geavanceerde integratie- en verpakkingstechnologieën, en bijdragen tot de versterking van het fotonica-ecosysteem van de Unie, de vergroting van haar technologische soevereiniteit en de versnelling van industriële toepassing.
- (25) Ten zesde moet de Commissie het “chipfonds” blijven steunen, een specifieke investeringsfaciliteit voor halfgeleiders die tot doel heeft het Europese halfgeleiderecosysteem te versterken door start-ups, scale-ups, en kmo’s te ondersteunen door zowel aandelen- als schuldoplossingen aan te bieden, met inbegrip van een blindingfaciliteit in het kader van het InvestEU-fonds dat is opgericht bij Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad³⁵, en, indien van toepassing, andere relevante investeringsregelingen in het kader van het meerjarig financieel kader 2028-2034, in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank Groep en samen met andere uitvoerende partners zoals nationale stimuleringsbanken en -instellingen. De activiteiten van het chipfonds moeten de ontwikkeling van een dynamisch en veerkrachtig halfgeleiderecosysteem ondersteunen

³⁵ Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

door kansen te bieden voor een ruimere beschikbaarheid van middelen ter ondersteuning van de groei van start-ups en kmo's, alsook van investeringen in de hele waardeketen voor halfgeleiders, waaronder voor andere ondernemingen in de waardeketen voor halfgeleiders. In dit opzicht zijn met name voor kmo's ondersteuning en duidelijke richtsnoeren nodig om hen bij te staan bij de aanvraagprocedure. In dat verband wordt van de Europese Innovatieraad verwacht dat ze verder gerichte steun verleent door middel van subsidies en investeringen in eigen vermogen voor marktcreërende innovatoren met een hoog risico.

- (26) Teneinde het technologisch leiderschap en het industriële concurrentievermogen van de Unie op het gebied van halfgeleiders verder te versterken, is het wenselijk als onderdeel van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 het concept van “grote uitdagingen” in te voeren. In deze grote uitdagingen moet het accent liggen op de ontwikkeling, integratie en industriële toepassing van veelbelovende en kritieke halfgeleidertechnologieën en aanverwante technologieën die van essentieel belang zijn voor de Unie. Aan de hand van grote uitdagingen moeten geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden bevorderd die de volgende generatie halfgeleidertechnologieën, waaronder degene die ten grondslag liggen aan AI, de cloud, datacentra en edge-infrastructuren, mogelijk maken, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, het waarborgen van capaciteiten op het gebied van geavanceerde technologieën en het consolideren van de sterke punten van de Unie op het gebied van fabricage. Tevens moeten in dit kader belangrijke technologische knelpunten worden aangepakt, met inbegrip van uitdagingen op het gebied van miniaturisatie, energie-efficiëntie, duurzaamheid, heterogene integratie, beveiliging, betrouwbaarheid en produceerbaarheid. Voor een maximale impact moet met grote uitdagingen worden bijgedragen aan de versterking van het halfgeleiderecosysteem in de gehele Unie door samenwerking binnen de volledige waardeketen van halfgeleiders, onder meer met relevante verticale sectoren, te bevorderen. Met name moet een gestructureerde samenwerking tussen ontwikkelaars van halfgeleiders en de verwerkende industrieën worden aangemoedigd met het oog op de verwerving van een concurrentievoordeel met betrekking tot toepassingen die van cruciaal belang zijn voor de technologische soevereiniteit en de industriële basis van de Unie. Ten slotte moet met grote uitdagingen de integratie en afstemming van inspanningen binnen bestaande infrastructuur, waaronder proeflijnen, verder worden gewaarborgd en de toespitsing ervan op industriële toepassingen worden bevorderd. In dit kader moet de overdracht, rijping en toepassing van in het kader van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 ontwikkelde technologieën worden gefaciliteerd, onder meer door middel van activiteiten met betrekking tot prototypeontwikkeling, testen, validatie, demonstratie, eerste industriële toepassing en integratie in productieomgevingen.
- (27) Kenniscentra moeten ertoe bijdragen dat de Unie haar leidende positie behoudt op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van chips en op het gebied van ontwerpcapaciteiten. Het stimuleren van menselijk potentieel en vaardigheden door middel van onderwijs in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, tot op postdoctoraal niveau, is van cruciaal belang om dat doel te bereiken. Kenniscentra moeten met name diensten verlenen aan belanghebbenden op het gebied van halfgeleiders, waaronder ook start-ups en kmo's. Het kan daarbij gaan om facilitering van toegang tot proeflijnen en het virtueel ontwerpplatform, het geven van opleidingen, het helpen ontwikkelen van vaardigheden, ondersteuning bij de zoektocht naar investeerders, benutting van bestaande lokale vaardigheden, of contactlegging met relevante delen van de keten. De diensten moeten op een open, transparante en

niet-discriminerende wijze worden verleend. Elk kenniscentrum moet zich aansluiten bij en actief zijn in het Europees netwerk van kenniscentra voor halfgeleiders en moet dienstdoen als toegangspunt tot andere schakels in het netwerk. In dat verband moeten synergieën met bestaande, vergelijkbare structuren, zoals de Europese digitale-innovatiehubs die zijn opgezet in het kader van het bij Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad³⁶ ingestelde programma Digitaal Europa, optimaal worden benut. Zo kan een lidstaat voor de toepassing van deze verordening een bestaande op halfgeleiders gerichte Europese digitale-innovatiehub als kenniscentrum aanwijzen, op voorwaarde dat het verbod op dubbele financiering niet wordt geschonden.

- (28) Om de toegang tot technische expertise te faciliteren, de verspreiding van kennis in de hele Unie te waarborgen en diverse initiatieven op het gebied van vaardigheden te ondersteunen, moet het in het kader van het “Chips voor Europa”-initiatief opgezette netwerk van kenniscentra via het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 wederom worden ondersteund. Daartoe moet de bij Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad opgerichte Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”³⁷ de procedure voor de voortzetting van de steun voor kenniscentra vaststellen, met inbegrip van de selectiecriteria, alsmede nadere bijzonderheden over de uitvoering van de in deze verordening genoemde taken en functies. De kenniscentra die het netwerk vormen, moeten worden geselecteerd door de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” en moeten over aanzienlijke algemene autonomie beschikken om hun organisatie, samenstelling en werkmethoden vast te stellen. De organisatie, de samenstelling en de werkmethoden ervan moeten echter voldoen aan en bijdragen aan de doelstellingen van deze verordening.
- (29) De door de Unie uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van vaardigheden en onderwijs zijn fundamenteel om te waarborgen dat het halfgeleiderecosysteem van de Unie kan blijven floreren. Daartoe moet het strategisch plan voor STEM-onderwijs³⁸ en de daarin opgenomen maatregelen worden benut, en moeten initiatieven als het pact voor vaardigheden³⁹, de academies voor vaardigheden⁴⁰, gezamenlijke Europese studieprogramma’s⁴¹, het initiatief voor de overdraagbaarheid van vaardigheden⁴² en de alliantie van Europese universiteiten⁴³ bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke maatregelen voor de halfgeleidersector. Tevens moeten de synergieën worden

³⁶ Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj>).

³⁷ Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 219/2007, (EU) nr. 557/2014, (EU) nr. 558/2014, (EU) nr. 559/2014, (EU) nr. 560/2014, (EU) nr. 561/2014 en (EU) nr. 642/2014 (PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj>).

³⁸ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een strategisch plan voor STEM-onderwijs: vaardigheden voor concurrentievermogen en innovatie”.

³⁹ https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_nl.

⁴⁰ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-digital-skills-academies-support-eus-technological-sovereignty-competitiveness-and-preparedness>.

⁴¹ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een blauwdruk voor een Europees diploma.

⁴² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15892-Fair-labour-mobility-package-Skills-portability-1-digitalised-cross-border-portability-of-qualifications-and-skills_nl.

⁴³ <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative/map>.

onderzocht met initiatieven die internationale werving vergemakkelijken, zoals de EU-talentpool⁴⁴, zodat de Unie extern talent kan aantrekken.

- (30) De kenniscentra en de door de overheid gefinancierde infrastructuur, zoals proef- en testfaciliteiten, moeten openstaan voor een breed scala aan gebruikers en moeten op transparante en niet-discriminerende basis en tegen marktvoorwaarden (of kosten plus een redelijke marge) worden aangeboden aan grote ondernemingen, terwijl kmo's en academische instellingen kunnen profiteren van een bevoorrechte toegang of lagere prijzen, zodat een bredere deelname aan innovatie op het gebied van halfgeleiders evenals de ontwikkeling en verspreiding van industriële capaciteiten in de hele Unie worden bevorderd. Bovendien moeten de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0, met inbegrip van technologische infrastructuur, ook ten goede te komen aan de defensiesector, zonder afbreuk te doen aan verdere activiteiten voor de ontwikkeling van defensieproducten en -technologieën in het kader van Verordening (EU) 2025/2643.
- (31) Het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0 kan derhalve alleen slagen indien de lidstaten en de Unie zich gezamenlijk inspannen om bij te dragen aan de aanzienlijke kapitaalkosten, zodat meer middelen beschikbaar komen voor virtueel ontwerp, testen en proefprojecten en voor de verspreiding van kennis, vaardigheden en competenties. Gezien de specifieke kenmerken van de activiteiten moeten de doelstellingen van het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0, met name de activiteiten van het chipfonds, indien nodig ook worden ondersteund door middel van een blendingfaciliteit in het kader van het InvestEU-fonds. De steun van het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0 moet worden gebruikt voor een proportionele kosteneffectieve aanpak van tekortkomingen van de markt of suboptimale investeringsituaties die het gevolg zijn van de hoge kapitaalintensiteit, het hoge risico en de kenmerkende complexiteit van het halfgeleiderecosysteem, en de acties mogen private financiering niet overlappen of verdringen, noch de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten in de hele Unie een duidelijke meerwaarde bieden.
- (32) Bovendien moet met het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0 worden voortgebouwd op de solide kennisbasis en moeten de synergieën worden versterkt met acties die momenteel door de Unie en de lidstaten worden ondersteund via programma's en initiatieven op het gebied van onderzoek en innovatie inzake halfgeleiders en de ontwikkeling van delen van de waardeketen, met name Horizon Europa en het programma Digitaal Europa, met als doel de positie van de Unie te versterken als mondiale speler op het gebied van halfgeleidertechnologie en toepassingen daarvan met een groeiend aandeel in de wereldwijde productie, in overeenstemming met de mededeling van de Commissie getiteld "Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium"⁴⁵. Voorts zullen er naar verwachting private investeringen worden aangetrokken ter aanvulling van de financiering in het kader van het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0, om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen ervan. Als aanvulling op die activiteiten zou binnen het "Chips voor Europa"-initiatief 2.0 nauw worden samengewerkt met andere belanghebbenden, waaronder de industriële alliantie voor halfgeleiders.

⁴⁴ Verordening (EU) 2026/1047 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2026 tot oprichting van een EU-talentenpool

⁴⁵ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, Digitaal Kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium", COM(2021) 118 final, 9 maart 2021.

- (33) Onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de Unie wordt in toenemende mate blootgesteld aan praktijken die gericht zijn op het misbruik van vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen en beschermde gegevens, zoals diefstal van intellectuele eigendom, gedwongen technologieoverdracht en economische spionage. Om negatieve gevolgen voor de belangen van de Unie en de doelstellingen van het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 te voorkomen, moet een aanpak worden gevolgd die strekt tot bescherming van de toegang tot en het gebruik van commercieel gevoelige informatie of resultaten, met inbegrip van gegevens en knowhow, beveiliging en overdracht van eigendom van resultaten, alsook van door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud die is gegenereerd in verband met of als gevolg van door het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 ondersteunde acties. Om die bescherming te waarborgen, moeten alle door het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0 ondersteunde en door de programma’s Horizon Europa en Digitaal Europa – en door de opvolgers ervan binnen een volgend meerjarig financieel kader – gefinancierde acties voldoen aan de desbetreffende bepalingen van die programma’s, onder meer aan de bepalingen inzake de deelname van in derde landen gevestigde, met het programma geassocieerde entiteiten, subsidieovereenkomsten, eigendom en bescherming, beveiliging, exploitatie en verspreiding, overdracht en licentieverlening, en toegangsrechten. Het is mogelijk om bij de uitvoering van die programma’s specifieke bepalingen vast te stellen, met name wat betreft beperkingen op een overdracht of licentieverlening overeenkomstig artikel 40, lid 4, van Verordening (EU) 2021/695, en beperking van de deelname van juridische entiteiten die gevestigd zijn in specifieke geassocieerde of andere derde landen om redenen gebaseerd op strategische activa, belangen, autonomie of veiligheidsredenen van de Unie en de lidstaten, overeenkomstig artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) 2021/695 en artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/694. Daarnaast moeten de behandeling van commercieel gevoelige informatie, veiligheid, vertrouwelijkheid, bescherming van bedrijfsgeheimen en intellectuele-eigendomsrechten worden geregeld door het Unierecht, met inbegrip van de Richtlijnen (EU) 2004/48 en (EU) 2016/943⁴⁶ van het Europees Parlement en de Raad, en het nationaal recht. De Commissie en de lidstaten kunnen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad technologieoverdrachten beschermen om redenen van Unie- en nationale veiligheidsbelangen in verband met investeringen in faciliteiten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
- (34) Om het gebruik in industriële waardeketens te stimuleren van halfgeleiders die in de Unie zijn ontworpen, in de Unie zijn vervaardigd of beide, is het noodzakelijk om een nauwere koppeling tot stand te brengen tussen het aanbod van halfgeleiders en de vraag van industriële afnemers, met inachtneming van de internationale verplichtingen en mededingingsregels van de Unie. In het bijzonder zou een betere coördinatie tussen aanbieders en gebruikers van halfgeleidertechnologie de vaststelling van de totale vraag en de ontwikkeling van gemeenschappelijke technische vereisten en van op de industriële behoeften van de Unie afgestemde oplossingen faciliteren. Een dergelijke coördinatie is met name relevant in belangrijke sectoren als cloud computing, de automobielenindustrie, de luchtvaart, telecommunicatie, defensie en robotica, die worden gekenmerkt door hoge eisen op het gebied van prestaties, beveiliging, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie, en waar halfgeleiders een sleuteltechnologie

⁴⁶ Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj>).

vormen voor innovatie, digitale transformatie en strategische autonomie. In die sectoren kan een vroegtijdige betrokkenheid van gebruikers in de ontwerp- en ontwikkelingsfase de marktintroductie aanzienlijk versnellen, de systeemintegratie verbeteren en waarborgen dat op halfgeleiders gebaseerde oplossingen geschikt zijn voor het beoogde doel en aansluiten op de constant veranderende industriële normen en operationele beperkingen. Hiertoe moet de Commissie, in samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden, de voorwaarden scheppen die nodig zijn zodat de Alliantie voor halfgeleiders industriële matchmaking, gezamenlijke ontwerpactiviteiten en samenwerkingsinitiatieven kan faciliteren, onder meer via een vraagforum, teneinde de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, innovatie-ecosystemen te bevorderen en de toepassing van op halfgeleiders gebaseerde oplossingen binnen de Unie te versnellen, met inachtneming van de mededingingsregels van de Unie en op een wijze die in overeenstemming is met de internationale verplichtingen van de Unie. Voor halfgeleiders die worden gebruikt in de defensie- en ruimtevaartsector – die zeer gespecialiseerd zijn en betrouwbaar moeten functioneren in extreme en vijandige omgevingen – moet de Commissie de activiteiten binnen het waarnemingscentrum van de EU voor kritieke technologieën voor ruimtevaart en defensie blijven coördineren.

- (35) In de ruimtevaart- en defensiesector zullen de activiteiten die zijn gericht op het in kaart brengen van lacunes, kwetsbaarheden en behoeften worden voortgezet binnen het reeds opgerichte EU-Observatorium voor kritieke technologieën (Observatory of Critical Technologies, OCT). Specifieke technologische EU-routekaarten voor ruimtevaart en defensie, waaronder voor halfgeleiders, die worden opgesteld naar aanleiding van de werkzaamheden van het OCT en betrekking hebben op onderzoek, innovatie en industrialisatie, zullen als input dienen voor het EU-werkprogramma voor ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van ruimtevaart en defensie.
- (36) Het vraagforum moet potentiële afnemers van halfgeleidertechnologieën in staat stellen hun behoeften en verwachte specificaties op geaggregeerd of sectorbreed niveau kenbaar te maken en Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie de mogelijkheid bieden hun technologische capaciteiten en voorgestelde oplossingen te presenteren. Via maatregelen in het kader van de vraagaanijager moeten samenwerkingsplatforms, proefprojecten en ontwerppartnerschappen worden bevorderd, zodat innovatieve op halfgeleiders gebaseerde oplossingen binnen de Unie in een vroeg stadium kunnen worden gevalideerd en ingezet. Deze maatregelen kunnen tevens bijdragen aan de groei van innovatieve ecosystemen en de opkomst van leidende markten in sleutelsectoren bevorderen, zodat het industriële concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit van de Unie worden versterkt. Bij alle activiteiten in het kader van het vraagforum en maatregelen in het kader van de vraagaanijager, moeten het mededingingsrecht van de Unie en andere relevante bepalingen van het Unierecht volledig in acht worden genomen, en eveneens worden gewaarborgd dat samenwerking tussen ondernemingen niet leidt tot concurrentievervalsingen of tot de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie.
- (37) Om een brede invoering in de Unie te bevorderen van systemen waarin geavanceerde halfgeleidertechnologieën zijn geïntegreerd, moeten gerichte maatregelen worden ondersteund ter bevordering van samenwerking en innovatie. Met name door aanbestedende diensten of entiteiten aan te moedigen landsgrensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingsregelingen op te zetten, kan worden bijgedragen aan de bundeling van de vraag en een verminderde marktfragmentatie, en worden efficiëntere

investeringen in complexe en kostbare, op halfgeleiders gebaseerde systemen mogelijk. Tegelijkertijd is het essentieel om de integratie en invoering van innovatieve halfgeleidertechnologieën te ondersteunen teneinde de toepassing ervan in sleutelsectoren, waaronder digitale infrastructuur, artificiële intelligentie en industriële toepassingen, te versnellen en zo de technologische capaciteit en het concurrentievermogen van de Unie te versterken. Om een doeltreffende uitvoering van dergelijke maatregelen te waarborgen, moet de Commissie aanbestedende diensten technische en juridische richtsnoeren aanreiken. Deze richtsnoeren moeten aanbestedende diensten ondersteunen bij de toepassing van criteria inzake leveringszekerheid, cyberbeveiliging, veerkracht, energie-efficiëntie, prestaties gedurende de levenscyclus, transparantie van de toeleveringsketen en meerwaarde van de Unie bij de aanschaf van systemen waarin innovatieve halfgeleiderontwerpen en -oplossingen zijn geïntegreerd, met inachtneming van het toepasselijke Unierecht en internationale verplichtingen. In het bijzonder moeten deze richtsnoeren precommerciële aanbesteding, innovatiepartnerschappen en gezamenlijke aanbestedingsprocedures bevorderen waarmee in een vroeg stadium vraag kan worden gecreëerd naar betrouwbare halfgeleidertechnologieën die in de Unie zijn ontwikkeld, in de Unie zijn geproduceerd of beide.

- (38) Gezien hun belang voor de leveringszekerheid en voor een veerkrachtig halfgeleiderecosysteem, moeten Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie worden beschouwd als zijnde van algemeen belang. Het waarborgen van de leveringszekerheid van halfgeleiders is ook belangrijk voor de digitalisering, die de groene transitie van vele andere sectoren mogelijk maakt. Om investeringen aan te trekken in de halfgeleidersector van de Unie en bij te dragen tot de leveringszekerheid van halfgeleiders en de veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie, kunnen de lidstaten steunmaatregelen toepassen, met inbegrip van stimulansen, en administratieve ondersteuning bieden in nationale vergunningsprocedures voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie. Binnen het meerjarig financieel kader 2028-2034 kunnen plannen voor nationaal en regionaal partnerschap deel uitmaken van de steun, met inachtneming van de bepalingen van die plannen. De mogelijkheid van steun door de lidstaten mag geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Commissie op het gebied van staatssteun uit hoofde van de artikelen 107 en 108 VWEU, indien van toepassing. Om de correcte en efficiënte toepassing van de staatssteunregels te waarborgen, heeft de Commissie in haar mededeling “Een chipverordening voor Europa”⁴⁷, reeds erkend dat er behoefte is aan een beoordeling per geval van staatssteun die wordt verleend aan faciliteiten voor de fabricage van halfgeleiders, teneinde de leveringszekerheid en de veerkracht van de toeleveringsketen van de Unie te waarborgen en tegelijkertijd aanzienlijke positieve gevolgen voor de bredere economie te genereren. Ook moeten de procedures voor de erkenning van Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie en voor de goedkeuring van staatssteun, indien van toepassing, parallel verlopen om het besluitvormingsproces te versnellen. De lidstaten moeten de totstandkoming van Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie stimuleren, overeenkomstig het recht van de Unie. Bij het nemen van steunmaatregelen voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie moeten de lidstaten overwegen niet-discriminerende vereisten vast te stellen met betrekking tot bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en beveiliging, met inbegrip van cyberveiligheid, en

⁴⁷ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een chipverordening voor Europa, COM(2022) 45 final, 8 februari 2022.

vertrouwelijkheid, en zouden ze mitigatiemaatregelen kunnen aanbevelen om specifieke risico's in verband met interferentie, gedwongen technologieoverdracht en diefstal van intellectuele eigendom door entiteiten uit derde landen aan te pakken.

- (39) Om de totstandbrenging van de nodige daarmee verband houdende ontwerpcapaciteiten aan te moedigen, kunnen de lidstaten dergelijke activiteiten ondersteunen overeenkomstig de staatssteunregels, ook uit hoofde van de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie⁴⁸ of Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie⁴⁹.
- (40) Het kan passend zijn om met overheidssteun de ontwikkeling van de nodige fabricage- en bijbehorende ontwerpcapaciteiten te stimuleren, hetgeen dan tevens de leveringszekerheid waarborgt en de veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie versterkt, met dien verstande dat dit niet tot verstoringen op de interne markt leidt. Daartoe moeten bepaalde voorwaarden voor marktdeelnemers die met specifieke projecten willen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, op Unieniveau worden geharmoniseerd, en moet een kader worden vastgesteld voor de erkenning van Europese initiatieven voor halfgeleider technologie.
- (41) Europese initiatieven voor halfgeleider technologie moeten voorzien in capaciteiten die binnen de Unie “pionierscapaciteiten” zijn en bijdragen aan de onontbeerlijke aard, de veerkracht, het welvaren, het concurrentievermogen en de leveringszekerheid van het halfgeleiderecosysteem van de Unie. De bepalende factor om een pioniersinitiatief te zijn is het introduceren van een innovatief element op de interne markt met betrekking tot de fabricageprocessen of het eindproduct, dat kan zijn gebaseerd op nieuwe of bestaande – met inbegrip van rijpe en geavanceerde – technologienodes. Een initiatief dat een innovatie met betrekking tot het fabricageproces of eindproduct inhoudt en dat vergelijkbaar is met een innovatie die reeds bestaat of is gepland in de Unie, kan nog steeds worden erkend als pioniersinitiatief indien kan worden aangetoond dat het initiatief noodzakelijk is om de veerkracht en de leveringszekerheid van de Unie te waarborgen door buitensporige strategische afhankelijkheden van invoer uit derde landen te verminderen. Een dergelijk initiatief moet op zijn eigen merites worden beoordeeld, waarbij bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met relevante marktanalyses, de mate van concentratie van de afhankelijkheden en het risico dat er een situatie van overcapaciteit wordt gecreëerd.
- (42) Relevante innovatieve elementen in een pioniersinitiatief kunnen betrekking hebben op de technologienode of het substraatmateriaal, of op werkwijzen die leiden tot rekenkracht- of andere prestatieverbeteringen, hogere energie-efficiëntie, een hoger niveau van beveiliging, veiligheid of betrouwbaarheid, alsook de integratie van nieuwe functionaliteiten, zoals artificiële intelligentie, geheugencapaciteit of andere. De integratie van verschillende processen die leidt tot efficiëntiewinst of automatisering van behuizing en assemblage is een voorbeeld van innovatie. Wat de winst op milieugebied betreft, zouden innovatieve elementen het op een kwantificeerbare manier verminderen van de gebruikte hoeveelheid energie, water of chemische stoffen, of het verbeteren van de recyclebaarheid omvatten.

⁴⁸ Mededeling van de Commissie – Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (C/2022/7388) (PB C 414 van 28.10.2022, blz. 1).

⁴⁹ Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

- (43) Teneinde te waarborgen dat overheidsinvesteringen in Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de leveringszekerheid en de veerkracht van de Unie, moeten ondernemingen die op grond van deze verordening erkenning of steun aanvragen, aantonen dat ze hun toeleveringsketen zodanig zullen inrichten dat de afhankelijkheid van ondernemingen uit derde landen wordt verminderd. Dergelijke informatie moet, voor zover van toepassing op de activiteiten van het initiatief, onder meer betrekking hebben op de herkomst van de essentiële apparatuur en substraten voor de fabricage van halfgeleiders, alsmede de mate waarin inkoop ervan bij ondernemingen uit derde landen vanwege technische prestatieoverwegingen noodzakelijk is. In het geval van front-end- of back-endfabricage van halfgeleiders moeten ondernemingen tevens aangeven welke andere relevante voorafgaande of navolgende front-end- of back-endfabricageprocessen die verband houden met de investering, binnen en buiten de Unie zullen worden uitgevoerd.
- (44) Om investeringen in de fabricage van halfgeleiders te bevorderen, moeten overheidsinstanties rekening houden met de noodzakelijke randvoorwaarden voor een duurzame exploitatie van dergelijke faciliteiten, met inbegrip van toegang tot energie, water en andere kritieke infrastructuurvoorzieningen. Ter ondersteuning van de veerkracht en duurzaamheid op lange termijn van het halfgeleiderecosysteem in de Unie moet passende aandacht worden besteed aan de verwachte behoefte aan hulpbronnen en de milieueffecten die gepaard gaan met dergelijke investeringen.
- (45) Als een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie productiecapaciteit aanbiedt aan ondernemingen die geen banden hebben met de exploitant van de faciliteit, moet een adequate en doeltreffende functionele scheiding worden vastgesteld, toegepast en gehandhaafd om de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen interne en externe productie te voorkomen. Dat moet voor alle informatie gelden die tijdens het ontwerp en tijdens front-end- of back-endfabricageprocessen wordt verkregen.
- (46) Om te worden aangemerkt als Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie, moet de oprichting van het initiatief door een binnenlandse onderneming op middellange tot lange termijn een duidelijk positief effect hebben op de waardeketen voor halfgeleiders van de Unie, met overloopeffecten die verder reiken dan de betrokken onderneming of lidstaat, door een positieve bijdrage te leveren aan de veerkracht en het concurrentievermogen van en innovatie in het halfgeleiderecosysteem, met inbegrip van de groei van start-ups en kmo's, en aan de tweeledige groene en digitale transitie van de Unie. Daarnaast moet deelname aan het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders ("het Platform") volgens deze zelfde redenering verplicht zijn voor fabricage-installaties – zoals installaties voor front-end- en back-endfabricage, maar bijvoorbeeld ook voor installaties voor de productie van apparatuur, substraten of materialen voor de fabricage van halfgeleiders. Een dergelijke verbintenis draagt bij aan de versterking van de veerkracht en het concurrentievermogen van en innovatie in de toeleveringsketens van het halfgeleiderecosysteem. Voor de kwalificatie als Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie kunnen uiteenlopende activiteiten van binnenlandse ondernemingen in aanmerking worden genomen die zijn gericht op het creëren van positieve overloopeffecten. Het kan hierbij gaan om toegangverlening tot fabricage-installaties tegen een marktconforme vergoeding; verstrekking van Process Design Kits aan kleinere ontwerpbedrijven of aan het virtueel ontwerpplatform; verspreiding van de resultaten van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; onderzoekssamenwerking met Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen;

samenwerking met nationale instanties of instellingen voor onderwijs en beroepsopleiding om bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden; het bijdragen aan Uniebrede onderzoeksprojecten; of het bieden van specifieke ondersteuning aan start-ups en kmo's. Het effect op verschillende lidstaten, ook wat betreft de cohesiedoelstellingen, moet worden beschouwd als een van de indicatoren voor een duidelijk positief effect van een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie op de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie.

- (47) Om juridische duidelijkheid en een consistente toepassing van deze verordening te waarborgen, moeten de voorwaarden worden verduidelijkt op grond waarvan een onderneming kan worden erkend als een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie. Uit de ervaringen met de uitvoering van het kader voor faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen krachtens Verordening (EU) 2023/1781 is gebleken dat het voor ondernemingen en lidstaten niet duidelijk is of faciliteiten voor halfgeleidertechnologie de status alleen kunnen aanvragen indien ze overheidssteun ontvangen. Derhalve moet uitdrukkelijk worden verduidelijkt dat een aanvraag voor een dergelijke status dan wel betrekking moet hebben op een pioniersinitiatief, maar dat de toekenning van de status niet afhankelijk mag worden gesteld van het ontvangen van steunmaatregelen of administratieve bijstand. Pioniersinitiatieven kunnen, mits ze voldoen aan de relevante in deze verordening vastgelegde vereisten, derhalve ook de status van een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie verkrijgen wanneer ze geen overheidsfinanciering ontvangen.
- (48) Het is van belang dat Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie niet zijn onderworpen aan een extraterritoriale toepassing door derde landen van openbaardienstverplichtingen die afbreuk doet aan hun vermogen om het eindproduct te gebruiken of weder uit te voeren dat voortkomt uit de infrastructuur, software, diensten, installaties, activa, middelen, intellectuele eigendom of knowhow die ze nodig hebben om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening, met name degene die verband houden met de leveringszekerheid.
- (49) Via Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie moet met het oog op de snelle ontwikkeling van halfgeleidertechnologieën en de versterking van het toekomstige industriële concurrentievermogen van de Unie, onophoudelijk geïnvesteerd blijven worden in innovatie in de Unie, opdat de halfgeleidertechnologie tastbaar beter wordt en technologie van de volgende generatie wordt voorbereid. In het kader van dergelijke initiatieven moet het mogelijk zijn om nieuwe ontwikkelingen te testen en ermee te experimenteren door middel van preferentiële toegang tot de proeflijnen die uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1781 zijn opgezet voor het “Chips voor Europa”-initiatief en die op basis van versnelde aanvraagprocedures zijn opgezet voor het “Chips voor Europa”-initiatief 2.0. Een dergelijke voorkeurstoegang sluit de daadwerkelijke toegang tot de proeflijnen tegen eerlijke voorwaarden voor andere belangstellende ondernemingen, met name start-ups en kmo's, niet uit, en staat deze niet in de weg. Rekening houdend met het belang van gekwalificeerde en geschoolde arbeidskrachten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, moeten Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie de doorstroming van talent in de Unie ondersteunen door opleidingen op het gebied van onderwijs en vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten en door de pool van gekwalificeerde en geschoolde arbeidskrachten te vergroten.
- (50) Ten behoeve van een uniforme en transparante toekenningsprocedure voor de status van Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie, moet het besluit tot toekenning van deze status door de Commissie worden vastgesteld nadat een onderneming of een

consortium van verschillende ondernemingen een aanvraag heeft ingediend. De status moet ontstaan voor zowel het opzetten van een nieuw initiatief voor de fabricage van halfgeleiders als de aanzienlijke schaalvergroting of de innovatieve transformatie van een bestaand initiatief voor de fabricage voor halfgeleiders. Wegens het belang van een gecoördineerde en gezamenlijke uitvoering van de geplande faciliteit, moet de Commissie bij haar beoordeling in voorkomend geval rekening houden met de bereidwilligheid van een of meer lidstaten waar de aanvrager zijn initiatieven wil opzetten, om de instelling van dergelijke initiatieven te ondersteunen. Voorts zou de Commissie bij de beoordeling van de haalbaarheid van het ondernemingsplan rekening kunnen houden met de algemene staat van dienst van de aanvrager en met de invoering van passende maatregelen om intellectuele eigendom en commercieel gevoelige informatie te beschermen.

- (51) In het licht van de rechten die zijn verbonden aan de status van Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie, moet de Commissie controleren of initiatieven waaraan die status is toegekend, aan de vereisten van deze verordening blijven voldoen. Is dit niet langer het geval, dan moet de Commissie het recht hebben om de status en, dienovereenkomstig, de aan die status verbonden rechten opnieuw te onderzoeken en indien nodig in te trekken. Een besluit om die status in te trekken mag pas worden genomen na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders en moet naar behoren worden gemotiveerd. Derhalve moet de onderneming die een Europees initiatief voor halfgeleidertechnologie exploiteert, proactief om herziening van de duur van de status of uitvoeringsplannen kunnen verzoeken ingeval onvoorziene externe omstandigheden, zoals ernstige verstoringen met directe economische gevolgen voor het erkende initiatief, mogelijk gevolgen hebben voor haar vermogen om aan de toepasselijke criteria te voldoen.
- (52) Om de technologische soevereiniteit, de veerkracht, de onontbeerlijke aard, het concurrentievermogen en het welvaren van de halfgeleidersector van de Unie te versterken, moeten projecten van strategisch belang van binnenlandse ondernemingen in de gehele waardeketen van halfgeleiders in kaart worden gebracht en worden ondersteund. Strategische projecten voor halfgeleiders moeten steun ontvangen uit programma's, fondsen en financiële instrumenten van de Unie, in overeenstemming met de doelstellingen die zijn vastgelegd in de verordening tot instelling van die fondsen en programma's, en onverminderd het volgende meerjarig financieel kader (2028-2034). In het bijzonder moeten aan die strategische projecten het keurmerk worden toegekend voor projecten die bijdragen aan het concurrentievermogen ("concurrentiekeurmerk") indien ze voldoen aan de voorwaarden uit Verordening (EU) 2026/XXX [tot instelling van het Europees Fonds voor concurrentievermogen] (EFC) ([1]), als hoogwaardige projecten die bijdragen aan de doelstelling van het Europees Fonds voor concurrentievermogen. Strategische projecten moeten bijdragen aan doelstellingen van gemeenschappelijk belang van de Unie, het vermogen van de Unie vergroten om geavanceerde halfgeleidertechnologieën te ontwerpen, vervaardigen en integreren, en een aantoonbare duidelijke Uniemeerwaarde en landsgrensoverschrijdende dimensie hebben, met name als resultaat van samenwerking tussen lidstaten of gecoördineerde overheidssteun. Ze moeten bijdragen tot de versterking van de veerkracht en robuustheid van het halfgeleiderecosysteem van de Unie, onder meer door knelpunten weg te nemen, de toeleveringsketens voor halfgeleiders te versterken en innovatie en industriële toepassing te bevorderen. De deelname van innovatieve kmo's en kleine midcap-ondernemingen aan strategische projecten wordt aangemoedigd.

- (53) Strategische projecten en Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie moeten niet alleen gericht kunnen worden op geavanceerde halfgeleidernodes, maar tevens op innovatieve bestaande en rijpe technologienodes, indien dit noodzakelijk is om het concurrentievermogen, de veerkracht en de leveringszekerheid van de Unie op het gebied van strategisch belangrijke halfgeleidertechnologieën en industriële toepassingen te handhaven en versterken. Teneinde te waarborgen dat met strategische projecten daadwerkelijk wordt bijgedragen aan het concurrentievermogen van de Unie op de lange termijn, moet met dergelijke projecten de ontwikkeling of inzet van kritieke capaciteiten, technologieën of vaardigheden binnen de Unie worden bevorderd. Het moet hierbij onder meer en in het bijzonder gaan om activiteiten die strategische afhankelijkheden verminderen en het technologisch leiderschap van de Unie in sleutelsegmenten van de waardeketen voor halfgeleiders versterken, onder meer door in de Unie de randvoorwaarden te scheppen voor kritieke technologieën en capaciteiten of deze te bevorderen of waarborgen.
- (54) Als strategische projecten op meerdere locaties worden uitgevoerd, moeten ze door één enkel consortium worden uitgevoerd en als een geïntegreerde eenheid functioneren, teneinde de samenhang, efficiëntie en doeltreffende coördinatie van activiteiten te waarborgen.
- (55) Gezien de strategische aard van de halfgeleidersector en het belang van de sector voor de veiligheid, moeten passende voorwaarden worden gesteld voor deelname aan strategische projecten. Overeenkomstig artikel 136 van Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad⁵⁰ is het mogelijk de deelname van bepaalde entiteiten te beperken of uit te sluiten wanneer een dergelijke deelname afbreuk doet aan de strategische troeven, belangen, autonomie of veiligheid van de Unie. In de regel moet deelname aan strategische projecten worden beperkt tot in de Unie gevestigde rechtspersonen. Bij wijze van uitzondering en indien dit naar behoren wordt gemotiveerd, kan de deelname echter worden uitgebreid tot in derde landen gevestigde entiteiten, mits een dergelijke deelname voldoet aan de toepasselijke voorwaarden en waarborgen en geen afbreuk doet aan de strategische troeven, belangen, autonomie of veiligheid van de Unie.
- (56) Teneinde flexibiliteit te waarborgen en rekening te kunnen houden met technologische ontwikkelingen en veranderende marktbehoeften, moet bij deze verordening een lijst van indicatieve technologische gebieden voor strategische projecten worden vastgesteld. De bevoegdheid om die lijst te wijzigen moet overeenkomstig artikel 290 VWEU worden gedelegeerd aan de Commissie, zodat deze gebieden kunnen worden bijgewerkt naar aanleiding van voor de halfgeleidersector relevante technologische en marktontwikkelingen. Teneinde een samenhangende en efficiënte inventarisatie en selectie van strategische projecten te waarborgen, moet de Commissie, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders, prioritaire gebieden aanwijzen en een lijst van onderwerpen voor potentiële projecten opstellen. Acties ter ondersteuning van dergelijke projecten moeten, in voorkomend geval, worden uitgevoerd via de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”, overeenkomstig de verordening tot oprichting daarvan en de werkprogramma’s. Om de soevereiniteit van de Unie te vergroten en de leveringszekerheid op het gebied van geavanceerde halfgeleiders te waarborgen, is het wenselijk prioriteit toe te kennen aan de oprichting van een open gieterij voor de fabricage van geavanceerde halfgeleiders binnen de

⁵⁰ Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2024 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

Unie, die, indien relevant, zou moeten functioneren op basis van open toegang voor verschillende gebruikers. Dat strategische project zou kunnen worden aangevuld met andere strategische projecten op gebieden als geheugen, ontwerp en andere halfgeleidertechnologieën.

- (57) De Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” moet via haar werkprogramma maatregelen uitvoeren ter ondersteuning van strategische projecten, onder meer door middel van oproepen tot het indienen van voorstellen in overeenstemming met de toepasselijke regels. Voorstellen moeten worden beoordeeld overeenkomstig de procedures en criteria die zijn vastgelegd in het governancekader van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”. Om efficiëntie te waarborgen en duplicatie van beoordelingen te voorkomen, moet de Commissie zich bij de aanwijzing van strategische projecten baseren op de uitkomst van de door de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” uitgevoerde beoordeling. Projecten die door de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” zijn geselecteerd voor financiering en voldoen aan de in deze verordening neergelegde criteria, moeten in aanmerking komen om te worden aangewezen als strategische projecten.
- (58) De aanwijzing van een project als strategisch project mag geen afbreuk doen aan de uitkomst van in het kader van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” genomen financieringsbesluiten. Projecten die niet zijn geselecteerd voor financiering door de Unie, moeten, mits de aanvrager daarmee instemt, niettemin de status van strategisch project kunnen verkrijgen, in welk geval de rechten en verplichtingen van toepassing zijn die krachtens deze verordening aan die status zijn verbonden. Voorbeelden van dergelijke rechten zijn de opname van strategische projecten in het vraagforum, de mogelijke toekenning van overheidssteun en administratieve ondersteuning, en het verkrijgen van de status “van dwingend algemeen belang” en eventueel de status “van het hoogste nationale belang” in het kader van vergunningsprocedures; en de verplichtingen zijn onder meer degene die ook van toepassing zijn op Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie, zoals deelname aan het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders en de verplichting om als prioritair aangemerkte bestellingen aan te nemen. Voor strategische projecten moeten, mits ze aan de relevante vereisten voldoen, dezelfde rechten en verplichtingen gelden als voor Europese initiatieven voor halfgeleidertechnologie teneinde een samenhangend regelgevingskader te waarborgen en de bijdrage van deze projecten aan de doelstellingen van de Unie voor de halfgeleidersector te maximaliseren. Indien relevant moet in een dergelijke aanwijzing tevens hun status als pioniersinitiatief worden bevestigd en de duur van die status worden bepaald aan de hand van de verwachte looptijd van het project.
- (59) Teneinde te garanderen dat strategische projecten blijven voldoen aan de in deze verordening vastgestelde criteria, moet de Commissie de aanwijzing van een project kunnen intrekken wanneer niet meer wordt voldaan aan die criteria of wanneer de aanwijzing was gebaseerd op onjuiste informatie. Alvorens een dergelijk besluit vast te stellen, moet de Commissie erop toezien dat de betrokken ondernemingen de gelegenheid krijgen om te worden gehoord, overeenkomstig het beginsel van goed bestuur, en moet ze het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders in acht nemen. Wanneer de aanwijzing van een strategisch project wordt ingetrokken, zijn alle rechten en verplichtingen die krachtens deze verordening aan die status zijn verbonden, niet meer van toepassing op het project. Voor dergelijke projecten blijven gedurende een beperkte periode echter specifieke verplichtingen in verband met leveringszekerheid gelden, indien deze verordening daarin voorziet.

- (60) Teneinde vergunningverlening te vereenvoudigen en versnellen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat vergunningen voor Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie via één enkele procedure kunnen worden aangevraagd, waarbij maar één aanvraag hoeft te worden ingediend. Tevens moeten de lidstaten een éénloketsysteem aanwijzen dat fungeert als enig contactpunt voor het project, teneinde een efficiënte, transparante en tijdige afhandeling van aanvragen te faciliteren en coördineren.
- (61) Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie moeten zo snel mogelijk worden opgezet, waarbij de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt. Daarom moeten de lidstaten aanvragen voor de planning, de bouw en de exploitatie van dergelijke faciliteiten zo snel mogelijk behandelen. Teneinde de uitvoering van Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie verder te versnellen, moeten er duidelijke en bindende termijnen worden vastgesteld voor vergunningsprocedures. In het bijzonder mag de totale duur van dergelijke procedures niet langer zijn dan de vastgestelde termijn van 12 maanden vanaf de indiening van een volledige aanvraag, onverminderd door de lidstaten vastgestelde kortere termijnen.
- (62) Gezien de potentiële landsgrensoverschrijdende aard van Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie, moeten de lidstaten alles in het werk te stellen om op het niveau van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de aangewezen éénloketsystemen, doeltreffend samen te werken en te coördineren, teneinde samenhangende en tijdige besluitvormingsprocessen te faciliteren.
- (63) De digitalisering van vergunningsprocedures is essentieel voor het verbeteren van de transparantie, efficiëntie en rechtszekerheid. De lidstaten moeten daarom op nationaal niveau centrale toegangsportalen opzetten waar aanvragers hun aanvragen in een volledig digitale omgeving kunnen indienen en beheren. Door middel van het gebruik van interoperabele digitale oplossingen, waaronder de Europese portemonnee voor ondernemingen, moet een veilige gegevensuitwisseling, hergebruik van bestaande informatie en een naadloze interactie tussen aanvragers en bevoegde autoriteiten worden gefaciliteerd, waarbij een hoog niveau van cyberbeveiliging en gegevensintegriteit moet worden gewaarborgd. Om de transparantie en voorspelbaarheid voor aanvragers te verbeteren, moet via het centrale toegangspuntaal actuele informatie worden verstrekt over de status van aanvragen, de toepasselijke procedures en termijnen, evenals kennisgevingen inzake door de bevoegde autoriteiten genomen besluiten.
- (64) Evenzo moeten de lidstaten, om investeringsbeslissingen te vergemakkelijken en informatieasymmetrieën te verminderen, relevante informatie over vergunningsprocedures, financieringsmogelijkheden, ondersteuningsdiensten voor bedrijven en toepasselijke regelgevingsvereisten op een gecentraliseerde en eenvoudig toegankelijke manier online beschikbaar stellen. Ze moet ook waarborgen dat op passende wijze gebruik wordt gemaakt van bestaande studies, vergunningen en machtigingen met betrekking tot de planning, bouw en exploitatie van Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie, voor zover dit verenigbaar is met het recht van de Unie en het nationale recht, teneinde duplicatie van administratieve procedures te vermijden en vertragingen te beperken. Met het oog op het strategische belang en de tijdgevoeligheid van Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleidertechnologie, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat administratieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot de vergunningverlening als spoedeisend worden behandeld, voor zover en in de mate

waarin het nationale recht voorziet in een dergelijke mogelijkheid, met volledige eerbiediging van de rechten van verdediging en de rechten van de betrokken personen en gemeenschappen.

- (65) Bij Verordening (EU) [202X/XX] van [...] ⁵¹ is een gemeenschappelijk versnellingskader voor milieubeoordelingen vastgesteld om de uitrol van belangrijke technologieën door de Unie te stimuleren, afhankelijkheden te verminderen en het concurrentievermogen te versterken. De procedures in verband met milieubeoordelingen moeten worden versneld en gestroomlijnd voor plannen, programma's en projecten in alle sectoren van de economie, met behoud van een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu. Voor sommige sectoren zijn echter mogelijk nog snellere milieubeoordelingen nodig. Daarom, en om de samenhang van het rechtskader voor milieubeoordelingen te waarborgen en tevens rekening te houden met de extra behoeften aan versnelling in bepaalde strategische sectoren, wordt bij Verordening (EU) [202X/XX] een specifieke toolbox vastgesteld die in het kader van deze verordening moet worden gebruikt. Gezien de essentiële rol die halfgeleider technologieën spelen bij het waarborgen van de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Unie door de invoering van innovatieve, duurzamere technologieën en fabricageprocessen, de integratie van halfgeleiders in klimaatneutrale technologieën en hun bijdrage aan de veerkracht en economische veiligheid van de Unie, moeten Europese initiatieven en strategische projecten voor halfgeleider technologie in de zin van deze verordening eveneens worden beschouwd als strategische projecten in de zin van Verordening (EU) [202X/XX], en derhalve gebruik kunnen maken van de specifieke krachten die verordening ingestelde instrumenten.
- (66) In de halfgeleidersector gedijen ondernemingen in gespecialiseerde lokale districten die investeringen kunnen aantrekken, innovatie kunnen stimuleren en veerkrachtige industriële ecosystemen kunnen ontwikkelen. Regio's en regionale industriële clusters zijn cruciaal voor de ontwikkeling en het faciliteren van de totstandbrenging van dergelijke ecosystemen. Er moet een keurmerk "Europese uitmuntende halfgeleider regio" worden ingesteld dat regio's in de Unie in kaart brengt, erkent en stimuleert die aantonen te beschikken over een gecoördineerde langetermijnstrategie om halfgeleidergerelateerde investeringen en waardeketens voor halfgeleiders te huisvesten, aan te trekken en uit te breiden. Internationale investeerders moeten in een "Europese uitmuntende halfgeleider regio" de ideale omgeving kunnen vinden om halfgeleidergerelateerde activiteiten te ontwikkelen. Een dergelijk keurmerk moet door de Commissie worden toegekend naar aanleiding van een aanvraag door een regionale autoriteit en na beoordeling van de samenhang en geloofwaardigheid van het investeringsplan voor de halfgeleider regio en van het niveau van toewijding van de betrokken autoriteiten, en de aanvraag moet worden bekrachtigd door de betrokken lidstaat teneinde politieke coördinatie tussen verschillende bestuursniveaus te waarborgen.
- (67) Regio's die een aanvraag indienen, moeten een investeringsplan voor de halfgeleider regio opstellen. De in dat plan voorgestelde maatregelen moeten met name betrekking hebben op randvoorwaarden om de fabricage van halfgeleiders te bevorderen, samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, de ontwikkeling van vaardigheden of duurzame infrastructuur, en moeten blijken geven van de bereidheid van de regio om halfgeleidergerelateerde investeringen aan te trekken.

⁵¹ Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het versnellen van milieubeoordelingen (COM/2025/984 final van 10.12.2025).

- (68) Na toekenning van het keurmerk moet de regio toegang krijgen tot nieuwe kansen, onder meer in de vorm van meer solide partnerschappen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, en een grotere aantrekkingskracht voor internationale investeerders die op zoek zijn naar betrouwbare locaties met veel potentieel. Erkende regio's moeten zich kunnen aansluiten bij een netwerk van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's, zodat ze kennis kunnen delen, allianties kunnen smeden en hun impact in de hele Unie kunnen vergroten, en de internationale erkenning van hun strategieën zou bovendien hun reputatie als vooraanstaande bestemmingen voor innovatie en investeringen op het gebied van halfgeleiders versterken.
- (69) Halfgeleiders zijn essentiële componenten die deel uitmaken van infrastructuur, apparatuur en systemen die worden gebruikt door kritieke entiteiten, waaronder degene die onder Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad⁵² vallen. De werking, veiligheid en continuïteit van dergelijke kritieke entiteiten zijn in toenemende mate afhankelijk van de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van halfgeleidercomponenten en van de leveranciers van deze componenten. Om de kwetsbaarheid van de Unie voor verstoringen in de toeleveringsketen en de afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers uit derde landen te verminderen, moeten de transparantie en veerkracht worden vergroot bij de inkoop van halfgeleiders die worden gebruikt in het kader van overheidsopdrachten voor kritieke infrastructuur en diensten. Overheidsopdrachten die vallen onder de Richtlijnen 2014/23/EU⁵³, 2014/24/EU⁵⁴ en 2014/25/EU⁵⁵ van het Europees Parlement en de Raad vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de vraag in de Unie en kunnen een strategische rol spelen bij de bevordering van betrouwbare en veerkrachtige toeleveringsketens voor halfgeleiders. Aanbestedende diensten of aanbestedende instanties—die kritieke infrastructuur aanschaffen, moeten overwegingen inzake leveringszekerheid in het gehele aanbestedingsproces integreren en tevens de meerwaarde in acht nemen die de in de aangeschafte apparatuur of systemen verwerkte halfgeleiders dankzij hun ontwerp- en fabricageproces hebben voor de veerkracht van de toeleveringsketen voor halfgeleiders van de Unie. Dergelijke overwegingen doen geen afbreuk aan de wetgeving van de Unie inzake cyberveiligheid.
- (70) Door aanbestedende diensten en aanbestedende instanties aan te moedigen om bij de inkoop van halfgeleiders van marktdeelnemers te eisen dat ze een verklaring inzake leveringszekerheid overleggen, kan de transparantie in verschillende toeleveringsketens worden vergroot en weloverwogen besluitvorming in aanbestedingsprocedures mogelijk worden gemaakt, terwijl geen onevenredige administratieve lasten worden opgelegd en de aanbestedende diensten en

⁵² Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (NIS 2-Richtlijn) (PB L 333 van 27.12.2022, blz. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁵³ Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

⁵⁴ Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

⁵⁵ Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

aanbestedende instanties de discretionaire bevoegdheid wordt gelaten om al dan niet in alle aanbestedingsprocedures om een dergelijke verklaring te verzoeken. Een dergelijke verklaring moet, indien vereist, essentiële elementen bevatten die een beoordeling mogelijk maken van de robuustheid van de toeleveringsketen, waaronder de vermelding van de betrokken ondernemingen, de diversiteit van leveranciers, de toegevoegde waarde voor de veerkracht van de toeleveringsketen voor halfgeleiders van de Unie, strategieën om de veerkracht te vergroten – bijvoorbeeld door middel van dubbele bevoorrading bij binnenlandse ondernemingen – en beoordelingen van de kwetsbaarheid voor mogelijke verstoringen, alsmede, indien van toepassing, overeenkomstig deze verordening uitgevoerde relevante risicobeoordelingen. Om te waarborgen dat overwegingen inzake veerkracht, veiligheid en toegevoegde waarde voor de Europese toeleveringsketen daadwerkelijk worden geïntegreerd in aanbestedingsbeslissingen, kunnen aanbestedende diensten en aanbestedende instanties in de aanbestedingsdocumenten eisen met betrekking tot leveringszekerheid specificeren voor halfgeleiders die deel uitmaken van de infrastructuur, apparatuur of systemen waarop de overheidsopdracht betrekking heeft. Hiertoe kunnen ze technische specificaties, selectiecriteria, gunningscriteria of bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht opnemen.

Het kader voor overheidsopdrachten dat is vastgesteld bij de Richtlijnen 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2009/81/EG bevat bepalingen die aanbestedende diensten in staat stellen marktdeelnemers uit te sluiten die zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen, relevante informatie hebben achtergehouden of valse of misleidende informatie hebben verstrekt in het kader van hun deelname aan een aanbestedingsprocedure. Die bepalingen blijven van toepassing op aanbestedingsprocedures die worden uitgevoerd door nationale aanbestedende diensten die onder deze verordening vallen.

- (71) In dit verband, en aangezien vrijhandelsovereenkomsten, douane-unies en de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten⁵⁶ verbintenissen bevatten met betrekking tot de toegang tot overheidsopdrachten, moeten ondernemingen uit derde landen die met de Unie dit soort internationale overeenkomsten hebben gesloten die dergelijke toegang waarborgen, worden verondersteld onder de definitie van binnenlandse ondernemingen te vallen. Voorts geven deze internationale overeenkomsten, alsook strategische partnerschappen voor halfgeleiders, blijk van een wederzijdse verbintenis tussen de Unie en haar partners om internationale toeleveringsketens voor halfgeleiders te waarborgen, hetgeen de reden is waarom ondernemingen uit deze partnerlanden van de Unie worden gelijkgesteld met binnenlandse ondernemingen.
- (72) Voor de toepassing van deze verordening moet bij de beoordeling of een onderneming al dan niet als binnenlandse of gelijkwaardige onderneming kan worden aangemerkt, de eigendomsstructuur en de zeggenschap over die onderneming in acht worden genomen. Voor de beoordeling van de zeggenschap moeten ondernemingen worden beschouwd als een onderneming die onder zeggenschap staat van een derde land of van een rechtspersoon uit een derde land, wanneer dat derde land of die rechtspersoon, direct of indirect, doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de strategische beslissingen van de onderneming, waaronder, met name, door het hebben van het recht of het uitoefenen van de bevoegdheid om de meerderheid van de leden van het

⁵⁶ Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>), dat op 6 april 2014 in werking is getreden (PB L 89 van 25.3.2014, blz. 5).

bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van de te beoordelen onderneming te benoemen of te ontslaan; het, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, aangesteld hebben van een meerderheid van de leden van het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de te beoordelen onderneming die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar in functie waren; het op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders van of vennoten in de te beoordelen onderneming, als enige beheersen van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van of vennoten in die te beoordelen onderneming; het hebben van het recht om doorslaggevende invloed uit te oefenen op de te beoordelen onderneming, krachtens een met die te beoordelen onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in haar statuten, voor zover die te beoordelen onderneming volgens het recht dat op haar van toepassing is, aan een dergelijke overeenkomst of bepaling mag worden onderworpen; het hebben van de bevoegdheid om het recht om een doorslaggevende invloed uit te oefenen op de te beoordelen onderneming, de facto uit te oefenen, zonder houder van dat recht te zijn; het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van de te beoordelen onderneming te gebruiken; het op geconsolideerde basis beheren van de te beoordelen onderneming, gepaard gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplichtingen van de te beoordelen onderneming of het garant staan hiervoor.

- (73) Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad⁵⁷ stelt de Unie in staat concessies of andere verplichtingen uit hoofde van internationale handelsovereenkomsten op te schorten of in te trekken naar aanleiding van schendingen door derde landen van internationale handelsregels die de handelsbelangen van de Unie schaden. Elke uitoefening van de rechten van de Unie uit hoofde van Verordening (EU) 2021/167 moet ook tot uiting komen in de uitlegging van de definitie van “binnenlandse onderneming” in het kader van deze verordening.
- (74) Naast de uitdagingen met betrekking tot de leveringszekerheid van halfgeleiders is er steeds meer aandacht gekomen voor cyberbeveiligingsrisico's die gepaard gaan met de inkoop van kritieke infrastructuur, apparatuur of systemen bij bepaalde leveranciers. Dergelijke cyberbeveiligingsrisico's vallen niet onder het toepassingsgebied van de verklaring die door marktdeelnemers wordt overlegd in aanbestedingsprocedures in het kader waarvan halfgeleiders worden geleverd of gebruikt, en vallen onder het toepasselijke wettelijke Uniekader inzake cyberbeveiliging. Niettemin moeten marktdeelnemers waarborgen dat ze de relevante Uniewetgeving inzake cyberbeveiliging naleven en in overeenstemming ermee handelen.
- (75) Gezien de complexiteit en het constant veranderende karakter van toeleveringsketens voor halfgeleiders moet de Commissie, in overleg met de Europese Raad voor Halfgeleiders en belanghebbenden uit de industrie, zo nodig aanbevelingen uitvaardigen waarin specifieke infrastructuur, apparatuur of systemen in kaart worden gebracht waarvoor de veerkracht van de toeleveringsketen van bijzonder belang is met het oog op potentiële risico's in de toeleveringsketen, die door aanbestedende diensten

⁵⁷

Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels en tot wijziging van Verordening (EG) van de Raad nr. 3286/94 tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 50, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj>).

en aanbestedende instanties in aanmerking moeten worden genomen bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures, zodat een consistente uitvoering in de gehele Unie wordt gewaarborgd.

- (76) Om flexibiliteit te waarborgen en aanbestedingsprocedures niet onnodig te beperken, moet het aanbestedende diensten en aanbestedende instanties worden toegestaan om, in naar behoren gemotiveerde gevallen, bijvoorbeeld bij een gebrek aan concurrentie of het ontbreken van geschikte inschrijvers, of wanneer de toepassing van vereisten zou leiden tot onevenredige kosten of technische incompatibiliteit, af te wijken van vereisten, met inbegrip van de vereisten die betrekking hebben op dubbele bevoorrading bij binnenlandse ondernemingen. Dergelijke afwijkingen moeten strikt worden geïnterpreteerd en op transparante wijze worden toegepast, waarbij moet worden gegarandeerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen om de veerkracht van de toeleveringsketen voor halfgeleiders te versterken en de werking van kritieke entiteiten te waarborgen.
- (77) Teneinde een doeltreffende en consistente toepassing te waarborgen van maatregelen voor de versterking van de veerkracht en de leveringszekerheid van halfgeleiders in het kader van overheidsopdrachten, kan de Commissie richtsnoeren verstrekken en de coördinatie tussen relevante actoren bevorderen. Dergelijke richtsnoeren moeten de uitvaardiging aanmoedigen van aanbevelingen waarin infrastructuur, apparatuur of systemen in kaart worden gebracht waarvoor het bijzonder belangrijk is dat halfgeleiders worden geleverd door binnenlandse ondernemingen, evenals de opstelling en beoordeling van verklaringen inzake leveringszekerheid, met inbegrip van elementen die verband houden met het in kaart brengen van de toeleveringsketen, het aandeel van de betrokken binnenlandse ondernemingen, veerkrachtstrategieën als dubbele bevoorrading, en kwetsbaarheids- en risicobeoordelingen. De richtsnoeren moeten tevens de toepassing faciliteren van gemeenschappelijke methoden voor de beoordeling van risico's in toeleveringsketens, met name in sectoren met een verhoogde kwetsbaarheid, en de uitwisseling van beste praktijken en relevante informatie aanmoedigen teneinde een samenhangende aanpak in de gehele Unie te waarborgen en een effectieve werking van de interne markt te bevorderen.
- (78) Teneinde de transparantie te vergroten en de leveringszekerheid van halfgeleiders voor kritieke sectoren te waarborgen, moet, indien de vastgestelde risico's niet naar behoren worden aangepakt, worden voorzien in de mogelijkheid van verdere Uniemaatregelen. Indien de Commissie, na de Europese Raad voor halfgeleiders te hebben geraadpleegd, tot de conclusie komt dat de maatregelen die zijn aanbevolen aan aanbestedende diensten of aanbestedende instanties om dergelijke risico's aan te pakken, ontoereikend zijn, moet ze de bevoegdheid hebben om uitvoeringsbesluiten vast te stellen waarin wordt bepaald welke overheidsinstanties van marktdeelnemers moeten eisen dat ze een verklaring inzake leveringszekerheid indienen, en voor welke procedures en producten.
- (79) In de toeleveringsketen voor halfgeleiders is sprake van verstoringen die bepaalde downstreamsectoren economische schade kunnen berokkenen. Kritieke sectoren die verband houden met de openbare veiligheid, zoals energie, defensie of openbaar bestuur, en sectoren waarin halfgeleiders een groot percentage van de waarde van het eindproduct vertegenwoordigen, zoals de automobiellindustrie, datacentra en industriële automatisering, zijn bijzonder kwetsbaar voor verstoringen in toeleveringsketens voor halfgeleiders. Daarom moet de Commissie deze sectoren kunnen aanmerken als risicovol.

- (80) Om te verduidelijken welke informatie moet worden meegenomen in risicobeoordelingen, moet de Commissie zo nodig methodologische richtsnoeren uitvaardigen inzake de uitvoering van deze beoordelingen, met aandacht voor de ontwikkeling van een strategie voor dubbele bevoorrading, het in kaart brengen van de up- en downstreamsegmenten van toeleveringsketens, kwetsbaarheidsanalyses en analyses van de gevoeligheid voor onderbrekingen in de levering. In dit kader kan de Commissie methodologische aanbevelingen uitvaardigen over de manier waarop risicobeoordelingen voor die sectoren moeten worden uitgevoerd.
- (81) Om een hoge mate van veerkracht van de toeleveringsketen voor halfgeleiders van de Unie te waarborgen, moet worden voorzien in de mogelijkheid van verdere Uniemaatregelen indien de vastgestelde risico's niet naar behoren worden aangepakt. Indien de Commissie, na de Europese Raad voor Halfgeleiders te hebben geraadpleegd, tot de conclusie komt dat de aanbevolen maatregelen om dergelijke risico's aan te pakken ontoereikend zijn, moet ze de bevoegdheid hebben om uitvoeringsbesluiten vast te stellen waarin passende risicobeperkende maatregelen worden gespecificeerd. Dergelijke maatregelen kunnen, indien dat gerechtvaardigd en evenredig is, voorschriften omvatten inzake diversificatie van leveringsbronnen, met inbegrip van dubbele bevoorrading en het aanleggen van strategische voorraden. Deze maatregelen moeten doelgericht en evenredig zijn en rekening houden met de specifieke kenmerken van de betrokken sectoren en ondernemingen en met de noodzaak om de werking van de interne markt te waarborgen en onnodige administratieve lasten te vermijden. De beoordeling van risico's voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders moet worden gebaseerd op objectieve en betrouwbare informatie. In dat kader moet de Commissie onder meer rekening houden met openbaar beschikbare informatie, gegevens die via verzoeken om informatie zijn verzameld en signalen van herhaalde of aanhoudende verstoringen van toeleveringsketens. Aan de hand van dergelijke informatie moet worden gewaarborgd dat alle vastgestelde maatregelen goed onderbouwd en transparant zijn en in verhouding staan tot de vastgestelde risico's, waarbij de vertrouwelijkheid van gevoelige bedrijfsinformatie wordt gewaarborgd.
- (82) Omwille van de leveringscontinuïteit en betrouwbaarheid zijn aanbestedende diensten en aanbestedende instanties bevoegd om marktdeelnemers die deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures of andere procedures voor overheidsfinanciering die betrekking hebben op risicovolle sectoren, te verzoeken om risicobeoordelingen met betrekking tot toeleveringsketens voor halfgeleiders.
- (83) Het doel van een strategische inventarisatie van de halfgeleidersector moet erin bestaan een analyse te verstrekken van de sterke en zwakke punten van de Unie in de mondiale halfgeleidersectoren, teneinde een basis voor maatregelen ter waarborging van de leveringszekerheid en de veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie te verschaffen. Daartoe moet bij het strategisch inventariseren worden vastgesteld welke factoren, zoals belangrijke producten en kritieke infrastructuren op de interne markt, afhankelijk zijn van de levering van halfgeleiders, de belangrijkste verwerkende industrieën en hun huidige en verwachte behoeften, belangrijke segmenten van de toeleveringsketen voor halfgeleiders van de Unie, technologische kenmerken, afhankelijkheid van technologie en leveranciers uit derde landen, en knelpunten in de halfgeleidersector van de Unie, de huidige en verwachte behoeften aan vaardigheden en toegang tot gekwalificeerde arbeidskrachten – voortbouwend op het werk van het in het kader van de vaardighedsunie opgerichte Europees Waarnemingscentrum voor informatie over vaardigheden – en, in voorkomend geval,

het potentiële effect van de maatregelen van het instrumentarium voor noodsituaties. De strategische inventarisatie moet worden gebaseerd op openbaar en commercieel beschikbare gegevens.

- (84) Om voorbereid te zijn op toekomstige verstoringen van de verschillende stadia van de waardeketen voor halfgeleiders en de handel in de Unie, moet de Commissie, bijgestaan door de Europese Raad voor halfgeleiders en op basis van de resultaten van de strategische inventarisatie, een lijst van indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing vaststellen en ontwikkelen. Dergelijke indicatoren kunnen onder meer betrekking hebben op atypische toenames van de aanlooptijd, de beschikbaarheid van de nodige grondstoffen en halffabricaten en het nodige menselijke kapitaal voor de fabricage van halfgeleiders, geschikte productieapparatuur, de voorspelde vraag naar halfgeleiders op de Uniemarkt en de wereldmarkt, prijsstijgingen die normale prijsschommelingen overstijgen, de gevolgen van ongevallen, aanvallen, natuurrampen of andere ernstige gebeurtenissen, het effect van handelsbeleid, tarieven, uitvoerbeperkingen, handelsbelemmeringen en andere handelsgerelateerde maatregelen, en het effect van bedrijfssluitingen, bedrijfsmigratie of overnames van cruciale marktdeelnemers. De monitoringactiviteiten van de Commissie moeten gericht zijn op deze indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing.
- (85) Gezien de complexe, snel evoluerende en onderling verbonden waardeketens voor halfgeleiders met daarin verschillende spelers, is een gecoördineerde benadering van monitoring vereist om de risico's die de levering van halfgeleiders kunnen benadelen, te beperken, en om de dynamiek van de waardeketen voor halfgeleiders beter te begrijpen. De Commissie moet in overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders toezicht houden op de waardeketen voor halfgeleiders, met bijzondere aandacht voor indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing en op basis van de vaststelling van beste praktijken voor risicobeperking en meer transparantie in de waardeketen voor halfgeleiders, op zodanige wijze dat dit geen buitensporige administratieve lasten voor ondernemingen, en met name kmo's en kleine midcap-ondernemingen, met zich meebrengt. Belangwekkende bevindingen, waaronder door belanghebbenden en brancheorganisaties verstrekte informatie, moeten aan de Europese Raad voor halfgeleiders worden verstrekt om de regelmatige uitwisseling van informatie met de raad en de opname van de informatie in een monitoringoverzicht van de waardeketen voor halfgeleiders mogelijk te maken.
- (86) Het Business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders ("het platform") moet een digitaal evenbeeld zijn van de toeleveringsketen voor halfgeleiders en dienen om de transparantie van de toeleveringsketen te vergroten en ondernemingen beter te informeren en op die manier bij te dragen tot hun veerkracht. Het moet een door de industrie geleid initiatief zijn dat deelnemende ondernemingen voordeel oplevert door ze bestendiger te maken tegen verstoringen in de toeleveringsketen voor halfgeleiders en tegen lagere kosten toegang te geven tot marktinformatie. De motivatie voor ondernemingen om zich bij het platform aan te sluiten en hoogwaardige inputgegevens aan te leveren, moet de toegevoegde waarde zijn die ze zelf uit de output van het platform kunnen halen. Dergelijke output kan de vorm aannemen van richtsnoeren van een onafhankelijke derde partij op basis van marktanalyses, geaggregeerde inzichten in de risico's in de toeleveringsketen voor halfgeleiders, resultaten van stresstests voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders, vroegtijdige waarschuwingen en advies inzake proactieve maatregelen, en heeft uitsluitend tot doel het risico in de toeleveringsketen voor halfgeleiders te verminderen. Deelname aan het platform moet ondernemingen aanmoedigen om

proactieve maatregelen te nemen om, zonder tussenkomst van de publieke sector, de veerkracht van hun toeleveringsketen te vergroten. De Commissie is van mening dat de kans kleiner is dat de crisisfase in werking treedt en noodmaatregelen moeten worden getroffen als de particuliere sector proactief en veerkrachtig is.

- (87) De Commissie moet de startfinanciering voor het platform verstrekken via een oproep tot het indienen van voorstellen, en op deze manier de oprichting van het platform ondersteunen en de opstartkosten dekken. Voor deze oproep moet uitsluitend een aantal minimumvereisten worden vastgesteld en moeten geen specifieke technische oplossingen of exacte vereisten inzake gegevensverzameling worden voorgeschreven. De begunstigde van de oproep tot het indienen van voorstellen en de deelnemende ondernemingen moeten op basis van een businesscase een financieringsmodel vaststellen waarmee het platform op middellange termijn zelfvoorzienend kan worden. De waarde en het nut van dit soort platforms kunnen worden afgemeten aan het succes van reeds bestaande, soortgelijke initiatieven op regionaal of internationaal niveau en in andere sectoren.
- (88) Het platform moet zodanig worden ontworpen dat het hoogst mogelijke niveau van vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie en naleving van het mededingingsrecht van de Unie [door het platform] gewaarborgd zijn. Het platform moet in het bijzonder op adequate wijze waarborgen dat de uitwisseling van informatie tussen deelnemende ondernemingen strikt beperkt blijft tot wat objectief noodzakelijk en evenredig is om de in deze verordening vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken, waarbij concurrentieverstorende uitwisseling van commercieel gevoelige informatie tussen concurrenten wordt voorkomen. Derhalve moeten deelnemende ondernemingen uitsluitend toegang krijgen tot hun eigen gegevens en tot geanonimiseerde, geaggregeerde rapporten.
- (89) Bijeenkomsten, besprekingen of informatie-uitwisselingen tussen deelnemende ondernemingen in het kader van het platform moeten beperkt blijven tot hetgeen onontbeerlijk is voor het bereiken van de doelstellingen van het platform en moeten op passende wijze worden gedocumenteerd. De uitwisseling van commercieel gevoelige informatie tussen deelnemers – waaronder informatie met betrekking tot de huidige of toekomstige prijzen, kosten, marges, verkoopvolumes, productieniveaus, capaciteiten of marktaandelen van individuele ondernemingen – moet worden uitgesloten⁵⁸. Het platform moet zodanig functioneren dat de deelnemende ondernemingen hun onafhankelijkheid bij het nemen van zakelijke beslissingen behouden. Deelnemende ondernemingen moeten verantwoordelijk blijven voor de naleving van de mededingingsregels van de Unie en van de lidstaten, met inbegrip van artikel 101 VWEU.
- (90) Het platform moet de deelname van de belangrijkste eindgebruikerssectoren van halfgeleiders sterk aanmoedigen, gezien de aanzienlijke meerwaarde die deze deelname voor hen zal opleveren. De voordelen voor deelnemende ondernemingen in de eindgebruikerssector zouden onder meer kunnen bestaan uit het verkrijgen van steeds meer inzicht in de risico's binnen hun eigen toeleveringsketen voor halfgeleiders, waardoor zij in staat worden gesteld proactieve maatregelen te nemen op het gebied van het beheer van die toeleveringsketen. De lijst met de belangrijkste eindgebruikerssectoren van halfgeleiders moet de huidige sectoren weergeven die

⁵⁸ Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 van de richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (horizontale richtsnoeren).

halfgeleiders aanschaffen om hun producten te vervaardigen, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect via de componenten daarvan. Aanbieders van diensten op het gebied van de productie van elektronica en distributeurs moeten in de lijst worden opgenomen vanwege de belangrijke rol die zij spelen in het halfgeleiderecosysteem van de Unie.

- (91) In het belang van de overheidssector en om een snelle informatiestroom te waarborgen in geval van verstoringen van de toeleveringsketen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten een actuele contactlijst bijhouden van de relevante op hun nationale grondgebied gevestigde ondernemingen die actief zijn in de toeleveringsketen voor halfgeleiders. Aan de hand van die lijst moeten geschikte personen kunnen worden gevonden om vrijwillige verzoeken om informatie te beantwoorden. De lijst hoeft niet uitputtend te zijn en moet worden behandeld met volledige inachtneming van de toepasselijke vertrouwelijkheidsregels.
- (92) Een aantal ondernemingen die halfgeleiderdiensten of -goederen leveren, wordt geacht essentieel te zijn voor een doeltreffende toeleveringsketen voor halfgeleiders in het ecosysteem voor halfgeleiders in de Unie wegens het aantal ondernemingen in de Unie dat van hun producten afhankelijk is, hun marktaandeel in de Unie of op de wereldmarkt, hun belang om een toereikend leveringsniveau te waarborgen of de mogelijke gevolgen van een verstoorde levering van hun producten of diensten. De lidstaten moeten die cruciale marktspelers op hun grondgebieden in samenwerking met de Commissie in kaart brengen en een actuele lijst daarvan bijhouden. In het kader van de monitoring moeten de lidstaten specifiek oog hebben voor de integriteit van de activiteiten van cruciale marktspelers. Dergelijke kwesties zouden door de betrokken lidstaat onder de aandacht van de Europese Raad voor halfgeleiders kunnen worden gebracht.
- (93) Om te kunnen anticiperen op potentiële tekorten, moeten de nationale bevoegde instanties de Commissie inlichten als zij kennis krijgen van een risico op ernstige verstoring van de levering van halfgeleiders of als zij beschikken over concrete en betrouwbare informatie over andere desbetreffende risicofactoren of gebeurtenissen die zich voordoen. Met het oog op een gecoördineerde aanpak moet de Commissie, wanneer zij kennis krijgt van een risico van ernstige verstoring van de levering van halfgeleiders of beschikt over concrete of betrouwbare informatie over andere desbetreffende risicofactoren of gebeurtenissen die zich voordoen, na waarschuwing of van internationale partners, een buitengewone vergadering van de Europese Raad voor halfgeleiders bijeenroepen om de ernst van de verstoringen en het eventueel inleiden van de procedure voor het activeren van de crisisfase te bespreken, en na te gaan of het passend, noodzakelijk en evenredig kan zijn dat de lidstaten als preventieve maatregel gecoördineerde gezamenlijke aanbestedingen doen, en een dialoog aangaan met belanghebbenden voor de vaststelling, voorbereiding en mogelijke coördinatie van dergelijke preventieve maatregelen. De Europese Raad voor halfgeleiders en de Commissie moeten in het kader van die dialoog rekening houden met de standpunten van belanghebbenden in de waardeketen voor halfgeleiders. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie adviseren over de vraag of er een preventief verzoek om informatie aan het platform moet worden gericht. De Commissie moet overleggen en samenwerken met betrokken derde landen om verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders gezamenlijk aan te pakken, met inachtneming van de internationale verplichtingen.
- (94) Nadat de Commissie advies heeft ontvangen van de Europese Raad voor halfgeleiders, moet zij verzoeken om informatie kunnen richten tot ondernemingen en tot het platform. Zoals is gebleken uit eerdere ervaringen met diverse verstoringen van de

toeleveringsketen en uit de problemen bij het verkrijgen van de benodigde informatie om deze verstoringen het hoofd te bieden, dienen preventieve verzoeken om informatie in de waarschuwingsfase ertoe om verstoringen van de toeleveringsketen adequaat aan te pakken voordat de crisisfase wordt geactiveerd en om input te leveren voor nauwkeurige beoordelingen van een mogelijke halfgeleidercrisis.

- (95) Ondernemingen die actief deelnemen aan het platform, moeten worden geacht te hebben voldaan aan hun verplichting om informatie met de Commissie te delen in gevallen van verstoringen van de toeleveringsketen en moeten derhalve worden vrijgesteld van het rechtstreeks ontvangen van een verzoek om informatie vóór de crisisfase. Door actief deel te nemen aan het platform tonen deze ondernemingen aan dat zij zich sterk inzetten om de risico's in hun toeleveringsketen proactief te verminderen. Ondernemingen die actief deelnemen aan het platform moeten derhalve worden beschermd tegen de mogelijke extra administratieve lasten die voortvloeien uit hun verplichting om te reageren op verzoeken om informatie van de Commissie. De Commissie moet de belangrijkste bevindingen uit de antwoorden op verzoeken om informatie die vóór de crisisfase zijn ontvangen zonder onnodige vertraging aan de Europese Raad voor halfgeleiders rapporteren. Om de aan het platform deelnemende ondernemingen te beschermen tegen ongewenste buitenlandse invloed en om bedrijfsgeheimen te beschermen, moet het platform worden verboden om te reageren op verzoeken om informatie, met uitzondering van verzoeken van de Commissie, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van het recht van de Unie of het nationale recht.
- (96) De crisisfase moet worden geactiveerd als er concrete, ernstige en betrouwbare aanwijzingen voor een halfgeleidercrisis zijn. Een halfgeleidercrisis doet zich voor in het geval van ernstige verstoringen bij de levering van halfgeleiders of ernstige belemmeringen voor de handel in halfgeleiders binnen de Unie die leiden tot aanzienlijke tekorten aan halfgeleiders, halffabricaten of grondstoffen of verwerkte materialen, en dergelijke aanzienlijke tekorten verhinderen de levering, reparatie en onderhoud van essentiële producten die door kritieke sectoren worden gebruikt, zoals medische en diagnostische apparatuur, voor zover een dergelijke crisis ernstige nadelige gevolgen zou hebben voor de werking van de kritieke sectoren als gevolg van hun impact op de samenleving, de economie en de veiligheid van de Unie.
- (97) Om een flexibele en doeltreffende respons op een dergelijke halfgeleidercrisis te waarborgen, moet de Commissie, indien zij kennis krijgt van een potentiële halfgeleidercrisis, beoordelen of aan de voorwaarden voor activering van de crisisfase is voldaan. Indien deze beoordeling concrete, ernstige en betrouwbare aanwijzingen voor een halfgeleidercrisis oplevert, moet de Commissie bij de Raad een voorstel kunnen indienen om de crisisfase te activeren voor een vooraf bepaalde periode van maximaal twaalf maanden, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders. De Commissie moet oordelen of de crisisfase moet worden verlengd of vroegtijdig worden beëindigd, en als dat het geval is, een dergelijke procedure inleiden, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders.
- (98) De synergieën tussen de mechanismen ter waarborging van de leveringszekerheid die zijn ingesteld krachtens hoofdstuk VII van Verordening (EU) 2025/2643 en deze verordening moeten de defensiesector van de Unie de nodige flexibiliteit en handelingsruimte bieden om te reageren en de leveringszekerheid te waarborgen. Met name de mogelijkheid voor de Commissie om op grond van deze verordening en op grond van hoofdstuk VII van Verordening (EU) 2025/2643 voorrang te geven aan

defensieproductie in het kader van de bepalingen inzake als prioritair aangemerkte bestellingen van beide verordeningen, moet verstoringen van de toeleveringsketen in de defensiesector tijdens een crisis tot een minimum beperken.

- (99) Aangezien activering van de crisisfase en mogelijke naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen gevoelige materie zijn, onder meer gezien de mogelijk aanzienlijke gevolgen van dergelijke maatregelen voor private ondernemingen in de Unie, moet aan de Raad de bevoegdheid worden verleend om ingeval van een halfgeleidercrisis een uitvoeringshandeling vast te stellen tot activering, verlenging en beëindiging van de crisisfase.
- (100) Nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten en coördinatie van alle nationale maatregelen die met betrekking tot de toeleveringsketen van halfgeleiders worden getroffen, zijn onontbeerlijk om tijdens de crisisfase verstoringen met de nodige samenhang, veerkracht en doeltreffendheid aan te pakken. Indien nodig moet de Europese Raad voor halfgeleiders daartoe buitengewone vergaderingen houden. De getroffen maatregelen moeten strikt beperkt blijven tot de duur van de crisisfase.
- (101) Met het oog op een snelle, efficiënte en gecoördineerde respons van de Unie op een halfgeleidercrisis is het noodzakelijk om de Commissie en de lidstaten via de Europese Raad voor halfgeleiders tijdig actuele informatie te bezorgen over de zich ontwikkelende operationele situatie en te waarborgen dat doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om de levering van halfgeleiders aan de getroffen kritieke sectoren veilig te stellen. Als de crisisfase wordt geactiveerd, moeten passende, doeltreffende en evenredige maatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd, zonder afbreuk te doen aan mogelijke verdere internationale contacten met relevante partners om de veranderende crisissituatie op te vangen. Indien nodig moet de Commissie ondernemingen in de toeleveringsketen van halfgeleiders om informatie verzoeken. Voorts moet de Commissie, waar nodig en evenredig, van Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie kunnen eisen dat zij een bestelling voor de productie van in een crisis relevante producten aanvaarden en prioriteren, en kunnen optreden als aankoopcentrale als de lidstaten daartoe de opdracht geven. De Commissie moet die maatregelen beperken tot bepaalde kritieke sectoren. De Europese Raad voor halfgeleiders kan ook passende en doeltreffende maatregelen beoordelen en daarover advies uitbrengen. Daarnaast kan de Europese Raad voor halfgeleiders advies uitbrengen over de noodzaak om beschermende maatregelen uit te vaardigen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad⁵⁹. Het gebruik van al die noodmaatregelen moet evenredig zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om de halfgeleidercrisis aan te pakken in het belang van de Unie. De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad regelmatig informeren over de getroffen maatregelen en de onderliggende redenen. De Commissie kan, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, nadere richtsnoeren verstrekken over de invoering en de toepassing van noodmaatregelen.
- (102) Sommige sectoren zijn cruciaal voor de goede werking van de interne markt. Voor de toepassing van deze verordening moeten die kritieke sectoren in een lijst in een bijlage bij deze verordening worden opgenomen. Die lijst moet worden beperkt tot de sectoren en subsectoren die zijn opgenomen in de bijlage bij Richtlijn (EU) 2022/2557

⁵⁹ Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (codificatie) (PB L 83 van 27.3.2015, blz. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/479/oj>).

van het Europees Parlement en de Raad⁶⁰, met toevoeging van de sectoren defensie en veiligheid op basis van hun belangrijke rol voor het waarborgen van vitale maatschappelijke functies. Bepaalde maatregelen mogen alleen worden vastgesteld om de levering aan kritieke sectoren veilig te stellen. De Commissie kan de noodmaatregelen beperken tot een aantal van die sectoren of tot bepaalde delen daarvan als de halfgeleidercrisis de werking ervan heeft verstoord of dreigt te verstoren.

- (103) Doel van het verzoek om informatieverstrekking door in de Unie gevestigde ondernemingen in de toeleveringsketen voor halfgeleiders tijdens de crisisfase, is de halfgeleidercrisis nauwkeurig te kunnen analyseren of mogelijke beperkende of noodmaatregelen op nationaal of Unieniveau vast te stellen en voor te bereiden. Het kan gaan om informatie over productievermogen, productiecapaciteit, primaire verstoringen en knelpunten. Die aspecten kunnen onder meer betrekking hebben op de typische en actuele voorraad van in een crisis relevante producten in fabricagefaciliteiten in de Unie alsmede fabricagefaciliteiten in derde landen waarin die ondernemingen opereren, waarmee zij contracten afsluiten of waaruit zij voorraden aankopen, de typische en actuele gemiddelde aanlooptijd voor de meest gangbare gefabriceerde producten; de verwachte productie voor de volgende drie maanden voor elke fabricagefaciliteit in de Unie of redenen die het benutten van de volledige productiecapaciteit in de weg staan. Dergelijke informatie moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om een analyse te kunnen maken van de aard van de halfgeleidercrisis of van mogelijke beperkende of noodmaatregelen op Unieniveau of nationaal niveau. Verzoeken om informatie mogen niet ertoe leiden dat informatie wordt verstrekt waarvan de openbaarmaking strijdig is met de nationale veiligheidsbelangen van de lidstaten. Welke informatie er concreet opgevraagd moet worden, kan worden bepaald aan de hand van eerdere antwoorden op verzoeken om informatie die vóór de crisisfase zijn ingediend of op basis van advies van een representatief aantal relevante ondernemingen dat zich vrijwillig laat raadplegen, in samenwerking met de Europese Raad voor halfgeleiders. Elk verzoek moet evenredig zijn en rekening houden met de legitieme doelstellingen van de onderneming en de nodige kosten en inspanningen om de gegevens beschikbaar te stellen; er moet een passende termijn worden vastgesteld voor het verstrekken van de informatie. Ondernemingen moeten worden verplicht om aan het verzoek te voldoen en kunnen worden beboet als zij dat niet doen of foute informatie verstrekken. De verkregen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de toepassing van deze verordening en valt onder de geheimhoudingsregels. Teneinde de lidstaat waar de onderneming zijn productielocatie heeft ten volle te betrekken, doet de Commissie onverwijld een kopie van het verzoek om informatie toekomen aan de nationale bevoegde instantie en deelt zij, indien die instantie daarom verzoekt, de verkregen informatie op beveiligde wijze met die bevoegde instantie. Als een onderneming een verzoek ontvangt om informatie over haar halfgeleideractiviteiten vanuit een derde land, moet zij de Commissie daarvan in kennis stellen, opdat de Commissie kan beoordelen of een verzoek om informatie door de Commissie gerechtvaardigd is.
- (104) Als laatste middel om te waarborgen dat kritieke sectoren tijdens een crisis kunnen blijven opereren en uitsluitend als dit daartoe noodzakelijk en evenredig is, kunnen Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie door de Commissie

⁶⁰ Richtlijn (EU) 2022/2557 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten en tot intrekking van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad (PB L 333 van 27.12.2022, blz. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

kunnen worden verplicht om bestellingen van in een crisis relevante producten te aanvaarden en voorrang te geven. Als prioritair aangemerkte bestellingen moeten bestemd zijn voor entiteiten uit kritieke sectoren of voor ondernemingen die leveren aan kritieke sectoren waarvan de activiteiten als gevolg van het tekort verstoord zijn of verstoord dreigen te worden. Om ervoor te zorgen dat als prioritair aangemerkte bestellingen uitsluitend daar gebruikt worden waar ze nodig zijn, moeten ze uitsluitend bestemd worden voor begunstigden die, na risicobeperkende maatregelen te hebben getroffen, niet in staat waren om bijvoorbeeld via hun aanbestedingspraktijken de gevolgen van het tekort te voorkomen of het met andere middelen, zoals het aanspreken van bestaande voorraden, te beperken. De verplichting om bestellingen van in een crisis relevante producten te aanvaarden en te prioriteren, kan ook worden uitgebreid tot strategische projecten en fabricagefaciliteiten voor halfgeleiders die in het kader van door hen ontvangen overheidssteun van een dergelijke mogelijkheid gebruikgemaakt hebben, indien die overheidssteun bedoeld is om het vermogen om de productiecapaciteit op te voeren, te vergroten. Het besluit over een als prioritair aangemerkte bestelling moet worden genomen overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke verplichtingen van de Unie, rekening houdend met de omstandigheden van het geval. De verplichting moet voorrang krijgen op elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke prestatieverplichting, maar er moet rekening worden gehouden met de legitieme doelstellingen van de ondernemingen en met de nodige kosten en inspanningen voor elke verandering in de productiesequentie. Elke als prioritair aangemerkte bestelling moet tegen een eerlijke en redelijke prijs worden geplaatst. Die prijs kan worden berekend op basis van de gemiddelde marktprijzen in de afgelopen jaren, mits eventuele verhogingen worden gemotiveerd, bijvoorbeeld rekening houdend met inflatie of stijgende energiekosten. Ondernemingen kunnen aan sancties worden onderworpen als zij de verplichting om als prioritair aangemerkte bestellingen te aanvaarden, niet nakomen.

- (105) Het kan voor de Commissie, bijgestaan door de Europese Raad voor halfgeleiders en de lidstaten nuttig zijn om ingeval van faciliteiten die een als prioritair aangemerkte bestelling uitvoeren, ten aanzien van de uitvoering van die bestelling beste praktijken uit te wisselen, waaronder beste administratieve praktijken.
- (106) De onderneming in kwestie moet worden verplicht om een als prioritair aangemerkte bestelling te aanvaarden en daaraan voorrang te geven. Om ervoor te zorgen dat als prioritair aangemerkte bestellingen aansluiten op de capaciteiten en de productieportefeuille van de faciliteit, moet de Commissie deze de gelegenheid bieden zich over de haalbaarheid en de details van de als prioritair aangemerkte bestelling uit te spreken. De Commissie mag als prioritair aangemerkte bestellingen niet plaatsen ingeval de faciliteit wegens gebrek aan productievermogen of productiecapaciteit of om technische redenen de bestelling niet produceren kan, ook niet als die geprioriteerd wordt, of ingeval de faciliteit het product niet levert of de dienst niet verricht, of omdat de bestelling een onredelijke economische last zou betekenen voor de onderneming, bijvoorbeeld in de vorm van een substantieel risico voor de bedrijfscontinuïteit.
- (107) De Commissie moet ten behoeve van een transparant en duidelijk uitvoeringskader voor als prioritair aangemerkte bestellingen, de bevoegdheid krijgen een uitvoeringshandeling vast te stellen met praktische en operationele regelingen voor de uitvoering van als prioritair aangemerkte bestellingen. Die uitvoeringshandeling moet waarborgen bevatten voor de naleving van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid bij de uitvoering van als prioritair aangemerkte bestellingen, zoals een mechanisme dat rekening houdt met bestaande bestellingen en een mechanisme

waardoor de volumes aan als prioritair aangemerkte bestellingen niet onnodig groot worden.

- (108) In de uitzonderlijke omstandigheid dat een onderneming in de toeleveringsketen voor halfgeleiders in de Unie een als prioritair aangemerkte bestelling krijgt vanuit een derde land, moet zij de Commissie daarvan in kennis stellen zodat kan worden beoordeeld of, indien sprake is van aanzienlijke gevolgen voor de leveringszekerheid in kritieke sectoren en er aan de andere vereisten inzake noodzakelijkheid, evenredigheid en wettigheid is voldaan, de Commissie eveneens een verplichting tot het uitvoeren van een als prioritair aangemerkte bestelling moet opleggen.
- (109) Gezien het belang van de leveringszekerheid voor kritieke sectoren die cruciale maatschappelijke functies vervullen, mag de naleving van de verplichting om een als prioritair aangemerkte bestelling uit te voeren, geen aansprakelijkheid voor schade jegens derden inhouden voor inbreuken op contractuele verplichtingen die het gevolg kunnen zijn van de noodzakelijke tijdelijke wijziging van de operationele processen van de desbetreffende fabrikant, beperkt tot de mate waarin de inbreuk op de contractuele verplichtingen noodzakelijk was om aan de opgelegde prioriteit te voldoen. Ondernemingen die voor een als prioritair aangemerkte bestelling in aanmerking komen, moeten in de voorwaarden van hun commerciële contracten op die mogelijkheid anticiperen. Onverminderd de toepasselijkheid van andere bepalingen moet deze ontheffing van aansprakelijkheid de in Richtlijn 85/374/EEG van de Raad⁶¹ bepaalde aansprakelijkheid voor producten met gebreken, onverlet laten. Overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”) eerbiedigt de verplichting om voorrang te geven aan de productie van bepaalde producten de wezenlijke inhoud van de in artikel 16 van het Handvest vastgelegde vrijheid van ondernemerschap en contractvrijheid en het in artikel 17 van het Handvest vastgelegde recht op eigendom.
- (110) Als de crisisfase wordt geactiveerd en ter waarborging van de leveringszekerheid voor kritieke sectoren die vitale maatschappelijke functies vervullen, kunnen twee of meer lidstaten de Commissie de opdracht geven de vraag te bundelen en namens hen op te treden voor overheidsopdrachten in het algemeen belang, overeenkomstig de bestaande regels en procedures van de Unie, en zo haar koopkracht benutten. Gemeenschappelijke aankopen mogen alleen worden gebruikt om iets te doen tegen verstoringen van de toeleveringsketen van halfgeleiders tijdens een crisis. De opdracht kan de Commissie machtigen om overeenkomsten te sluiten voor de aankoop van in een crisis relevante producten voor bepaalde kritieke sectoren. De Commissie moet in overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders voor elk verzoek het nut, de noodzaak en de evenredigheid beoordelen. Als de Commissie niet van plan is het verzoek in te willigen, moet zij de betrokken lidstaten en de Europese Raad voor halfgeleiders daarvan in kennis stellen en de redenen daarvoor vermelden. De procedurele details moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de Commissie en de deelnemende lidstaten, met inbegrip van de redenen voor de toepassing van het mechanisme voor gezamenlijke aankoop en de verbintenissen die worden aangegaan. Een dergelijke overeenkomst kan het aantal te sluiten contracten bevatten en de voorwaarden voor de gemeenschappelijke aankopen, zoals prijzen, leveringstermijnen, hoeveelheden, en opt-in- of opt-out-clausules. Voor de gemeenschappelijke aankopen kan ofwel één enkel contract worden ondertekend dat

⁶¹ Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1985/374/oj>).

de behoeften van alle lidstaten dekt, ofwel meerdere contracten die elk in de behoeften van een of meer lidstaten voorzien. Voorts moeten de deelnemende lidstaten het recht hebben vertegenwoordigers aan te wijzen om richtsnoeren en advies te verstrekken tijdens de aanbestedingsprocedures en de onderhandelingen over de aankoopovereenkomsten. De uitrol, het gebruik en de doorverkoop van aangekochte producten moeten onder de bevoegdheid van de deelnemende lidstaten blijven.

- (111) Tijdens een crisis door een tekort aan halfgeleiders kan het noodzakelijk worden dat de Unie beschermende maatregelen overweegt. De Europese Raad voor halfgeleiders moet zijn standpunt kenbaar kunnen maken ter onderbouwing van de beoordeling door de Commissie van de vraag of de marktsituatie een aanzienlijk tekort aan essentiële producten inhoudt op grond van Verordening (EU) 2015/479.
- (112) Onverminderd deze verordening moet voor de Europese Raad voor halfgeleiders het institutionele kader voor deskundigengroepen gelden, waaronder de regels inzake transparantie voor de entiteit en haar subgroepen. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie adviseren en bijstaan met betrekking tot de ontwikkeling van een alomvattend beleid inzake halfgeleiders en bij specifieke technische kwesties. Tot die kwesties kunnen behoren het verstrekken van advies over het initiatief Chips voor Europa 2.0 aan de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”; het uitwisselen van informatie over de werking van Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie; het bespreken en voorbereiden van de identificatie van specifieke sectoren en technologieën met een potentieel groot maatschappelijk effect en van de veiligheidsbelangen waarvoor een certificering voor betrouwbare producten nodig is, en het aanpakken van gecoördineerde monitoring en crisisrespons. Voorts moet de Europese Raad voor halfgeleiders de consistente toepassing van deze verordening waarborgen, en de samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van informatie over kwesties in verband met deze verordening vergemakkelijken. Ook moet de Europese Raad voor halfgeleiders, met passende betrokkenheid van belanghebbenden, van gedachten wisselen met de Commissie over de vraag hoe met betrekking tot de halfgeleidersector het best gezorgd kan worden voor een doeltreffende bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie ondersteunen bij internationale samenwerking in overeenstemming met internationale verplichtingen. Hij moet dienen als forum voor de coördinatie van het nationale beleid inzake halfgeleiders en de daarmee samenhangende investeringen, internationale samenwerking en de wijze waarop de samenwerking in de mondiale waardeketen voor halfgeleiders kan worden versterkt, met name door de nadruk te leggen op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en programma's voor de uitwisseling van vaardigheden, onverminderd de prerogatieven van het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig de Verdragen. Daartoe moet de Europese Raad voor halfgeleiders rekening houden met de standpunten van de industriële alliantie voor halfgeleiders en andere belanghebbenden. Daarnaast moet die Raad coördineren, samenwerken en informatie uitwisselen met andere structuren voor crisisrespons en crisisparaatheid van de Unie met het oog op een coherente en gecoördineerde aanpak van de Unie met betrekking tot crisisrespons- en crisisparaatheidsmaatregelen voor halfgeleidercrises.
- (113) De Europese Raad voor halfgeleiders moet worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Elke lidstaat moet één vertegenwoordiger op hoog niveau en één vervanger in de Europese Raad voor halfgeleiders benoemen. De

lidstaten kunnen ook maximaal drie technische vertegenwoordigers voor de verschillende taken van de Europese Raad voor halfgeleiders benoemen, afhankelijk van bijvoorbeeld welk deel van deze verordening op een vergadering van de Europese Raad voor halfgeleiders wordt besproken. De lidstaten moeten streven naar een effectieve en efficiënte samenwerking in de Europese Raad voor halfgeleiders. De lidstaten moeten een centraal contactpunt aanwijzen om te zorgen voor betrouwbare en tijdige uitwisseling van informatie over de werking van de Europese Raad voor halfgeleiders. Voor het inwinnen van belangrijk advies over de activiteiten van de Europese Raad voor halfgeleiders en voor een passende betrokkenheid van belanghebbenden, moet de voorzitter subgroepen kunnen oprichten en moet hij of zij het recht hebben werkafspraken te maken door deskundigen en waarnemers uit te nodigen die op ad-hocbasis aan de vergaderingen deelnemen, of om in zijn subgroepen belanghebbenden, en dan met name organisaties die de belangen van de halfgeleiderindustrie van de Unie vertegenwoordigen, zoals de industriële alliantie voor halfgeleiders, uit te nodigen als waarnemers.

- (114) De voorzitter moet uitwisselingen tussen de Europese Raad voor halfgeleiders en andere organen, bureaus, agentschappen en deskundigen- en adviesgroepen van de Unie kunnen faciliteren. Gezien het belang van de levering van halfgeleiders voor andere sectoren en de daaruit voortvloeiende behoefte aan coördinatie, moet de voorzitter ervoor zorgen dat andere instellingen en organen van de Unie als waarnemers deelnemen aan de vergaderingen van de Europese Raad voor halfgeleiders waar dat relevant en passend is in verband met het bij deze verordening ingestelde monitoring- en crisisresponsmechanisme.
- (115) De lidstaten moeten een belangrijke rol spelen bij de toepassing en handhaving van deze verordening. In dat verband moet elke lidstaat een of meer nationale bevoegde instanties aanwijzen die verantwoordelijk is of zijn voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening en ervoor zorgen dat die autoriteiten over voldoende bevoegdheden en middelen beschikken. De lidstaten kunnen een of meer bestaande autoriteiten aanwijzen. Om de efficiëntie van de organisatie in de lidstaten te vergroten en een officieel contactpunt in te stellen voor het publiek en andere tegenhangers op het niveau van de Unie en de lidstaten, met inbegrip van de Commissie en de Europese Raad voor halfgeleiders, moet elke lidstaat onder de instanties die hij uit hoofde van deze verordening als bevoegde instantie aanwijst, één nationaal contactpunt aanwijzen dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van kwesties in verband met deze verordening en voor landsgrensoverschrijdende samenwerking met bevoegde instanties van andere lidstaten.
- (116) De Unie moet zich inspannen om strategische partnerschappen voor halfgeleiders aan te gaan met gevestigde of opkomende internationale partners, teneinde de leveringszekerheid van de Unie en de samenwerking in de hele waardeketen voor halfgeleiders te verbeteren. Deze partnerschappen moeten er tevens naar streven het tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van halfgeleiders in de Unie aan te pakken door nieuw talent aan te trekken, in te zetten en binnen de Unie te houden. Voor partners waarmee de Unie via een digitaal partnerschap, handels- en technologieraad of digitale dialoog samenwerkt op het gebied van halfgeleiders, moet het strategisch partnerschap voor halfgeleiders de politieke koers en prioriteiten weerspiegelen die in die fora zijn overeengekomen.
- (117) Om een samenhangend kader te ontwikkelen en te waarborgen voor het aangaan van toekomstige strategische partnerschappen voor halfgeleiders, moeten de lidstaten en de Commissie, in het kader van hun samenwerking binnen de Europese Raad voor

halfgeleiders, onder meer bespreken of de beoogde doelstellingen met de bestaande partnerschappen worden verwezenlijkt, welke prioriteit aan partners moet worden toegekend bij het aangaan van nieuwe partnerschappen, wat de inhoud van dergelijke partnerschappen is en in hoeverre deze aansluiten bij en synergieën kunnen opleveren met andere kaders voor internationale samenwerking van de Commissie en met de bilaterale samenwerking van de lidstaten met relevante internationale strategische partners. Dit moet plaatsvinden onverminderd de prerogatieven van de Raad overeenkomstig de Verdragen. De Unie moet streven naar wederzijds voordelige partnerschappen met opkomende markten en ontwikkelingslanden, die stroken met haar Global Gateway-strategie⁶² en haar internationale digitale strategie⁶³, bijdragen aan de diversificatie van de toeleveringsketen voor halfgeleiders en meerwaarde bieden voor die internationale strategische partners.

- (118) Om de strategische autonomie en het leiderschap van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologieën te versterken, moet de industriële alliantie op het gebied van processoren en halfgeleidertechnologieën worden opgeheven en moeten haar activiteiten worden overgenomen door de industriële alliantie voor halfgeleiders (de “alliantie”), die bij deze verordening wordt opgericht, onder toezicht van de Commissie. Alle leden en deelnemers van de bestaande industriële alliantie op het gebied van processoren en halfgeleidertechnologieën moeten automatisch lid en deelnemer van de alliantie worden. Het mandaat waarin de werking, taken en samenstelling van de alliantie nader worden omschreven, moet ter verduidelijking op de website van de Commissie worden gepubliceerd⁶⁴. De alliantie moet belanghebbenden uit de gehele waardeketen bijeenbrengen, waaronder de industrie, kmo's, onderzoeksorganisaties en belangrijke gebruikerssectoren, om kritieke lacunes in de capaciteiten van de Unie te inventariseren en de technologische en industriële vooruitgang te stimuleren die nodig is om het concurrentievermogen te versterken. Door het bevorderen van samenwerking en innovatie moet de alliantie helpen om afhankelijkheden te verminderen, de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken en de schaalvergroting van kleinere actoren in de Unie te ondersteunen. Om de samenhang met de strategie en prioriteiten van de Unie op het gebied van halfgeleiders te waarborgen en een soepele en doeltreffende uitvoering van deze verordening te bevorderen, moet het stuurcomité van de alliantie een regelmatige dialoog onderhouden met de Europese Raad voor halfgeleiders, terwijl de werkgroepen van de alliantie op verzoek updates kunnen voorleggen. Deze gestructureerde betrokkenheid moet de Raad in staat stellen om inzichten uit de sector te integreren in beleidsbeslissingen, zodat publieke en private inspanningen op elkaar blijven aansluiten bij het bevorderen van de technologische soevereiniteit van de Unie.
- (119) Voor een betrouwbare en constructieve samenwerking van bevoegde instanties op Unie- en nationaal niveau moeten alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van deze verordening, de vertrouwelijkheid van de bij de uitvoering van hun taken verkregen informatie en gegevens eerbiedigen, met name om intellectuele-

⁶² Europese Commissie: Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen, The Global Gateway strategy, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

⁶³ Europese Commissie: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, *An international digital strategy for the European Union*, Europese Commissie, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/4019528>.

⁶⁴ Europese Commissie: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, *Alliance on Processors and Semiconductors Technologies*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies>

eigendomsrechten, gevoelige bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen te beschermen. Alle bij de aanvraag tot erkenning als Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie verkregen informatie in het kader van verzoeken om informatie of kennisgevingsverplichtingen uit hoofde van deze verordening mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden van deze verordening en valt onder de geheimhoudingsplicht overeenkomstig artikel 339 VWEU, alsook onder de interne voorschriften van de Commissie inzake de veilige verwerking van gegevens, met name Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie⁶⁵. De Commissie en de nationale bevoegde instanties, hun ambtenaren, personeelsleden en andere personen die onder het toezicht van die autoriteiten werken, alsmede ambtenaren en personeelsleden van andere autoriteiten van de lidstaten moeten de vertrouwelijkheid van de bij de uitvoering van hun taken en activiteiten verkregen informatie waarborgen. Dat moet ook gelden voor de Europese Raad voor halfgeleiders en het halfgeleidercomité. In voorkomend geval moet de Commissie uitvoeringshandelingen kunnen vaststellen tot nadere bepaling van de praktische regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie in het kader van de verzameling van informatie.

- (120) De naleving van de uit hoofde van deze verordening opgelegde verplichtingen moet door middel van geldboeten en dwangsommen kunnen worden afgedwongen. Daartoe moeten er passende geldboeten worden ingesteld voor niet-inwilliging van verzoeken om informatie en niet-naleving van kennisgevingsverplichtingen uit hoofde van deze verordening, ermee rekening houdend dat bij de ene verplichting niet-naleving niet even ernstig is als bij de andere, en er voorzien moet worden in lagere maxima voor kmo's. Voorts moeten er dwangsommen worden ingesteld voor niet-naleving van de verplichting om als prioritair aangemerkte bestellingen te aanvaarden en uit te voeren. Die dwangsommen moeten evenredig zijn en een afspiegeling vormen van de marktprijzen gedurende de voorgaande 90 dagen, waarbij voor kmo's lagere maxima moeten gelden. Naast de verjaringstermijnen voor de uitvoering van sancties moeten verjaringstermijnen gelden voor het opleggen van geldboeten en dwangsommen. Bovendien moet de Commissie de desbetreffende onderneming of representatieve organisaties van ondernemingen het recht geven te worden gehoord.
- (121) Teneinde rekening te houden met technologische veranderingen en marktontwikkelingen die relevant zijn voor de halfgeleidersector en te zorgen voor doeltreffende uitvoering en evaluatie van het initiatief Chips voor Europa 2.0, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen ten aanzien van de door het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunde acties op een wijze die strookt met de doelstellingen van het initiatief en ten aanzien van de meetbare indicatoren voor de monitoring van de uitvoering van het initiatief Chips voor Europa 2.0 en voor de verslaglegging over de voortgang ervan bij de verwezenlijking van de doelstellingen ervan alsook teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van de aanvraagprocedure en de vereisten en voorwaarden voor de toekenning, monitoring en intrekking van het label van excellente ontwerpcentra. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016

⁶⁵ Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj>).

over beter wetgeven⁶⁶. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

- (122) Onverminderd de begrotingsprocedure en haar administratieve autonomie, moet de Commissie optimaal gebruikmaken van de middelen om ervoor te zorgen dat zij haar taken doeltreffend kan verrichten en haar bevoegdheden uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen.
- (123) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een kader voor de versterking van het halfgeleiderecosysteem op Unieniveau, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(124) Verordening (EU) 2023/1781 moet daarom worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Onderwerp

1. Bij deze verordening wordt een kader vastgesteld om het halfgeleiderecosysteem te verbeteren en afhankelijkheden aan te pakken en te voorkomen die de leveringszekerheid van halfgeleiders op Unieniveau in gevaar kunnen brengen, met name door middel van de volgende maatregelen:
 - a) voortzetting en verdere ontwikkeling van het initiatief Chips voor Europa, oorspronkelijk ingesteld bij Verordening (EU) 2023/1781 en in deze verordening aangeduid als het initiatief Chips voor Europa 2.0;
 - b) vaststelling van criteria voor de erkenning en ondersteuning van Europese pioniersinitiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie, alsmede strategische projecten die de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van het halfgeleiderecosysteem van de Unie bevorderen;
 - c) versterking van het coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie, dat oorspronkelijk bij Verordening (EU) 2023/1781 is ingesteld en betrekking heeft op de inventarisatie en monitoring van de halfgeleiderindustrie in de Unie, alsmede crisispreventie en de respons op tekorten aan halfgeleiders en, in voorkomend geval, verzoeken om informatie en overleg met belanghebbenden uit de toeleveringsketen van halfgeleiders.

⁶⁶ PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

1. De eerste algemene doelstelling van deze verordening is het verzekeren van de nodige omstandigheden voor het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologieën en het waarborgen van de aanpassing van de sector aan structurele veranderingen.
2. De tweede algemene doelstelling, die losstaat van en een aanvulling vormt op de in lid 2 bepaalde eerste algemene doelstelling, is de versterking van de crisisparaatheid om de leveringszekerheid van de EU te waarborgen en daarmee de werking van de interne markt te verbeteren door de vaststelling van een uniform Unierechtskader om de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologieën te versterken.
3. Deze verordening is van toepassing onverminderd de specifieke aanbestedingsprocedures en kwalificeringsnormen die van toepassing zijn in de defensiesector, zoals bedoeld in Verordening (EU) 2025/2643.

Artikel 2 *Definities*

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- (1) “halfgeleider”: een van de volgende:
 - a) een materiaal, met inbegrip van geavanceerde materialen, in elementaire vorm of als verbinding waarvan de elektrische geleidbaarheid kan worden gewijzigd;
 - b) een component bestaande uit een aantal lagen halfgeleidende, isolerende en geleidende materialen die volgens een vooraf bepaald patroon zijn bepaald, dat bestemd is om duidelijk omschreven elektronische en/of fotonische functies te vervullen;
- (2) “chip”: een elektronisch apparaat dat verschillende functionele elementen op één stuk halfgeleidermateriaal bevat, doorgaans in de vorm van geheugen, logische poorten, processoren, opto-elektronica en analoge elementen;
- (3) “kwantumchip”: een apparaat dat informatie verwerkt op het niveau van individuele kwantumsystemen, met een niveau van integratie van componenten op een chip dat varieert naargelang het gebruikte kwantumplatform, met inbegrip van platforms voor kwantumcomputing, -communicatie, -detectie of -metrologie;
- (4) “technologienode”: een specifiek fabricageproces voor halfgeleiders en de ontwerpregels daarvan;
- (5) “toeleveringsketen voor halfgeleiders”: het systeem van activiteiten, organisaties, actoren, technologie, informatie, hulpbronnen en diensten die betrokken zijn bij de productie van halfgeleiders, met inbegrip van grondstoffen en verwerkte materialen, zoals gassen, apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders, ontwerp, met inbegrip van daarmee verband houdende softwareontwikkeling, fabricage, assemblage, testen en behuizing;
- (6) “waardeketen voor halfgeleiders”: de reeks activiteiten met betrekking tot een halfgeleiderproduct vanaf het ontwerp tot het eindgebruik, met inbegrip van grondstoffen en verwerkte materialen, zoals gassen, apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, ontwerp, met inbegrip van de daaraan gerelateerde softwareontwikkeling, fabricage, testen, assemblage en

behuizing tot inbedding en integratie in eindproducten, alsmede processen aan het einde van de levenscyclus, zoals hergebruik, demontage en recycling;

- (7) “proeflijn”: een test- en experimenteerfaciliteit gericht op hogere niveaus van technologische paraatheid, tot en met industriële toepassing, en die bedoeld is voor het testen, demonstreren, valideren en kalibreren van producten, apparatuur, processen of systemen;
- (8) “kleine en middelgrote ondernemingen” of “kmo’s”: kleine of middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd in de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie⁶⁷;
- (9) “kleine midcap”: een kleine midcap-onderneming zoals gedefinieerd in de bijlage bij Aanbeveling 2025/1099/EG;
- (10) “pioniersinitiatief”: een van de volgende initiatieven die innovatie in de Unie oplevert met betrekking tot het productieproces of het eindproduct, voor zover deze innovatie nog niet in voldoende mate aanwezig is of er nog geen toezegging is gedaan om deze binnen de Unie te realiseren teneinde de veerkracht en de leveringszekerheid van de Unie te waarborgen, met inbegrip van innovatie die verbeteringen behelst qua rekenkracht of het niveau van beveiliging, veiligheid of betrouwbaarheid, energie- en milieuprestaties, de technologienode of het substraatmateriaal, of qua invoering van productieprocessen die tot efficiëntieverbetering leiden:
 - a) een nieuwe of substantieel verbeterde fabricagefaciliteit voor halfgeleiders;
 - b) een nieuwe of substantieel verbeterde faciliteit of een nieuw of substantieel verbeterd proces voor de productie van apparatuur;
 - c) een nieuwe of substantieel verbeterde faciliteit of een nieuw of substantieel verbeterd proces voor de productie van essentiële componenten voor dergelijke apparatuur of voor de productie van andere basisproducten die voornamelijk worden gebruikt bij de fabricage van halfgeleiders, zoals materialen;
 - d) een nieuwe of substantieel verbeterde faciliteit voor de productie of integratie van elektronica;
 - e) nieuwe op fabricage gerichte chipontwerpactiviteiten;
- (11) “op fabricage gerichte chipontwerpactiviteiten”: het voorbereiden van ontwerpen voor fabricage, het co-optimaliseren van ontwerp en proces en het uitvoeren van de final tape-out, zijnde de fase waarin een chipontwerp wordt vrijgegeven voor fabricage in de vorm van een fysiek prototype ter validatie voorafgaand aan massaproductie;
- (12) “halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie”: halfgeleidertechnologieën die verder gaan dan de huidige stand van de techniek door aanzienlijke verbeteringen qua functionele prestaties, rekenkracht of energie-efficiëntie te bieden, alsook andere aanzienlijke energie- en milieuvoordelen;
- (13) “ultramoderne halfgeleidertechnologieën”: de laatste stand van de innovatie op het gebied van chips en halfgeleidertechnologieën wanneer de projecten worden uitgevoerd;

⁶⁷ Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

- (14) “fabricage van halfgeleiders”: elke fase van de productie en verwerking van halfgeleiderwafers, waaronder ontwerp, substraatmateriaal, front-end en back-end, die noodzakelijk is om een afgewerkt halfgeleiderproduct te leveren;
- (15) “front-end”: de volledige bewerking van een schijfje halfgeleidermateriaal;
- (16) “back-end”: de behuizing, de assemblage en het testen van een halfgeleiderproduct;
- (17) “fabricage en integratie van elektronica”: de fabricage of integratie van printplaten, geavanceerde behuizingssubstraten en elektronische fabricage met betrekking tot de assemblage, het testen of de systeemintegratie van halfgeleiders of op halfgeleiders gebaseerde producten;
- (18) “gebruiker van halfgeleiders”: een onderneming die producten produceert waarin halfgeleiders zijn ingebouwd;
- (19) “cruciale marktspelers”: ondernemingen in de toeleveringsketen van de Unie voor halfgeleiders waarvan de betrouwbare werking essentieel is voor de toelevering van halfgeleiders;
- (20) “kritieke sector”: een in bijlage V bedoelde sector;
- (21) “in een crisis relevant product”: elk van de volgende producten die getroffen worden door een halfgeleidercrisis en relevant zijn ter waarborging van cruciale functies van een kritieke sector:
 - a) halfgeleiders of chips die hetzij rechtstreeks door kritieke sectoren worden ingezet, hetzij worden gebruikt voor de productie van apparaten die door kritieke sectoren worden gebruikt;
 - b) tussenproducten die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders of chips;
 - c) grondstoffen en verwerkte materialen die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders, chips of tussenproducten.
- (22) “productievermogen”: de mogelijkheid van een faciliteit om bepaalde typen producten te fabriceren;
- (23) “productiecapaciteit”: de maximale potentiële output van een faciliteit;
- (24) “bedrijfsgeheim”: een bedrijfsgeheim zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2016/943;
- (25) “vergunningsprocedure”: een procedure die betrekking heeft op alle relevante vergunningen voor de bouw, uitbreiding, omzetting en exploitatie van industriële halfgeleiderfabricageprojecten, met inbegrip van bouw-, chemische en netaansluitingsvergunningen zoals gedefinieerd in artikel 1 van [het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen (EU) 2018/2001, (EU) 2019/944 en (EU) 2024/1788 wat betreft de versnelling van vergunningsprocedures], en indien vereist milieubeoordelingen en -vergunningen, en die alle aanvragen en procedures omvat vanaf de bevestiging van de volledigheid van de aanvraag tot de kennisgeving van het raambesluit over het resultaat van de procedure;
- (26) “opdracht”: een overheidsopdracht zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van Richtlijn 2014/24/EU, opdrachten voor werken, leveringen en diensten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad [insert footnote], en concessieovereenkomsten zoals gedefinieerd in artikel 5, punt 1, van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad;

- (27) “aanbestedende dienst”: aanbestedende dienst zoals gedefinieerd in artikel 6 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 2, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 van Richtlijn 2014/25/EU;
- (28) “aanbestedende instantie”: aanbestedende instantie zoals gedefinieerd in artikel 7 van Richtlijn 2014/23/EU en artikel 4 van Richtlijn 2014/25/EU;
- (29) “beveiligde verwerkingsomgeving”: de fysieke of virtuele omgeving en organisatorische middelen om te zorgen voor de naleving van het Unierecht, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad⁶⁸, met name wat betreft de rechten van datasubjecten, antitrustregels, intellectuele-eigendomsrechten, en handels- en statistisch geheim, integriteit en toegankelijkheid, alsook van het toepasselijke nationale recht, en om de entiteit die de beveiligde verwerkingsomgeving biedt in staat te stellen alle gegevensverwerkingsactiviteiten te bepalen en er toezicht op te houden, met inbegrip van het tonen, opslaan, downloaden en exporteren van gegevens en het berekenen van afgeleide gegevens door middel van computeralgoritmen;
- (30) “wettelijke vertegenwoordiger”: een in de Unie woonachtige of gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die is aangewezen om namens het overeenkomstig artikel 34 van deze verordening opgerichte platform op te treden;
- (31) “binnenlandse onderneming”:
- a) elke onderneming in de waardeketen voor halfgeleiders die haar zetel in de Unie heeft en die eigendom is van en onder zeggenschap staat van een onderneming in de Unie;
 - b) elke onderneming in de waardeketen voor halfgeleiders die aan een van de volgende criteria voldoet, ongeacht of haar zetel in de Unie is gevestigd:
 - c) ze is in eigendom van en staat onder zeggenschap van een onderneming in de Unie en heeft haar zetel buiten de Unie;
 - d) ze is in eigendom van en staat onder zeggenschap van een onderneming die is gevestigd in een derde land of gebied waarmee de Unie een overeenkomst heeft gesloten tot instelling van een vrijhandelszone, een douane-unie of een strategisch partnerschap voor halfgeleiders, gesloten overeenkomstig artikel 49;
 - e) ze is in eigendom van en staat onder zeggenschap van een onderneming die is gevestigd in een land dat de overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO heeft ondertekend.
- (32) “eigendom”: het bezit zijn van ten minste 50 % van de eigendomsrechten van de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, of er een meerderheidsbelang in hebben;
- (33) “zeggenschap”: zeggenschap zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 6, van Verordening (EU) 2021/697;
- (34) “onderneming in de Unie”: een naar het recht van een lidstaat opgerichte onderneming;

⁶⁸ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- (35) “strategisch partnerschap voor halfgeleiders”: een verbintenis tussen de Unie en een derde land of gebied om hun samenwerking in verband met de waardeketen voor halfgeleiders te intensiveren, die is vastgelegd in een niet-bindend instrument waarin concrete maatregelen van wederzijds belang zijn vermeld;
- (36) “strategisch project”: een project dat een aanzienlijke meerwaarde voor de Unie oplevert door wezenlijk bij te dragen aan doelstellingen van gemeenschappelijk Uniebelang, dat een duidelijke landsgrensoverschrijdende dimensie heeft (met name door middel van technische samenwerking of overheidssteun waarbij meer dan één lidstaat betrokken is) en dat bijdraagt aan het versterken van de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van de waardeketen voor halfgeleiders van de Unie en de technologische soevereiniteit en het technologisch leiderschap van de Unie, door kritieke capaciteiten, technologieën of vermogens binnen de Unie mogelijk te maken, te bevorderen of veilig te stellen, onder meer door strategische afhankelijkheden te verminderen;
- (37) “Gemeenschappelijke Onderneming “Chips””: de gemeenschappelijke onderneming die is opgericht bij Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad en, indien van toepassing, elke opvolgende entiteit of elk opvolgend initiatief dat krachtens het Unierecht is opgericht in het kader van een volgend meerjarig financieel kader.

Hoofdstuk II

Initiatief Chips voor Europa 2.0

Artikel 3

Initiatief Chips voor Europa 2.0

1. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 wordt ondersteund voor de duur van het bij Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad vastgestelde meerjarig financieel kader 2021-2027⁶⁹.
2. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 wordt ondersteund met financiering uit het programma Horizon Europa en het programma Digitaal Europa, overeenkomstig de Verordeningen (EU) 2021/694 en (EU) 2021/695, alsmede uit nationale en particuliere middelen.

Artikel 4

Doelstelling van het initiatief Chips voor Europa 2.0

3. De algemene doelstelling van het initiatief Chips voor Europa 2.0 is de verwezenlijking van grootschalige technologische capaciteitsopbouw en de ondersteuning van daarmee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de gehele waardeketen voor halfgeleiders van de Unie, teneinde:
 - a) de technologische soevereiniteit, economische veiligheid, veerkracht, welvaart, onmisbaarheid en het industriële concurrentievermogen van de Unie te versterken door te zorgen voor de overdracht en industriële toepassing van

⁶⁹ Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

technologieën die in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0 zijn ontwikkeld;

- b) de vraag naar halfgeleiders binnen de Unie te stimuleren, onder meer door middel van aanbestedingsprocedures die, overeenkomstig het Unierecht en de internationale verplichtingen van de Unie, de invoering en integratie bevorderen van halfgeleider technologieën, -componenten en -systemen die in de Unie zijn ontworpen, ontwikkeld of vervaardigd;
- c) de innovatie, ontwikkeling en toepassing van ultramoderne halfgeleider technologieën mogelijk te maken (waaronder fotonica als transversale en faciliterende technologie), met name die welke van cruciaal belang zijn voor artificiële intelligentie (AI), waaronder edge-AI, en voor belangrijke toepassingssectoren zoals gezondheidszorg, energie, industriële automatisering, robotica, vervoer, defensie, automobielen- en luchtvaartssystemen en datacentra en cloudinfrastructuur;
- d) bij te dragen tot de verwezenlijking van de groene en de digitale transitie, met name door de energie-, milieu- en klimaatgevolgen van elektronische systemen te verminderen, chips van de volgende generatie duurzamer te maken en de processen van de circulaire economie te versterken, bij te dragen aan hoogwaardige arbeidsplaatsen in het halfgeleider ecosysteem en “beveiliging door ontwerp”-beginselen in acht te nemen die bescherming bieden tegen cyberdreigingen.

4. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 heeft de volgende zes operationele doelstellingen:

- a) operationele doelstelling 1: de ondersteuning van geavanceerde ontwerpcapaciteit voor halfgeleider technologieën;
- b) operationele doelstelling 2: de ontwikkeling van nieuwe en de versterking van bestaande geavanceerde proeflijnen in de hele Unie, zodat er ultramoderne halfgeleider technologieën en halfgeleider technologieën van de volgende generatie kunnen worden ontwikkeld en op industriële schaal kunnen worden ingezet, alsmede proefbanken om de integratie en het gebruik van die technologieën in belangrijke toepassingen en verwerkende industrieën te valideren en te demonstreren;
- c) operationele doelstelling 3: het opbouwen van geavanceerde technologische en technische capaciteit om de innovatieve ontwikkeling van geavanceerde kwantumchips en bijbehorende halfgeleider technologieën te versnellen;
- d) operationele doelstelling 4: het ondersteunen van een netwerk van kenniscentra in de hele Unie door bestaande faciliteiten te versterken of nieuwe op te richten;
- e) operationele doelstelling 5: het opbouwen en versterken van geavanceerde capaciteiten op het gebied van ontwerp, prototyping en industriële toepassing van fotonische geïntegreerde schakelingstechnologieën en andere fotonische technologieën in de hele Unie;
- f) operationele doelstelling 6: het uitvoeren van activiteiten, die gezamenlijk worden aangeduid als chipfondsactiviteiten, ter vergemakkelijking van de toegang tot financiering, onder meer door het verstrekken van duidelijke richtsnoeren, met name voor start-ups, scale-ups, kmo's en kleine midcaps in

de waardeketen voor halfgeleiders, door middel van financiële instrumenten en mechanismen voor investeringssteun ter ondersteuning van eigen vermogen, vreemd vermogen of gemengde financiering in het kader van de Accelerator van de Europese Innovatieraad, het InvestEU-fonds en, indien van toepassing, andere instrumenten van de Unie en de opvolgers daarvan in het kader van het meerjarig financieel kader 2028-2034.

5. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt grootschalige, sectoroverschrijdende initiatieven die gericht zijn op belangrijke technologische en industriële uitdagingen die van strategisch belang zijn voor de Unie (“grote uitdagingen”).
6. De operationele doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0 kunnen activiteiten voor capaciteitsopbouw en daarmee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten omvatten. In het kader van het meerjarig financieel kader 2021-2027 worden alle activiteiten voor capaciteitsopbouw gefinancierd uit het programma Digitaal Europa en de daarmee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten worden gefinancierd uit het programma Horizon Europa.

Artikel 5

Operationele doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0

Het initiatief Chips voor Europa 2.0 omvat:

- a) onder operationele doelstelling 1:
 - i) het onderhouden en uitbreiden van een virtueel ontwerpplatform dat in de gehele Unie beschikbaar is en waarin een breed scala aan nieuwe en bestaande ontwerpmiddelen, hulpmiddelen en diensten is geïntegreerd, waardoor de toegang met name voor de academische wereld, start-ups, scale-ups en kmo's wordt vergemakkelijkt, met het oog op het versterken van de groei en opschaling van fabriekloze ondernemingen in de Unie;
 - ii) het uitbreiden van de ontwerpcapaciteiten van de Unie, onder meer op het gebied van fotonica en kwantumtechnologieën, door innovatieve ontwikkelingen op het gebied van geavanceerd chipontwerp en -architecturen te stimuleren, en zal daartoe ambitieuze strategische ontwerpprojecten ondersteunen die van groot belang zijn voor de strategische autonomie en het concurrentievermogen van de Unie;
- b) onder operationele doelstelling 2:
 - i) het versterken van het vermogen van productietechnologieën voor chips en apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders van de volgende generatie, door de integratie van onderzoeks- en innovatieactiviteiten en de voorbereiding van de ontwikkeling van toekomstige technologienodes en fabricageprocessen van halfgeleiders;
 - ii) grootschalige ondersteuning van innovatie door toegang tot nieuwe of bestaande proeflijnen voor het uitproberen, het testen, de procescontrole, de karakterisering van het eindproduct, het testen en valideren van nieuwe technologieën en ontwerpconcepten waarin belangrijke functies worden geïntegreerd;
 - iii) het ondersteunen van innovatie door middel van toegang tot nieuwe of uitgebreide proefbanken waar verschillende innovatieve technologieën of producten worden gecombineerd en geïntegreerd voor de ontwikkeling

en validering van nieuwe apparaten in belangrijke toepassingen en verwerkende industrieën, voorafgaand aan de volledige toepassing op industriële schaal, teneinde risico's te inventariseren, prestaties te valideren en de haalbaarheid onder werkelijke omstandigheden te waarborgen;

- iv) het verlenen van steun aan Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie door middel van preferentiële toegang tot nieuwe of bestaande proeflijnen, alsmede het waarborgen van toegang tegen billijke voorwaarden tot nieuwe proeflijnen en proefbanken voor een breed scala aan gebruikers binnen het halfgeleiderecosysteem van de Unie;
 - v) het voorbereiden van de overdracht en industriële toepassing van technologieën die in het kader van deze operationele doelstelling zijn ontwikkeld;
- c) onder operationele doelstelling 3:
- i) het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe of bestaande proeflijnen, cleanrooms en gieterijen voor de prototyping en productie van kwantumchips, ten behoeve van de integratie van kwantumcircuits en regelelektronica;
 - ii) het ontwikkelen van faciliteiten voor het testen en valideren van geavanceerde kwantumchips die door de proeflijnen worden geproduceerd, teneinde de terugkoppeling van innovatie tussen ontwerpers, producenten en gebruikers van kwantumcomponenten te sluiten;
 - iii) het ontwikkelen van innovatieve ontwerpbibliotheken voor kwantumchips, in nauwe samenhang met operationele doelstelling 1;
- d) onder operationele doelstelling 4:
- i) het versterken van de capaciteit en de verlening van een breed scala aan deskundigheid aan belanghebbenden, met inbegrip van start-ups, scale-ups en kmo's als eindgebruikers, waarbij de toegang tot en het effectieve gebruik van de in dit artikel bedoelde capaciteit en faciliteiten wordt vereenvoudigd;
 - ii) het bestrijden van het tekort aan vakmensen en het aanpakken van de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden door nieuw talent op het vlak van onderzoek, ontwerp en productie aan te trekken, te mobiliseren en te behouden, met inbegrip van omscholing en bijscholing van werknemers;
- e) onder operationele doelstelling 5:
- i) het versterken van het vermogen van productietechnologieën, apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders en materiaalplatforms voor fotonische geïntegreerde schakelingen door de integratie van onderzoeks- en innovatieactiviteiten;
 - ii) het versterken van bestaande en ontwikkeling van nieuwe proeflijnen en open-access-fabricagefaciliteiten voor halfgeleiders, ten behoeve van de

- prototyping en productie van fotonische geïntegreerde schakelingen en bijbehorende fotonische technologieën;
- iii) het ontwikkelen en onderhouden van ontwerpbibliotheken en ontwerpautomatiseringstools voor fotonische geïntegreerde schakelingen, bijbehorende fotonische technologieën en methoden voor de integratie daarvan in modules die in de hele Unie op open en niet-discriminerende voorwaarden beschikbaar zijn;
- iv) het voorbereiden van de overdracht en industriële toepassing van technologieën die in het kader van deze operationele doelstelling zijn ontwikkeld;
- f) onder operationele doelstelling 6:
 - i) het ondersteunen van start-ups en scale-ups in de hele waardeketen voor halfgeleiders bij het verkrijgen van financiering in alle groeifasen, met bijzondere aandacht voor het overbruggen van de financieringskloof die hen belet de schaalgrootte te bereiken die nodig is om wereldwijd te kunnen concurreren;
 - ii) het versnellen en verbeteren van de toegang tot investeringen in de waardeketen voor halfgeleiders, met name door het aantrekken van durfkapitaal en groeikapitaal, en het benutten van financiering uit zowel de publieke als de particuliere sector, waarbij de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van het halfgeleiderecosysteem in de Unie worden vergroot.

Deze doelstellingen worden, waar van toepassing, uitgevoerd overeenkomstig de technische beschrijving in bijlage I.

Artikel 6

Europees netwerk van kenniscentra voor halfgeleiders

1. Met het oog op operationele doelstelling 4 van het initiatief Chips voor Europa 2.0 wordt ondersteuning verleend aan het Europees netwerk van kenniscentra voor halfgeleiders, systeemintegratie en -ontwerp ("het netwerk"), dat is opgericht krachtens Verordening (EU) 2023/1781. Het netwerk bestaat uit de overeenkomstig lid 3 door de Gemeenschappelijke Onderneming "Chips" geselecteerde kenniscentra.
2. Kenniscentra verrichten alle of sommige van de volgende activiteiten ten behoeve van en in nauwe samenwerking met de bedrijfstak in de Unie, met name kmo's en midcap-ondernemingen, alsmede organisaties voor onderzoek en technologie, universiteiten, de overheidssector en andere belanghebbenden uit de waardeketen voor halfgeleiders:
 - a) zorgen voor afstemming tussen de activiteiten van het kenniscentrum en, indien van toepassing, de halfgeleiderstrategie van de lidstaat waarin het kenniscentrum is gevestigd;
 - b) bewustmaking en verstrekking van de nodige knowhow, deskundigheid en vaardigheden aan belanghebbenden om hen te helpen de ontwikkeling van nieuwe halfgeleidertechnologieën, de fabricage van halfgeleiders, apparatuur, ontwerpopties en systeemconcepten alsmede de integratie van nieuwe halfgeleidertechnologieën te versnellen via een doeltreffend gebruik van de infrastructuur en andere ter beschikking staande middelen van het netwerk;

- c) verlening van toegang tot ontwerpdiensten en ontwerpinstrumenten in het kader van operationele doelstelling 1 van het initiatief Chips voor Europa 2.0, alsmede tot de proeflijnen die in het kader van operationele doelstelling 2 van het initiatief Chips voor Europa 2.0 worden ondersteund;
 - d) bewustmaking en verlening en waarborging van toegang tot deskundigheid, knowhow en diensten, met inbegrip van de paraatheid voor systeemontwerp, nieuwe en bestaande proeflijnen en ondersteunende acties die noodzakelijk zijn om de door het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunde vaardigheden en competenties op te bouwen;
 - e) bevordering van de overdracht van deskundigheid en knowhow tussen lidstaten en regio's door de uitwisseling van vaardigheden, kennis en goede praktijken te stimuleren en gezamenlijke programma's aan te moedigen;
 - f) ontwikkeling en beheer van specifieke opleidings-, bijscholings- en omscholingsacties op het gebied van halfgeleidertechnologieën en de toepassingen daarvan, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de talentenpool en ter verhoging van het aantal studenten en de kwaliteit van het onderwijs in relevante studierichtingen op scholen en universiteiten in de Unie tot en met het doctoraal niveau;
 - g) faciliteren van contacten tussen studenten en halfgeleiderbedrijven in de hele Unie, met bijzondere aandacht voor de participatie van vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen, en voortbouwend op bestaande initiatieven ter ondersteuning van onderwijs of opleiding of beide, en de mobiliteit van studenten en werknemers binnen en van buiten de Unie.
3. De lidstaten wijzen in aanmerking komende kenniscentra aan in overeenstemming met hun nationale procedures en administratieve en institutionele structuren, door middel van open en vergelijkende procedures.
- Het werkprogramma van de Gemeenschappelijke Onderneming "Chips" bevat de procedure voor de ondersteuning van kenniscentra, met inbegrip van de selectiecriteria, alsmede nadere bijzonderheden over de uitvoering van de in deze verordening genoemde taken en functies.
- De Gemeenschappelijke Onderneming "Chips" kiest de aan het netwerk deelnemende kenniscentra.
- De lidstaten en de Commissie zorgen voor een maximale synergie met bestaande kenniscentra die zijn opgericht in het kader van andere initiatieven van de Unie, zoals de Europese digitale-innovatiehubs als bedoeld in Verordening (EU) 2021/694.
4. De kenniscentra bepalen in wezenlijke, algehele autonomie hun eigen organisatie, samenstelling en werkmethoden. De organisatie, de samenstelling en de werkmethoden van de kenniscentra moeten overeenstemmen met en bijdragen aan de doelstellingen van deze verordening en van het initiatief Chips voor Europa 2.0.

Artikel 7 *Grote uitdagingen*

1. Grote uitdagingen zorgen voor de ontwikkeling, integratie en industriële toepassing van veelbelovende en cruciale halfgeleidertechnologieën en aanverwante technologieën die van essentieel belang zijn voor de Unie, en worden, waar van toepassing, uitgevoerd overeenkomstig de technische beschrijving in bijlage I.

2. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt grote uitdagingen door:
- a) het bevorderen van geavanceerde O&O waarmee de volgende generatie AI-chips kan worden ontwikkeld, de infrastructuur voor cloud, datacenters en edge-AI kan worden ondersteund door middel van ongekende niveaus van energie-efficiëntie, de capaciteiten van de Unie op het gebied van geavanceerde technologieën kan worden gewaarborgd en de sterke punten van de Unie op het gebied van de fabricage van halfgeleiders kunnen worden versterkt;
 - b) het aanpakken van belangrijke belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van halfgeleidertechnologieën, zoals miniaturisatie, energie-efficiëntie, duurzaamheid, heterogene integratie, veiligheid en betrouwbaarheid, en produceerbaarheid;
 - c) het uitbreiden van het halfgeleiderecosysteem door nauw samen te werken met verticale marktsectoren;
 - d) het verwerven van concurrentievoordeel bij specifieke toepassingen die van cruciaal belang zijn voor de technologische soevereiniteit en het industriële concurrentievermogen van de Unie door de samenwerking tussen ontwikkelaars van halfgeleiders en de verwerkende industrieën te structureren;
 - e) het integreren van de inspanningen van meerdere proeflijnen en het afstemmen daarvan op industrieel gebruik door middel van verhoogde energie-efficiëntie en geavanceerde halfgeleidertechnologieën;
 - f) het waarborgen van de overdracht en industriële toepassing van technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0, met inbegrip van activiteiten gericht op technologische rijping, kwalificering, prototyping, demonstratie, eerste industriële toepassing en overdracht naar productieomgevingen.
3. Grote uitdagingen worden uitgevoerd in samenwerking met de grote uitdagingen zoals vastgesteld bij Verordening (EU) XXXX/XXXX [de verordening cloud- en AI-ontwikkeling (CADA)], alsmede met initiatieven van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing, opgericht bij Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad⁷⁰.

Artikel 8 *Vraagaanjagers*

1. De Commissie en de lidstaten stimuleren het gebruik van halfgeleiders die in de Unie zijn ontworpen of vervaardigd, met name op belangrijke markten zoals de cloud, de automobielsector, de luchtvaart, de telecommunicatiesector, de defensiesector en, waar van toepassing, op andere markten.
2. De vraagaanjagers worden uitgevoerd door de industriële alliantie voor halfgeleiders.
3. De Commissie kan, in samenwerking met de lidstaten en de betrokken belanghebbenden uit het bedrijfsleven, en met inachtneming van de mededingingsregels:

⁷⁰ Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad van 13 juli 2021 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1488 (PB L 256 van 19.7.2021, blz. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj>).

- a) potentiële gebruikers, met name afnemers van halfgeleider technologieën, in staat stellen om van gedachten te wisselen over de eisen en technologische specificaties van de halfgeleidergerelateerde producten die hun sector waarschijnlijk nodig zal hebben;
- b) de ontwikkeling van gemeenschappelijke technische routekaarten mogelijk maken, en activiteiten op het gebied van gezamenlijk ontwerp tussen in de Unie gevestigde halfgeleiderfabrikanten en industriële gebruikers in de toeleveringsketen, waaronder systeemintegrators en apparatuurfabrikanten, ondersteunen en stimuleren, met als doel halfgeleidercomponenten te ontwikkelen die zijn afgestemd op industriële toepassingen in de Unie;
- c) samenwerkingsplatforms, proefprojecten of ontwerppartnerschappen faciliteren die het mogelijk maken dat industriële gebruikers in een vroeg stadium worden betrokken bij het ontwerp van innovatieve halfgeleider technologieën die in de Unie worden ontwikkeld.

Artikel 9 Vraagforum

1. De Commissie richt een vraagforum op om een podium voor halfgeleider technologie te bieden, met name door Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleider technologie, alsmede door geïntegreerde fabricagefaciliteiten en open EU-gieterijen die krachtens Verordening (EU) 2023/1781 zijn erkend, met inachtneming van de mededingingsregels.
2. Het vraagforum wordt uitgevoerd door de industriële alliantie voor halfgeleiders.

Artikel 10 Aanbesteding van chipinnovatie

1. Met het oog op de ondersteuning van aanbestedende diensten of aanbestedende instanties en economische actoren die als inkoopinstanties optreden bij de aanbesteding, integratie, kwalificering en eerste toepassing van systemen waarin halfgeleiders zijn geïntegreerd, neemt de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” de volgende maatregelen:
 - a) waar nodig, het ondersteunen van de totstandkoming van landsgrensoverschrijdende regelingen voor gezamenlijke aanbestedingen tussen aanbestedende diensten of aanbestedende instanties;
 - b) het ondersteunen van de integratie en toepassing van innovatieve halfgeleider technologieën.

Artikel 11 Synergieën met andere programma's

1. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 wordt uitgevoerd in synergie met andere programma's van de Unie overeenkomstig bijlage IV. De Commissie zorgt ervoor dat het bereiken van de in artikel 4 bedoelde doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0 niet in het gedrang komt wanneer gebruik wordt gemaakt van het complementaire karakter van het initiatief Chips voor Europa 2.0 ten aanzien van programma's van de Unie.

Artikel 12

Uitvoering

1. De operationele doelstellingen 1 tot en met 5 van het initiatief Chips voor Europa 2.0 en grote uitdagingen worden toevertrouwd aan de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” en uitgevoerd door middel van in het werkprogramma ervan opgenomen maatregelen.
2. Met het oog op aanpassing aan technologische veranderingen en marktontwikkelingen die relevant zijn voor de halfgeleidersector, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I wat betreft de daarin genoemde acties, op een wijze die strookt met de in artikel 4 bepaalde doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0.
3. Met het oog op een doeltreffende uitvoering en evaluatie van het initiatief Chips voor Europa 2.0, en om rekening te houden met technologische veranderingen en marktontwikkelingen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III wat betreft de meetbare indicatoren voor de monitoring van de uitvoering en de verslaglegging over de voortgang van het initiatief Chips voor Europa 2.0 bij de verwezenlijking van de doelstellingen als bepaald in artikel 4.
4. Omwille van een doeltreffende uitvoering, monitoring en evaluatie van het initiatief Chips voor Europa 2.0 bevat het jaarlijkse activiteitenverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” informatie over aangelegenheden die verband houden met de operationele doelstellingen 1 tot en met 5 van het initiatief Chips voor Europa 2.0 en grote uitdagingen, op basis van de meetbare indicatoren in bijlage III.
5. De Commissie brengt de Europese Raad voor halfgeleiders regelmatig op de hoogte van de voortgang bij de uitvoering van operationele doelstelling 6 van het initiatief Chips voor Europa 2.0.

Hoofdstuk III

Leveringszekerheid en vraag

AFDELING 1

VERMOGEN VOOR DE FABRICAGE VAN HALFGELEIDERS

Artikel 13

Algemeen belang en overheidssteun

1. Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleiderstechnologie worden, doordat zij bijdragen aan de leveringszekerheid van halfgeleiders en de veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie, geacht in het belang van de Unie te zijn.
2. Om leveringszekerheid en veerkracht van het halfgeleiderecosysteem van de Unie te bereiken, kunnen de lidstaten, onverminderd de artikelen 107 en 108 VWEU, steunmaatregelen toepassen en administratieve steun verlenen aan strategische

projecten, overeenkomstig Verordening (EU) XXXX/XXXX [Europees Fonds voor concurrentievermogen] en andere desbetreffende Uniewetgeving en Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie.

3. Bovendien kan de Commissie steunmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot subsidies, toepassen op strategische projecten overeenkomstig Verordening (EU) XXXX/XXXX [Europees Fonds voor concurrentievermogen] en andere desbetreffende Uniewetgeving.

Artikel 14

Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie

1. Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie worden uitgevoerd door binnenlandse ondernemingen.
2. Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie tonen aan dat zij hun toeleveringsketen zodanig inrichten dat de afhankelijkheid van buitenlandse ondernemingen wordt verminderd en de leveringszekerheid van de Unie wordt versterkt.
3. Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie zijn pioniersinitiatieven die bijdragen aan de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart en de leveringszekerheid van het halfgeleiderecosysteem van de Unie.
4. Bij de indiening van een aanvraag overeenkomstig artikel 15, lid 1, wordt een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie verplicht aangemerkt als pioniersinitiatief.
5. Pioniersinitiatieven hoeven geen begunstigde te zijn van steunmaatregelen of administratieve ondersteuning zoals bedoeld in artikel 13 om de status van Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie aan te vragen.
6. Een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie voldoet aan de volgende vereisten:
 - a) de oprichting heeft een duidelijk positief effect, met overloopeffecten die verdergaan dan het initiatief zelf of de betrokken lidstaat of lidstaten, op de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie en de eindmarkten van de Unie op middellange tot lange termijn teneinde de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van het halfgeleiderecosysteem, met inbegrip van de groei van start-ups en kmo's, te waarborgen en bij te dragen aan de groene en digitale transitie van de Unie en, voor zover relevant voor het bedrijfsmodel van de faciliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin productiecapaciteit, front-end of back-end, of beide, wordt aangeboden aan ondernemingen die niet met de faciliteit zijn verbonden, indien er voldoende vraag is;
 - b) zij verzekert dat zij niet onderworpen is aan de extraterritoriale toepassing van openbardienstverplichtingen van derde landen op een wijze die afbreuk kan doen aan het vermogen van de onderneming om aan de in artikel 43, lid 1, genoemde verplichtingen te voldoen, en verbindt zich ertoe de Commissie op de hoogte te stellen wanneer een dergelijke verplichting ontstaat;
 - c) zij blijft investeren in innovatie in de Unie teneinde tastbare vooruitgang te boeken in de halfgeleidertechnologie of halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie voor te bereiden;

- d) zij ondersteunt de doorstroming van talent van de Unie door opleidingen op het gebied van onderwijs en vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten en door de pool van gekwalificeerde en geschoolde arbeidskrachten te vergroten;
 - e) indien het om een fabricagefaciliteit gaat, neemt zij deel aan het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders, zoals bedoeld in artikel 34.
7. Voor investeringen in continue innovatie overeenkomstig lid 6, punt c), hebben Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie bevoorrechte toegang tot de overeenkomstig artikel 5, punt b), opgezette proeflijnen. Een dergelijke bevoorrechte toegang sluit de toegang tot de proeflijnen tegen eerlijke voorwaarden voor andere belangstellende ondernemingen, met name start-ups en kmo's, niet uit, en staat deze niet in de weg.
8. Wanneer een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie productiecapaciteit aanbiedt aan ondernemingen die niet met het initiatief zijn verbonden, stelt het initiatief een passende en doeltreffende functionele scheiding van de ontwerp- en fabricageprocessen in en handhaaft hij deze om de bescherming van de informatie die in elke fase wordt verkregen, te waarborgen.

Artikel 15

Aanvraag van de status van Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie

1. Een onderneming of een consortium van ondernemingen kan bij de Commissie een aanvraag indienen om aan een project de status van Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie toe te kennen.
2. De Commissie beoordeelt de aanvraag, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders, via een eerlijk en transparant proces op basis van de volgende elementen:
 - a) naleving van de criteria van artikel 14, lid 2, en een belofte om de vereisten van artikel 14, lid 6, na te leven;
 - b) een bedrijfsplan waarin de financiële en technische levensvatbaarheid van het project, waarbij wordt gekeken naar de volledige looptijd, met inbegrip van informatie over eventuele geplande overheidssteun, wordt beoordeeld;
 - c) aantoonbare ervaring van de aanvrager met de exploitatie van soortgelijke initiatieven;
 - d) overlegging van een passend bewijsstuk waaruit blijkt dat de lidstaat of lidstaten waar de aanvrager voornemens is zijn faciliteit op te richten, bereid is of zijn om de oprichting van een dergelijk initiatief te ondersteunen;
 - e) het bestaan van passend beleid en passende licentieovereenkomsten, met inbegrip van technische beschermings- en uitvoeringsmaatregelen, gericht op het waarborgen van de bescherming van niet-openbaar gemaakte informatie en intellectuele-eigendomsrechten, met name om ongeoorloofde openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of het weglekken van gevoelige opkomende technologieën te voorkomen.

De Commissie verstrekt richtsnoeren inzake de vereiste informatie op grond van de eerste alinea en de vorm waarin deze moet worden verstrekt.

3. De Commissie behandelt de aanvraag, stelt haar besluit vast en stelt de aanvrager binnen drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag van haar besluit in kennis. Indien de Commissie van oordeel is dat de in de aanvraag verstrekte informatie onvolledig is, stelt zij de aanvrager in de gelegenheid de aanvullende informatie die nodig is om de aanvraag te vervolledigen, onverwijld in te dienen. In dit besluit van de Commissie wordt de duur van de status bepaald op basis van de voorspelde levensduur van het project.
4. De Commissie monitort de vooruitgang die is geboekt bij de oprichting en exploitatie van Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie en brengt regelmatig verslag uit aan de Europese Raad voor halfgeleiders.
5. De exploitant van het initiatief kan de Commissie verzoeken de duur van de status te evalueren of de uitvoeringsplannen van de faciliteit te wijzigen met betrekking tot de naleving van de vereisten van artikel 14, lid 6, indien de exploitant van oordeel is dat een dergelijke evaluatie naar behoren gerechtvaardigd is wegens onvoorziene externe omstandigheden. Op basis van die evaluatie kan de Commissie de duur van de overeenkomstig lid 3 verleende status herzien of de wijziging van de uitvoeringsplannen aanvaarden.
6. Indien de Commissie vaststelt dat een initiatief niet langer voldoet aan de vereisten in artikel 14, lid 6, stelt zij de exploitant van het Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie in de gelegenheid om opmerkingen te maken en passende maatregelen voor te stellen.
7. De Commissie kan een besluit tot erkenning van de status van een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie intrekken indien de erkenning gebaseerd was op een aanvraag met onjuiste informatie of indien het Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie, ondanks de voltooiing van de procedure van lid 5, niet voldoet aan de vereisten in artikel 14, lid 6. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, brengt de Commissie de Europese Raad voor halfgeleiders op de hoogte van de redenen voor de voorgestelde intrekking en overlegt zij met hem. Elk besluit tot intrekking van de status van een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie wordt naar behoren gemotiveerd en kan door de exploitant worden aangevochten.
8. Initiatieven waarvan de status van Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie is ingetrokken op grond van lid 7, verliezen alle aan de erkenning van deze status verbonden rechten die voortvloeien uit deze verordening. Dergelijke initiatieven blijven echter onderworpen aan de verplichting van artikel 42, lid 1, gedurende een periode die gelijk is aan de periode die oorspronkelijk was vastgesteld toen de status overeenkomstig lid 3 van dit artikel werd toegekend, of, indien de status werd geëvalueerd, aan de overeenkomstig lid 5 van dit artikel toepasselijke duur.

Artikel 16 *Strategische projecten*

1. De Commissie erkent halfgeleiderprojecten als strategische projecten indien ze aan alle volgende vereisten voldoen:
 - a) het project levert een aanzienlijke meerwaarde voor de Unie op door in belangrijke mate bij te dragen aan doelstellingen van gemeenschappelijk Uniebelang;

- b) het strategisch project wordt uitgevoerd door binnenlandse ondernemingen;
 - c) het strategisch project toont aan dat het zijn toeleveringsketen zodanig inricht dat de afhankelijkheid van buitenlandse ondernemingen wordt verminderd en de leveringszekerheid van de Unie wordt versterkt;
 - d) het project heeft een duidelijke landsgrensoverschrijdende dimensie, met name door middel van technische samenwerking of overheidssteun waarbij meer dan één lidstaat betrokken is;
 - e) het project draagt bij aan de veerkracht en robuustheid van de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie;
 - f) het project draagt bij aan versterking van de technologische soevereiniteit en het technologisch leiderschap van de Unie, door kritieke capaciteiten, technologieën of vermogens binnen de Unie mogelijk te maken, te bevorderen of veilig te stellen, onder meer door strategische afhankelijkheden te verminderen.
2. Strategische projecten met meerdere vestigingen worden geëxploiteerd door één enkel consortium en functioneren als één geïntegreerde juridische en technische entiteit.
 3. Deelname aan strategische projecten is voorbehouden aan entiteiten van de Unie.
 4. In afwijking van lid 3 is deelname van in derde landen gevestigde juridische entiteiten toegestaan, mits deze deelname in overeenstemming is met de in lid 1 bedoelde voorwaarden en onderworpen is aan de desbetreffende veiligheidsvoorwaarden van de toepasselijke programma's van de Unie.

Artikel 17

Vaststelling van prioritaire gebieden voor strategische projecten

1. Bijlage II bevat een technische beschrijving van de prioritaire gebieden voor mogelijke strategische projecten op bepaalde indicatieve technologische gebieden. Met het oog op het actualiseren van de technologische beschrijvingen en de indicatieve technologische gebieden die in bijlage II zijn genoemd, om recht te doen aan de technologische veranderingen en marktontwikkelingen die relevant zijn voor de halfgeleidersector, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II.
2. De Commissie stelt de prioritaire gebieden voor mogelijke strategische projecten vast, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders, op basis van de in artikel 16, lid 1, vastgestelde criteria en de in bijlage II genoemde indicatieve technologische gebieden.

Artikel 18

Aanwijzing van strategische projecten

1. De maatregelen ter ondersteuning van potentiële strategische projecten worden toevertrouwd aan de Gemeenschappelijke Onderneming "Chips" en worden uitgevoerd door middel van de in haar het werkprogramma opgenomen maatregelen.

2. De Commissie, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders, wijst bij besluit de voor financiering door de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” geselecteerde voorstellen aan als strategische projecten, mits ze aan de in artikel 16, lid 1, vastgestelde criteria en aan dat verzoek tot aanwijzing als zodanig voldoen.
3. Met instemming van de aanvrager of aanvragers kunnen voorstellen die niet door de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” zijn geselecteerd voor financiering, eveneens als strategische projecten worden aangewezen wanneer ze voldoen aan de toepasselijke beoordelingsvereisten zoals vastgelegd in de oproep tot het indienen van voorstellen en aan de criteria zoals uiteengezet in artikel 16, lid 1. De mogelijkheid om een dergelijke aanwijzing te verkrijgen, moet duidelijk worden vermeld in de oproepen tot het indienen van voorstellen en de bijbehorende aanvraagprocedures, en moet door het project worden aangevraagd.
4. In het besluit van de Commissie wordt aangegeven of een strategisch project overeenkomstig deze verordening in aanmerking komt als een pioniersinitiatief en wordt de duur van pioniersstatus vastgesteld op basis van de verwachte levensduur van het project.
5. Projecten die als strategische projecten zijn aangewezen, genieten de rechten van en zijn onderworpen aan de verplichtingen die krachtens deze verordening van toepassing zijn op Europese initiatieven op het gebied van halfgeleidertechnologie, mits zij voldoen aan de in artikel 14, lid 6, vastgestelde vereisten.
6. Het strategisch project kan de Commissie verzoeken de duur van de status van strategisch project te evalueren of de uitvoeringsplannen van de exploitant aan te passen met betrekking tot de naleving van de vereisten van artikel 16, lid 1, indien de exploitant van oordeel is dat een dergelijke evaluatie naar behoren gerechtvaardigd is wegens onvoorziene externe omstandigheden. Op basis van die evaluatie kan de Commissie de duur van de toegekende status van strategisch project herzien of de wijziging van de uitvoeringsplannen aanvaarden.
7. Onverminderd een eventuele opschorting of beëindiging van financieringsovereenkomsten tussen de exploitant die het strategisch project uitvoert en de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”, kan de Commissie, indien zij vaststelt dat een als strategisch project aangewezen project niet meer aan de criteria van artikel 16 voldoet, of indien de aanwijzing ervan was gebaseerd op een aanvraag die dusdanig onjuiste informatie bevat dat niet meer aan die criteria wordt voldaan, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders, de aanwijzing van dat project bij besluit intrekken.
8. Alvorens een besluit krachtens lid 6 vast te stellen, deelt de Commissie de exploitant die het strategisch project uitvoert de redenen voor de voorgenomen intrekking mee en biedt zij hem de gelegenheid om binnen een redelijke termijn opmerkingen in te dienen. De Commissie houdt naar behoren rekening met deze opmerkingen. Elk besluit tot intrekking van de status van strategisch project wordt naar behoren gemotiveerd en kan worden aangevochten.
9. Projecten waarvan de aanwijzing als strategisch project is ingetrokken, verliezen alle rechten en verplichtingen in verband met de status van strategisch project op grond van deze verordening. Dergelijke projecten blijven echter onderworpen aan de verplichting van artikel 43, lid 1, gedurende een periode die gelijk is aan de periode die oorspronkelijk was voorzien toen de status werd toegekend.

Artikel 19
Geavanceerde fabricage van halfgeleiders

1. Met het oog op het versterken van de soevereiniteit en het waarborgen van de leveringszekerheid van de Unie op het gebied van halfgeleiders geeft de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 1, de hoogste prioriteit aan een strategisch project voor een in de Unie gevestigde open gieterij voor de fabricage van geavanceerde halfgeleiders.
2. De in lid 1 bedoelde open gieterij voor de fabricage van geavanceerde halfgeleiders bestaat uit een faciliteit of een gecoördineerd netwerk van faciliteiten op meerdere locaties op het grondgebied van de Unie, waar geavanceerde halfgeleidertechnologieën kunnen worden geproduceerd en verpakt volgens de meest geavanceerde industriële methoden.
3. In de open gieterij voor de fabricage van geavanceerde halfgeleiders wordt rekening gehouden met de eisen en doelstellingen die door potentiële afnemers zijn vastgesteld zoals bepaald in artikel 8.

Artikel 20
Coördinatie van de financiering

1. De Commissie kan, in voorkomend geval in samenwerking met de lidstaten, activiteiten uitvoeren om investeringen in Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie aan te trekken. Onverminderd de artikelen 107 en 108 VWEU, kunnen deze activiteiten onder meer bestaan uit het verlenen en coördineren van steun aan Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie die moeite hebben met de toegang tot financiering, in synergie met programma's van de Unie.
2. De Europese Raad voor halfgeleiders verstrekt, op verzoek van een Europees initiatief of strategisch project op het gebied van halfgeleidertechnologie, advies over de financiering van het initiatief of het project, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verkregen financiering en waarbij ten minste de volgende elementen in overweging worden genomen:
 - a) aanvullende publieke en particuliere financieringsbronnen, waaronder eigen vermogen;
 - b) steun met middelen van de Europese Investeringsbank of andere financiële instellingen;
 - c) bestaande instrumenten en programma's van de lidstaten, waaronder die van exportkredietinstellingen en nationale stimuleringsbanken en -instellingen;
 - d) relevante subsidie- en financieringsprogramma's van de Unie.

AFDELING 2

VERGUNNINGSPROCEDURES

Artikel 21

Versnelde procedures voor het verlenen van vergunningen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat administratieve aanvragen met betrekking tot de planning, de bouw en de exploitatie van Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie efficiënt, transparant en tijdig worden verwerkt.
2. De vergunningsprocedure voor Europese initiatieven of strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie mag niet langer duren dan twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment waarop een volledige aanvraag bij het éénloketsysteem is ingediend.
3. De in lid 2 vastgestelde termijn laat eventuele kortere termijnen die door de lidstaten zijn vastgesteld, onverlet.
4. Indien het nationaal recht een dergelijke status erkent, wordt aan Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie de hoogst mogelijke status van nationaal belang verleend en zij worden als zodanig behandeld in vergunningsprocedures. Dit lid geldt alleen wanneer het nationaal recht een dergelijke status kent en brengt voor de lidstaten niet de verplichting met zich mee om een dergelijke status in te voeren.

Artikel 22

Eénloketsysteem voor vergunningsprocedures

1. De lidstaten wijzen een éénloketsysteem aan dat verantwoordelijk is voor het centraliseren en coördineren van de uitvoering van Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie op grond van dit artikel.
2. De lidstaten stellen één enkele vergunningsprocedure vast op basis van één enkele aanvraag bij het overeenkomstig artikel 22, lid 1, aangewezen éénloketsysteem, voor alle vergunningen die vereist zijn voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie.
3. Het éénloketsysteem dient als centraal contactpunt voor het Europees initiatief of strategisch project op het gebied van halfgeleidertechnologie.
4. Uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de enkele aanvraag bevestigt het aangewezen éénloketsysteem dat de aanvraag volledig is of verzoekt het om alle ontbrekende informatie die nodig is om de aanvraag te verwerken.
5. Indien de aanvraag na de indiening van ontbrekende informatie nog steeds als onvolledig wordt beschouwd, kan het éénloketsysteem binnen 30 dagen na de indiening van de gevraagde ontbrekende informatie een tweede verzoek om nog ontbrekende informatie indienen. Het éénloketsysteem verzoekt niet om informatie betreffende gebieden die niet onder het eerste verzoek om aanvullende informatie vallen en verzoekt alleen om aanvullende informatie om de ontbrekende informatie aan te vullen.

6. Indien voor de oprichting van een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie besluiten in twee of meer lidstaten moeten worden genomen, nemen de relevante aangewezen éénloketsystemen alle nodige maatregelen voor een efficiënte en doeltreffende samenwerking en coördinatie.

Artikel 23

Faciliteren van administratieve procedures en vergunningverlening

1. Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie in de zin van deze verordening worden beschouwd als strategische projecten die bijdragen aan de veerkracht, decarbonisatie of hulpbronnenefficiëntie voor de toepassing van artikel 14, lid 1, van het [voorstel voor een verordening betreffende de versnelling van de milieueffectbeoordeling]. De punten 1, 2, en 3 van de bijlage bij die verordening zijn van toepassing.
2. Onverminderd [het voorstel voor een verordening betreffende de versnelling van de milieueffectbeoordeling] zorgen de lidstaten ervoor dat rekening wordt gehouden met alle uitgevoerde studies of verleende vergunningen of toestemmingen in verband met de planning, bouw en exploitatie van Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie, en dat er geen duplicaten van studies, vergunningen of toestemmingen vereist zijn, tenzij dat uit hoofde van het Unierecht of nationaal recht vereist is.

Artikel 24

Gebruik van Europese portemonnees voor ondernemingen door het centrale toegangsporaal

1. De lidstaten zetten op nationaal niveau een centraal toegangsporaal op voor de indiening van de in artikel 22, lid 2, bedoelde aanvraag voor de gecombineerde vergunning voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie.

Het centrale toegangsporaal wijst de vergunningsaanvragen automatisch toe aan de relevante autoriteit, stelt de aanvrager in kennis van alle stappen van de vergunningsprocedure, de status van de procedure en de besluiten van de autoriteiten, en stelt de aanvrager in staat de naleving van de toepasselijke termijnen te controleren.
2. Daartoe maakt het centrale toegangsporaal gebruik van de Europese portemonnees voor ondernemingen die zijn opgezet overeenkomstig [het voorstel voor een verordening tot instelling van Europese portemonnees voor ondernemingen].
3. Door het gebruik van Europese portemonnees voor ondernemingen maken de centrale toegangsportalen het volgende mogelijk:
 - a) interoperabiliteit en geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen relevante autoriteiten;
 - b) hergebruik van gegevens en documenten die reeds in het bezit zijn van relevante autoriteiten;
 - c) een hoog niveau van cyberbeveiliging en informatie-integriteit;
 - d) transparantie en verantwoordingsplicht in de vergunningsprocedure.

4. Bij het opzetten van centrale toegangsportalen maken de lidstaten in voorkomend geval gebruik van bestaande digitale infrastructuur, catalogi en bouwstenen van de Unie die bij het Unierecht zijn vastgesteld.
5. Het aangewezen éénloketsysteem als bedoeld in artikel 22 van deze verordening heeft toegang tot alle relevante gegevens en informatie die beschikbaar zijn via het centrale toegangspuntaal, teneinde zijn taken te kunnen uitvoeren.

Artikel 25

Online-toegankelijkheid van informatie

1. De lidstaten verlenen gecentraliseerde, gemakkelijke online-toegang tot de volgende informatie over processen die relevant zijn voor de ontwikkeling van mogelijke Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleiderstechnologie:
 - a) de in artikel 24 bedoelde Europese portemonnees voor ondernemingen;
 - b) de vergunningverleningsprocedure, met inbegrip van informatie over geschillenbeslechting;
 - c) financierings- en investeringsdiensten;
 - d) financieringsmogelijkheden op het niveau van de Unie of de lidstaten;
 - e) bedrijfsondersteunende diensten, met inbegrip van de aangifte voor de vennootschapsbelasting, lokale belastingwetgeving of het arbeidsrecht.
2. De Commissie biedt alle informatie die de lidstaten hebben verstrekt op een gecentraliseerde en makkelijk toegankelijke manier aan op haar website, zodat er een volledig en duidelijk overzicht is van alle relevante informatie per lidstaat.

AFDELING 3

EUROPESE UITMUNTENDE HALFGELEIDERREGIO'S

Artikel 26

Keurmerk "Europese uitmuntende halfgeleiderregio"

1. De Commissie kan besluiten het keurmerk "Europese uitmuntende halfgeleiderregio" toe te kennen door middel van een uitvoeringshandeling. Het keurmerk kan worden toegekend na een aanvraag door een regionale overheid en wordt uitdrukkelijk bekrachtigd door de betrokken lidstaat.
2. De aanvraag bevat een investeringsplan voor de halfgeleiderregio, waaruit blijkt dat alle relevante autoriteiten een gezamenlijke strategische visie delen.
3. Onverminderd de toepasselijke regels inzake programma's en instrumenten van de Unie kan het keurmerk "Europese uitmuntende halfgeleiderregio" in aanmerking worden genomen bij de beoordeling en selectie van acties die in het kader van financieringsprogramma's van de Unie worden voorgesteld.

Artikel 27
Investeringsplan voor Europese halfgeleiderregio's

1. Het investeringsplan voor Europese halfgeleiderregio's, zoals bedoeld in artikel 26, lid 2, bevat een beschrijving van de regio, met inbegrip van het geografische toepassingsgebied en ten minste de volgende elementen:
 - a) strategische visie en toepassingsgebied:
 - i) een beoordeling van het bestaande industriële en halfgeleiderecosysteem in de regio, met inbegrip van de bestaande fabricagefaciliteiten voor halfgeleiders; relevante eindgebruikerssectoren; haar positie in de waardeketen voor halfgeleiders, met name wat betreft haar unieke kenmerken en potentiële bijdrage aan de veerkracht en groei van de Europese waardeketen voor halfgeleiders;
 - ii) een strategische visie voor de ontwikkeling van de regio op het gebied van halfgeleiders in de komende tien jaar, met inbegrip van en waar van toepassing, de omvorming of koppeling van bestaande industriële activiteiten aan halfgeleideractiviteiten;
 - b) de beschikbaarheid en verdere ontwikkeling van gunstige randvoorwaarden en infrastructuur in de betreffende regio:
 - i) een beschrijving van maatregelen om toegang tot voldoende, betrouwbare en schone energie te waarborgen, met inbegrip van netcapaciteit en trajecten voor decarbonisatie in overeenstemming met de doelstelling inzake klimaatneutraliteit van de Europese klimaatwet;
 - ii) een beschrijving van de beschikbaarheid van geschikt terrein en faciliteiten voor activiteiten in verband met de waardeketen voor halfgeleiders, met inbegrip van bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening en industrieterreinen;
 - iii) een beschrijving van de vervoers-, communicatie- en waterinfrastructuur die van belang is voor de activiteiten in de regio in verband met de waardeketen voor halfgeleiders;
 - iv) een beschrijving van maatregelen ter vereenvoudiging en versnelling van vergunnings- en administratieve procedures, met inbegrip van de koppeling met het in artikel 22 bedoelde éénloketsysteem;
 - c) steun voor innovatie- en onderzoeksactiviteiten in de betreffende regio:
 - i) een beschrijving van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten en de verdere ondersteuning daarvan in verband met de waardeketen voor halfgeleiders in de regio, met inbegrip van synergieën met nationale en EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's;
 - ii) een beschrijving van samenwerkingen met universiteiten, organisaties voor onderzoek en technologie, met inbegrip van en voor zover van toepassing, koppelingen naar de activiteiten van proeflijnen als bedoeld in artikel 5, punt b), en kenniscentra als bedoeld in artikel 6;
 - d) ondersteuning van onderwijs, vaardigheden en arbeidskrachten en de verdere ontwikkeling daarvan in de betreffende regio:

- i) een beschrijving van maatregelen om te waarborgen dat er op alle niveaus geschoold personeel beschikbaar is voor de halfgeleiderindustrie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de synergieën en voordelen die worden geboden in het kader van het pact voor vaardigheden⁷¹;
 - ii) een beschrijving van samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties op het gebied van halfgeleiders;
 - iii) een beschrijving van maatregelen om talent uit de halfgeleiderindustrie aan te trekken, te behouden en bij te scholen, waaronder, waar van toepassing, internationaal talent;
- e) ondersteuning van de aantrekkelijkheid van de industrie en investeringen en de verdere ontwikkeling daarvan in de betreffende regio:
 - i) een beschrijving van maatregelen om particuliere investeringen aan te trekken en te behouden die relevant zijn voor de waardeketen voor halfgeleiders;
 - ii) een beschrijving van maatregelen om kmo's en kleine midcaps in het regionale ecosysteem te integreren.

Artikel 28

Beoordeling van aanvragen voor het keurmerk “Europese uitmuntende halfgeleiderregio”

1. De Commissie beoordeelt aanvragen voor het keurmerk “Europese uitmuntende halfgeleiderregio” op basis van de samenhang en geloofwaardigheid van het investeringsplan voor de halfgeleiderregio en de mate van inzet van de relevante autoriteiten.
2. De Commissie behandelt de aanvragen, stelt het in artikel 26, lid 1, bedoelde besluit vast en stelt de regio, de betrokken lidstaat en de Europese Raad voor halfgeleiders binnen drie maanden na ontvangst van een volledige aanvraag van haar besluit in kennis.
3. Indien de Commissie van oordeel is dat de in de aanvraag verstrekte informatie onvolledig is, stelt zij de betrokken regionale autoriteit en lidstaat hiervan onverwijld in kennis en stelt zij hen in de gelegenheid de aanvullende informatie die nodig is om de aanvraag te vervolledigen, in te dienen.
4. In het in artikel 26, lid 1, bedoelde besluit van de Commissie wordt de geldigheidsduur van het keurmerk “Europese uitmuntende halfgeleiderregio” vastgesteld; deze wordt gebaseerd op de beoordeling van het ingediende investeringsplan voor de halfgeleiderregio.
5. De regionale autoriteit en de betrokken lidstaat monitoren de vooruitgang van de uitvoering van het investeringsplan voor de halfgeleiderregio en brengen ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Commissie en de Europese Raad voor halfgeleiders.

⁷¹ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (COM(2020) 274 final).

6. Een samenvatting van het investeringsplan voor de halfgeleiderregio, waarbij commercieel gevoelige informatie is weggelaten en die bedoeld is om investeringen aan te trekken, wordt via de volgende twee kanalen openbaar gemaakt:
 - a) een website van de Commissie;
 - b) een website van de betrokken lidstaat, de regio en/of de relevante autoriteiten.

Artikel 29

Netwerk van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's

1. Een netwerk van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's ("het netwerk") wordt opgericht.
2. Het netwerk organiseert zijn werkzaamheden op autonome wijze. Het kan zijn eigen werkwijzen vaststellen, waaronder het organiseren van vergaderingen, het aanwijzen van een voorzitter op basis van een roulatiesysteem onder de deelnemende regio's en het vaststellen van informele regelingen ter bevordering van samenwerking en informatie-uitwisseling.
3. Het netwerk brengt de regio's samen waaraan overeenkomstig artikel 26 het keurmerk "Europese uitmuntende halfgeleiderregio" is toegekend.
4. Het netwerk heeft onder meer de volgende doelstellingen:
 - a) het faciliteren van samenwerking en uitwisseling van beste praktijken tussen Europese uitmuntende halfgeleiderregio's;
 - b) het promoten van het netwerk en zijn activiteiten bij aangesloten en niet-aangesloten regio's door middel van outreach-, communicatie- en verspreidingsactiviteiten, teneinde de zichtbaarheid en deelname te vergroten.
 - c) het stimuleren van synergieën en complementariteit tussen regionale halfgeleiderecosystemen in de hele Unie, ook tussen verschillende segmenten van de waardeketen voor halfgeleiders;
 - d) het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's, met het oog op particuliere investeringen en internationale partnerschappen.
5. De Commissie kan de werking van het netwerk bevorderen en kan bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten organiseren ter ondersteuning van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de deelnemende regio's.

AFDELING 4

VEERKRACHT IN TOELEVERINGSKETENS

Artikel 30

Overheidsopdrachten

1. Voor aanbestedingsprocedures die binnen het toepassingsgebied van de Richtlijnen 2024/23/EU, 2014/24/EU of 2014/25/EU vallen en die op of na [OJ: insert date one year after entry into force] zijn gestart en betrekking hebben op infrastructuur, apparatuur of systemen in zeer kritieke sectoren, zoals vermeld in bijlage I bij

Richtlijn (EU) 2022/2555, en in andere kritieke sectoren, zoals vermeld in bijlage II bij die richtlijn, kunnen aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten van marktdeelnemers verlangen dat zij, samen met hun aanbestedingsdocumenten, een verklaring inzake leveringszekerheid indienen met betrekking tot de inkoop van halfgeleiders die zijn verwerkt in de infrastructuur, apparatuur of systemen waarop de opdracht betrekking heeft.

2. De in lid 1 bedoelde verklaring omvat de volgende elementen:
 - a) een overzicht van de ondernemingen die betrokken zijn bij de levering van de halfgeleiders die in het product zijn verwerkt, met vermelding van het aandeel van binnenlandse ondernemingen;
 - b) de meerwaarde van de Unie, die blijkt uit de bijdrage van de aanbesteding aan de versterking van de Europese toeleveringsketen voor halfgeleiders, zoals de opname van pioniersinitiatieven en strategische projecten als leveranciers;
 - c) de strategie van de inschrijver inzake veerkracht en diversificatie van de toeleveringsketen voor halfgeleiders, zoals de dubbele-inkoopstrategie van de inschrijver, met inbegrip van en voor zover haalbaar en passend, de betrokkenheid van ten minste één binnenlandse onderneming;
 - d) in voorkomend geval, eventuele aanbevelingen of verplichtingen als bedoeld in artikel 31;
 - e) in voorkomend geval, de overeenkomstig artikel 32 uitgevoerde risicobeoordeling inzake leveringszekerheid.
3. Indien marktdeelnemers een verklaring inzake leveringszekerheid moeten overleggen, kunnen aanbestedende diensten en aanbestedende instanties in de aanbestedingsdocumenten vereisten vaststellen met betrekking tot de leveringszekerheid bij de inkoop van halfgeleiders die zijn verwerkt in de infrastructuur, apparatuur of systemen waarop de overheidsopdracht betrekking heeft. Daartoe kunnen aanbestedende autoriteiten en aanbestedende diensten onder meer technische specificaties, selectiecriteria, gunningscriteria of bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht opnemen.
4. De krachtens lid 3 vastgestelde vereisten:
 - a) zijn verbonden met het onderwerp van de opdracht;
 - b) mogen de aanbestedende dienst of de aanbestedende instantie geen onbeperkte keuzevrijheid verlenen;
 - c) worden uitdrukkelijk vermeld in de aanbestedingsdocumenten of in het aanbestedingsbericht;
 - d) zijn bijkomstig en niet doorslaggevend bij de gunning van de opdracht;
 - e) worden opgesteld in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de Unie.
5. Aanbestedende autoriteiten en aanbestedende diensten stellen hun nationale bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 48 van deze verordening in kennis van de lijst van binnenlandse ondernemingen die zijn vermeld in de door de marktdeelnemers afgegeven verklaringen inzake leveringszekerheid.
6. De nationale bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 48 van deze verordening stelt een geverifieerde lijst op van alle binnenlandse ondernemingen die in het kader van

procedures voor overheidsopdrachten binnen de lidstaat in kaart gebracht zijn. De lijsten kunnen geheel of gedeeltelijk tussen de lidstaten worden uitgewisseld, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheidsvoorschriften, overeenkomstig artikel 50.

Artikel 31

Verdere acties op het gebied van overheidsopdrachten

1. Indien de Commissie in het kader van de monitoring die overeenkomstig artikel 35 wordt uitgevoerd, een potentieel risico in de toeleveringsketen constateert, kan zij, na raadpleging van de Europese Raad voor halfgeleiders, aanbevelingen doen aan aanbestedende autoriteiten en aanbestedende diensten met betrekking tot de levering van halfgeleiders door binnenlandse ondernemingen in het kader van de in artikel 30, lid 1, bedoelde aanbestedingsprocedures.
2. Indien de Commissie vaststelt dat de in lid 1 genoemde risico's in de toeleveringsketen voortduren, kan zij, na raadpleging van de Europese Raad voor halfgeleiders en met inachtneming van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid, een uitvoeringsbesluit vaststellen waarin wordt gespecificeerd voor welke specifieke infrastructuren, apparatuur of systemen als bedoeld in artikel 30 de aanbestedende diensten en aanbestedende instanties een verklaring inzake leveringszekerheid van marktdeelnemers moeten eisen.
3. Aanbestedende diensten en aanbestedende instanties kunnen besluiten de vereisten die zijn vastgelegd in het in lid 2 bedoelde uitvoeringsbesluit niet toe te passen, indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - a) de vereiste producten of diensten kunnen alleen door specifieke marktdeelnemers worden geleverd en er bestaat geen redelijk alternatief of een vervangende oplossing en het ontbreken van mededinging is niet het gevolg van een kunstmatige beperking van de parameters van de aanbestedingsprocedure;
 - b) er zijn geen geschikte inschrijvingen of geschikte verzoeken tot deelname ingediend, ook niet naar aanleiding van een soortgelijke eerdere aanbestedingsprocedure die door dezelfde aanbestedende dienst of aanbestedende instantie is uitgeschreven in de twee jaar voorafgaand aan de aanvang van de geplande nieuwe aanbestedingsprocedure;
 - c) het in aanmerking nemen van de overeenkomstig artikel 31, lid 2, punt d), vastgestelde elementen zou een aanbestedende dienst of aanbestedende instantie ertoe verplichten goederen, diensten of werken aan te schaffen tegen onevenredige kosten of zou leiden tot technische incompatibiliteit bij het gebruik en het onderhoud ervan;
 - d) voor de toepassing van punt c) mogen aanbestedende diensten en aanbestedende instanties de op objectieve en transparante gegevens gebaseerde geraamde kostenverschillen die meer dan 25 % van de waarde van de aanbesteding bedragen, als onevenredig beschouwen.

Artikel 32
Risicogevoelige sectoren

1. Na raadpleging van de Europese Raad voor halfgeleiders en op basis van bewijsmateriaal inzake risico's in de toeleveringsketen kan de Commissie door middel van een uitvoeringsbesluit een of meer in bijlage V of bijlage VI genoemde sectoren, of subsectoren daarvan, aanmerken als risicogevoelig.
2. De Commissie kan methodologische richtsnoeren opstellen over de wijze waarop risicobeoordelingen inzake leveringszekerheid moeten worden uitgevoerd en mogelijke risicobeperkende maatregelen aanbevelen voor sectoren die als risicogevoelig zijn aangemerkt. Deze richtsnoeren hebben betrekking op de volgende elementen:
 - a) een dubbele-inkoopstrategie, waarbij ten minste één binnenlandse onderneming is betrokken;
 - b) de inventarisatie van de toeleveringsketen, zowel upstream als downstream;
 - c) kwetsbaarheidsanalyse en gevoeligheid voor verstoring van de levering.
3. De in lid 2 bedoelde risicobeoordelingen betreffende de leveringszekerheid kunnen door aanbestedende diensten of aanbestedende instanties worden aangevraagd in het kader van aanbestedingsprocedures als bedoeld in artikel 30, lid 1.
4. Indien de Commissie, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, van oordeel is dat de in lid 2 bedoelde aanbevolen risicobeperkende maatregelen, die noodzakelijk zijn om de leveringszekerheid van halfgeleiders of producten waarin halfgeleiders zijn verwerkt te waarborgen, niet in voldoende mate worden overgenomen door de als risicogevoelig aangemerkte sector, kan zij een uitvoeringshandeling vaststellen betreffende specifieke risicobeperkende maatregelen die sectoren of subsectoren moeten nemen voor bepaalde halfgeleiderproducten, namelijk risicobeperkende maatregelen met betrekking tot:
 - a) de uitvoering van een risicobeoordeling;
 - b) de inkoop van halfgeleiders;
 - c) dubbele inkoop;
 - d) het aanleggen van voorraden;
 - e) diversificatie van de levering van halfgeleiders of gerelateerde componenten.
5. Na de vaststelling van een uitvoeringshandeling overeenkomstig lid 4 kan de Commissie, op basis van bewijs dat de vastgestelde risico's in de toeleveringsketen zijn aangepakt en na raadpleging van de Europese Raad voor halfgeleiders, de aanmerking als risicogevoelig intrekken.
6. De Commissie baseert haar beoordelingen die overeenkomstig dit artikel worden uitgevoerd op bewijsmateriaal, waaronder openbaar beschikbare informatie, informatie die is verkregen via verzoeken om informatie overeenkomstig artikel 38 of het bestaan van herhaalde verstoringen van de toeleveringsketen.

Hoofdstuk IV

Monitoring en crisisrespons

AFDELING 1

MONITORING

Artikel 33

Strategische inventarisatie van de halfgeleiderindustrie in de Unie

1. De Commissie voert in samenwerking met de Europese Raad voor halfgeleiders een strategische inventarisatie uit van de halfgeleiderindustrie in de Unie. De strategische inventarisatie verschaft een analyse van de sterke en zwakke punten van de Unie in de mondiale halfgeleiderindustrie en brengt factoren in kaart zoals:
 - a) belangrijke producten en kritieke infrastructuren op de interne markten die afhankelijk zijn van de levering van halfgeleiders;
 - b) de belangrijkste verwerkende industrieën in de Unie en hun huidige en verwachte behoeften en afhankelijkheden, met inbegrip van een analyse van de mogelijke risico's voor de leveringszekerheid, ook in verband met ontoereikende investeringen;
 - c) cruciale segmenten van de toeleveringsketen voor halfgeleiders van de Unie, met inbegrip van ontwerp, software voor ontwerp, materialen, fabricageapparatuur, fabricage van halfgeleiders en uitbestede back-endfabricage;
 - d) de technologische kenmerken, de afhankelijkheden van technologie uit een derde land en leveranciers en knelpunten van de halfgeleiderindustrie van de Unie, met inbegrip van de toegang tot basisproducten;
 - e) huidige en verwachte behoeften aan vaardigheden en effectieve toegang tot gekwalificeerde arbeidskrachten in de halfgeleiderindustrie;
 - f) in voorkomend geval, de mogelijke gevolgen van de in de artikelen 41, 42 en 43 bedoelde crisismaatregelen voor de halfgeleiderindustrie.
2. De Commissie brengt de Europese Raad voor halfgeleiders regelmatig op de hoogte van de geaggregeerde resultaten van de strategische inventarisatie.
3. De Commissie stelt, op basis van de resultaten van de overeenkomstig lid 1 uitgevoerde strategische inventarisatie en na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, een lijst van indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing op. De Commissie evalueert, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, regelmatig de lijst van indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing.
4. De Commissie ontwikkelt, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, een kader en methodologie voor een strategische inventarisatie van de halfgeleiderindustrie. De Commissie actualiseert het kader en de methodologie indien nodig.
5. De strategische inventarisatie wordt met name gebaseerd op openbaar en commercieel beschikbare gegevens en relevante, niet-vertrouwelijke informatie van

ondernemingen, het resultaat van soortgelijke uitgevoerde analyses en de overeenkomstig artikel 57, lid 1, uitgevoerde evaluaties. Indien dit niet volstaat om de strategische inventarisatie overeenkomstig lid 1 tot stand te brengen, kan de Commissie na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders vrijwillige verzoeken om informatie richten aan actoren over de waardeketen van halfgeleiders in de Unie. Ten behoeve van dergelijke verzoeken om informatie voorziet de Commissie in gestandaardiseerde, beveiligde middelen voor de in artikel 50, bedoelde verzameling en verwerking van informatie.

6. Alle uit hoofde van dit artikel verkregen informatie wordt behandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheidsverplichtingen in artikel 50.
7. De Commissie stelt na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders richtsnoeren vast voor de verstrekking van informatie overeenkomstig lid 5. De Commissie actualiseert de richtsnoeren indien nodig.

Artikel 34

Business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders

1. De Commissie zorgt voor de oprichting van het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders (“het platform”), dat dient als een digitale tweeling van de toeleveringsketen voor halfgeleiders, met als doel de transparantie en veerkracht ervan te vergroten. Het platform zorgt ten minste voor het volgende:
 - a) het verzamelen van marktinformatie en geaggregeerde gegevens om als waarnemingspost voor de halfgeleidermarkt te fungeren;
 - b) het verzamelen van gegevens van deelnemende ondernemingen in een interoperabel formaat;
 - c) het verschaffen van geaggregeerde inzichten aan de deelnemende ondernemingen met betrekking tot de risico's en kwetsbaarheden in de toeleveringsketen voor halfgeleiders in de gehele waardeketen voor halfgeleiders, zonder dat deze inzichten aan individuele ondernemingen kunnen worden toegeschreven;
 - d) de deelname van ondernemingen die actief zijn in de toeleveringsketen voor halfgeleiders en van gebruikers van halfgeleiders, met name in de in bijlage VI genoemde sectoren;
 - e) het uitvoeren van stresstests van de toeleveringsketen voor halfgeleiders;
 - f) het vroegtijdig verstrekken van waarschuwingen en richtsnoeren voor proactieve maatregelen aan de deelnemende ondernemingen om hun toeleveringsketen voor halfgeleiders minder kwetsbaar te maken;
 - g) het ontwikkelen van indicatoren om de veerkracht van de Europese toeleveringsketen voor halfgeleiders te beoordelen en de presentatie daarvan in de vorm van een dashboard;
 - h) een beveiligde verwerkingsomgeving.
2. Deelname aan het platform staat uitsluitend open voor binnenlandse ondernemingen.
3. De wettelijke vertegenwoordiger van het platform stelt de Commissie zonder onnodige vertraging in kennis van huidige of verwachte verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders.

Artikel 35
Monitoring en anticipatie

1. De Commissie voorziet, in overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, in de regelmatige monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders om vast te stellen welke factoren de levering van halfgeleiders in de Unie of de handel daarin kunnen verstoren, in gevaar kunnen brengen of negatief kunnen beïnvloeden. Voor de toepassing van deze verordening bestaat de monitoring uit de volgende activiteiten:
 - a) de monitoring van de overeenkomstig artikel 33, vastgestelde indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing;
 - b) de monitoring door de lidstaten van de integriteit van de activiteiten die worden uitgevoerd door de overeenkomstig artikel 36 aangewezen cruciale marktspelers en de rapportage door de lidstaten over belangrijke gebeurtenissen die de reguliere uitvoering van dergelijke activiteiten kunnen belemmeren;
 - c) het in kaart brengen van beste praktijken voor preventieve risicobeperking en meer transparantie in de halfgeleiderindustrie.

Na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders stelt de Commissie de frequentie van de monitoring vast op basis van de behoeften van de halfgeleiderindustrie.

De Commissie coördineert de activiteiten in verband met de monitoring van de halfgeleiderindustrie op basis van informatie die is verzameld op grond van artikel 33, artikel 34, lid 3, of van andere bronnen, zoals internationale partners.

2. De Commissie nodigt cruciale marktspelers, een representatieve groep gebruikers van halfgeleiders uit de kritieke sectoren, representatieve organisaties uit de waardeketen voor halfgeleiders en andere belanghebbenden uit om op vrijwillige basis informatie te verstrekken met het oog op de uitvoering van monitoringactiviteiten overeenkomstig lid 1, punt a).

De Commissie besteedt bijzondere aandacht aan kmo's en kleine midcap-ondernemingen om de administratieve lasten als gevolg van de informatieverzameling tot een minimum te beperken.

3. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt b), kunnen de lidstaten, wanneer zulks nodig en evenredig is, op vrijwillige basis informatie opvragen bij cruciale marktspelers.
4. Voor de toepassing van lid 3 zorgen de overeenkomstig artikel 48 aangewezen nationale bevoegde instanties voor het opstellen en bijhouden van een lijst met contactpersonen van alle relevante, op hun grondgebied gevestigde ondernemingen die actief zijn in de toeleveringsketen voor halfgeleiders. De lijst wordt aan de Commissie toegezonden. Met het oog op interoperabiliteit voorziet de Commissie in een model voor de lijst van contactpersonen.
5. Alle op grond van dit artikel verkregen informatie wordt overeenkomstig artikel 50 verwerkt.
6. Op basis van de informatie die door middel van de activiteiten uit hoofde van lid 1 is verzameld, brengt de Commissie verslag uit over alle bevindingen aan de Europese Raad voor halfgeleiders in de vorm van regelmatige updates. De Europese Raad voor halfgeleiders komt bijeen om de resultaten van de monitoring te beoordelen. De

Commissie nodigt representatieve organisaties uit de waardeketen voor halfgeleiders uit voor dergelijke vergaderingen. Indien wenselijk kan de Commissie tevens cruciale marktspelers, gebruikers van halfgeleiders uit kritieke sectoren, autoriteiten of representatieve organisaties uit partnerlanden en deskundigen uit de academische wereld en het maatschappelijk middenveld uitnodigen voor dergelijke vergaderingen.

Artikel 36 *Cruciale marktspelers*

De lidstaten brengen, in samenwerking met de Commissie en overeenkomstig artikel 35, de op hun grondgebied gevestigde cruciale marktspelers in de toeleveringsketen voor halfgeleiders in kaart, rekening houdend met de volgende elementen:

- a) het aantal ondernemingen in de Unie dat afhankelijk is van de diensten of goederen die door een marktpartij worden aangeboden;
- b) het marktaandeel in de Unie of wereldwijd van een marktspeler op de markt voor dergelijke diensten of goederen;
- c) het belang van een marktspeler om een toereikend niveau van aanbod van diensten of goederen in de Unie te handhaven, rekening houdend met de beschikbaarheid van alternatieve middelen voor het leveren van die diensten of goederen;
- d) de gevolgen die een verstoring van het aanbod van de door de marktspeler geleverde diensten of goederen kan hebben voor de toeleveringsketen van halfgeleiders in de Unie en de daarvan afhankelijke markten.

AfDELING 2

WAARSCHUWINGEN EN DE ACTIVERING VAN DE CRISISFASE

Artikel 37 *Waarschuwingen en preventieve maatregelen*

1. Indien een nationale bevoegde instantie die overeenkomstig artikel 48 is aangewezen, kennis krijgt van een risico op ernstige verstoring in de levering van halfgeleiders of beschikt over concrete en betrouwbare informatie over een andere relevante risicofactor of reële gebeurtenis, waarschuwt zij de Commissie onverwijld.
2. Indien de Commissie, onder meer op basis van indicatoren voor vroege waarschuwing, na een waarschuwing op grond van lid 1 of via internationale partners, kennis krijgt van een risico op ernstige verstoring in de levering van halfgeleiders of beschikt over concrete en betrouwbare informatie over een andere relevante risicofactor of reële gebeurtenis, doet zij onverwijld het volgende:
 - a) zij roept een buitengewone vergadering van de Europese Raad voor halfgeleiders samen voor coördinatie van de volgende acties:
 - i) zij bespreekt de ernst van de verstoring in de levering van halfgeleiders;
 - ii) zij houdt een gedachtewisseling over de vraag of het inleiden van de in artikel 39 bedoelde procedure noodzakelijk en evenredig kan zijn;

- iii) zij bespreekt of het voor de lidstaten passend, noodzakelijk en evenredig is om bij wijze van preventieve maatregel over te gaan tot gezamenlijke aankoop van halfgeleiders, tussenproducten van grondstoffen (gezamenlijke aanbesteding);
 - iv) zij treedt in dialoog met belanghebbenden in de waardeketen voor halfgeleiders met het oog op het vaststellen, voorbereiden en eventueel coördineren van preventieve maatregelen;
 - v) zij adviseert de Commissie over de vraag of er overeenkomstig artikel 38 een verzoek om informatie aan het platform moet worden gericht.
- b) zij treedt, namens de Unie, in overleg of samenwerking met relevante derde landen teneinde in overeenstemming met internationale verplichtingen op samenwerking gebaseerde oplossingen te zoeken ten aanzien van verstoringen van de toeleveringsketen die in voorkomend geval coördinatie in relevante internationale fora kunnen omvatten;
 - c) zij verzoekt de overeenkomstig artikel 48 aangewezen nationale bevoegde instanties om de mate van paraatheid van cruciale marktspelers te beoordelen.
3. Elke gezamenlijke aanbesteding die wordt uitgevoerd naar aanleiding van de in lid 2, punt a), iii), bedoelde besprekingen, wordt door de lidstaten uitgevoerd overeenkomstig de regels van de artikelen 38 en 39 van Richtlijn 2014/24/EU en de artikelen 56 en 57 van Richtlijn 2014/25/EU.

Artikel 38

Preventieve informatieverzameling

1. Om het risico van ernstige verstoringen in de levering van halfgeleiders te beoordelen, kan de Commissie verzoeken om informatie richten tot het platform of tot afzonderlijke ondernemingen die actief zijn in de waardeketen voor halfgeleiders en die diensten verlenen in de Unie of producten op de markt van de Unie aanbieden, indien zij geen deel uitmaken van het platform, na raadpleging van de Europese Raad voor halfgeleiders tijdens de in artikel 37, lid 2, punt a), bedoelde buitengewone vergadering.
2. Alvorens een verzoek om informatie te versturen, kan de Commissie een facultatief overleg met een representatief aantal relevante ondernemingen organiseren om de passende en evenredige inhoud van dat verzoek vast te stellen.
3. In een verzoek om informatie aan een individuele onderneming moeten de rechtsgrondslag en het doel van het verzoek worden vermeld; het verzoek moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is en evenredig zijn wat betreft de omvang van de gegevens en de frequentie waarmee toegang wordt verkregen tot de gevraagde gegevens. In het verzoek wordt de termijn vermeld waarbinnen de informatie moet worden verstrekt, alsmede de mogelijke sancties voor het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie overeenkomstig artikel 51. De gegevens worden, waar nodig, geanonimiseerd en geaggregeerd. Wanneer een onderneming in de Unie het voorwerp uitmaakt van een verzoek om informatie overeenkomstig lid 5, stelt de Commissie de lidstaat waarin de betrokken onderneming is gevestigd, in kennis van dat verzoek.
4. In een verzoek om informatie aan de wettelijke vertegenwoordiger van het platform worden de rechtsgrondslag en het doel van het verzoek vermeld; het verzoek moet

beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is en evenredig zijn wat betreft de omvang van de gegevens en de frequentie waarmee toegang wordt gevraagd tot de gevraagde gegevens, rekening houdend met de legitieme doelstellingen van het platform. In het verzoek wordt de termijn vermeld waarbinnen de informatie moet worden verstrekt, en wordt informatie opgenomen over mogelijke sancties op grond van artikel 51.

5. De eigenaren van de ondernemingen of hun vertegenwoordigers en, in het geval van rechtspersonen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de krachtens de wet of de statuten tot vertegenwoordiging bevoegde personen verstrekken de gevraagde informatie namens de betrokken onderneming of ondernemersvereniging.
6. De Commissie legt de geaggregeerde gegevens uit de antwoorden op verzoeken om informatie voor aan de Europese Raad voor halfgeleiders.
7. De wettelijke vertegenwoordiger van het platform geeft geen gehoor aan verzoeken om informatie die niet door de Commissie zijn ingediend, tenzij hij daartoe krachtens het Unierecht of het nationale recht wettelijk verplicht is.
8. Alle op grond van dit artikel verkregen informatie wordt overeenkomstig artikel 50 verwerkt.

Artikel 39 *Activering van de crisisfase*

1. Er is sprake van een halfgeleidercrisis wanneer aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:
 - a) er is sprake van ernstige verstoringen in de toeleveringsketen van halfgeleiders of ernstige belemmeringen voor de handel in halfgeleiders binnen de Unie die leiden tot aanzienlijke tekorten aan halfgeleiders, halffabricaten of grondstoffen of verwerkte materialen;
 - b) dergelijke aanzienlijke tekorten verhinderen de levering, reparatie of het onderhoud van essentiële producten die door kritieke sectoren worden gebruikt, en wel in zodanige mate dat er sprake zou zijn van ernstige nadelige gevolgen voor de werking van de kritieke sectoren vanwege hun impact op de samenleving, de economie en de veiligheid van de Unie.
2. Wanneer de Commissie kennis krijgt van een mogelijke halfgeleidercrisis overeenkomstig artikel 37, lid 2, beoordeelt zij of aan de voorwaarden van lid 1 van dit artikel is voldaan. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de mogelijke positieve en negatieve effecten en gevolgen van de crisisfase voor de halfgeleiderindustrie en de kritieke sectoren van de Unie. Indien die beoordeling concrete en betrouwbare aanwijzingen voor een halfgeleidercrisis oplevert, kan de Commissie, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, de Raad voorstellen de crisisfase te activeren.
3. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten tot activering van de crisisfase door middel van een uitvoeringshandeling. De duur van de crisisfase wordt in de uitvoeringshandeling vermeld en bedraagt ten hoogste twaalf maanden.

De Commissie brengt regelmatig, en ten minste om de drie maanden, verslag uit aan de Europese Raad voor halfgeleiders en het Europees Parlement over de stand van zaken met betrekking tot de crisis.

4. Vóór het verstrijken van de periode waarvoor de crisisfase was geactiveerd, beoordeelt de Commissie of het passend is om de crisisfase te verlengen. Indien deze beoordeling concrete en betrouwbare aanwijzingen oplevert dat er nog steeds aan de voorwaarden voor activering van de crisisfase wordt voldaan, kan de Commissie, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, de Raad voorstellen de crisisfase te verlengen.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten tot verlenging van de crisisfase door middel van een uitvoeringshandeling. De duur van de verlenging wordt beperkt en in die uitvoeringshandeling vermeld.

De Commissie kan voorstellen de crisisfase eenmaal of vaker te verlengen wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd is.

5. Tijdens de crisisfase beoordeelt de Commissie, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, of een vroegtijdige beëindiging van de crisisfase passend is. Indien de beoordeling daar aanleiding toe geeft, kan de Commissie aan de Raad voorstellen de crisisfase te beëindigen.

De Raad kan besluiten tot beëindiging van de crisisfase door middel van een uitvoeringshandeling.

6. Tijdens de crisisfase roept de Commissie, op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief, indien nodig buitengewone vergaderingen van de Europese Raad voor halfgeleiders bijeen.

De lidstaten werken nauw samen met de Commissie, brengen haar tijdig op de hoogte van alle nationale maatregelen van de Europese Raad voor halfgeleiders met betrekking tot de toeleveringsketen voor halfgeleiders en zorgen voor de coördinatie van deze maatregelen.

7. Na het verstrijken van de periode waarvoor de crisisfase was geactiveerd of in geval van vroegtijdige beëindiging op grond van lid 5, houden de overeenkomstig de artikelen 41, 42 en 43 genomen maatregelen onmiddellijk op van toepassing te zijn.

8. De Commissie actualiseert de inventarisatie en de monitoring van de waardeketens voor halfgeleiders op grond van de artikelen 33 en 35, rekening houdend met de ervaring die men in de crisis heeft opgedaan, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de duur van de crisisfase.

AFDELING 3

RESPONS BIJ TEKORTEN

Artikel 40

Instrumentarium voor noodsituaties

1. Wanneer de crisisfase wordt geactiveerd op grond van artikel 39 en indien nodig om de halfgeleidercrisis in de Unie aan te pakken, kan de Commissie de in artikel 41, 42 of 43 bedoelde maatregelen nemen onder de daarin vastgelegde voorwaarden.
2. De Commissie moet, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, de toepassing van de in de artikelen 42 en 43 bedoelde maatregelen beperken tot de

kritieke sectoren waarvan de werking als gevolg van de halfgeleidercrisis wordt verstoord of dreigt te worden verstoord. Het gebruik van de in lid 1 bedoelde maatregelen is evenredig en beperkt tot wat noodzakelijk is om ernstige verstoringen die van invloed zijn op kritieke sectoren in de Unie aan te pakken, en moet in het belang van de Unie zijn. Bij het gebruik van die maatregelen wordt voorkomen dat met name kmo's en kleine midcap-ondernemingen onevenredige administratieve lasten worden opgelegd.

3. Wanneer de crisisfase wordt geactiveerd overeenkomstig artikel 39 en indien nodig om de halfgeleidercrisis in de Unie aan te pakken, kan de Europese Raad voor halfgeleiders:
 - a) passende en doeltreffende noodmaatregelen overwegen en daarover advies verstrekken;
 - b) het verwachte effect van de mogelijke oplegging van beschermende maatregelen op de halfgeleiderindustrie van de Unie beoordelen, door te onderzoeken of de marktsituatie overeenstemt met een aanzienlijke schaarste aan essentiële producten overeenkomstig Verordening (EU) 2015/479, en de Commissie een advies verstrekken.
4. De Commissie brengt het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte van alle overeenkomstig lid 1 genomen maatregelen en licht de redenen voor haar besluit toe.
5. De Commissie kan, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, richtsnoeren verstrekken over de invoering en het gebruik van de noodmaatregelen.

Artikel 41

Informatieverzameling tijdens de crisisfase

1. Wanneer de crisisfase wordt geactiveerd op grond van artikel 39 kan de Commissie alle ondernemingen die actief zijn in de toeleveringsketen voor halfgeleiders, verzoeken informatie te verstrekken over hun productievermogen, hun productiecapaciteit en huidige primaire verstoringen. De gevraagde informatie blijft beperkt tot wat noodzakelijk is om de aard van de halfgeleidercrisis te beoordelen of om mogelijke beperkende of noodmaatregelen op Unieniveau of nationaal niveau vast te stellen en te beoordelen. De verzoeken om informatie leiden er niet toe dat informatie wordt verstrekt waarvan de openbaarmaking strijdig zou zijn met de nationale veiligheidsbelangen van de lidstaten.
2. Alvorens een verzoek om informatie te versturen, kan de Commissie een facultatief overleg met een representatief aantal relevante ondernemingen organiseren om de passende en evenredige inhoud van een dergelijk verzoek vast te stellen. De Commissie stelt het verzoek om informatie op in overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders.
3. De Commissie verwerkt eventueel verkregen informatie overeenkomstig artikel 50 en gebruikt de beveiligde middelen om het verzoek om informatie te versturen. Daartoe verstrekken de overeenkomstig artikel 48 aangewezen nationale bevoegde autoriteiten aan de Commissie de overeenkomstig artikel 35, lid 4, opgestelde lijst van contactpersonen.

De Commissie zendt onverwijld een afschrift van het verzoek om informatie aan de overeenkomstig artikel 48 is aangewezen nationale bevoegde instantie van de lidstaat

op het grondgebied waarvan de productielocatie van de geadresseerde onderneming zich bevindt. Indien de nationale bevoegde instantie daarom verzoekt, zendt de Commissie de van de desbetreffende onderneming verkregen informatie aan haar door overeenkomstig het Unierecht.

4. Het verzoek om informatie vermeldt de rechtsgrondslag, beperkt zich tot het strikt noodzakelijke minimum, is evenredig wat betreft de gedetailleerdheid en de omvang van de gegevens en de frequentie van de toegang tot de gevraagde gegevens, houdt rekening met de legitieme doelstellingen van de onderneming en de kosten en inspanningen die noodzakelijk zijn om de gegevens beschikbaar te stellen, en vermeldt de termijn waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. Het verzoek vermeldt eveneens de in artikel 51 bedoelde sancties.
5. De eigenaren van de ondernemingen of hun vertegenwoordigers en, in het geval van rechtspersonen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de krachtens de wet of de statuten tot vertegenwoordiging bevoegde personen verstrekken de gevraagde informatie namens de betrokken onderneming of ondernemersvereniging.
6. Indien een onderneming in antwoord op een verzoek uit hoofde van dit artikel onjuiste, onvolledige of misleidende informatie verstrekt of de informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt, wordt haar een geldboete opgelegd overeenkomstig artikel 51, tenzij de onderneming voldoende redenen heeft om de gevraagde informatie niet te verstrekken.
7. Indien een onderneming in de Unie of een dochteronderneming die eigendom is en onder zeggenschap staat van die onderneming, van een derde land een verzoek om informatie ontvangt met betrekking tot haar activiteiten op het gebied van halfgeleiders, verstrekt zij de door het derde land verzochte en aan dat derde land verstrekte informatie onmiddellijk aan de Commissie. De Commissie informeert de Europese Raad voor halfgeleiders dat er sprake is van een dergelijk verzoek uit een derde land en deelt mee welke informatie door de onderneming is verstrekt.

Artikel 42

Als prioritair aangemerkte bestellingen

1. Indien de crisisfase wordt geactiveerd op grond van artikel 39, kan de Commissie Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleiderstechnologie ertoe verplichten een bestelling van in een crisis relevante producten te aanvaarden en daaraan voorrang te geven (als prioritair aangemerkte bestellingen). Een dergelijke verplichting heeft voorrang boven alle andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke prestatieverplichtingen.
2. Indien van toepassing kan de verplichting van lid 1 ook worden opgelegd aan andere halfgeleiderondernemingen die deze mogelijkheid hebben aanvaard wanneer zij overheidssteun ontvangen.
3. Indien een in de Unie gevestigde halfgeleideronderneming onderworpen is aan een maatregel inzake als prioritair aangemerkte bestellingen uit een derde land, stelt zij de Commissie daarvan in kennis. Indien die verplichting aanzienlijke gevolgen heeft voor de werking van bepaalde kritieke sectoren, kan de Commissie die onderneming, indien nodig en evenredig, verplichten bestellingen van in een crisis relevante producten te aanvaarden en daaraan voorrang te geven overeenkomstig de leden 5, 6 en 7.

4. Als prioritair aangemerkte bestellingen zijn uitsluitend bestemd voor begunstigden die gebruikers van halfgeleiders uit kritieke sectoren zijn of voor ondernemingen die leveren aan kritieke sectoren waarvan de activiteiten verstoord worden of dreigen te worden verstoord en die, ondanks dat zij passende risicobeperkende maatregelen hebben getroffen, niet in staat waren de gevolgen van het tekort te voorkomen of te temperen. De Commissie kan een begunstigde verzoeken daarvoor passend bewijs te leveren.
5. De verplichtingen uit hoofde van de leden 1, 2 en 3 worden door de Commissie bij besluit vastgesteld, en uitsluitend als uiterste middel. De Commissie stelt dat besluit vast na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders en in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen van de Unie, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, alsook met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de legitieme doelstellingen van de betrokken onderneming en met de kosten, inspanningen en technische aanpassingen die vereist zijn voor een eventuele wijziging van de productiesequentie. In haar besluit vermeldt de Commissie de rechtsgrondslag van de als prioritair aangemerkte bestelling, legt zij de termijn vast waarbinnen de bestelling moet worden uitgevoerd en specificeert zij in voorkomend geval het product en de hoeveelheid, en vermeldt zij, in voorkomend geval, de in artikel 51 bedoelde sancties voor niet-naleving van een dergelijke verplichting. De als prioritair aangemerkte bestelling wordt tegen een eerlijke en redelijke prijs geplaatst.
6. Alvorens als prioritair aangemerkte bestellingen overeenkomstig lid 1 te plaatsen, stelt de Commissie de beoogde ontvanger van een als prioritair aangemerkte bestelling in de gelegenheid om te worden gehoord over de haalbaarheid en de details van de bestelling. De Commissie plaatst de als prioritair aangemerkte bestelling niet indien:
 - a) de onderneming wegens een ontoereikend productievermogen of onvoldoende productiecapaciteit of om technische redenen niet in staat is de als prioritair aangemerkte bestelling uit te voeren, zelfs niet bij preferentiële behandeling van de bestelling;
 - b) aanvaarding van de bestelling een onredelijke economische last zou meebrengen en de onderneming bijzondere moeilijkheden zou berokkenen, waaronder een aanzienlijk risico voor de bedrijfscontinuïteit.
7. Wanneer een onderneming ertoe wordt verplicht een als prioritair aangemerkte bestelling te aanvaarden en daaraan prioriteit te verlenen, is zij niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van contractuele verplichtingen die het gevolg is van de uitvoering van de als prioritair aangemerkte bestelling. Contractuele aansprakelijkheid wordt alleen uitgesloten voor zover de schending van contractuele verplichtingen noodzakelijk was om te voldoen aan de opgelegde prioritering.
8. De Commissie stelt een uitvoeringshandeling vast met de praktische en operationele regelingen voor het werken met als prioritair aangemerkte bestellingen. Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 55, lid 6, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 43
Gemeenschappelijke aankopen

1. Wanneer de crisisfase wordt geactiveerd overeenkomstig artikel 39 kan de Commissie, op verzoek van twee of meer lidstaten, namens alle lidstaten die wensen deel te nemen (deelnemende lidstaten) als aankoopcentrale optreden voor hun overheidsopdrachten betreffende in een crisis relevante producten voor kritieke sectoren (gemeenschappelijke aankopen). Deelname aan de gemeenschappelijke aankopen laat andere aanbestedingsprocedures onverlet. Een verzoek om gezamenlijke aankoop bevat de redenen voor het verzoek en kan alleen worden gedaan met het oog op het aanpakken van verstoringen in de toeleveringsketen van halfgeleiders die de crisis hebben veroorzaakt.
2. De Commissie beoordeelt het nut, de noodzaak en de evenredigheid van het verzoek, rekening houdend met de standpunten van de Europese Raad voor halfgeleiders. Indien de Commissie voornemens is geen gevolg te geven aan het verzoek, stelt zij de betrokken lidstaten en de Europese Raad voor halfgeleiders daarvan in kennis en motiveert zij haar weigering.
3. De Commissie stelt een voorstel op voor een overeenkomst die door de deelnemende lidstaten moet worden ondertekend. Een dergelijke overeenkomst regelt omstandig de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke aankopen, met inbegrip van de redenen voor de toepassing van het mechanisme voor gezamenlijke aankoop en de verbintenissen die worden aangegaan, en bevat het mandaat voor de Commissie om namens de deelnemende lidstaten op te treden.
4. Aanbestedingen uit hoofde van deze verordening worden door de Commissie uitgevoerd overeenkomstig de regels waarin Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 voorziet voor haar eigen aanbestedingen. De Commissie kan de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben om namens alle deelnemende lidstaten contracten te sluiten met marktpartijen, met inbegrip van individuele producenten van in een crisis relevante producten, met betrekking tot de aankoop van dergelijke producten of betreffende de financiering van de productie of de ontwikkeling van dergelijke producten in ruil voor een prioritair recht op het resultaat.
5. Wanneer de aanbesteding van in een crisis relevante producten financiering uit de begroting van de Unie omvat, kunnen er specifieke voorwaarden worden vastgelegd in specifieke overeenkomsten met marktpartijen.
6. De Commissie voert de aanbestedingsprocedures uit en sluit de overeenkomsten met de marktpartijen namens de deelnemende lidstaten. De Commissie verzoekt de deelnemende lidstaten om vertegenwoordigers aan te wijzen die deelnemen aan de voorbereiding van de aanbestedingsprocedures. De deelnemende lidstaten blijven verantwoordelijk voor de uitrol, het gebruik en de doorverkoop van de aangekochte producten overeenkomstig de in lid 3 bedoelde overeenkomst.
7. De inzet van gemeenschappelijke aankopen uit hoofde van dit artikel laat andere instrumenten waarin Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 voorziet onverlet.

HOOFDSTUK V

Bestuur

AFDELING 1

EUROPESE RAAD VOOR HALFGELEIDERS

Artikel 44

Taken van de Europese Raad voor halfgeleiders

1. De Europese Raad voor halfgeleiders staat de Commissie bij in kwesties die betrekking hebben op het beleid inzake halfgeleiders van de Unie, met name door:
 - a) het verstrekken van advies over het initiatief Chips voor Europa 2.0 aan de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”;
 - b) het verstrekken van advies aan de Commissie over strategische technologische gebieden binnen de waardeketen voor halfgeleiders;
 - c) het verstrekken van advies aan de Commissie bij de beoordeling van de aanvragen voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie;
 - d) het voeren van een gestructureerde dialoog met het stuurcomité van de industriële alliantie voor halfgeleiders, met het oog op het vaststellen van een gemeenschappelijke strategie op het gebied van halfgeleiders;
 - e) gedachtenwisselingen met de Commissie over de voortgang bij de uitvoering van de investeringsplannen van uitmuntende halfgeleiderregio's;
 - f) gedachtewisselingen met de Commissie over de beste manieren om, overeenkomstig het Unierecht en nationaal recht, te zorgen voor een doeltreffende bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen, met de nodige betrokkenheid van belanghebbenden, met betrekking tot de halfgeleiderindustrie;
 - g) besprekingen en voorbereidingen voor de aanwijzing van specifieke sectoren en technologieën die mogelijk een grote sociale of ecologische impact hebben of van belang zijn op het gebied van veiligheid en bijgevolg certificering voor groene, betrouwbare en veilige producten nodig hebben;
 - h) de behandeling van kwesties op het gebied van strategische inventarisatie, monitoring, waarschuwing en preventieve maatregelen en crisisrespons;
 - i) advisering over de instrumenten inzake de crisisfase waarin de artikelen 40 tot en met 43 voorzien;
 - j) verstrekking van advies en aanbevelingen over de consistente uitvoering van deze verordening, bevordering van samenwerking tussen de lidstaten en uitwisseling van informatie over aangelegenheden die verband houden met deze verordening;
 - k) adviseren van de Commissie over zaken met betrekking tot internationale samenwerking op het gebied van halfgeleiders.

2. De Raad adviseert en informeert de Commissie over de prioriteiten van de lidstaten in de halfgeleidersector, met name door regelmatig actuele informatie te verstrekken over:
 - a) hun nationale beleid inzake halfgeleiders;
 - b) relevante publieke en particuliere investeringen op het grondgebied van de lidstaat die zij vertegenwoordigen;
 - c) internationale verbintenissen, waaronder programma's op het gebied van O&O, innovatie en uitwisseling van vaardigheden met derde landen.
3. De Europese Raad voor halfgeleiders zorgt in voorkomend geval voor coördinatie, samenwerking en informatie-uitwisseling met de desbetreffende structuren voor crisisrespons en crisisparaatheid die krachtens het Unierecht zijn opgericht.

Artikel 45

Structuur van de Europese Raad voor halfgeleiders

1. De Europese Raad voor halfgeleiders bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. Een vertegenwoordiger van de Commissie is de voorzitter van de Europese Raad voor halfgeleiders.
2. Elke lidstaat benoemt een vertegenwoordiger op hoog niveau in de Europese Raad voor halfgeleiders. Indien dit relevant is voor de functie en de deskundigheid, kan een lidstaat meer dan één vertegenwoordiger hebben met betrekking tot verschillende taken van de Europese Raad voor halfgeleiders. Elk lid van de Europese Raad voor halfgeleiders heeft een plaatsvervanger. Enkel de lidstaten zijn stemgerechtigd. Elke lidstaat heeft slechts één stem, ongeacht hoeveel vertegenwoordigers hij heeft.
3. De voorzitter kan permanente of tijdelijke subgroepen oprichten om specifieke vraagstukken te onderzoeken.

In voorkomend geval nodigt de voorzitter representatieve organisaties uit de halfgeleiderwaardeketen, het stuurcomité van de industriële alliantie voor halfgeleiders en de desbetreffende werkgroepen daarvan, vakbonden en gebruikers van halfgeleiders op het niveau van de Unie uit om input te leveren aan deze subgroepen in de hoedanigheid van waarnemers.

Artikel 46

Werking van de Europese Raad voor halfgeleiders

1. De Europese Raad voor halfgeleiders belegt ten minste een keer per jaar een gewone vergadering. Hij kan op verzoek van de Commissie of een lidstaat buitengewone vergaderingen houden als bedoeld in de artikelen 37 en 39.
2. De Europese Raad voor halfgeleiders houdt afzonderlijke vergaderingen voor zijn taken bedoeld in artikel 44, lid 1.
3. De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda op overeenkomstig de taken van de Europese Raad voor halfgeleiders uit hoofde van deze verordening en overeenkomstig zijn reglement.

De Commissie verleent administratieve en analytische ondersteuning voor de activiteiten van de Europese Raad voor halfgeleiders overeenkomstig artikel 44.

4. In voorkomend geval nodigt de voorzitter representatieve organisaties uit de halfgeleiderindustrie en deskundigen met specifieke kennis over het onderwerp, onder meer van organisaties van belanghebbenden zoals het netwerk van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's, uit en wijst hij waarnemers aan om deel te nemen aan de vergaderingen, onder meer op voorstel van leden. De voorzitter kan uitwisselingen faciliteren tussen de Europese Raad voor halfgeleiders en andere organen, instanties, deskundigengroepen en adviesgroepen van de Unie, waaronder de industriële alliantie voor halfgeleiders. De voorzitter zorgt ervoor dat het stuurcomité van de industriële alliantie voor halfgeleiders ten minste eenmaal per jaar wordt uitgenodigd om de laatste stand van zaken te presenteren en relevante aspecten van de Europese strategische aanpak op het gebied van halfgeleiders te bespreken.
5. De voorzitter nodigt een vertegenwoordiger van het Europees Parlement uit als permanent waarnemer in de Europese Raad voor halfgeleiders, met name voor vergaderingen over hoofdstuk IV inzake monitoring en crisisrespons. De voorzitter zorgt voor deelname van andere relevante instellingen en organen van de Unie als waarnemer in de Europese Raad voor halfgeleiders wanneer de vergadering betrekking heeft op hoofdstuk IV inzake monitoring en crisisrespons.

Waarnemers en deskundigen hebben geen stemrecht en nemen niet deel aan het formuleren van standpunten, aanbevelingen of adviezen van de Europese Raad voor halfgeleiders en zijn subgroepen. In voorkomend geval kan de Europese Raad voor halfgeleiders deze waarnemers en deskundigen uitnodigen om met informatie en inzichten aan de vergadering bij te dragen.
6. De Europese Raad voor halfgeleiders neemt de nodige maatregelen om de veilige behandeling en verwerking van vertrouwelijke informatie in overeenstemming met artikel 50 te waarborgen.

Artikel 47

Internationale samenwerking en strategische partnerschappen voor halfgeleiders

1. De Europese Raad voor halfgeleiders adviseert de Commissie over zaken met betrekking tot internationale samenwerking op het gebied van halfgeleiders. Daartoe bespreekt de Europese Raad voor halfgeleiders periodiek de volgende punten:
 - a) de mate waarin de internationale samenwerking van de Unie op het gebied van halfgeleiders, met inbegrip van strategische partnerschappen daarvoor, bijdraagt aan:
 - het versterken van de onmisbaarheid, veerkracht en welvaart van de Unie;
 - het verbeteren van de samenwerking binnen de waardeketen voor halfgeleiders tussen de Unie en internationale partners, onder meer op het gebied van onderzoek en innovatie;
 - het bestrijden van het tekort aan kennis en vaardigheden en het aanpakken van de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden door nieuw talent aan te trekken, in te zetten en binnen de Unie te houden;
 - b) de samenhang en mogelijke synergieën tussen bilaterale samenwerking van lidstaten met relevante internationale partners en de acties die in het kader van internationale samenwerking worden ondernomen op het gebied van

halfgeleiders, met inbegrip van strategische partnerschappen voor halfgeleiders;

c) welke internationale partners prioriteit moeten krijgen bij het aangaan van strategische partnerschappen voor halfgeleiders, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria:

- de mogelijke bijdrage tot de leveringszekerheid, onmisbaarheid, veerkracht en welvaart, rekening houdend met de potentiële capaciteiten van een partner op het gebied van halfgeleiders, diversificatie en afhankelijkheden;
- de vraag of met het regelgevingskader van een partner de monitoring en minimalisatie van milieueffecten, het gebruik van maatschappelijk verantwoorde praktijken, een transparante bedrijfsvoering en het voorkomen van negatieve gevolgen voor de goede werking van het openbaar bestuur en de rechtsstaat worden gewaarborgd;
- de vraag of er bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen een derde land of gebied en de Unie zijn, en, voor opkomende markten en ontwikkelingslanden, het potentieel om investeringsprojecten in het kader van de Global Gateway⁷² op te zetten;
- de vraag of het regelgevingskader van de partner, of het relevante toepasselijke kader, voorziet in de toepassing van controles op de uitvoer van technologie waarmee de toegang tot goederen en technologie die nodig zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen in de EU, of de uitvoer van goederen en technologie die in de EU zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd, zou kunnen worden beperkt.

2. De Commissie zorgt ervoor dat de Europese Raad voor halfgeleiders kan samenwerken met andere relevante samenwerkingsfora, waaronder de fora die zijn opgezet in het kader van de Global Gateway⁷³, en ondersteunt deze samenwerking.

3. De lidstaten zorgen voor samenhang tussen hun bilaterale samenwerking met internationale partners en de internationale samenwerking van de Unie op het gebied van halfgeleiders, met inbegrip van niet-bindende strategische partnerschappen. Zij ondersteunen de Commissie tevens bij de uitvoering van de samenwerkingsmaatregelen die zijn vastgelegd in het kader van de internationale samenwerking van de Unie op het gebied van halfgeleiders, met inbegrip van strategische partnerschappen voor halfgeleiders.

⁷² Europese Commissie: Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen, The Global Gateway strategy, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

⁷³ Europese Commissie: Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen, The Global Gateway strategy, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

AFDELING 2

NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN

Artikel 48

Aanwijzing van nationale bevoegde instanties en nationale centrale contactpunten

1. Elke lidstaat wijst een of meer nationale bevoegde instanties aan voor het toezicht op de toepassing en de uitvoering van deze verordening op nationaal niveau.
2. Indien een lidstaat meer dan één nationale bevoegde instantie aanwijst, bepaalt hij duidelijk de respectieve bevoegdheden van de betrokken autoriteiten en zorgt hij ervoor dat deze doeltreffend en efficiënt samenwerken om hun taken uit hoofde van deze verordening te vervullen, onder meer met betrekking tot de aanwijzing en de activiteiten van het in lid 3 bedoelde nationale centrale contactpunt.
3. Elke lidstaat wijst één nationaal centraal contactpunt aan om een verbindingfunctie uit te oefenen met het oog op landsgrensoverschrijdende samenwerking met de nationale bevoegde instanties van andere lidstaten, met de Commissie en met de Europese Raad voor halfgeleiders. Indien een lidstaat slechts één nationale bevoegde instantie aanwijst, is die nationale bevoegde instantie eveneens het nationale centrale contactpunt.
4. Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis van de aanwijzing van de nationale bevoegde instantie of van meer dan één nationale bevoegde instantie, en van het nationale centrale contactpunt, met inbegrip van hun precieze taken en bevoegdheden uit hoofde van deze verordening, hun contactgegevens en eventuele latere wijzigingen daarin. Het nationale centrale contactpunt voorziet de Commissie van een functionele mailbox.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale bevoegde instanties, met inbegrip van het aangewezen nationale centrale contactpunt, hun bevoegdheden onpartijdig, transparant en tijdig uitoefenen en dat zij worden toegerust met de bevoegdheden en de passende technische, financiële en personele middelen om hun taken uit hoofde van deze verordening te vervullen.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale bevoegde instanties, waar passend en in overeenstemming met het Unierecht en het nationale recht, overleg plegen en samenwerken met andere betrokken nationale autoriteiten en belanghebbende partijen.

De Commissie bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen de nationale bevoegde instanties.

AFDELING 3

INDUSTRIËLE ALLIANTIE

Artikel 49

Industriële alliantie voor halfgeleiders

1. Hierbij wordt een industriële alliantie voor halfgeleiders (“de alliantie”) opgericht.

2. De alliantie brengt betrokken belanghebbenden bijeen om de Commissie en de lidstaten bij te staan bij zaken die van belang zijn voor de halfgeleiderindustrie van de Unie, waaronder:
 - f) huidige markt- en industriële trends;
 - g) de ontwerp- en productiecapaciteit van de Unie op het gebied van halfgeleiders;
 - h) opkomende halfgeleidertechnologieën en de impact daarvan;
 - i) identificatie en aanbevelingen om de sterke en zwakke punten van de industrie in de Unie aan te pakken;
 - j) strategieën ter versnelling van de industrialisering van innovatie;
 - k) geopolitieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de industrie;
 - l) het versterken van het mondiale concurrentievermogen van de Unie;
 - m) bijdragen aan de werking van de vraagaanjagers;
 - n) bijdragen aan de werking van het vraagforum.
3. De leden van de alliantie zijn vertegenwoordigers van de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie, waaronder ondernemingen, start-ups, onderzoeks- en technologieorganisaties en gebruikerssectoren, die aan de volgende criteria voldoen:
 - a) zij beschikken over aantoonbare ervaring, kennis en capaciteiten op het gebied van halfgeleiders;
 - b) zij dragen bij of verbinden zich ertoe bij te dragen aan de leveringszekerheid van halfgeleiders in de Unie;
 - c) zij hebben een relevante aanwezigheid op de Europese markt of hebben zich ertoe verbonden een dergelijke aanwezigheid binnen de Unie op te bouwen.
4. De Commissie benoemt de leden van de alliantie overeenkomstig de in lid 4 vastgestelde criteria.
5. Een vertegenwoordiger van de Commissie is de voorzitter van de alliantie.
6. De alliantie houdt ten minste een keer per jaar een algemene vergadering. De alliantie kan op verzoek van haar voorzitter of een lid van het stuurcomité buitengewone vergaderingen beleggen, mits de voorzitter hiermee instemt.
7. De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda op, overeenkomstig het reglement van orde en de taken van de alliantie krachtens deze verordening.
8. De Commissie richt binnen de alliantie een stuurcomité op. Het stuurcomité voert ten minste eenmaal per jaar een strategische dialoog met de Europese Raad voor halfgeleiders, zoals bepaald in artikel 44.
9. De voorzitter van de alliantie of het stuurcomité kan, mits de voorzitter hiermee instemt, permanente of tijdelijke werkgroepen instellen om specifieke kwesties te onderzoeken.

Hoofdstuk VI

Vertrouwelijkheid en sancties

Artikel 50

Behandeling van vertrouwelijke informatie

1. Informatie die bij de uitvoering van deze verordening wordt verkregen, wordt alleen voor de toepassing van deze verordening gebruikt en wordt beschermd door het relevante Unierecht en nationale recht.
2. Niet-vertrouwelijke informatie die krachtens deze verordening wordt verzameld, wordt aan de nationale statistische instanties en aan Eurostat verzonden met het oog op het opstellen van statistieken overeenkomstig Verordening (EU) 2024/3018 van het Europees Parlement en de Raad.
3. De op grond van de artikelen 14, 33, 35, 38, 41 en 46, verkregen informatie valt onder het beroepsgeheim en geniet de bescherming die wordt geboden door de op de instellingen van de Unie toepasselijke voorschriften en het desbetreffende nationale recht, met inbegrip van de bepalingen die in geval van schending van die voorschriften in werking treden.
4. De Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten, hun ambtenaren, personeelsleden en andere personen die onder toezicht van die autoriteiten werken, waarborgen de vertrouwelijkheid van de bij de uitvoering van hun taken verkregen informatie en gegevens op zodanige wijze dat met name intellectuele-eigendomsrechten en commercieel gevoelige informatie of handelsgeheimen worden beschermd. Deze verplichting geldt voor alle vertegenwoordigers van de lidstaten, waarnemers, deskundigen en andere deelnemers van vergaderingen van de Europese Raad voor halfgeleiders op grond van artikel 44 en de leden van het halfgeleidercomité op grond van artikel 56, lid 1.
5. De Commissie voorziet in gestandaardiseerde en veilige middelen voor het verzamelen, verwerken en opslaan van de uit hoofde van deze verordening verkregen informatie.
6. De Commissie en de lidstaten kunnen, indien nodig, overeenkomstig de artikelen 35, 38 en 39 verkregen informatie met bevoegde instanties van derde landen waarmee zij bilaterale of multilaterale geheimhoudingsovereenkomsten hebben gesloten om een passend niveau van geheimhouding te waarborgen, alleen uitwisselen in een geaggregeerde vorm die voorkomt dat conclusies over de specifieke situatie van een onderneming in een lidstaat openbaar worden gemaakt. Alvorens tot uitwisseling van informatie over te gaan, stellen de Commissie of de lidstaten de Europese Raad voor halfgeleiders in kennis van de informatie die zal worden gedeeld en van de desbetreffende geheimhoudingsregeling.

Voor de uitwisseling van informatie met de bevoegde instanties van derde landen wijst de Commissie een centraal contactpunt in de Unie aan, en zij maakt van dit contactpunt gebruik om, overeenkomstig de desbetreffende procedures van de Commissie, die informatie of gegevens gemakkelijker op vertrouwelijke wijze door te sturen.
7. De Commissie kan, waar nodig op basis van de ervaring die met het verzamelen van informatie is opgedaan, uitvoeringshandelingen vaststellen ter nadere bepaling van

de praktische regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie in het kader van de uitwisseling van informatie op grond van deze verordening. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 51 *Sancties*

1. Indien dit noodzakelijk en evenredig wordt geacht, kan de Commissie een besluit nemen om:
 - a) geldboeten op te leggen wanneer een onderneming opzettelijk of door grove nalatigheid onjuiste, onvolledige of misleidende informatie verstrekt in antwoord op een verzoek overeenkomstig artikel 38 of artikel 41, of de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt;
 - b) geldboeten op te leggen wanneer een onderneming opzettelijk of door grove nalatigheid niet voldoet aan de verplichting om de Commissie in kennis te stellen van een verplichting vanuit een derde land uit hoofde van artikel 38, lid 8, artikel 41, lid 7, en artikel 42, lid 3;
 - c) dwangsommen op te leggen wanneer een onderneming opzettelijk of door grove nalatigheid niet voldoet aan een verplichting tot het verlenen van prioriteit aan de productie van in een crisis relevante producten uit hoofde van artikel 42.
2. Alvorens een besluit op grond van lid 1 te nemen, stelt de Commissie ondernemingen in de gelegenheid te worden gehoord overeenkomstig artikel 54. Om te bepalen of geldboeten of dwangsommen noodzakelijk en evenredig zijn houdt zij rekening met alle naar behoren gemotiveerde redenen die een dergelijke onderneming heeft aangevoerd.
3. De geldboeten die in de in lid 1, punt a), bedoelde gevallen worden opgelegd, mogen niet meer bedragen dan 300 000 EUR.

De geldboeten die in de in lid 1, punt b), bedoelde gevallen worden opgelegd, mogen niet meer bedragen dan 150 000 EUR.

Indien de betrokken onderneming een kmo is, mogen de opgelegde geldboeten niet meer bedragen dan 50 000 EUR.
4. De dwangsommen die in het in lid 1, punt c), bedoelde geval worden opgelegd, mogen niet meer bedragen dan 1,5 % van de actuele dagelijkse omzet voor elke werkdag waarin de verplichting uit hoofde van artikel 43 niet is nagekomen, berekend vanaf de datum die is vastgelegd in het besluit waarbij de als prioritair aangemerkte bestelling is geplaatst.

Indien de betrokken onderneming een kmo is, bedragen de opgelegde dwangsommen niet meer dan 0,5 % van de actuele dagelijkse omzet.
5. Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete of de dwangsom houdt de Commissie rekening met de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, ook in gevallen van niet-naleving van de in artikel 43 vastgelegde verplichting om een als prioritair aangemerkte bestelling te aanvaarden en daaraan voorrang te geven, en met de vraag of de onderneming de als prioritair aangemerkte bestelling ten dele heeft voldaan; zij houdt daarbij terdege rekening met de beginselen van evenredigheid en geschiktheid.

6. Indien de onderneming de verplichtingen is nagekomen ter afdwinging waarvan de periodieke dwangsom was opgelegd, kan de Commissie de uiteindelijk verschuldigde dwangsom vaststellen op een bedrag dat lager is dan het uit het oorspronkelijke besluit voortvloeiende bedrag.
7. Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht ter zake van beroep tegen besluiten van de Commissie waarbij een geldboete of een dwangsom wordt vastgesteld. Het kan de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Artikel 52

Verjaringstermijn voor de oplegging van sancties

1. De bevoegdheid van de Commissie uit hoofde van artikel 51 verjaart:
 - a) na twee jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake verzoeken om informatie overeenkomstig artikel 38 of 41;
 - b) na twee jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake informatieverplichtingen uit hoofde van artikel 38, lid 8, artikel 41, lid 7, en artikel 42, lid 3;
 - c) na drie jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake de verplichting om overeenkomstig artikel 42 prioriteit te verlenen aan de productie van in een crisis relevante producten.
2. De in lid 1 bedoelde verjaringstermijnen gaan in op de dag waarop de inbreuk is gepleegd. Bij voortdurende of herhaalde inbreuken gaat de verjaringstermijn in op de dag waarop de laatste inbreuk werd gepleegd.
3. De verjaring wordt gestuit door de maatregelen die de Commissie of de nationale bevoegde instanties van de lidstaten nemen om de naleving van deze verordening te waarborgen.
4. De stuiting van de verjaring geldt voor alle partijen die aansprakelijk worden gesteld voor de deelname aan de inbreuk.
5. Na elke stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw van voren af aan te lopen. De verjaring treedt echter uiterlijk in op de dag waarop een termijn gelijk aan of tweemaal de verjaringstermijn is verstreken zonder dat de Commissie een geldboete of een dwangsom heeft opgelegd. Die termijn wordt verlengd met de periode waarin de verjaringstermijn is geschorst omdat tegen het besluit van de Commissie een procedure aanhangig is bij het Hof van Justitie.

Artikel 53

Verjaring voor tenuitvoerlegging van sancties

1. De verjaringstermijn voor de aan de Commissie verleende bevoegdheden om overeenkomstig artikel 51 genomen besluiten ten uitvoer te leggen, belooft drie jaar.
2. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop het besluit definitief wordt.
3. De verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van geldboeten en dwangsommen wordt gestuit:
 - a) door de kennisgeving van een besluit waarbij het oorspronkelijke bedrag van de geldboete of de dwangsom wordt gewijzigd of waarbij een daartoe strekkend verzoek wordt afgewezen

- b) door elke handeling van de Commissie of van een lidstaat op verzoek van de Commissie tot inning van de geldboete of de dwangsom.
- 4. Na elke stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw van voren af aan te lopen.
- 5. De verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van geldboeten en dwangsommen wordt geschorst zolang:
 - a) zolang een betalingstermijn is toegestaan;
 - b) zolang de tenuitvoerlegging krachtens een beslissing van het Hof van Justitie is opgeschort.

Artikel 54

Recht om te worden gehoord vóór het opleggen van sancties

- 1. Alvorens een besluit op grond van artikel 51 vast te stellen, stelt de Commissie de betrokken onderneming in de gelegenheid te worden gehoord over:
 - a) voorlopige bevindingen van de Commissie, met inbegrip van alle zaken waartegen de Commissie bezwaren heeft gemaakt;
 - b) maatregelen die de Commissie eventueel voornemens is te nemen in het licht van de in punt a) bedoelde voorlopige bevindingen.
- 2. De betrokken ondernemingen kunnen hun opmerkingen over de voorlopige bevindingen van de Commissie op grond van lid 1, punt a), indienen binnen een termijn die de Commissie in haar voorlopige bevindingen vastlegt en die niet minder dan 14 dagen bedraagt.
- 3. De Commissie baseert haar besluiten enkel op de punten van bezwaar waarover de betrokken ondernemingen opmerkingen hebben kunnen maken.
- 4. Het recht van verdediging van de betrokken onderneming wordt in de loop van iedere procedure ten volle geëerbiedigd. De betrokken ondernemingen hebben recht op inzage van het dossier van de Commissie volgens de voorwaarden van een onderhandelde inzageverlening, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van de ondernemingen inzake de bescherming van hun zakengeheimen. Het recht tot inzage van het dossier geldt niet voor vertrouwelijke inlichtingen en interne documenten van de Commissie of de autoriteiten van de lidstaten. Met name geldt het recht tot inzage niet voor de correspondentie tussen de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten. Niets in dit lid belet de Commissie om voor het bewijs van een inbreuk noodzakelijke inlichtingen bekend te maken of te gebruiken.

HOOFDSTUK VII

Bevoegdheidsdelegatie en comitéprocedure

Artikel 55

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

- 1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De bevoegdheid om de in artikel 12 en artikel 17 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt met ingang van [OP: please insert date of entry into force] voor onbepaalde tijd aan de Commissie gedelegeerd.
3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 en artikel 17 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 12 of artikel 17 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 56
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité (het “halfgeleidercomité”). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011 in samenhang met artikel 5 van toepassing.

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 57
Evaluatie en toetsing

1. Uiterlijk [OP: insert date for four years after date of entry into force] en vervolgens om de vier jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de evaluatie en de toetsing van deze verordening. De verslagen worden openbaar gemaakt.
2. Ten behoeve van de evaluatie en toetsing van deze verordening verstrekken de Europese Raad voor halfgeleiders, de lidstaten en de nationale bevoegde instanties desgevraagd informatie aan de Commissie.

3. Bij de uitvoering van de evaluatie en toetsing van deze verordening neemt de Commissie de standpunten en bevindingen van de Europese Raad voor halfgeleiders, het Europees Parlement, de Raad en andere relevante instanties of bronnen in aanmerking.

Artikel 58

Intrekking

1. Verordening (EU) 2023/1781 wordt ingetrokken. 2. Verwijzingen naar Verordening (EU) 2023/1781 gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

Artikel 59

Overgangsbepalingen

1. Verordening (EU) 2023/1781 blijft van toepassing op geïntegreerde fabricagefaciliteiten en open EU-gieterijen, als bedoeld in respectievelijk de artikelen 13 en 14 van die verordening, waaraan deze status is toegekend overeenkomstig artikel 15, lid 3, van die verordening, gedurende de geldigheidsduur van die status of gedurende de termijn die van toepassing is krachtens artikel 15, lid 8, tweede zin, van die verordening.

Artikel 60

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

FINANCIEEL EN DIGITAAL MEMORANDUM

1.	KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF	3
1.1.	Benaming van het voorstel/initiatief	3
1.2.	Betrokken beleidsterreinen.....	3
1.3.	Doelstellingen	3
1.3.1.	Algemene doelstellingen.....	3
1.3.2.	Specifieke doelstellingen	3
1.3.3.	Verwachte resultaten en gevolgen	3
1.3.4.	Prestatie-indicatoren.....	3
1.4.	Het voorstel/initiatief betreft:	4
1.5.	Motivering van het voorstel/initiatief	4
1.5.1.	Behoeften waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief.....	4
1.5.2.	Meerwaarde van het optreden van de EU (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatie-winst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “meerwaarde van het optreden van de EU” verstaan de waarde die het optreden van de Unie oplevert boven op de waarde die door een optreden van alleen de lidstaten zou zijn gecreëerd.	4
1.5.3.	Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan	4
1.5.4.	Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten	5
1.5.5.	Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voorerschikking	5
1.6.	Duur van het voorstel/initiatief en van de financiële gevolgen ervan.....	6
1.7.	Wijzen van uitvoering van de begroting	6
2.	BEHEERSMAATREGELEN	8
2.1.	Regels inzake monitoring en rapportage.....	8
2.2.	Beheers- en controlesystemen.....	8
2.2.1.	Rechtvaardiging van de voorgestelde wijzen van uitvoering van de begroting, uitvoeringsmechanismen voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie	8
2.2.2.	Informatie over de vastgestelde risico's en het systeem of de systemen voor interne controle die zijn opgezet om die risico's te beperken	8
2.2.3.	Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding tussen de controlekosten en de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)	8
2.3.	Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden.....	9
3.	GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF	10

3.1.	Rubrieken van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderdelen voor uitgaven.....	10
3.2.	Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten	12
3.2.1.	Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten.....	12
3.2.1.1.	Kredieten uit goedgekeurde begroting	12
3.2.1.2.	Kredieten uit externe bestemmingsontvangsten.....	17
3.2.2.	Geraamde output, gefinancierd uit beleidskredieten.....	22
3.2.3.	Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten	24
3.2.3.1.	Kredieten uit goedgekeurde begroting	24
3.2.3.2.	Kredieten uit externe bestemmingsontvangsten.....	24
3.2.3.3.	Totaal kredieten.....	24
3.2.4.	Geraamde personeelsbehoeften.....	25
3.2.4.1.	Gefinancierd uit goedgekeurde begroting.....	25
3.2.4.2.	Gefinancierd uit externe bestemmingsontvangsten	26
3.2.4.3.	Totale personeelsbehoeften.....	26
3.2.5.	Overzicht van het geschatte effect op investeringen die met digitale technologie samenhangen	28
3.2.6.	Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader	28
3.2.7.	Bijdragen van derden	28
3.3.	Geraamde gevolgen voor de ontvangsten	29
4.	DIGITALE DIMENSIES.....	29
4.1.	Voorschriften met digitale relevantie	30
4.2.	Data	30
4.3.	Digitale oplossingen.....	31
4.4.	Interoperabiliteitsbeoordeling	31
4.5.	Maatregelen ter ondersteuning van de digitale uitvoering.....	32

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders, tot intrekking van Verordening (EU) 2023/1781 (chipsverordening 2.0)

1.2. Betrokken beleidsterreinen

Een nieuw plan voor duurzame welvaart en concurrentievermogen in Europa

1.3. Doelstellingen

1.3.1. Algemene doelstellingen

De chipsverordening 2.0 heeft twee algemene doelstellingen, zoals uiteengezet in de toelichting:

1. Vergroten van het concurrentievermogen van de Europese waardeketen voor halfgeleiders om de technologische soevereiniteit en veerkracht ervan te verbeteren door de industriële toepassing van onderzoek en innovatie te versnellen, de voorzieningszekerheid te waarborgen en strategische afhankelijkheden op het gebied van zowel geavanceerde als volwassen halfgeleidertechnologieën te verminderen.
2. Versterken van crisisparaatheid om de leveringszekerheid van de EU te waarborgen door de veerkracht van de Europese toeleveringsketen voor halfgeleiders te vergroten en de economische veiligheid van de EU te beschermen.

1.3.2. Specifieke doelstellingen

Specifieke doelstelling nr. 1

Versterken van de capaciteit, de leveringszekerheid en het concurrentievermogen van de halfgeleiderindustrie in de EU in de gehele waardeketen, met inbegrip van geavanceerde AI-chips

Specifieke doelstelling nr. 2

Ontwikkelen van een sterke gebruikersmarkt in belangrijke industriële sectoren

Specifieke doelstelling nr. 3

Vergroten van de inlichtingencapaciteiten voor crisisparaatheid en -respons

1.3.3. Verwachte resultaten en gevolgen

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

De halfgeleiderindustrie van de Unie moet steun genieten voor grootschalige technologische capaciteitsopbouw op het gebied van geavanceerde halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie die het geavanceerde ontwerp, de integratie van systemen en de productiecapaciteit voor chips in de EU zullen versterken. De industrie zou eveneens moeten profiteren van strategische projecten op het gebied van ontwerp en productie. Halfgeleiderfaciliteiten zullen profiteren van doeltreffendere vergunningsprocedures.

Halfgeleidergebruikers in alle sectoren van de Unie moeten profiteren van een grotere, niet verstoorde leveringszekerheid voor halfgeleiders en van inspanningen om nauwere banden met de halfgeleiderindustrie te bevorderen. Daarnaast moeten kritieke sectoren profiteren van een grotere leveringszekerheid voor halfgeleiders.

Eindgebruikers van producten met halfgeleiders moeten profiteren van een grotere leveringszekerheid, tegen aantrekkelijkere marktprijzen.

Het concurrentievermogen van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders zal verbeteren.

1.3.4. Prestatie-indicatoren

Vermeld de indicatoren voor de monitoring van de voortgang en de beoordeling van de resultaten.

Prestatie-indicatoren zijn over het algemeen relevant voor het initiatief Chips voor Europa 2.0. Bijlage III bevat de eerste versies van meetbare indicatoren voor monitoring van de uitvoering en verslaglegging over de voortgang van het initiatief Chips voor Europa 2.0 bij de verwezenlijking van de algemene doelstellingen:

1. Totale instroom van directe investeringen in de EU op het gebied van halfgeleiders.
2. Geschoolde arbeidskrachten op het gebied van halfgeleiders en fotonica, waaronder arbeidskrachten die zijn opgeleid of omgeschoold via initiatieven van de nationale kenniscentra voor chips.
3. Overheidssteun voor start-ups en scale-ups.
4. Financiering van scale-ups via private equity en durfkapitaal.

1.4. Het voorstel/initiatief betreft:

☒ een nieuwe actie

☐ een nieuwe actie na een proefproject/voorbereidende actie⁷⁴

☒ de verlenging van een bestaande actie

☐ de samenvoeging of ombuiging van een of meer acties naar een andere/een nieuwe actie

⁷⁴

In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. *Behoeften waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief*

Deze verordening moet kort na de vaststelling ervan in werking treden, d.w.z. op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De verordening bouwt voort op de bepalingen die momenteel gelden krachtens EU-verordening 2023/1781 (chipsverordening).

1.5.2. *Meerwaarde van het optreden van de EU (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “meerwaarde van het optreden van de EU” verstaan de waarde die het optreden van de Unie oplevert boven op de waarde die door een optreden van alleen de lidstaten zou zijn gecreëerd.*

De doelstellingen om de ontwerp- en productiecapaciteit van de EU op het gebied van halfgeleiders te versterken en de crisisparaatheid te verbeteren, kunnen doeltreffender op Unieniveau worden verwezenlijkt, aangezien de omvang en het systemische karakter van de uitdagingen de capaciteit van afzonderlijke lidstaten die op eigen kracht optreden, te boven gaan. Er ontstaan aanzienlijke schaalvoordelen bij het coördineren van investeringen in grootschalige fabricagefaciliteiten, gedeelde O&O-infrastructuur en landsgrensoverschrijdende systemen voor vroegtijdige waarschuwing en monitoring, wat betekent dat maatregelen op EU-niveau het mogelijk maken middelen te bundelen, duplicatie te verminderen en efficiënter resultaten te boeken dan versnipperde nationale inspanningen. Maatregelen zoals het opvoeren van de productiecapaciteit, het versnellen van vergunningsprocedures, als prioritair aangemerkte bestellingen en gezamenlijke inkoop zijn bedoeld om een samenhangende respons op toekomstige crises te waarborgen.

Een gemeenschappelijk kader biedt tevens duidelijke voordelen, aangezien het uiteenlopende nationale stimuleringsmaatregelen, crisisresponsprotocollen en rapportageverplichtingen vervangt door gemeenschappelijke benaderingen die voor samenhang zorgen, de administratieve lasten verminderen en een subsidiewedloop of inconsistente regelgevingsvereisten voorkomen. De werking van de interne markt wordt verbeterd doordat gecoördineerde EU-maatregelen verstoringen tot een minimum beperken, voor eerlijke concurrentie bij het aantrekken van halfgeleiderprojecten zorgen, het soepele verkeer van cruciale grondstoffen en chips vergemakkelijken en de veerkracht versterken van landsgrensoverschrijdende toeleveringsketens die afhankelijk zijn van een naadloze integratie tussen de lidstaten.

1.5.3. *Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

Uit de evaluatie van de huidige chipsverordening⁷⁵ kunnen verschillende lessen worden getrokken. Ten eerste zijn er beleidsmechanismen nodig voor de omzetting van innovatie in industriële capaciteit, waarbij een expliciete brug wordt geslagen tussen proeflijninfrastructuur en investeringen in de productie. Hoewel de chipsverordening met goed gevolg heeft gezorgd voor de totstandkoming van

⁷⁵

Werkdocument van de diensten van de Commissie

onderzoeks- en validatiefaciliteiten van wereldklasse, leert de ervaring dat productie op marktschaal niet automatisch voortvloeit uit technologische capaciteiten alleen. Toekomstige initiatieven zouden baat hebben bij het integreren van transitiemechanismen die de overgang van proeflijnen naar industriële toepassing op een meer systematische wijze vergemakkelijken.

Ten tweede moet vraaggerichtheid worden ingebouwd in de instrumenten van het industriebeleid. Uit de evaluatie blijkt dat investeringen aan de aanbodzijde op zichzelf niet noodzakelijkerwijs leiden tot schaalvoordelen of concurrentievermogen, indien er geen sprake is van een betrouwbare marktacceptatie. Instrumenten die de toepassing ondersteunen, moeten daarom gepaard gaan met maatregelen die de vraag stimuleren, zoals coördinatie van aanbestedingen of stimulansen voor verbruik.

Ten derde moet de toegang tot financiering een centrale rol blijven spelen in het industriebeleid. Uit de evaluatie blijkt dat dit pionierskader de rechtszekerheid voor grote investeringen heeft verbeterd, maar dat belanghebbenden nog steeds te maken hebben met vertragingen als gevolg van staatssteunregels, langdurige kennisgevingsprocedures en onzekerheid op projectniveau. Durfkapitaal in een laat stadium en beperkingen op het gebied van institutionele investeringen vormen eveneens een belemmering voor de financiering van scale-ups. Deze factoren ondermijnen het concurrentievermogen van Europa en remmen de groei van wereldwijd concurrerende ondernemingen af.

Ten slotte hangt crisisparaatheid af van hoogwaardige systeeminformatie. Uit de evaluatie blijkt dat effectieve monitoring een actueel overzicht van de gehele waardeketen vereist, waarbij niet alleen de fabricage, maar ook materialen, behuizing, ontwerp tools en eindgebruikers worden meegenomen. Toekomstige kaders zouden prioriteit kunnen geven aan verbeterde gegevensverzameling, gedeelde gegevensinfrastructuren en geïntegreerde rapportage met het oog op tijdige risicodetectie en gecoördineerde responsen.

1.5.4. Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten

Om de positieve effecten ervan te maximaliseren, zal het initiatief Chips voor Europa 2.0 (pijler I) blijven voortbouwen op de sterke kennisbasis en synergieën met acties die momenteel door de Unie en de lidstaten worden ondersteund door middel van programma's en acties op het gebied van onderzoek en innovatie inzake halfgeleiders en door ontwikkelingen in een deel van de toeleveringsketen. Het gaat hierbij met name om het kaderprogramma Horizon Europa en het programma Digitaal Europa, met als doel Europa te versterken als mondiale speler op het gebied van halfgeleidertechnologie en de toepassingen daarvan, zodat het mondiale aandeel in de productie tegen 2030 zal stijgen. Als aanvulling op deze activiteiten wordt er in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0 nauwer samengewerkt met de industriële alliantie voor halfgeleiders.

1.5.5. Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking

Zonder vooruit te lopen op het resultaat van de onderhandelingen over het volgende MFK, zijn de vanaf 2028 geplande kredieten louter indicatief.

1.6. Duur van het voorstel/initiatief en van de financiële gevolgen ervan

☒ beperkte geldigheidsduur

- ☒ in werking vanaf de datum van goedkeuring van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipsverordening 2.0)
- ☒ financiële gevolgen vanaf 2028 tot en met 2034 voor vastleggingskredieten en vanaf 2028 tot en met 2038 voor betalingskredieten.

☐ onbeperkte geldigheidsduur

- ☐ Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
- ☐ gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Wijzen van uitvoering van de begroting

☒ Direct beheer door de Commissie

- ☒ door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;
- ☐ door de uitvoerende agentschappen

☐ Gedeeld beheer met de lidstaten

☒ Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken toe te vertrouwen aan:

- ☐ derde landen of de door hen aangewezen organen
- ☐ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke)
- ☐ de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds
- ☒ de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen
- ☐ publiekrechtelijke organen
- ☐ privaatrechtelijke organen met een openbardienstverleningstaak, voor zover zij zijn voorzien van voldoende financiële garanties
- ☐ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die zijn voorzien van voldoende financiële garanties
- ☐ organen waaraan of personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling
- ☐ in een lidstaat gevestigde organen die onder het privaatrecht van een lidstaat of onder het Unierecht vallen en die in aanmerking komen om overeenkomstig sectorspecifieke regelgeving te worden belast met de uitvoering van middelen van de Unie of begrotingsgaranties, voor zover dergelijke organen onder zeggenschap staan van publiekrechtelijke organen of privaatrechtelijke organen met een openbardienstverleningstaak, en beschikken over voldoende financiële garanties in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van de controlerende organen of gelijkwaardige financiële garanties, die voor elke actie beperkt kunnen blijven tot het maximumbedrag van de steun van de Unie.

Opmerkingen

Met uitzondering van a) activiteiten en budgetten in verband met het chipfonds en b) activiteiten en budgetten die in het kader van de Europese Innovatieraad zijn gereserveerd, zal het initiatief Chips voor Europa 2.0 verder onder indirect beheer worden uitgevoerd door de uitvoering van taken toe te vertrouwen aan de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” en, in voorkomend geval, aan de gemeenschappelijke onderneming of een andere soortgelijke entiteit of een opvolgend initiatief dat krachtens het Unierecht is opgericht in het kader van een volgend meerjarig financieel kader. De lidstaten en andere deelnemende staten cofinancieren acties onder contract.

Andere onderdelen, zoals de activiteiten in het kader van pijler 2 en pijler 3, vallen onder direct beheer. Het gaat hierbij om taken die aan de Commissie zijn toevertrouwd om toezicht te houden op de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”, aanvragen voor halfgeleidertechnologiefaciliteiten te beoordelen en daarover te beslissen, de Europese Raad voor halfgeleiders te ondersteunen, een business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders te ondersteunen en – samen met de lidstaten – de toeleveringsketens voor halfgeleiders te monitoren en, indien nodig, maatregelen vast te stellen.

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake monitoring en rapportage

Dit memorandum omvat de uitgaven voor het personeel van de Commissie. Voor dit soort uitgaven zijn de standaardregels van toepassing. De Commissie zal de output, resultaten en gevolgen van dit voorstel elke vier jaar evalueren na de datum waarop het van toepassing wordt.

Bovendien, als orgaan van de Unie, functioneert de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” volgens strikte toezichtregels. Monitoring wordt op de volgende manieren uitgeoefend:

- de eigen internecontrolecapaciteit en de auditdienst van de Commissie;
- het toezicht door de raad van bestuur. De uitvoerend directeur zal intern toezien op de activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming;
- een reeks kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren die worden vastgesteld om toe te zien op de uitvoering van het programma en om de effecten ervan te meten;
- tussentijdse en eindevaluaties van het programma door externe deskundigen, onder toezicht van de Commissie;
- het werkprogramma en het jaarlijks activiteitenverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming.

2.2. Beheers- en controlesystemen

2.2.1. *Rechtvaardiging van de voorgestelde wijzen van uitvoering van de begroting, uitvoeringsmechanismen voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie*

De verordening voert een herzien beleidskader in met betrekking tot het aantrekken van investeringen in en het verbeteren van de fabricage van geavanceerde halfgeleiders in de Unie, alsmede het stimuleren van de vraag, en voert geharmoniseerde regels in voor een gecoördineerde aanpak van de monitoring van en de paraatheid bij tekorten aan halfgeleiders. De instrumenten van grote uitdagingen, strategische projecten, het vraagforum, de vraagaanjagers en het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders zijn nieuwe elementen, evenals de erkenning van Europese uitmuntende halfgeleiderregio's.

Deze regels vereisen een coherentiemechanisme voor de landsgrensoverschrijdende toepassing van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening en voor de coördinatie van de activiteiten van de nationale autoriteiten en van de Commissie via de Europese Raad voor halfgeleiders.

Om de taken die de Commissie moet uitvoeren het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de diensten van de Commissie over voldoende middelen beschikken.

Voor andere onderdelen is indirect beheer gerechtvaardigd omdat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips een publiek-privaat partnerschap is waarbij een deel van de medefinanciering wordt verstrekt via bijdragen van de deelnemende staten en bijdragen in natura van particuliere leden.

Elk jaar wordt een besluit over de EU-bijdrage aan de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips genomen via de EU-begroting voor dat jaar.

In een kaderovereenkomst inzake financieel partnerschap tussen de Europese Commissie en de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips zal worden vermeld dat de Commissie voor de jaarlijks uit te voeren taken een bijdrage zal betalen zodra een bijdrageovereenkomst met de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips is ondertekend en de Gemeenschappelijke Onderneming de overeenkomstige betalingsverzoeken heeft doen toekomen aan de andere leden dan de Unie.

De Commissie zorgt ervoor dat de regels voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips volledig stroken met de vereisten van het financieel reglement. In overeenstemming met artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 zal de Gemeenschappelijke Onderneming de beginselen van goed financieel beheer in acht nemen. De Gemeenschappelijke Onderneming voor chips voldoet ook aan de bepalingen van de op de Gemeenschappelijke Onderneming toepasselijke financiële modelregeling. Elke afwijking van die financiële modelregeling die nodig is om in de specifieke behoeften van de Gemeenschappelijke Onderneming te voorzien moet vooraf door de Commissie worden goedgekeurd.

Alle toezichtsregelingen, ook via de vertegenwoordiging van de Unie in de raad van bestuur en de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips en verslagleggingsregelingen, moeten waarborgen dat de diensten van de Commissie hun verantwoordingsplicht tegenover het college en de begrotingsautoriteit kunnen nakomen.

Het kader voor interne controle van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips is gebaseerd op:

- de toepassing van de internecontrolenormen die ten minste even sterke waarborgen bieden als die van de Commissie;
- procedures voor het selecteren van de beste projecten door middel van onafhankelijke evaluatie, en voor de vertaling daarvan naar rechtsinstrumenten;
- project- en contractbeheer gedurende de gehele projectcyclus;
- controles *vooraf* van alle declaraties (met inbegrip van het opvragen van auditcertificaten) en certificering vooraf van methoden voor de kostenberekening;
- controles *achteraf* van een steekproef van de declaraties als onderdeel van de controles achteraf van Horizon Europa;
- wetenschappelijke evaluatie van projectresultaten.

2.2.2. Informatie over de vastgestelde risico's en het systeem of de systemen voor interne controle die zijn opgezet om die risico's te beperken

Dit voorstel gaat vergezeld van een effectbeoordelingsverslag, dat de analyse bevat die ten grondslag ligt aan de gekozen beleidsaanpak. Bij de voorbereiding van het initiatief werden ook een openbare raadpleging en gerichte raadplegingen van belanghebbenden uit de sector, de lidstaten en brancheorganisaties gehouden, waardoor relevante gegevens, informatie en feedback konden worden verzameld. Niettemin kunnen zich tijdens de uitvoering nog steeds onbedoelde gevolgen of onvoorziene effecten voordoen. Deze zullen worden vastgesteld aan de hand van de

in de verordening vastgestelde monitoringprocedures, zodat de Commissie ze tijdig en op passende wijze kan aanpakken.

Bovendien zijn er diverse maatregelen vastgesteld om het inherente risico op belangenconflicten binnen de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” te beperken, in het bijzonder:

- voor standaard besluitvorming, een gelijk aantal stemmen in de raad van bestuur (een derde) voor de Commissie, de deelnemende staten (samen) en de particuliere leden (samen); een gelijk aantal stemmen (de helft) in de raad van overheidsinstanties voor de Commissie en de deelnemende staten (samen);
- besluiten op hoog niveau over de activiteiten/budgetten voor de activiteiten van het initiatief Chips voor Europa 2.0 (capaciteitsopbouw in toekomstige werkprogramma's) worden uitsluitend door de raad van overheidsinstanties met lidstaten genomen;
- het deel van het werkprogramma dat betrekking heeft op activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw wordt uitsluitend door de raad van overheidsinstanties met lidstaten goedgekeurd;
- selectie van de uitvoerend directeur door de raad van bestuur op voordracht van de Commissie;
- onafhankelijkheid van het personeel;
- evaluaties door onafhankelijke deskundigen op basis van bekendgemaakte evaluatiecriteria, in combinatie met beroepsmechanismen en volledige belangenverklaringen;
- een verplichting voor de raad van bestuur om regels vast te stellen voor het voorkomen, vermijden en beheren van belangenconflicten in de Gemeenschappelijke Ondernemingen, in overeenstemming met de financiële regeling van de Gemeenschappelijke Ondernemingen en met het statuut voor het personeel.

De voortzetting van bestaande ethische en organisatorische waarden wordt een van de kerntaken van de Gemeenschappelijke Onderneming en de Commissie zal hierop toezien.

De uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” is als ordonnateur verplicht om een kosteneffectief systeem voor interne controle en intern beheer in te voeren. Het bureau van de gemeenschappelijke onderneming moet verslag doen aan de Commissie over het ingestelde internecontrolekader.

De Commissie zal toezien op het risico van niet-overeenstemming door middel van het rapportagesysteem dat zij zal ontwikkelen, alsmede door het opvolgen van de resultaten van controles achteraf van de ontvangers van EU-financiering van de Gemeenschappelijke Onderneming “Chips”, als onderdeel van controles achteraf met betrekking tot Horizon Europa en Digitaal Europa als geheel.

Er bestaat een duidelijke behoefte aan een efficiënt en effectief beheer van de begroting waarbij fraude en verspilling moeten worden voorkomen. In het controlesysteem moet evenwel een goed evenwicht worden gevonden tussen het bereiken van een aanvaardbaar foutenpercentage en de vereiste controlebelasting en moet worden vermeden dat de programma's van de Unie minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

2.2.3. *Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding tussen de controlekosten en de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)*

Aangezien de regels van Horizon Europa en het programma Digitaal Europa die van toepassing zijn op de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips, vergelijkbaar zijn met de regels die de Commissie zal hanteren in haar werkprogramma, met een groep begunstigden met een gelijksoortig risicoprofiel als die van de programma's onder direct beheer, kan worden verwacht dat het foutenpercentage vergelijkbaar zal zijn met het door de Commissie voor Horizon Europa en het programma Digitaal Europa beoogde niveau, d.w.z. dat er een redelijke zekerheid bestaat dat het foutenrisico gedurende de meerjarige uitgavenperiode op jaarbasis tussen de 2 en 5 % beweegt, met als einddoel tot een resterend foutenpercentage te komen dat zo dicht mogelijk bij 2 % ligt bij de sluiting van de meerjarige programma's, wanneer rekening is gehouden met het financiële effect van alle audits en corrigerende en herstelmaatregelen.

2.3. **Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden**

De Commissie draagt er zorg voor dat procedures voor fraudebestrijding in alle stadia van het beheerproces worden toegepast door de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips.

De Commissie zorgt ervoor dat passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat bij de uitvoering van uit hoofde van deze verordening gefinancierde acties het financiële belang van de Unie wordt beschermd door de toepassing van preventieve maatregelen tegen fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, door doeltreffende controles en, indien onregelmatigheden worden ontdekt, door de terugvordering van de ten onrechte betaalde bedragen en, voor zover van toepassing, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

De Rekenkamer is bevoegd om bij alle begunstigden van subsidies, contractanten en subcontractanten die uit hoofde van het programma EU-middelen hebben ontvangen, audits uit te voeren op basis van documenten en controles ter plaatse.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan overeenkomstig de procedures van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 controles en verificaties ter plaatse bij de direct of indirect bij de financiering betrokken economische subjecten uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten in verband met een subsidieovereenkomst of -besluit of een contract betreffende financiering door de Unie, waardoor de financiële belangen van de Unie zijn geschaad. De Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten eveneens toetreden tot het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Het Europees Openbaar Ministerie kan overeenkomstig de bepalingen en procedures van Verordening (EU) 2017/193923 van de Raad onderzoeken uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubrieken van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderdelen voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer	GK/NGK ⁷⁶	van EVA-landen ⁷⁷	van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten ⁷⁸	van andere derde landen	andere bestemmingsontvangsten
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten	van andere derde landen	andere bestemmingsontvangsten
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

⁷⁶ GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

⁷⁷ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

⁷⁸ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven

3.2.1.1. Kredieten uit goedgekeurde begroting

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Nummer	2
---	--------	---

DG CNECT			Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	Functie 2034	TOTAAL MFK 2028-2034
Beleidskredieten											
Begrotingsonderdeel [ECF]	Vastleggingen	(1a)	30 000		20 000		10 000		10 000		70 000
	Betalingen	(2a)	18 000	6 000	15 000	7 000	8 000	4 000	7 000	5 000	70 000
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ⁷⁹											
Begrotingsonderdeel		(3)									0
TOTAAL kredieten	Vastleggingen	=1a+1b+ 3	30 000		20 000		10 000		10 000		70 000
voor DG CNECT	Betalingen	=2a+2b+ 3	18 000	6 000	15 000	7 000	8 000	4 000	7 000	5 000	70 000
			Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	Functie 2034	T C T A

⁷⁹ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

											A L M F K 2 0 2 8 - 2 0 3 4 7 0 0 0
TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)	30 000		20 000		10 000		10 000		0 0 0
	Betalingen	(5)	18 000	6 000	15 000	7 000	8 000	4 000	7 000	5 000	7 0 0 0
TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)									0
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 2	Vastleggingen	=4+6	30 000		20 000		10 000		10 000		7 0 0 0 0

											A L M F K 2 0 2 8 - 2 0 3 4
• TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken)	Vastleggingen	(4)	30 000	0,000	20 000	0,000	10 000	0,000	10 000	0,000	7 0 0 0 0
	Betalingen	(5)	18 000	6 000	15 000	7 000	8 000	4 000	7 000	5 000	7 0 0 0 0
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten (alle beleidsrubrieken)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0 , 0 0 0 0
TOTAAL kredieten onder de rubrieken 1 tot en met 3	Vastleggingen	=4+6	30 000	0,000	20 000	0. 000	10 000	0,000	10 000		7 0 0

van het meerjarig financieel kader (referentiebedrag)	Betalingen										0 0
		=5+6	18 000	6 000	15 000	7 000	8 000	4 000	7 000	5 000	7 0 0 0

Rubriek van het meerjarig financieel kader		4	“Administratieve uitgaven” ⁸⁰						
DG: CENCT		Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	TOTAAL MFK 2028- 2034
• Personele middelen		1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	13 804
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG CNECT		1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	13 804

DG: COMP		Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	TOTAAL MFK 2028- 2034
• Personele middelen		0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	6 167
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG COMP	Kredieten	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	6 167

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 4 van het meerjarig financieel kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	19 971
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

⁸⁰

De benodigde kredieten moeten worden bepaald aan de hand van de gemiddelde jaarlijkse kostencijfers die beschikbaar zijn op de desbetreffende BUDGpedia-webpagina.

		Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	Functie 2034	TOTAAL MFK 2028- 2034
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4	Vastleggingen	32 853	2 853	22 853	2 853	12 853	2 853	12 853	0,000	89 971
van het meerjarig financieel kader	Betalingen	20 853	8 853	17 853	9 853	10 853	6 853	9 853	5 000	89 971

De geraamde gevolgen voor de uitgaven en het personeelsbestand voor 2028 en daarna worden louter ter illustratie verstrekt en lopen niet vooruit op het volgende meerjarig financieel kader. De financieringsbron en de omvang van de financiële vastlegging van de Unie voor de periode na 2027 blijven afhankelijk van het resultaat van de interinstitutionele onderhandelingen over het MFK 2028-2034 en zullen daarna worden vastgesteld via de jaarlijkse begrotingsprocedure. Alle kredieten en personeelstoewijzingen vanaf 2028 zijn indicatief.

3.2.2. Geraamde output, gefinancierd uit beleidskredieten (not to be completed for decentralised agencies)

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓			Jaar 2028		Jaar 2029		Jaar 2030		Jaar 2031		Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)						TOTAAL	
	OUTPUTS																	
	Soort 81	Gem. kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ⁸² ...																		
- Output																		
- Output																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																		
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2...																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																		
TOTAAL																		

⁸¹ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

⁸² Zoals beschreven in punt 1.3.2. "Specifieke doelstellingen"

3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven

3.2.3.1. Kredieten uit goedgekeurde begroting

GOEDGEKEURDE KREDIETEN	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRIEK 4								
Personele middelen	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	19 971
Andere administratieve uitgaven	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotaal RUBRIEK 4	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	19 971
Buiten RUBRIEK 4								
Personele middelen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andere administratieve uitgaven	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotaal buiten RUBRIEK 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAAL	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	19 971

Ter ondersteuning van de werkzaamheden op het gebied van monitoring en crisisbeheer kan DG CNECT een administratieve overeenkomst met het JRC sluiten voor ongeveer 2 vte's (CA), afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen en expertise. In dit financieel en digitaal memorandum is geen begroting opgenomen voor een dergelijke mogelijke administratieve overeenkomst.

De geraamde gevolgen voor de uitgaven en het personeelsbestand voor 2028 en daarna worden louter ter illustratie verstrekt en lopen niet vooruit op het volgende meerjarig financieel kader. De financieringsbron en de omvang van de financiële vastlegging van de Unie voor de periode na 2027 blijven afhankelijk van het resultaat van de interinstitutionele onderhandelingen over het MFK 2028-2034 en zullen daarna worden vastgesteld via de jaarlijkse begrotingsprocedure. Alle kredieten en personeelstoewijzingen vanaf 2028 zijn indicatief.

3.2.4. Geraamde personeelsbehoeften

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven

3.2.4.1. Gefinancierd uit goedgekeurde begroting

Raming in voltijdequivalenten (vte's)⁸³

GOEDGEKEURDE KREDIETEN	Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)							
20 01 02 01 (hoofdkantoor en vertegenwoordigingen van de Commissie)	12	12	12	12	12	12	12

⁸³ Specificeer onder de tabel hoeveel vte's binnen het aangegeven aantal reeds zijn toegewezen voor het beheer van de actie en/of binnen uw DG kunnen worden heringezet en wat uw nettobehoeften zijn.

20 01 02 03 (EU-delegaties)	0	0	0	0	0	0	0
(Onderzoek onder contract)	0	0	0	0	0	0	0
(Eigen onderzoek)	0	0	0	0	0	0	0
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)	0	0	0	0	0	0	0
• Extern personeel (in vte's)							
20 02 01 (AC, END van de "totale financiële middelen")	5	5	5	5	5	5	5
20 02 03 (AC, AL, END en JPD in de EU-delegaties)	0	0	0	0	0	0	0
Admin. ondersteuning	• centrale diensten • EU-delegaties	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]		0	0	0	0	0	0
(AC, END — onderzoek onder contract)		0	0	0	0	0	0
(AC, END — eigen onderzoek)		0	0	0	0	0	0
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) – rubriek 4		0	0	0	0	0	0
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) – buiten rubriek 4		0	0	0	0	0	0
TOTAAL		17	17	17	17	17	17

De geraamde gevolgen voor de uitgaven en het personeelsbestand voor 2028 en daarna worden louter ter illustratie verstrekt en lopen niet vooruit op het volgende meerjarig financieel kader. De financieringsbron en de omvang van de financiële vastlegging van de Unie voor de periode na 2027 blijven afhankelijk van het resultaat van de interinstitutionele onderhandelingen over het MFK 2028-2034 en zullen daarna worden vastgesteld via de jaarlijkse begrotingsprocedure. Alle kredieten en personeelstoewijzingen vanaf 2028 zijn indicatief.

Aantal personeelsleden dat nodig is voor de uitvoering van het voorstel (in vte's):

	Uit te voeren door bestaand personeel van de diensten van de Commissie	Uitzonderlijk aanvullend personeel*		
		Te financieren uit rubriek 4 of onderzoek	Te financieren uit BA-onderdeel	Te financieren uit vergoedingen
Personeelsformatieposten	5	7	n.v.t.	
Extern personeel (AC, END, INT)	2	3		

Beschrijving van de uit te voeren taken door:

Ambtenaren en tijdelijk personeel	Sommige taken kunnen worden uitgevoerd door middel van herschikking van personeel dat momenteel aan soortgelijke taken werkt, bv. op het gebied van programmatoezicht, contacten met belanghebbenden en rapportage over onderzoeks-
-----------------------------------	---

	en ontwikkelingsactiviteiten en capaciteitsopbouw in het kader van pijler I. De extra taken die in het voorstel worden genoemd, moeten worden uitgevoerd door extra personeel, bv. het vaststellen van en toezien op strategische projecten, met inbegrip van het monitoren van mijlpalen en te leveren resultaten; nalevingscontroles (staatssteun, aanbestedingen); landsgrensoverschrijdende coördinatie met de lidstaten; het definiëren van grote uitdagingen en het toezicht houden op de uitvoering daarvan; het coördineren van administratief (niet-financieel) toezicht; het beoordelen van regionale investeringsplannen; het beoordelen van de eigendom van en zeggenschap over binnenlandse ondernemingen; het raadplegen van de Europese Raad voor halfgeleiders inzake strategische projecten, aanbevelingen betreffende chips van binnenlandse ondernemingen bij overheidsopdrachten, overleg met de alliantie teneinde een gemeenschappelijke strategie inzake halfgeleider technologieën vast te stellen en advies over risicogevoelige sectoren; het aangaan van strategische partnerschappen met derde landen; het verstrekken van richtsnoeren inzake overheidsopdrachten aan de lidstaten en aanbestedende diensten; het verstrekken van methodologische aanbevelingen voor het uitvoeren van risicobeoordelingen op het gebied van leveringszekerheid; het uitvoeren van oefeningen met betrekking tot crisisparaatheid; het opzetten en faciliteren van vraagfora; het ondersteunen van gezamenlijke ontwerpactiviteiten tussen halfgeleiderfabrikanten en industriële downstream-gebruikers; het verstrekken van technisch en juridisch advies bij de aanschaf van systemen waarin innovatieve halfgeleiderontwerpen en -oplossingen zijn geïntegreerd; het waarborgen van samenhang tussen het initiatief Chips voor Europa 2.0 en nationale/regionale strategieën; het toezicht houden op de organisatie en verslaglegging aan de Raad/het Parlement. Daarnaast houdt het voorstel extra taken in met betrekking tot het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders, bv het monitoren van toeleveringsketens voor halfgeleiders; functies voor analyse en crisisparaatheid; het opstellen en afhandelen van verzoeken om informatie en het controleren en samenvoegen van gegevens in de fase vóór de crisis; en sectoroverschrijdende coördinatie met belanghebbenden uit de sector. Een aanzienlijk deel van de bovengenoemde extra taken kan worden uitgevoerd door middel vanerschikking van bestaand personeel.
Extern personeel	Idem.

3.2.5. Overzicht van het geschatte effect op investeringen die met digitale technologie samenhangen

Verplicht: in onderstaande tabel moet de beste schatting worden gegeven van de met digitale technologie samenhangende investeringen die uit het voorstel/initiatief voortvloeien.

De kredieten onder rubriek 4 moeten in uitzonderlijke gevallen in het desbetreffende onderdeel worden opgenomen, indien vereist voor de uitvoering van het voorstel/initiatief.

De kredieten onder de rubrieken 1 t/m 3 moeten worden weergegeven als “IT-beleidsuitgaven inzake operationele programma’s”. Deze uitgaven betreffen het operationele budget dat gebruikt moet worden voor hergebruik, koop of ontwikkeling van IT-platforms of tools die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het initiatief, alsook daarmee verband houdende investeringen (bv. licenties, studies, gegevensopslag enz.). De in deze tabel vermelde informatie moet in overeenstemming zijn met de gegevens in afdeling 4, “Digitale dimensies”.

TOTAAL Digitale en IT- kredieten	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL MFK 2028-2034
--	------	------	------	------	------	------	------	----------------------------

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRIEK 4								
IT-uitgaven (algemeen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal RUBRIEK 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Buiten RUBRIEK 4								
IT-beleidsuitgaven inzake operationele programma's	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal buiten RUBRIEK 4	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.6. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

- ☒ kan volledig worden gefinancierd door middel vanerschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK)
- ☐ vereist een beroep op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening
- ☐ vereist een herziening van het MFK

De geraamde gevolgen voor de uitgaven en het personeelsbestand voor 2028 en daarna worden louter ter illustratie verstrekt en lopen niet vooruit op het volgende meerjarig financieel kader. De financieringsbron en de omvang van de financiële vastlegging van de Unie voor de periode na 2027 blijven afhankelijk van het resultaat van de interinstitutionele onderhandelingen over het MFK 2028-2034 en zullen daarna worden vastgesteld via de jaarlijkse begrotingsprocedure. Alle kredieten en personeelstoewijzingen vanaf 2028 zijn indicatief.

3.2.7. Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

- ☒ voorziet niet in medefinanciering door derden
- ☐ voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034	Totaal

Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- ☒ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.
- ☐ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - ☐ voor de eigen middelen
 - ☐ voor overige ontvangsten
 - ☐ geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ⁸⁴						
		Jaar 2028	Jaar 2029	Jaar 2030	Jaar 2031	Jaar 2032	Jaar 2033	Jaar 2034
Artikel								

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten de betrokken begrotingsonderdelen voor uitgaven.

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

4. DIGITALE DIMENSIES

In deze afdeling wordt aandacht besteed aan trans-Europese digitale overheidsdiensten en de vereisten inzake landsgrensoverschrijdende interoperabiliteit daarvan.

4.1. Voorschriften met digitale relevantie

Korte beschrijving van de voorschriften met digitale relevantie en de categorieën ervan (data, procesdigitalisering en -automatisering, digitale oplossingen en/of digitale overheidsdiensten):

⁸⁴ Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

Verwijzing naar voorschrift	Beschrijving van voorschrift	Betrokken actoren	Processen op hoog niveau	Categorieën
Artikel 15	Aanvraag voor de status van Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie	Europese Commissie	Toepassing	Data
Artikel 22	De lidstaten stellen één enkele vergunningsprocedure vast op basis van één enkele aanvraag voor alle vergunningen die vereist zijn voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie	Lidstaten Nationale bevoegde autoriteiten	Vergunningverlening	Data Digitale oplossing Procesdigitalisering en -automatisering
Artikel 24	De lidstaten zetten op nationaal niveau een centraal toegangsporaal op voor de indiening van de aanvraag voor de gecombineerde vergunning voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie	Lidstaten Nationale bevoegde autoriteiten	Vergunningverlening	Procesdigitalisering en -automatisering
Artikel 33	Strategische inventarisatie van de halfgeleiderindustrie in de Unie	Europese Commissie	Monitoring	Data
Artikel 34	Oprichting van het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders	Particuliere exploitanten	Delen van gegevens	Digitale oplossing Data
Artikel 35	De Commissie voorziet, in overleg met de Europese Raad	Europese Commissie	Monitoring	Data

Verwijzing naar voorschrift	Beschrijving van voorschrift	Betrokken actoren	Processen op hoog niveau	Categorieën
	voor halfgeleiders, in de regelmatige monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders om vast te stellen welke factoren de levering van halfgeleiders in de Unie of de handel daarin kunnen verstoren, in gevaar kunnen brengen of negatief kunnen beïnvloeden.			
Artikel 38	Preventieve informatieverzameling	Europese Commissie	Verslaglegging	Data
Artikel 41	Informatieverzameling tijdens de crisisfase	Europese Commissie	Verslaglegging	Data

4.2. Data

Korte beschrijving van de betrokken data.

Soort data	Verwijzing naar voorschrift(en)	Standaard en/of specificatie (indien van toepassing)
Gegevens in het kader van de aanvraag voor de status van een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie	Artikel 15	n.v.t.
Vergunningsaanvragen	Artikel 22	n.v.t.
Gegevens die nodig zijn voor een strategische inventarisatie van de halfgeleiderindustrie in de Unie	Artikel 33	n.v.t.
Gegevens in het kader van het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders	Artikel 34	n.v.t.
Gegevens die nodig zijn voor de monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders	Artikel 35	n.v.t.
Preventieve informatieverzameling	Artikel 38	n.v.t.

Informatieverzameling tijdens de crisisfase	Artikel 41	n.v.t.
---	------------	--------

Datastromen

Korte beschrijving van de datastromen

Soort data	Verwijzing(en) naar het document	Actoren die data verstrekken	Actoren die data ontvangen	Aanleiding voor uitwisseling van data	Frequentie (indien van toepassing)
Gegevens in het kader van de aanvraag voor de status van een Europees initiatief op het gebied van halfgeleidertechnologie	Artikel 15	Industrie	Europese Commissie	n.v.t.	n.v.t.
Vergunningsaanvragen	Artikel 22	Industrie	Lidstaten	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens die nodig zijn voor een strategische inventarisatie van de halfgeleiderindustrie in de Unie	Artikel 33	Industrie	Europese Commissie	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens in het kader van het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders	Artikel 34	Industrie	Europese Commissie	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens die nodig zijn voor de monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders	Artikel 35	Industrie	Europese Commissie	n.v.t.	n.v.t.
Preventieve informatieverzameling	Artikel 38	Industrie	Europese Commissie	Fase vóór de crisis	n.v.t.
Informatieverzameling tijdens de crisisfase	Artikel 41	Industrie	Europese Commissie	Crisisfase	n.v.t.

Afstemming op Europese datastrategie

Toelichting hoe het voorschrift of de voorschriften zijn afgestemd op de Europese datastrategie:

Dit wetgevingsinitiatief is in overeenstemming met het gebruik van gegevens in particulier bezit door overheidsinstanties (business-to-government — B2G) om empirisch onderbouwde beleidsbeslissingen te waarborgen. Het digitaal vergunningsstelsel wordt zodanig ontworpen dat interoperabiliteit en geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen bevoegde autoriteiten, het hergebruik van gegevens en documenten die reeds in het bezit zijn van overheidsinstanties, een hoog niveau van cyberbeveiliging en informatie-integriteit, alsook transparantie en verantwoordingsplicht in de vergunningsprocedure worden gewaarborgd.

Afstemming op eenmaligheidsbeginsel

Artikel 22 voorziet in de vaststelling van één enkele vergunningsprocedure op basis van één enkele aanvraag voor alle vergunningen die nodig zijn voor Europese initiatieven en strategische projecten op het gebied van halfgeleidertechnologie.

4.3. Digitale oplossingen

Geef voor elke digitale oplossing de referentie naar de eis(en) van digitaal belang met betrekking tot die oplossing, een beschrijving van de voorgeschreven functionaliteit van de digitale oplossing, de instantie die daarvoor verantwoordelijk zal zijn, en andere relevante aspecten zoals herbruikbaarheid en toegankelijkheid. Vermeld tot slot of het de bedoeling is dat de digitale oplossing gebruikmaakt van AI-technologieën.

Digitale oplossing	Verwijzing naar voorschrift (en)	Belangrijkste vereiste functies	Bevoegde instantie	Hoe wordt gezorgd voor toegankelijkheid?	Hoe wordt herbruikbaarheid in aanmerking genomen?	Gebruik van AI-technologie
Digitaal vergunningsstelsel	Artikel 22 en artikel 24	Vergunningsprocedures verlopen volledig digitaal. Het systeem voorziet in één gebruikersinterface die	Lidstaten nationale bevoegde autoriteiten	Het digitaal vergunningstelsel moet zo worden ontworpen dat het gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor alle aanvragers, met inbegrip van personen met een	Het digitaal vergunningsstelsel moet zo worden ontworpen dat het hergebruik van gegevens en documenten die reeds in het bezit zijn van overheidsin	//

Digitale oplossing	Verwijzing naar voorschrift (en)	Belangrijkste vereiste functies	Bevoegde instantie	Hoe wordt gezorgd voor toegankelijkheid?	Hoe wordt herbruikbaarheid in aanmerking genomen?	Gebruik van AI-technologie
		interactie met de relevante overheidsdiensten mogelijk maakt. Het digitale vergunningssysteem maakt de papierloze indiening, opvolging en besluitvorming van vergunningaanvragen mogelijk.		handicap	stanties wordt gewaarborgd	
Business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders	Artikel 34	Het platform moet gegevens verzamelen van deelnemende ondernemingen om de transparantie en veerkracht van de toelevering	Particuliere exploitanten	Het platform moet zo worden ontworpen dat het gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor alle aanvragers, met inbegrip van personen met een handicap.		//

Digitale oplossing	Verwijzing naar voorschrift (en)	Belangrijkste vereiste functies	Bevoegde instantie	Hoe wordt gezorgd voor toegankelijkheid?	Hoe wordt herbruikbaarheid in aanmerking genomen?	Gebruik van AI-technologie
		ngsketen voor halfgeleiders te vergroten				

Digitaal vergunningsstelsel

Digitale en/of sectorale beleidsmaatregelen (indien van toepassing)	Zo is gezorgd voor afstemming
EU-kader voor cyberbeveiliging	Het nationale digitale vergunningsstelsel moet worden ontworpen om een hoog niveau van gegevensbescherming, cyberbeveiliging en integriteit van informatie te waarborgen.
Europese portemonnees voor ondernemingen	Het centrale toegangspunt van een nationaal digitaal vergunningsstelsel maakt gebruik van de Europese portemonnees voor ondernemingen.

Business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders

Digitale en/of sectorale beleidsmaatregelen (indien van toepassing)	Zo is gezorgd voor afstemming
EU-kader voor cyberbeveiliging	Het business-to-businessplatform voor de toeleveringsketen voor halfgeleiders moet worden ontworpen om een hoog niveau van gegevensbescherming, cyberbeveiliging en integriteit van informatie te waarborgen.

4.4. Interoperabiliteitsbeoordeling

n.v.t.

4.5. Maatregelen ter ondersteuning van de digitale uitvoering

n.v.t.



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 3.6.2026
COM(2026) 504 final

ANNEXES 1 to 7

BIJLAGEN

bij

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**betreffende een kader voor maatregelen ter versterking van het halfgeleiderecosysteem
van de Unie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/1781 (chipsverordening 2.0)**

{SEC(2026) 504 final} - {SWD(2026) 504 final} - {SWD(2026) 505 final}

BIJLAGE I Acties in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0

Technische beschrijving van het initiatief Chips voor Europa 2.0: reikwijdte van de acties

In voorkomend geval worden de door het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunde acties uitgevoerd overeenkomstig de volgende technische beschrijvingen:

1. Ontwerpcapaciteiten voor geïntegreerde halfgeleidertechnologieën

Achtergrond

In het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0 wordt de opbouw van grootschalige innovatieve ontwerpcapaciteiten voor halfgeleidertechnologieën ondersteund via een cloudgebaseerd ontwerpplatform dat in de hele Unie beschikbaar is. Het ontwerpplatform bestaat uit innovatieve ontwerpfaciliteiten met uitgebreide bibliotheken en instrumenten, waarin een groot aantal bestaande en nieuwe technologieën worden geïntegreerd, waaronder opkomende technologieën zoals geïntegreerde fotonica, kwantumtechnologie en artificiële intelligentie/neuromorfische technologieën. In combinatie met de bestaande instrumenten voor elektronische ontwerpautomatisering maakt dit platform het mogelijk innovatieve componenten en nieuwe systeemconcepten te ontwerpen en belangrijke sleutelfuncties te demonstreren, zoals nieuwe benaderingen van krachtige, energiezuinige, veiligheids-, nieuwe 3D-architectuur en heterogene systeemarchitecturen.

Als strategische ruggengraat van het initiatief Chips voor Europa 2.0 biedt het platform een centraal toegangspunt dat gebruikers begeleidt van het ontwerp tot de ontwikkeling van prototypes en de fabricage, en waar onderzoek, onderwijs en industrie samenkomen. Het uiteindelijke doel ervan is de ontwikkeling te bevorderen van een nieuwe generatie fabriekloze start-ups in de Unie. Die ondernemingen dragen bij tot de ontwikkeling van innovatieve chips voor de verwerkende industrieën in de Unie, genereren de hoogste waarde in de waardeketen voor halfgeleiders, stimuleren innovatie op snelgroeiende markten en verminderen de afhankelijkheid van de Unie van buitenlandse ontwerpecosystemen.

Status

Sinds mei 2026 is een breed scala aan actoren bij het platform betrokken, waaronder een platformcoördinatieteam (PCT)¹, teams voor ontwerpondersteuning², cloudaanbieders, leveranciers van elektronische ontwerpautomatisering (EDA) en leveranciers van intellectuele eigendom. Het ontwerpplatform wordt stapsgewijs geïmplementeerd: om te beginnen is er een platformcoördinatieteam geselecteerd en opgezet om het platform te exploiteren, de centrale cloudinfrastructuur te hosten en de ondersteunende diensten voor gebruikers te coördineren. Ook de teams voor ontwerpondersteuning zijn geselecteerd om gebruikers gedurende het gehele chipontwikkelingsproces ondersteuning op maat te bieden. Er is een contractant

¹ De platformcoördinatieteams fungeren als hostingentiteit voor de virtuele infrastructuur en centrale diensten van het ontwerpplatform, coördineren de toegang tot een breed scala aan instrumenten, voorzieningen en diensten en helpen de Gemeenschappelijk Onderneming “Chips” (GO Chips) bij de aanbesteding van het cloudplatform.

² De teams voor ontwerpondersteuning helpen gebruikers bij het opzetten en aanpassen van ontwerpomgevingen en -processen en bij het inzetten van instrumenten voor elektronische ontwerpautomatisering in de cloud.

geselecteerd voor de centrale cloudinfrastructuur, waar intellectuele eigendom, Process Design Kits voor proeflijnen en opensource-EDA-instrumenten zullen worden ondergebracht.

Er zijn onderhandelingen gaande om grote EDA-aanbieders te selecteren en in het platform te integreren. Deze onderhandelingen zullen naar verwachting najaar 2026 worden afgerond. De eerste grootschalige faciliteiten zullen naar verwachting eind 2026 operationeel zijn.

Het ontwerpplatform wordt aangevuld met andere acties om ontwerpgerelateerde competenties in de Unie te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer om het beheer van subsidies voor start-ups en kmo's die het platform gebruiken, steun voor de ontwikkeling van opensource-EDA-instrumenten en voor de Europractice-diensten waarmee aan meer dan 600 Europese universiteiten tegen geringe kosten toegang wordt geboden tot EDA-opleidingsinstrumenten en tot de productiecapaciteit van toonaangevende gieterijen.

Vooruitzichten voor de toekomst

Het ontwerpplatform wordt voortdurend geüpgraded met nieuwe ontwerpcapaciteiten, aangezien het steeds meer technologieën en ontwerpen integreert, waaronder nieuwe opensource-processorarchitecturen en andere innovatieve architecturen, minichips, programmeerbare chips, nieuwe soorten geheugen, processoren, versnellers of energiezuinige chips.

Het platform integreert ook fotonica en intellectuele eigendom voor kwantumchips, bibliotheken en instrumenten voor ontwerpautomatisering in een volledig geïntegreerde systeembenadering (zie ook de punten 3 en 5). Het omvat ook de Process Design Kits (PDK's) voor de belangrijkste proeflijnen van het initiatief Chips voor Europa 2.0, alsook PDK's voor industriële fabricagefaciliteiten (afhankelijk van hun voorafgaande toestemming) om het ontwerpen van chips die klaar zijn om naar dergelijke proeflijnen en industriële faciliteiten te worden gestuurd, te vergemakkelijken.

Het platform biedt zijn diensten via de cloud aan, waarbij de toegang en openheid voor de hele gemeenschap wordt gemaximaliseerd door een netwerk van bestaande en nieuwe ontwerpcentra in de lidstaten te creëren. Het platform biedt met name steun aan start-ups, scale-ups en kmo's. Het vergroot het ecosysteem voor halfgeleiders van de Unie door dit te integreren met verschillende marktsectoren, zoals gezondheid, mobiliteit, energie, telecommunicatie, veiligheid, defensie en ruimtevaart. Er zal meer aandacht worden besteed aan de industrialisering van innovatieve componenten die op het platform worden ontworpen en in leidende sectoren worden ingevoerd.

2. Proeflijnen voor de voorbereiding van innovatieve productie, testen en validering

Achtergrond

Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt proeflijnen voor productie, testen en validering die de kloof tussen het laboratorium en de fabricage van geavanceerde halfgeleidertechnologieën helpen overbruggen, zoals architecturen en materialen voor vermogenslektronica, neuromorfische en ingebedde AI-chips, geïntegreerde fotonica, grafeen en andere 2D-materiaalgebaseerde technologieën, waarbij elektronica en microvloeistoffen in heterogene systemen worden geïntegreerd.

Status

Sinds mei 2026 zijn vijf proeflijnen in verschillende mate operationeel. Deze worden nog steeds uitgebreid met aanvullende uitrusting, machines en instrumenten om het vermogen en de capaciteit van de proeflijnen te vergroten. De technologische gebieden voor de proeflijnen zijn gekozen om de meest kritieke lacunes op het gebied van halfgeleiders in de Unie te dichten, maar ook om voort te bouwen op bestaande sterke punten en het concurrentievermogen op lange termijn, de voorzieningszekerheid en de industriële veerkracht te waarborgen. De vijf proeflijnen zijn:

- *sub-2 nm logic*, dat de Unie de mogelijkheid biedt deel te nemen aan de geavanceerde nodes die aan de basis liggen van AI, HPC, datacentra en communicatie van de volgende generatie;
- *FD-SOI* biedt verdere verdieping op een gebied waarop de Unie al een voortrekkersrol speelt door de levering van energiezuinige chips met een hoge betrouwbaarheid voor de automobielsector, mobiliteitstoepassingen, industriële automatisering en het internet der dingen;
- *advanced packaging and heterogeneous integration* (geavanceerde behuizingen en heterogene integratie) is gebaseerd op het uitgangspunt dat toekomstige prestatieverbeteringen afhangen van de integratie op systeemniveau. De Unie kampt met een strategische tekortkoming op het gebied van behuizingen, maar heeft ook een uitgelezen kans om het voortouw te nemen op het gebied van minichips, 3D-stacking en de co-integratie van logica, geheugen, detectie en connectiviteit;
- *wide-bandgap materials* (materialen met een grote bandbreedte, zoals SiC en GaN) sluiten goed aan bij de sterke punten van de Unie op het gebied van vermogenslektronica en zijn van vitaal belang voor de energietransitie, elektrische mobiliteit, hernieuwbare infrastructuur en hoogrenderende industriële systemen; en
- *photonic integrated circuits* (fotonische geïntegreerde schakelingen), die steeds belangrijker worden voor datatransmissie met een grote bandbreedte en een laag energieverbruik, detectie en geavanceerde computerarchitecturen in telecom- en datacentra.

Bovendien streven “Lab to Fab Accelerators” naar een snelle invoering door de EU-industrie van de in het kader van de proeflijnen ontwikkelde technologieën, met name technologieën voor geavanceerde behuizingen en heterogene integratie.

Vooruitzichten voor de toekomst

De proeflijnen blijven ondersteuning bieden om de prestaties van intellectuele eigendomsblokken, virtuele prototypes, nieuwe ontwerpen en nieuwe geïntegreerde heterogene systemen op een open en toegankelijke manier uit te proberen, te testen en te valideren, onder meer door middel van process design kits (PDK's). De PDK's worden in het ontwerpplatform geïntegreerd om het gebruik ervan bij ontwerpprojecten en projecten voor de ontwikkeling van (virtuele) prototypes mogelijk te maken.

De huidige proeflijnen zullen in toenemende mate gericht zijn op de industrialisering en uitrol van proeflijntechnologieën ter ondersteuning van het ecosysteem voor halfgeleiders van de Unie.

Voor nieuwe uitdagingen, zoals energie-efficiënte AI-chips, kunnen er nieuwe of verbeterde proeflijnen worden ondersteund; geavanceerde technologieën zoals CFET-apparaten en monolithische 3D-geïntegreerde schakelingen voor betere prestaties en een lager energieverbruik; ferro-elektrische geheugenchips en geheugenchips op basis van weerstand of lading die ultrasnelle operaties met een ultralaag energieverbruik mogelijk maken.

Bovendien kunnen er nieuwe of verbeterde proeftuinen worden ondersteund wanneer verschillende innovatieve technologieën of producten worden gecombineerd en geïntegreerd voor de ontwikkeling en validering van nieuwe apparaten voor belangrijke toepassingen en verwerkende industrieën. Een voorbeeld hiervan is een proeftuin voor miniaturisatie, geavanceerde optica en laserprojectietechnologieën voor de toepassing in slimme brillen. Proeftuinen helpen risico's in kaart te brengen, prestaties te valideren en de haalbaarheid onder reële omstandigheden vast te stellen voordat zij volledig op industriële schaal worden uitgerold.

3. Geavanceerde technologie en engineeringcapaciteit voor kwantumchips

Achtergrond

Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt de ontwikkeling van kwantumchips en aanverwante technologieën, waaronder chips op basis van halfgeleidermateriaal en fotonisch geïntegreerde chips. Specifieke acties in dit verband omvatten ontwerpbibliotheken voor kwantumchips, proeflijnen voor de bouw van kwantumchips en faciliteiten voor het testen en valideren van door de proeflijnen geproduceerde kwantumchips. Het doel is onderzoekers, start-ups en het bedrijfsleven in de Unie betrouwbare toegang te bieden tot faciliteiten die in staat zijn de belangrijkste kwantumchiptechnologieën te produceren en te valideren.

Status

Sinds mei 2026 zijn er zes proeflijnen voor kwantumchips opgezet, één voor elk van de leidende technologieplatforms van de Unie: supergeleidende, spintronische, fotonische en diamant-chips, en chips op basis van neutrale atomen en gevangen ionen. De projecten zijn gericht op het opzetten van stabiele productieprocessen op proefschaal, het integreren van test- en experimenteerfaciliteiten, het ontwikkelen van routekaarten voor vroege industrialisering en het leggen van de basis voor toekomstige schaalvergroting.

Proeflijn	Naam	Coördinator
Supergeleiding	SUPREME	VTT (FI)
Spintronisch	SPINS	IMEC (BE)
Fotonisch	P4Q	Universiteit Twente (NL)
Diamant	DIREQT	CNR (IT)
Neutrale atomen	Q-PLANET	PASCAL (FR)
Gevangen ionen	CHAMP-ION	SAL (AT)

Daarnaast zijn de activiteiten gericht op het ondersteunen van de totstandkoming van een pan-Europese ontwerpgemeenschap voor het ontwerpen van kwantumchips, het uitvoeren van simulaties en het opbouwen van verificatiebibliotheken en -instrumenten voor kwantumchips. Tot slot worden ontsluitende technologieën ondersteund, met inbegrip van de elektronische,

cryogene, behuizings- en interfacing-subsysteem die helpen om kwantumapparaten voor te bereiden, te beschermen, te controleren, onderling met elkaar te verbinden en uit te lezen.

Vooruitzichten voor de toekomst

De geavanceerde technologische en technische capaciteit voor kwantumchips wordt verder opgebouwd en versterkt. Dit omvat ontwerpcapaciteiten, ontwerpbibliotheken voor kwantumchips, proeflijnen, test- en experimenteerfaciliteiten en ontsluitende technologieën. Er wordt ook steun verleend aan projecten voor de eerste industrialisering van de meest volwassen technologieën. Voor verschillende technologieplatforms worden verschillende vormen van steun verleend. Naarmate kwantumchiptechnologieën volwassen worden, zal de industrialisering ervan toenemen.

4. Een netwerk van kenniscentra en ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van halfgeleiders

Achtergrond

Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt de vorming van een netwerk van kenniscentra voor halfgeleiders. Deze centra bieden gestructureerde toegang tot technische expertise, testfaciliteiten en adviesdiensten, en stellen bedrijven (met name kmo's en start-ups) in staat hun ontwerpcapaciteiten te versterken, met nieuwe technologieën te experimenteren en gespecialiseerde vaardigheden te ontwikkelen. Kenniscentra spelen een sleutelrol bij het aanpakken van de vaardigheidskloof van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologieën.

Status

Sinds mei 2026 zijn in alle lidstaten en in Noorwegen kenniscentra opgezet. Daarnaast is er een ondersteunende actie vastgesteld om de werkzaamheden van de nationale kenniscentra in gang te zetten en te coördineren. In het kader van de ondersteunende actie is er een focusgroep voor opleiding en ontwikkeling van vaardigheden opgezet die de samenwerking tussen de kenniscentra stimuleert met het oog op de uitrol van onderwijs- en bijscholingsinitiatieven, het creëren van opleidingsconcepten en het bieden van specifieke opleiding en toegang tot het ontwerpplatform en proeflijnen.

Vooruitzichten voor de toekomst

De kenniscentra voor halfgeleiders blijven ondersteund worden. De mogelijkheden om nieuwe centra op te richten of bestaande centra te heroriënteren, afhankelijk van de technologische en marktontwikkelingen, moeten worden geanalyseerd. De samenwerking tussen kenniscentra wordt in het hele netwerk waar mogelijk versterkt. Voorts wordt de steun van kenniscentra voor de ontwikkeling van vaardigheden versterkt, onder meer door de samenwerking met aanbieders van hoger onderwijs en beroepsopleiding te bevorderen, nauw samen te werken met het pact voor vaardigheden en de werkgroep vaardigheden van de industriële alliantie, en door de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de halfgeleidersector te vergroten.

5. Capaciteiten voor het geavanceerd ontwerp, de ontwikkeling van prototypes en de industriële toepassing van technologieën op basis van fotonische geïntegreerde schakelingen

Achtergrond

Dit nieuwe onderdeel van het initiatief Chips voor Europa ondersteunt de ontwikkeling van fotonische geïntegreerde schakelingen en aanverwante technologieën. De acties omvatten de ontwikkeling van ontwerpbibliotheken en ontwerpautomatiseringsinstrumenten voor fotonische geïntegreerde schakelingen en de verbetering van bestaande proeflijnen en/of de oprichting van nieuwe proeflijnen voor de ontwikkeling van prototypes en de productie van fotonische geïntegreerde schakelingen. De capaciteiten op het gebied van productietechnologieën, waaronder voor gecombineerde behuizingen en heterogene integratie met elektronische chips, productieapparatuur en materiaalplatforms voor fotonische geïntegreerde schakelingen, moeten worden versterkt.

Status

In mei 2026 is een proeflijn voor fotonische geïntegreerde schakelingen geopend. Deze proeflijn biedt open toegang tot fabricagediensten op 14 hostinglocaties, die meerdere platforms voor fotonisch materiaal omvatten, van silicium en siliciumnitride tot indiumfosfide. Deze diensten omvatten chipproductiegangen, hybride integratie, behuizing, tests en betrouwbaarheidskwalificatie. Er zijn technologische demonstratiemodellen gepland, waaronder fotonische chips in gecombineerde behuizing voor AI-datacentra, LiDAR-sensoren, zichtbare lichtmotoren voor AR/VR en programmeerbare fotonische processoren. Bovendien worden naast de proeflijn industriële demonstratiemodellen van geavanceerde fotonische technologieën ontwikkeld die de schaalbaarheid, betrouwbaarheid en integratiemogelijkheden daarvan moeten aantonen.

Vooruitzichten voor de toekomst

Fotonische geïntegreerde schakelingen en aanverwante technologieën worden verder ondersteund. Dit geldt voor de ontwerpinstrumenten, ontwerpbibliotheken, proeflijnen, demonstratiemodellen en opleidingsdiensten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de overdracht en industriële toepassing van technologieën die in het kader van dit onderdeel van het initiatief Chips voor Europa 2.0 zijn ontwikkeld.

6. Activiteiten van het chipfonds voor toegang tot kapitaal voor start-ups, scale-ups en kmo's

Achtergrond

Het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt de creatie van een bloeiend ecosysteem voor halfgeleider- en kwantuminnovatie door de toegang tot durfkapitaal voor start-ups, scale-ups en kmo's te ondersteunen met het oog op bedrijfsuitbreiding en duurzame versterking van hun aanwezigheid op de markt.

Status

Sinds mei 2026 wordt het chipfonds uitgevoerd via twee thematische investeringsfaciliteiten: het Accelerator-programma van de Europese Innovatieraad, met financiering uit Horizon Europa in de vorm van gemengde subsidies en eigen vermogen voor deeptech-start-ups met een hoog risico; en het InvestEU-fonds, beheerd door het Europees Investeringsfonds, met een garantie van het programma Digitaal Europa, voor kapitaalinvesteringen via intermediairs, variërend van de zaai- tot de groeifase. Het beschikbare budget van 300 miljoen EUR voor het Accelerator-programma werd in slechts twee jaar volledig besteed.

Hiermee werden 24 zeer innovatieve start-ups ondersteund met in totaal 62 miljoen EUR aan subsidies en 238 miljoen EUR aan aanbevolen investeringen in eigen vermogen. Voor het InvestEU-deel van het chipfonds zijn vier financiële partners geselecteerd, waarmee overeenkomsten voor de toewijzing van 68 miljoen EUR aan middelen zijn ondertekend of goedgekeurd, wat er tot dusver toe heeft geleid dat 31 ondernemingen van de beginfase tot de groeifase 116 miljoen EUR aan investeringen in eigen vermogen hebben ontvangen.

Vooruitzichten voor de toekomst

Hoewel er aandacht voor start-ups moet blijven, zal er meer aandacht worden besteed aan scale-ups en de financiering voor latere fasen. Er moet aanzienlijk meer financiering uit het Scaleup Europe-fonds voor deeptech-scale-ups worden verleend, als hefboom om aanvullend particulier durfkapitaal aan te trekken.

7. Grote uitdagingen

Achtergrond

Dit nieuwe onderdeel van het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt grootschalige, sectoroverschrijdende initiatieven voor het aanpakken van belangrijke technologische en industriële uitdagingen van strategisch belang voor de Unie (“grote uitdagingen”) die gevolgen kunnen hebben voor verschillende ecosystemen. De aanpak van deze grote uitdagingen zal naar verwachting leiden tot technologische vooruitgang op het gebied van mainstream- en geavanceerde technologieën, eind-tot-eindintegratie van producten gedurende de gehele productontwikkelingscyclus en de precommerciële industrialisering ervan.

Status

Sinds mei 2026 zijn er nog geen activiteiten uitgevoerd in het kader van het onderdeel “grote uitdagingen” van het initiatief.

Vooruitzichten voor de toekomst

Een grote uitdaging die zou kunnen worden aangepakt, is de ontwikkeling van nieuwe computertechnologieën die tot een drastische vermindering van het energieverbruik moeten leiden (bijvoorbeeld duizend keer minder). De aanpak van deze grote uitdaging kan energie-efficiënte, veilige en gespreide AI-infrastructuren opleveren, die hoogwaardige AI-versnellers (geheugen van HBM-klasse, “stacked logic”, optische/RF-verbindingen), agentische/ingebbede AI-systemen, contextuele edge-intelligentie en veilige energiezuinige infrastructuren mogelijk maken. De ontwikkeling van energie-efficiënte chips, waaronder AI-chips, kan ook helpen om de grote uitdaging “baanbrekende energie- en hulpbronnen-efficiënte rekeninfrastructuur, met het oog op het verbeteren van de duurzaamheid ervan bij gebruik op grote schaal” te verwezenlijken, zoals vastgesteld in de verordening cloud- en AI-ontwikkeling (CADA)³. De O&I-activiteiten worden nauw op elkaar afgestemd om deze twee complementaire uitdagingen aan te pakken, onder meer door eventuele gecoördineerde oproepen tot het indienen van voorstellen.

Een andere grote uitdaging is de ontwikkeling van processoren en versnellers die in de EU worden ontworpen en, in voorkomend geval, vervaardigd om te worden gebruikt in cloud- en AI-stacks. Deze grote uitdaging is op haar beurt nauw verbonden met een andere grote uitdaging vermeld in de CADA-verordening, namelijk “het bereiken van autonomie op het gebied van cloud- en AI-stacks, om een einde te maken aan afhankelijkheden op het gebied

³ Zie artikel 4 van de verordening cloud- en AI-ontwikkeling.

van kritieke technologieën”⁴. Deze grote uitdaging kan met name worden aangepakt met oplossingen die door toekomstige start-ups worden ontwikkeld, alsook door het gebruik van overheidsopdrachten voor innovatie. Ook hier worden de O&I-activiteiten nauw op elkaar afgestemd om deze twee complementaire uitdagingen aan te pakken, onder meer door eventuele gecoördineerde oproepen tot het indienen van voorstellen.

Een derde mogelijke grote uitdaging heeft betrekking op “fysieke AI”, namelijk om de levering van de basistechnologieën mogelijk te maken die nodig zijn om een breed scala aan toekomstige toepassingen, diensten en autonome systemen mogelijk te maken, zoals humanoïde en industriële robots en de inzet hiervan, met name op het gebied van medische technologie en gezondheidszorg en op het gebied van productie, lucht- en ruimtevaart en defensie. O&I op het gebied van fysieke AI leidt tegelijkertijd tot vooruitgang op het gebied van reguliere technologieën zoals vermogenshalfgeleiders, microcontrollers en analoge/gemengde signaal- en sensortechnologieën. O&I wordt gevolgd door de industriële productie en commercialisering van ingebedde geavanceerde AI in autonome machines, robots, breedbandnetwerken en verbonden apparaten van de volgende generatie.

Een mogelijke vierde grote uitdaging heeft betrekking op slimme brillen en virtuele werelden. In een mededeling van de Commissie worden de strategie en de voorgestelde acties op het gebied van virtuele werelden en Web 4.0 uiteengezet⁵. In dit verband zijn optica, fotonica en halfgeleidertechnologieën van cruciaal belang voor de ontwikkeling van detectie- en visualisatieapparatuur ter ondersteuning van toepassingen voor virtuele werelden, zoals slimme brillen. Met O&I worden de kwaliteit, prestaties en efficiëntie van de verwerking en communicatie van inhoud voor virtuele werelden aanzienlijk verbeterd. Een grote uitdaging bij het maken van slimme brillen betreft de integratie van relevante componenten met een ultralaag vermogen, zoals vermogenselektronica, sensoren, camera’s, audioapparaten, lasers, speciale glazen, beeldschermen en neuromorfische of AI-chips in werkende prototypes en demonstratiemodellen.

Grote uitdagingen kunnen ook betrekking hebben op marktdoelstellingen, bijvoorbeeld de productie van tape-outs van chips door 100 fabriekloze start-ups, waaronder tien eenhoorns tegen 2035. Een ander soort grote uitdagingen kan betrekking hebben op leidende markten en het stimuleren van de vraag, bijvoorbeeld door hardwareplatforms voor de automobielsector of de volledige “stack” voor AI-(giga)fabrieken te ontwikkelen. Grote uitdagingen kunnen ook betrekking hebben op nieuwe technologieën die gebruikt worden bij de productie van halfgeleiders, bijvoorbeeld voor het verhogen van de recycling en het bevorderen van de circulariteit van materialen, of op de ontwikkeling van geavanceerde koeltechnologieën voor halfgeleiders.

De industrialisering van nieuwe technologieën is een essentieel aspect van de grote uitdagingen.

⁴ Zie artikel 5 van de verordening cloud- en AI-ontwikkeling.

⁵ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Een EU-initiatief voor Web 4.0 en virtuele werelden: een voorsprong bij de volgende technologische transitie” (COM(2023) 442 final van 11 juli 2023).

BIJLAGE II Prioritaire gebieden voor strategische projecten

*Technische beschrijving van potentiële prioritaire gebieden voor strategische projecten:
reikwijdte van de acties*

1. Europese fabricage van geavanceerde halfgeleiders⁶

Er moeten bij de ontwikkeling van het ecosysteem voor geavanceerde technologie van de EU versterkte maatregelen worden genomen om een duurzame vraag naar geavanceerde halfgeleiders te creëren. De soevereiniteit en voorzieningszekerheid van de EU bij de productie van geavanceerde chips en op het gebied van innovatie zijn van essentieel belang om een bloeiend en concurrerend ecosysteem voor halfgeleiders in de EU te bevorderen, dat minder afhankelijk is van buitenlandse toeleveringsketens. Dit is met name belangrijk om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar AI- en cloudinfrastructuur. Daarnaast zijn geavanceerde chips onmisbaar voor strategische industriële sectoren zoals defensie, gezondheid, ruimtevaart, robotica, gezondheidszorg, beveiligde communicatie, drones en autonome voertuigen. Zij vormen ook kritieke input voor opkomende en hoogwaardige gebieden zoals fotonica en kwantumchips.

Dit strategische project heeft tot doel een halfgeleiderfabriek in de EU op te zetten die de productie van geavanceerde node-chips combineert met minichip-integratie en 2,5D/3D-behuizingen. Het bouwt voort op solide onderzoeksresultaten die overeenkomstig de chipverordening zijn gevalideerd in het kader van het initiatief Chips voor Europa. De fabricagefaciliteit neemt Europese waarden in acht, met inbegrip van garanties voor de vertrouwelijkheid, integriteit en traceerbaarheid van chips, met name voor gevoelige en strategische toepassingen en infrastructuur. Europese bedrijven kunnen helpen om vraag te creëren door stimulansen te bieden ter bevordering van fabriekloze chips en AI-gestuurd systeemontwerp. De publieke en particuliere investeringen worden geraamd op 20 tot 40 miljard EUR, afhankelijk van de gekozen optie. Er kan 3 tot 4 miljard EUR aan publieke en particuliere investeringen worden gemobiliseerd om de groei van fabriekloze chipontwerpbedrijven in de hele EU te bevorderen met financiering uit het volgende MFK, van de lidstaten en van relevante industrieën en particuliere investeerders.

Dit project, dat moet worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met binnenlandse en internationale belanghebbenden, waaronder vakkundige partners op het gebied van technologie en productie, maakt het mogelijk geavanceerde capaciteiten te creëren die de structurele afhankelijkheid van leveranciers van buiten de EU verminderen, de voorzieningszekerheid voor sectoren zoals AI, defensie, ruimtevaart, gezondheidszorg, telecommunicatie en de automobielsector vergroten en de technologische soevereiniteit van de EU versterken.

Als eerste stap kan een informele oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden gedaan. Na een analyse van de ingediende voorstellen kan hierna een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan.

2. AI-chips en -systemen voor computinginfrastructuur in de EU

De Unie is momenteel afhankelijk van buitenlandse AI-chips en geïntegreerde systemen, wat leidt tot een aanzienlijke uitstroom van kapitaal om kritieke buitenlandse AI-technologieën in

⁶ In dit deel wordt ingegaan op de mogelijke uitvoering van artikel 19.

te voeren. Om de technologische soevereiniteit van de Unie te versterken, moet daarom concurrerende, binnenlandse capaciteit worden opgebouwd op het niveau van losse chips en de hele stack.

Dit strategische project heeft tot doel AI-chips en computingsystemen te ontwerpen en te ontwikkelen, inclusief prototypes en tape-outs, op basis van geavanceerde Europese technologieën. Het ontwerp van AI-chips moet leiden tot de ontwikkeling van demonstratiemodellen en prototypen die in een gemeenschappelijke proeftuin kunnen worden beoordeeld aan de hand van duidelijke benchmarks. Er worden full-rack-AI-systeemprototypes ontwikkeld, met inbegrip van AI-versnellers, geheugen met hoge bandbreedte, borden, netwerkcapaciteit met zeer lage latentie en een full-software stack, en deze worden geleverd voor vergelijkende evaluatie op basis van een overeengekomen werkbelasting. Prototypes van systemen op achtergrondniveau moeten in een gemeenschappelijke EU-proeftuin worden gedemonstreerd. Bij de definitieve tests en de bepaling van de scores worden duidelijke KPI's gebruikt voor gemeenschappelijke EU-proeftuinen die door een neutrale faciliteit worden beheerd.

Dit strategische project moet de afhankelijkheid van leveranciers van buiten de EU verminderen en de technologische soevereiniteit in de volledige AI-stack vergroten. Het versterkt het ecosysteem van de EU voor wat betreft het ontwerp, de integratie en de optimalisering van hoogwaardige AI-systemen. Daarbij worden de O&O-activiteiten, gegevensverwerking en tests in de Unie uitgevoerd, waardoor de vaardigheden, knowhow en toeleveringsketens in Europa worden verankerd. Een toenemend gebruik van AI-systemen zal zorgen voor meer vraag, die verdere investeringen in de productie in Europa rechtvaardigt.

Als eerste stap kan een informele oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden gedaan. Na een analyse van de ingediende voorstellen kan hierna een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan.

3. Applicatieprocessor voor zelfrijdende auto's

De automobielsector ondergaat momenteel een cruciale transformatie, voornamelijk als gevolg van de opkomst van elektrische, verbonden, autonome voertuigen. Deze omslag vereist een meer gecentraliseerde, geïntegreerde en flexibele elektrische/elektronische (E/E) architectuur om tegemoet te komen aan de geavanceerde computingbehoeften van autonome rijsystemen, naadloze voertuigconnectiviteit te waarborgen, het energiebeheer van elektrische voertuigen (EV) te ondersteunen en nieuwe mobiliteitsdiensten mogelijk te maken. Momenteel zijn Europese OEM's voor de automobielsector afhankelijk van niet-Europese leveranciers voor de applicatieprocessoren die autonoom rijden mogelijk maken, wat leidt tot afhankelijkheden, mogelijke kwetsbaarheden die kunnen worden uitgebuit en potentiële veiligheidsrisico's.

Dit strategische project heeft tot doel hoogwaardige, op RISC-V gebaseerde applicatieprocessoren voor de automobielsector te ontwerpen en te ontwikkelen, inclusief prototypes en tape-outs. Deze processoren omvatten geavanceerde computerarchitectuurtechnieken, multikernconfiguraties en ondersteuning voor geheugeninterfaces met hoge bandbreedte, rekening houdend met de complexe computingbehoeften van autonome rijsystemen. Daarnaast worden er AI- en ML-versnellers ontwikkeld met gespecialiseerde extensies van de instructiesetarchitectuur (ISA) voor efficiënte data-intensieve berekeningen. Deze versnellers worden geoptimaliseerd voor toepassingen in de automobielsector, ter ondersteuning van geavanceerde AI-modellen, waarbij de nadruk ligt op energie-efficiëntie, verminderde latentietijd en

realtimeverwerkingscapaciteiten. Het eindresultaat is een siliciumtape-out van industriële kwaliteit, met een concurrerende RISC-V-applicatieprocessor naast geheugen, versnellers en andere relevante intellectuele eigendom, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde verpakkingstechnieken. De ontwikkeling van de hardware gaat vergezeld van een direct inzetbare toolset. Automobielfabrikanten kunnen de resultaten in een operationele omgeving gebruiken als gekwalificeerde apparatuur.

Het strategische project draagt bij aan de technologische soevereiniteit van Europa op het gebied van AI-processoren en -versnellers voor de automobielsector. Het vermindert de afhankelijkheid van Europese OEM's in de automobielsector van buitenlandse leveranciers. Een toenemend gebruik van applicatieprocessoren en versnellers zal zorgen voor meer vraag, die verdere investeringen in de productie in Europa rechtvaardigt.

Als eerste stap kan een informele oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden gedaan. Na een analyse van de ingediende voorstellen kan hierna een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan.

4. Europese geheugenfabricagefaciliteit

Geheugenchips, zoals DRAM, NAND en nieuwe niet-vluchtige geheugentypes, zijn essentiële componenten in datacentra, AI-systemen, auto-elektronica, telecommunicatieapparatuur, industriële automatisering en defensietoepassingen. Momenteel is de mondiale geheugenmarkt sterk geconcentreerd in Azië (Zuid-Korea, Taiwan, China) en de Verenigde Staten. De EU heeft geen eigen productiecapaciteit voor geheugen, waardoor kritieke Europese toeleveringsketens zeer kwetsbaar zijn voor geopolitieke schokken, handelsgeschillen en natuurrampen. Deze afhankelijkheid is in 2026 pijnlijk duidelijk geworden, aangezien de stijgende vraag naar AI-gerelateerd geheugen met hoge bandbreedte (HBM) fabrikanten ertoe heeft aangezet hun productiecapaciteit minder in te zetten voor standaard DRAM- en NAND-geheugenchips, wat heeft geleid tot prijsstijgingen in sommige segmenten en ernstige leveringstekorten voor de Europese industrie. Het ontbreken van een Europese geheugenfabriek vormt dan ook een strategische kwetsbaarheid wanneer het gaat om de digitale soevereiniteit, economische veerkracht en defensiegereedheid van de EU. Een strategisch project voor een Europese geheugenfabriek is niet alleen nodig om de voorziening voor belangrijke industrieën veilig te stellen, maar ook om geavanceerde knowhow op productiegebied te verankeren, innovatie in de hele waardeketen voor halfgeleiders te stimuleren en de bredere beleidsdoelstellingen van de EU inzake industriële, digitale en economische veiligheid te ondersteunen.

Het strategische project voor de oprichting van een Europese faciliteit voor geheugenfabricage vereist een op consortia gebaseerde aanpak, waarbij overheidsfinanciering van de EU en de deelnemende lidstaten wordt gecombineerd met aanzienlijke particuliere investeringen, die gezien de kapitaalintensiteit van moderne geheugenfabrieken waarschijnlijk tussen de 15 en 30 miljard EUR zullen bedragen. Overwogen kan worden een gezamenlijke onderneming onder Europese leiding op te zetten om een onderscheidende positie op te bouwen, bijvoorbeeld op het gebied van ingebed geheugen, energiezuinig geheugen of opkomende technologieën in verband met AI en edgecomputing. Gekozen kan worden voor een gefaseerde aanpak die begint met een proeflijn/O&O-lijn alvorens stapsgewijs op te schalen naar productie in grote hoeveelheden, waardoor de risico's worden beperkt en geleidelijk capaciteit wordt opgebouwd.

Er kan een specifieke oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden georganiseerd om industriële partners, technologieleveranciers en lidstaten te identificeren die bereid zijn zich voor dit strategische initiatief in te zetten.

5. Geavanceerd chipontwerp

Hoewel de bouw van fysieke fabricagefaciliteiten van vitaal belang is, schuilt een groot deel van de economische waarde, winstmarges en technologische controle in de toeleveringsketen voor halfgeleiders in het ontwerp, de architectuur en de intellectuele eigendom van chips. Europa heeft belangrijke sterke punten op het gebied van onderzoek, halfgeleiders voor de automobielsector en halfgeleiderapparatuur; zij is echter nog relatief zwak in het grootschalige ontwerp van de meest geavanceerde logische chips, met name die welke gebaseerd zijn op geavanceerde architecturen en procesnodes. Als gevolg daarvan is de EU sterk afhankelijk van niet-Europese bedrijven voor geavanceerde reken- en AI-capaciteit. Zonder eigen geavanceerde ontwerpcapaciteit dreigt Europa afhankelijk te blijven van buitenlandse architecturen, waardoor kritieke infrastructuur, defensie en AI-gerelateerde industrieën blootstaan aan geopolitieke beperkingen en afhankelijk zijn van bepaalde leveranciers, soms zelfs geheel van één enkele leverancier. Versterking van de capaciteit voor het ontwerpen van chips zou de EU niet alleen in staat stellen meer waarde binnen de waardeketen voor halfgeleiders te genereren, maar ook om Europese prioriteiten zoals veiligheid, privacy, weerbaarheid en energie-efficiëntie rechtstreeks in geavanceerde hardware te integreren.

Een strategisch project voor geavanceerd chipontwerp heeft tot doel binnen de EU soevereine capaciteit van wereldklasse voor het ontwerp van geavanceerde logische chips tot stand te brengen, waarbij de nadruk ligt op intellectuele eigendom, architectuur en verificatie in plaats van op productie. De aandachtsgebieden hierbij zijn onder meer:

- geavanceerde AI-versnellers voor cloud-, edge- en industriële toepassingen (onder meer voor geospatiale modellering en digitale tweelingen);
- krachtige processoren voor supercomputers en datacentra;
- “secure-by-design”-chips voor kritieke infrastructuur, defensie, luchtvaart en ruimtevaart;
- domeinspecifieke processoren voor autonome voertuigen, robotica en industriële automatisering;
- toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC’s) en “system-on-chips” (SoC’s) voor 5G/6G;
- op RISC-V-gebaseerde open-architectuurprocessoren voor geavanceerde nodes;
- geavanceerde minichip-platforms voor 2,5D/3D-integratie in automobiel-, lucht- en ruimtevaart- en telecommtoepassingen.

De uitvoering kan de vorm aannemen van een grootschalig publiek-privaat partnerschap waarvoor 8-12 miljard EUR aan gecombineerde financiering van de EU, de lidstaten en de particuliere sector wordt aangetrokken, gestructureerd rond consortia van fabriekloze halfgeleiderbedrijven, en waarbij ontwerpbedrijven van ASIC’s, leveranciers van elektronische ontwerpautomatiseringsinstrumenten, aanbieders van intellectuele eigendom, onderzoeksinstellingen en eindgebruikerssectoren (OEM’s uit de automobielsector en de luchtvaart, telecombedrijven, leidende defensiebedrijven) betrokken zijn. De investeringen zijn bestemd voor chiparchitectuur en ontwerpteam, geavanceerde ontwerpinstrumenten en

IE-bibliotheken, de ontwikkeling van prototypes, verificatie, softwarestacks en industrialisering. Het project moet gegarandeerde toegang hebben tot geavanceerde fabricage door middel van partnerschappen met toonaangevende gieterijen of Europese proeflijnen voor chips van 2 nm en kleiner. Op basis van een gefaseerde aanpak kan worden begonnen met het in kaart brengen van de capaciteiten en het selecteren van de beoogde toepassingen, gevolgd door ontwerp- en valideringsprogramma's, proeven met tape-outs, de ontwikkeling van ecosystemen en de commerciële uitrol, naast specifieke maatregelen om talent te ontwikkelen en technische expertise van wereldklasse aan te trekken.

Op grond van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling kunnen industriële consortia worden uitgenodigd voorstellen in te dienen voor baanbrekende projecten op het gebied van chipontwerp met een duidelijk strategisch belang, waarbij aanvragers wordt verzocht het beoogde toepassingsdomein, de verwachte technologische differentiatie, de vereiste investeringen, de toegang tot ontwerp- en productie-infrastructuur, het tijdschema voor de ontwikkeling van prototypes en de commercialisering, en de bijdrage aan de veerkracht en het concurrentievermogen van Europa te specificeren.

6. Versterking van essentiële segmenten van de waardeketen

De Unie heeft te maken met verschillende kwetsbaarheden in de waardeketen voor halfgeleiders. Veel van deze kwetsbaarheden zijn algemeen bekend, waaronder de bovengenoemde kwetsbaarheden, terwijl andere minder evident zijn en/of als minder kritiek worden beschouwd. Deze laatste kwetsbaarheden kunnen aan het licht komen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, waardoor de volledige gevolgen ervan duidelijk worden en afhankelijkheden worden blootgelegd, zoals is gebleken in de zaak Nexperia (zie het werkdocument van de diensten van de Commissie).

Het zal voor de Unie niet haalbaar of praktisch zijn om alle mogelijke kwetsbaarheden in de waardeketen voor halfgeleiders aan te pakken. Het kan voor de Unie echter wenselijk zijn om bepaalde kwetsbaarheden te verminderen en belangrijke segmenten van de waardeketen te versterken, met name wanneer verstoringen daarvan het bestaan van afhankelijkheden hebben aangetoond of wanneer dergelijke verstoringen zich waarschijnlijk zullen voordoen.

Dit soort strategische projecten heeft tot doel een specifiek essentieel segment van de waardeketen voor halfgeleiders te versterken. Deze ingrepen beperken zich niet tot de meest geavanceerde delen van de waardeketen en kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de productie van reguliere chips, back-endprocessen, de assemblage van printplaten (Printed Circuit Boards, PCB's) en op materialen en apparatuur. Een voorbeeld van een mogelijk strategisch project is de oprichting van een OSAT-faciliteit⁷ die voornamelijk bestemd zou zijn voor Europese verwerkende industrieën. Een ander voorbeeld is het opzetten van een geavanceerde verpakkingsfaciliteit die een aanvulling kan vormen op (nieuwe) front-endfabrieken. De belangrijkste deelnemers aan strategische projecten zijn ondernemingen die hun hoofdkantoor in de Unie hebben; de voornaamste investeringen vinden doorgaans, hoewel niet per se altijd, plaats in de Unie.

Met dit soort strategische projecten worden vermoedelijke en bewezen kwetsbaarheden in de waardeketen voor halfgeleiders aangepakt. Het gebruik van gerichte acties om essentiële segmenten van de waardeketen te versterken, vergroot de technologische soevereiniteit van Europa en vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse actoren.

⁷ OSAT's (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) zijn derde dienstverleners die gespecialiseerd zijn in de laatste, kritieke fasen van de fabricage van chips, d.w.z. het verpakken van de halfgeleider-die en het testen ervan op functionaliteit voordat deze de klant bereikt.

De Europese Raad voor halfgeleiders speelt een sleutelrol bij het selecteren van de gebieden van de waardeketen waar versterking nodig is. Als volgende stap kan een informele oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden gedaan. Na een analyse van de ingediende voorstellen kan hierna een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan.

BIJLAGE III Meetbare indicatoren voor monitoring van de uitvoering en verslaglegging over de voortgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen in het kader van deze verordening

De Commissie is verantwoordelijk voor de regelmatige monitoring van de uitvoering van deze verordening, eventueel met behulp van externe studies, gegevens van de lidstaten en marktgegevens. De Commissie voert een uitgebreide evaluatie uit van de doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, evenredigheid en subsidiariteit van deze verordening. Overeenkomstig artikel 60 van deze verordening wordt bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een **evaluatieverslag** met de belangrijkste bevindingen ingediend. In voorkomend geval kan de Commissie dit verslag vergezeld doen gaan van voorstellen ter verbetering of aanpassing van deze verordening.

De Commissie houdt, in nauwe samenwerking met de lidstaten, regelmatig toezicht op de uitvoering en toepassing van de wettelijke bepalingen, met bijzondere aandacht voor de doeltreffendheid van de vastgestelde maatregelen. Voor de monitoringactiviteiten worden kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren gebruikt, die worden gemeten aan de hand van gegevens die worden verstrekt door belanghebbenden in de hele waardeketen voor halfgeleiders, de lidstaten en relevante organen van de Unie.

De meetbare indicatoren zijn afgeleid van de twee algemene doelstellingen van deze verordening.

Algemene indicatoren voor de monitoring:

- de totale instroom van aan halfgeleiders gerelateerde BDI in de Unie;
- geschoolde arbeidskrachten op het gebied van halfgeleiders en fotonica, met inbegrip van arbeidskrachten die zijn opgeleid/omgeschoold via initiatieven van de nationale kenniscentra voor chips;
- overheidssteun voor start-ups en scale-ups; en
- financiering voor opschaling via particulier eigen vermogen en durfkapitaal.

Specifieke indicatoren voor de monitoring:

Eerste specifieke monitoringindicatoren inzake de verbetering van de capaciteit, de voorzieningszekerheid en het concurrentievermogen van de halfgeleiderindustrie van de EU in de hele waardeketen, onder meer voor geavanceerde AI-chips:

- aandeel van de Unie in de mondiale waarde van halfgeleiders (in EUR) in de verschillende segmenten van de waardeketen:
 - ontwerp, intellectuele eigendom, EDA;
 - fabricage van halfgeleiders;
 - fabricage van apparatuur;
 - OSAT (verpakking);
 - materialen/gassen;
- belangrijkste ondernemingen in de Unie in elk segment van de waardeketen;

- geïnstalleerde capaciteit voor de fabricage van wafers in de Unie (wafers per maand, wpm).

Tweede specifieke monitoringindicator inzake de ontwikkeling van een sterke gebruikersmarkt in belangrijke industriële sectoren: gebruik van chips door belangrijke sectoren (automobielsector, energie, gezondheid, defensie, telecommunicatie, AI/datacentra/cloud) naar waarde (EUR).

Derde specifieke monitoringindicator inzake het verbeteren van de capaciteit voor het verzamelen van inlichtingen met het oog op crisisparaatheid en -respons: deel van de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie (in %) dat wordt gemonitord door het Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform.

BIJLAGE IV Synergieën van deze verordening met andere programma's

- (1) Synergieën van het initiatief Chips voor Europa 2.0 met de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 van het **programma Digitaal Europa** waarborgen het volgende:
 - (a) de beoogde thematische focus van het initiatief Chips voor Europa 2.0 op halfgeleider- en kwantumtechnologieën is complementair;
 - (b) de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 van het programma Digitaal Europa ondersteunen de opbouw van digitale capaciteit op het gebied van geavanceerde digitale technologieën, waaronder high-performance computing, artificiële intelligentie en cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden;
 - (c) het initiatief Chips voor Europa 2.0 zal investeren in capaciteitsopbouw voor de versterking van capaciteiten op het gebied van geavanceerd ontwerp, productie en systeemintegratie in ultramoderne halfgeleidertechnologieën, halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie en ultramoderne kwantumtechnologieën met het oog op innovatieve bedrijfsontwikkeling, voor de versterking van de toeleverings- en waardeketens van halfgeleiders van de Unie, de toelevering in industriële sleutelsectoren en de uitbouw van nieuwe markten.
- (2) Synergieën met **Horizon Europa** waarborgen het volgende:
 - (a) hoewel de thematische gebieden van het initiatief Chips voor Europa 2.0 samenvallen met verschillende gebieden van Horizon Europa, zijn het soort te ondersteunen acties, de verwachte resultaten en de interventielogica ervan verschillend en complementair;
 - (b) Horizon Europa biedt uitgebreide steun aan onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratie, proefprojecten, haalbaarheidsstudies, tests en prototyping, met inbegrip van de precommerciële uitrol van innovatieve digitale technologieën, met name via:
 - i) een specifiek budget in de pijler “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen” voor de cluster “Digitaal, industrie en ruimtevaart” voor de ontwikkeling van ontsluitende technologieën (artificiële intelligentie en robotica, internet van de volgende generatie, high performance computing en big data, digitale sleuteltechnologieën (waaronder micro-elektronica), waarbij digitale met andere technologieën worden gecombineerd);
 - ii) ondersteuning voor onderzoeksinfrastructuren binnen de pijler “Wetenschappelijke excellentie”;
 - iii) de integratie van digitaal beleid in alle wereldwijde uitdagingen (gezondheid, veiligheid, energie en mobiliteit, klimaat enz.); en
 - iv) ondersteuning voor de schaalvergroting van baanbrekende innovaties binnen de pijler “Innovatief Europa” (waarbij in veel gevallen digitale en andere technologieën worden gecombineerd);
 - (c) het initiatief Chips voor Europa 2.0 is uitsluitend gericht op het opbouwen van grootschalige capaciteiten op het gebied van halfgeleider- en kwantumtechnologieën in de hele Unie. Het zal investeren in:

- i) de bevordering van innovatie door ondersteuning van twee nauw met elkaar verbonden technologische capaciteiten die het ontwerpen van nieuwe systeemconcepten en het testen en valideren ervan in proeflijnen faciliteren;
 - ii) verlening van gerichte steun voor het opbouwen van opleidingscapaciteit en het verbeteren van toegepaste geavanceerde digitale kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van halfgeleiders door technologische ontwikkeling en eindgebruikers; en
 - iii) een netwerk van nationale kenniscentra, die de toegang tot en het verstrekken van expertise en innovatiediensten aan eindgebruikersgemeenschappen en -industrieën faciliteren om nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen en marktfalen aan te pakken.
 - (d) de technologiecapaciteiten van het initiatief Chips voor Europa 2.0 zullen ter beschikking worden gesteld van de onderzoeks- en innovatiegemeenschap, onder meer voor door Horizon Europa ondersteunde acties;
 - (e) naarmate de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën op het gebied van halfgeleiders via Horizon Europa tot rijping komt, zullen deze indien mogelijk geleidelijk zullen worden ingevoerd en uitgerold in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0;
 - (f) de in het kader van Verordening (EU) 2021/695 opgezette Horizon Europa-programma's voor de ontwikkeling van curricula van vaardigheden en competenties, met inbegrip van curricula die worden verstrekt in de co-locatiecentra van de kennis- en innovatiegemeenschappen van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, worden aangevuld door capaciteitsopbouw in door het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunde geavanceerde toegepaste digitale vaardigheden en kwantumtechnologieën;
 - (g) er worden sterke coördinatiemechanismen voor de programmering en uitvoering ingevoerd, waarmee alle procedures voor Horizon Europa en het initiatief Chips voor Europa 2.0 zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Bij de beheersstructuren worden alle bevoegde diensten van de Commissie betrokken.
- (3) Synergieën met de voorgestelde **verordening inzake cloud- en AI-ontwikkeling (CADA)** dragen bij tot een coherente aanpak om de technologische soevereiniteit van de Unie te versterken, door zowel het aanbod van als de vraag naar geavanceerde halfgeleidertechnologieën te bevorderen, met name door:
- (a) de vraag naar halfgeleiders als gevolg van cloud- en AI-ontwikkeling te stimuleren: deze verordening ondersteunt het vermogen van de Unie om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige en energie-efficiënte halfgeleiders die wordt gegenereerd door de uitbreiding van cloud- en AI-infrastructuur, waaronder datacentra en grootschalige computerfaciliteiten;
 - (b) de uitrol van AI-fabrieken en AI-gigafabrieken te ondersteunen: deze verordening ondersteunt de beschikbaarheid van geavanceerde en gespecialiseerde halfgeleiders die nodig zijn voor toepassingen op het gebied van high-performance computing en artificiële intelligentie, waardoor de uitrol en opschaling van AI-fabrieken en AI-gigafabrieken in de Unie mogelijk wordt gemaakt en wordt bijgedragen tot de ontwikkeling van AI op industriële schaal en wetenschappelijke capaciteiten;

- (c) veilige en veerkrachtige digitale infrastructuur te ondersteunen: deze verordening helpt om de beschikbaarheid van componenten te waarborgen die nodig zijn voor de ontwikkeling van betrouwbare en soevereine cloud- en AI-omgevingen voor kritieke gebruiksmogelijkheden die nodig zijn om het gebruik van veilige en betrouwbare hardwarecomponenten te vergroten, door de veerkracht en beveiliging van waardeketens voor halfgeleiders te versterken;
 - (d) de uitrol van digitale infrastructuur op basis van de technologische capaciteiten van de Unie te ondersteunen ter vermindering van externe afhankelijkheden;
 - (e) bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor de uitrol van digitale infrastructuur: deze verordening ondersteunt de ontwikkeling en productie van hulpbronnenefficiënte en energie-efficiënte halfgeleiders met het oog op de toenemende uitrol van datacentra en cloudinfrastructuur, die naar verwachting de vraag naar energie-efficiënte digitale technologieën zal doen toenemen;
- (4) Synergieën met programma's van de Unie onder gedeeld beheer, waaronder **het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur**, garanderen de ontwikkeling en versterking van regionale en lokale ecosystemen voor innovatie, industriële transformatie en de digitale transformatie van de samenleving en van overheidsdiensten. Daartoe behoren de ondersteuning van de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de toepassing van resultaten alsmede de uitrol van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 zal zorgen voor aanvulling op en ondersteuning van transnationale netwerken en de inventarisering van capaciteiten. Daardoor zullen deze toegankelijk worden voor kmo's en eindgebruikers in alle regio's van de Unie.
- (5) Synergieën met de **Connecting Europe Facility** waarborgen het volgende:
- (a) het initiatief Chips voor Europa 2.0 is gericht op grootschalige opbouw van digitale capaciteiten en infrastructuur op het gebied van halfgeleiders en beoogt een brede invoering en uitrol in de hele Unie van kritieke bestaande of geteste innovatieve digitale oplossingen binnen het kader van de Unie op gebieden van algemeen belang of bij marktfalen. Het initiatief Chips voor Europa 2.0 moet voornamelijk worden uitgevoerd via gecoördineerde en strategische investeringen met de lidstaten, in de opbouw van digitale capaciteiten op het gebied van halfgeleidertechnologieën die in de hele Unie en in Uniebrede acties moeten worden gedeeld. Dit is met name van belang voor elektrificatie en zelfrijdende vervoermiddelen en is bedoeld om de ontwikkeling van meer concurrerende eindgebruikerssectoren ten goede te komen en te faciliteren, met name in de sectoren mobiliteit en vervoer;
 - (b) de capaciteiten en infrastructuren van het initiatief Chips voor Europa 2.0 worden beschikbaar gesteld voor het testen van innovatieve nieuwe technologieën en oplossingen die in de sectoren mobiliteit en vervoer kunnen worden toegepast. De Connecting Europe Facility moet de uitrol en invoering van innovatieve nieuwe technologieën en oplossingen op het gebied van mobiliteit en vervoer en op andere gebieden ondersteunen;
 - (c) er worden coördinatiemechanismen opgezet, met name door middel van passende beheersstructuren.

- (6) Synergieën met het **InvestEU-programma** waarborgen het volgende:
- (a) in het kader van Verordening (EU) 2021/523 wordt steun verleend via marktgebaseerde financiering, onder meer met het oog op de beleidsdoelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0; dergelijke marktgebaseerde financiering kan worden gecombineerd met de ondersteuning door middel van subsidies;
 - (b) een blendingfaciliteit in het kader van het InvestEU-fonds wordt ondersteund met financiering die wordt verstrekt uit Horizon Europa of het programma Digitaal Europa in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen.
- (7) Synergieën met **Erasmus+** waarborgen het volgende:
- (a) het initiatief Chips voor Europa 2.0 ondersteunt de ontwikkeling en verwerving van geavanceerde digitale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde halfgeleidertechnologieën in samenwerking met relevante bedrijfstakken;
 - (b) het gedeelte van Erasmus+ dat betrekking heeft op geavanceerde vaardigheden, vormt een aanvulling op de acties van het initiatief Chips voor Europa 2.0 die gericht zijn op de verwerving van vaardigheden op alle gebieden en op alle niveaus, door middel van mobiliteitservaringen.
- (8) Synergieën met andere **programma's en initiatieven van de Unie inzake competenties en vaardigheden** worden gewaarborgd.
- (9) Synergieën met de **wetgeving van de Unie inzake cyberbeveiliging** waarborgen het volgende:
- (a) investeringen die in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0 worden ondersteund, dragen bij tot versterking van de veiligheid en veerkracht van de toeleveringsketens voor halfgeleiders in de Unie;
 - (b) het initiatief Chips voor Europa 2.0 vormt een aanvulling op de doelstellingen van de verordening cyberweerbaarheid en de EU-cyberbeveiligingsverordening door de ontwikkeling en uitrol van betrouwbare halfgeleidertechnologieën te ondersteunen;
 - (c) er wordt gezorgd voor coördinatie met de uitvoering van Richtlijn (EU) 2022/2555 (richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging, NIS2), waarbij in voorkomend geval ook het gebruik van betrouwbare chips in kritieke sectoren wordt bevorderd.
- (10) Synergieën met **belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's) en de relevante staatssteunkaders** waarborgen het volgende:
- (a) acties die in het kader van het initiatief Chips voor Europa 2.0 worden ondersteund, zijn in overeenstemming met de bestaande staatssteun- en mededingingsregels, met inbegrip van het O&O&I-kader en de IPCEI-mededeling;
 - (b) IPCEI's, waaronder de IPCEI-kandidaat voor geavanceerde halfgeleidertechnologieën (AST), kunnen helpen een koppeling te leggen tussen onderzoeks- en innovatieactiviteiten en de ontwikkeling van industriële uitrol- en productiecapaciteit, en zo een aanvulling vormen op de doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0;

- (c) het initiatief Chips voor Europa 2.0 biedt oplossingen voor eventuele verdere tekorten aan investeringen ter ondersteuning van fabricagefaciliteiten met pionierstechnologie voor halfgeleiders en de daarmee verband houdende technologische capaciteiten.
- (11) Synergieën met **nationale halfgeleiderstrategieën, routekaarten en investeringsplannen** waarborgen het volgende:
- (a) de nationale halfgeleiderstrategieën en investeringsplannen van de lidstaten zijn afgestemd op de doelstellingen van het initiatief Chips voor Europa 2.0;
 - (b) nationale en Unie-investeringen dragen bij tot de versterking van regionale en landsgrensoverschrijdende halfgeleiderecosystemen in de hele Unie;
 - (c) coördinatiemechanismen ondersteunen de inventarisatie van capaciteiten op het gebied van halfgeleiders en vergemakkelijken de samenwerking tussen de lidstaten om de veerkracht van de waardeketens voor halfgeleiders van de Unie te versterken en onnodige dubbele investeringen te voorkomen.

BIJLAGE V Kritieke sectoren

- (1) Energie
- (2) Vervoer
- (3) Bankwezen
- (4) Financiële marktinfrastructuur
- (5) Volksgezondheid
- (6) Drinkwater
- (7) Afvalwater
- (8) Digitale infrastructuur
- (9) Overheid
- (10) Ruimtevaart
- (11) Productie, verwerking en distributie van levensmiddelen
- (12) Defensie
- (13) Veiligheid

BIJLAGE VI Industriële sectoren die halfgeleiders gebruiken

- (1) Automobiellindustrie
- (2) Datacentra, cloud en AI
- (3) Industriële automatisering en robotica
- (4) Luchtvaart
- (5) Ruimtevaart, defensie en veiligheid
- (6) Infrastructuur voor elektronische communicatie
- (7) Industriële computing en internet der dingen (IoT)
- (8) Gezondheidszorg en medische hulpmiddelen
- (9) Aanbieders en distributeurs van diensten voor de productie van elektronica
- (10) Hernieuwbare en koolstofarme energiesystemen

BIJLAGE VII Concordantietabel

Verordening (EU) 2023/1781	Deze verordening
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3	Artikel 3
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	Artikel 11
Artikel 7	-
Artikel 8	-
Artikel 9	-
Artikel 10	-
Artikel 11	Artikel 6
Artikel 12	Artikel 12
Artikelen 13 t/m 14	Artikel 14
Artikel 15	Artikel 15
Artikel 16	Artikel 13
Artikel 17	-
Artikel 18	Artikel 21
Artikel 19	Artikel 33
Artikel 20	Artikel 35

Artikel 21	Artikel 36
Artikel 22	Artikel 37
Artikel 23	Artikel 39
Artikel 24	Artikel 40
Artikel 25	Artikel 41
Artikel 26	Artikel 42
Artikel 27	Artikel 43
Artikel 28	Artikel 44
Artikel 29	Artikel 45
Artikel 30	Artikel 46
Artikel 31	Artikel 48
Artikel 32	Artikel 50
Artikel 33	Artikel 51
Artikel 34	Artikel 52
Artikel 35	Artikel 53
Artikel 36	Artikel 54
Artikel 37	Artikel 55
Artikel 38	Artikel 56
Artikel 39	-
Artikel 40	Artikel 57
Artikel 41	Artikel 60